

弘塑科技股份有限公司

Grand Process Technology Corporation

一〇九年度 年 報

中 華 民 國 一 一 〇 年 四 月 三 十 日 刊 印

查詢本年報網址：<http://mops.twse.com.tw/>

本 公 司 網 址：<http://www.gptc.com.tw/>

一、本公司發言人及代理發言人

發言人姓名：黃富源
職稱：副總經理
電話：(03)5183030
電子郵件信箱：invest@gptc.com.tw
代理發言人姓名：張鴻泰
職稱：董事長
電話：(03)5183030
電子郵件信箱：invest@gptc.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司及工廠地址：
30095 新竹市香山區中華路六段 89 號 電話：(03)5183030
分公司：無

三、辦理股票過戶機構

名稱：群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
地址：106 台北市大安區敦化南路二段 97 號地下二樓
網址：<https://www.capital.com.tw/>
電話：(02)27023999

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師名稱：方蘇立會計師、鍾鳴遠會計師
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
地址：300 新竹市科學工業園區展業一路 2 號 6 樓
網址：<http://www.deloitte.com.tw/>
電話：(03)5780899

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：不適用。

六、公司網址

<http://www.gptc.com.tw/>

— 目 錄 —

	頁次
壹、致股東報告書	1
貳、公司簡介	3
一、設立日期	3
二、公司沿革	3
參、公司治理報告	5
一、組織系統	5
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	8
三、公司治理運作情形	17
四、會計師公費資訊	33
五、更換會計師資訊	33
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	34
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	34
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	35
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	36
肆、募資情形	37
一、資本及股份	37
二、公司債辦理情形	42
三、特別股辦理情形	42
四、海外存託憑證辦理情形	42
五、員工認股權憑證辦理情形	42
六、限制員工權利新股辦理情形	42
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	42
八、資金運用計畫執行情形	42
伍、營運概況	43
一、業務內容	43
二、市場及產銷概況	64
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	76
四、環保支出資訊	76
五、勞資關係	76
六、重要契約	78
陸、財務概況	79
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表	79

— 目 錄 —

	頁次
二、最近五年度財務分析	83
三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告	88
四、最近年度財務報告，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及附註或附表	88
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告，但不含重要會計項目明細表	88
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，是否有發生財務週轉困難情事	88
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	219
一、財務狀況	219
二、財務績效	219
三、現金流量	220
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	221
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	221
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估	222
七、其他重要事項	225
捌、特別記載事項	226
一、關係企業相關資料	226
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由及自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形及計畫執行進度	226
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形	226
四、其他必要補充說明事項	226
玖、對股東權益或證券價格有重大影響之事項	226
附件一 內部控制制度聲明書	233

壹、致股東報告書

各位股東大家好，感謝各位股東對公司的支持，在百忙之中撥空親臨本公司一一〇年股東常會。

一〇九年度本公司營收成長，獲利亦成長，整體而言繳出不錯的成績單。

在此感謝全體同仁的辛勞及各位股東及董事、監察人的支持與信任，茲就一〇九年度經營結果及一一〇年營運的展望在此做報告。

一、一〇九年度營運報告：

(一) 營運計劃實施成果(合併財務報告)：本公司一〇九年營收淨額為2,487,671 仟元，較一〇八年營收淨額 2,061,387 仟元，年增 20.68%；一〇九年的稅後純益 396,873 仟元，稅後每股盈餘為新台幣 13.92 元，與一〇八年的稅後純益 309,970 仟元及稅後每股盈餘新台幣 11.11 元相比較，純益年增 28.04%，每股盈餘年增 25.29%。

高階半導體封裝產業產能擴張於一〇八年下半年逐漸開始回升，且因國內對新型冠狀病毒(COVID-19)疫情控制得宜，一〇九年度半導體產業需求持續暢旺。本公司藉由集團各公司間資源之整合互補、設備品質的提升、新製程的應用以及新客戶的開發，維持穩定成長的經營績效。

(二) 預算執行情形、財務收支及獲利能力分析：

1. 預算執行情形：本公司未編列一〇九年度財務預測，故不適用。

2. 財務收支及獲利能力分析：請參閱以下簡表及完整財務報告。

單位：新台幣仟元

項 目		年 度	108 年度	109 年度	增(減)比例
財務收支	營業收入		2,061,387	2,487,671	20.68%
	營業毛利		948,697	1,126,320	18.72%
	稅後淨利		309,970	396,873	28.04%
獲利能力 分析	資產報酬率(%)		6.96	7.76	11.64%
	股東權益報酬率(%)		12.96	14.04	8.33%
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	141.98	182.48	28.53%
		稅前純益	138.30	174.57	26.23%
	純益率(%)		15.04	15.95	6.10%
	每股盈餘 (元)		11.11	13.92	25.29%

(三) 一〇九年度研發成果如下：

1. 垂直浸泡槽與單晶圓旋轉噴洗之可調式傳送機構。
2. 單晶圓旋轉設備搭配複數個抽氣系統。
3. 全自動電鍍銅設備之軟體開發。
4. IC 製造金屬導線銅蝕刻拋光液開發。
5. 半導體及電子級臭氧濃度計之開發與驗證。
6. EDA 工程數據分析軟體套件-人工智能預測功能模組。

二、一一〇年營運計劃概述：

(一) 經營方針：

1. 銷售計劃：

- (1) 加強與既有國內客戶之配合，並積極開發海外客戶訂單。
- (2) 運用兩岸各服務據點，提供即時售後支援，提昇客戶滿意度。

- (3) 整合既有的產業優勢與供應商，以現有的行銷網路為基礎，強化行銷，提供客戶更完整的服務，為企業創造更多的營收與價值。
- (4) 加強與客戶的互動，隨時掌握客戶產品開發的最新資訊，配合進行相關製程的 DESIGN IN，加快產品之研發、產製速度，創造雙贏的合作模式。
- (5) 以新技術、新製程的應用，開發新領域的客戶。
- (6) 與目前投資、結盟之公司及弘塑集團子公司，透過整合雙方公司/集團關係企業資源，結合彼此技術資源，提升營運效益，以因應未來產業變化，提升競爭優勢。
- (7) 積極尋求國外先進與技術領先的同質性公司進行策略聯盟。

2.生產計劃：

- (1) 與客戶共同開發新製程機台、化學品及關鍵零組件等，朝向產品多元化發展。並且為確保研發成果符合客戶及市場需求，採取與客戶就新產品或製程依客戶需求共同開發。與目前結盟之公司，整合雙方專業，強化研發及技術能力，提升產品競爭力。
- (2) 在與國內許多客戶合作上，皆能於有限時間達交並提供製程解決方案，持續於國內自動化濕式製程設備佔有領先地位。
- (3) 產品交期與售後服務：產品交期與開案速度是能跟客戶緊密合作的關鍵優勢，因應電子產業交期短、良率高之行業特性，能否提供如期、如質之設備乃成為客戶於選擇設備供應商之最重要因素之一。本公司自成立後即投入濕製程設備之研發，為國內最早投入該產品領域之公司，在歷經多年之研究開發工作後，已累積厚實之自有技術專利，加上提供即時且彈性之售後支援服務團隊，可確保滿足客戶所需。

3.產品競爭力：比較美、日等國之國際大廠之產品，本公司生產之產品，已具有品質及價格競爭優勢，並取得業界領導廠商之認可及購置。

(二)預期銷售數量及其依據：

- 1.因本公司未編列一一〇年度財務預測，故不予以預測營業額。整體而言係依據產業環境、客戶產品與產能需求、市場供需、競爭狀況而定。
- 2.持續關注新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，與集團各子公司、各供應商充分合作，妥善完成已接單客戶交機時程，並持續留意半導體市場資本支出動態，期將影響降至最低。

(三)重要的產銷政策：

- 1.有效運用現有客戶基礎，共同開發新製程，讓產品線更具多樣化。
- 2.加強工程品質與降低成本一直是公司管理階層與同仁長期努力的目標。透過產品零件標準化，以減少庫存及提高存貨週轉率。
- 3.依業務發展策略，有效規劃產能，提昇產品品質，拓展行銷版圖。

最後敬祝 各位股東
身體健康 萬事如意

董事長 張鴻泰



敬上

貳、公司簡介

一、設立日期：民國 82 年 5 月 7 日

二、公司沿革：

82 年 5 月：弘塑科技有限公司成立，額定資本額 3,000 仟元，實收資本額 3,000 仟元。

84 年 12 月：辦理現金增資 9,000 仟元，增資後實收資本額為 12,000 仟元。

86 年 11 月：組織型態由有限公司變更為股份有限公司。

86 年 12 月：辦理現金增資 18,000 仟元，增資後實收資本額為 30,000 仟元。

87 年 9 月：辦理現金增資 35,000 仟元，增資後實收資本額為 65,000 仟元。

87 年 12 月：辦理盈餘轉增資 5,000 仟元，增資後實收資本額為 70,000 仟元。

88 年 1 月：經 DNV 認證公司稽核取得 ISO 9002 認證資格。

88 年 9 月：與工研院機械所成功開發出第一台 8 吋單晶圓濕式旋轉清洗設備，符合 0.13um 線寬銅製程所需。

89 年 1 月：辦理現金增資 22,000 仟元，增資後實收資本額為 92,000 仟元。

89 年 4 月：辦理現金增資 58,000 仟元，增資後實收資本額為 150,000 仟元。

89 年 5 月：遷入新廠—新竹縣湖口鄉大同路 13 號(現址)。

89 年 9 月：開發出第一套 12 吋全自動濕式晶圓清洗設備及第一套 12 吋單晶圓濕式清洗設備。

89 年 10 月：辦理現金增資 50,000 仟元，增資後實收資本額為 200,000 仟元。

91 年 3 月：經 SGS 認證取得 ISO 9001 資格。

91 年 7 月：投資第三地區公司 Anelva China Semiconductor Equipment Inc.(持股 35.6%)，並經由該公司轉投資設立安內華弘塑（上海）半導體設備有限公司。

92 年 10 月：辦理現金增資 90,000 仟元，增資後實收資本額為 290,000 仟元。

93 年 1 月：投資第三地區公司 Tokyo Kakoki CO., LTD.(持股 40%)，並經由該公司轉投資設立弘塑電子設備（上海）有限公司。

93 年 11 月：開發出第一套銅電鍍(Cu plating)機台。

94 年 9 月：開發出第一套鎳電鍍(Ni plating)機台。

94 年 12 月：出售第三地區投資之 Anelva China Semiconductor Equipment Inc.及 Tokyo Kakoki CO., LTD.。

95 年 8 月：開發出第一套化鍍(electro-less plating)機台。

95 年 10 月：辦理減資彌補虧損 158,527 仟元，減資後實收資本額為 131,473 仟元。

96 年 8 月：辦理盈餘轉增資 13,147 仟元、員工紅利轉增資 4,430 仟元暨現金增資 10,950 仟元，增資後實收資本額為 160,000 仟元。

97 年 5 月：成立 100%持有之香港子公司 Grand Plastic Technology Limited。

97 年 7 月：辦理盈餘轉增資 30,000 仟元暨現金增資 10,000 仟元，增資後實收資本額為 200,000 仟元。

97 年 9 月：證期局核准公開發行，證券代號 3131。

97 年 11 月：經由 100%持有之香港子公司 Grand Plastic Technology Limited 轉投資設立 100%持有之弘懋光電科技(上海)有限公司，註冊資本金為美金伍拾萬元整。

98 年 5 月：獲核准登錄興櫃交易，證券代號 3131。

99 年 2 月：台南辦公室成立。

99 年 3 月：董事會通過買進不動產或土地以作為新廠房之資本支出預算案。

99 年 7 月：因應營運所需，增加租賃湖口實踐路廠房。

99 年 11 月：證券櫃檯買賣中心正式核准通過本公司上櫃案。

100 年 1 月：辦理上櫃現金增資 20,000 仟元，增資後實收資本額為 220,000 仟元，弘塑科技正式掛牌上櫃。

100 年 3 月：成立 GSD 部門(Glass Slimming Division)。

100 年 9 月：正式生產玻璃薄化設備。

100 年 9 月：12 吋酸槽設備取得 Semi S2-0310 與 S8-0308E 產品認證。

101 年 9 月：董事會通過增資發行新股收購添鴻科技股份有限公司。

101 年 9 月：12 吋單晶片旋轉機台取得 Semi S2-0310 與 S8-0310 產品認證。

101 年 10 月：股東臨時會通過增資發行新股收購添鴻科技股份有限公司。

101 年 11 月：公司遷址至新廠-新竹市香山區中華路六段 89 號(現址)。

102 年 1 月：開始依據國際財務報導準則(IFRSs)編制公司合併財務報告。

102 年 1 月：增資發行新股收購添鴻科技股份有限公司，添鴻科技成為弘塑百分之百持有之子公司。增資後實收資本額為 246,838 仟元。

102 年 8 月：董事會通過投資境外公司 AQUA Talent Co.,LTD.美金 45 萬元。

104 年 11 月：董事會通過投資日本 TAZMO CO., LTD. 10.5%股權，投資金額上限為日幣四億伍仟萬元整。

105 年 1 月：子公司添鴻科技董事會通過購置土地用以興建新廠房之資本支出預算案。

105 年 3 月：子公司添鴻科技簽約購置土地用以興建新廠房。

105 年 3 月：董事會通過投資境外公司 AQUA Talent Co.,LTD.美金 55 萬元。

105 年 5 月：開始進行輔導，預計導入 ISO 14001 與 ISO 45001。

105 年 10 月：公司開始出具企業社會責任報告書(GRI/G4)。

106 年 12 月：開始進行 ISO 9001:2015 改版輔導。

107 年 1 月：子公司添鴻科技遷廠完成。

107 年 3 月：董事會通過增資發行新股收購佳霖科技股份有限公司。

107 年 6 月：董事會通過投資 Silicon Valley X-Ray Inc.，投資金額上限為美金伍佰萬元整。

107 年 6 月：股東常會通過增資發行新股收購佳霖科技股份有限公司。

107 年 9 月：取得 ISO 9001:2015 認證。

107 年 11 月：董事會通過投資太引資訊系統股份有限公司，投資金額上限為新台幣 1.85 億元整。

108 年 1 月：取得 ISO 14001 與 ISO 45001 認證。

108 年 3 月：增資發行新股收購佳霖科技股份有限公司，佳霖科技成為弘塑百分之百持有之子公司。增資後實收資本額為 292,160 仟元。

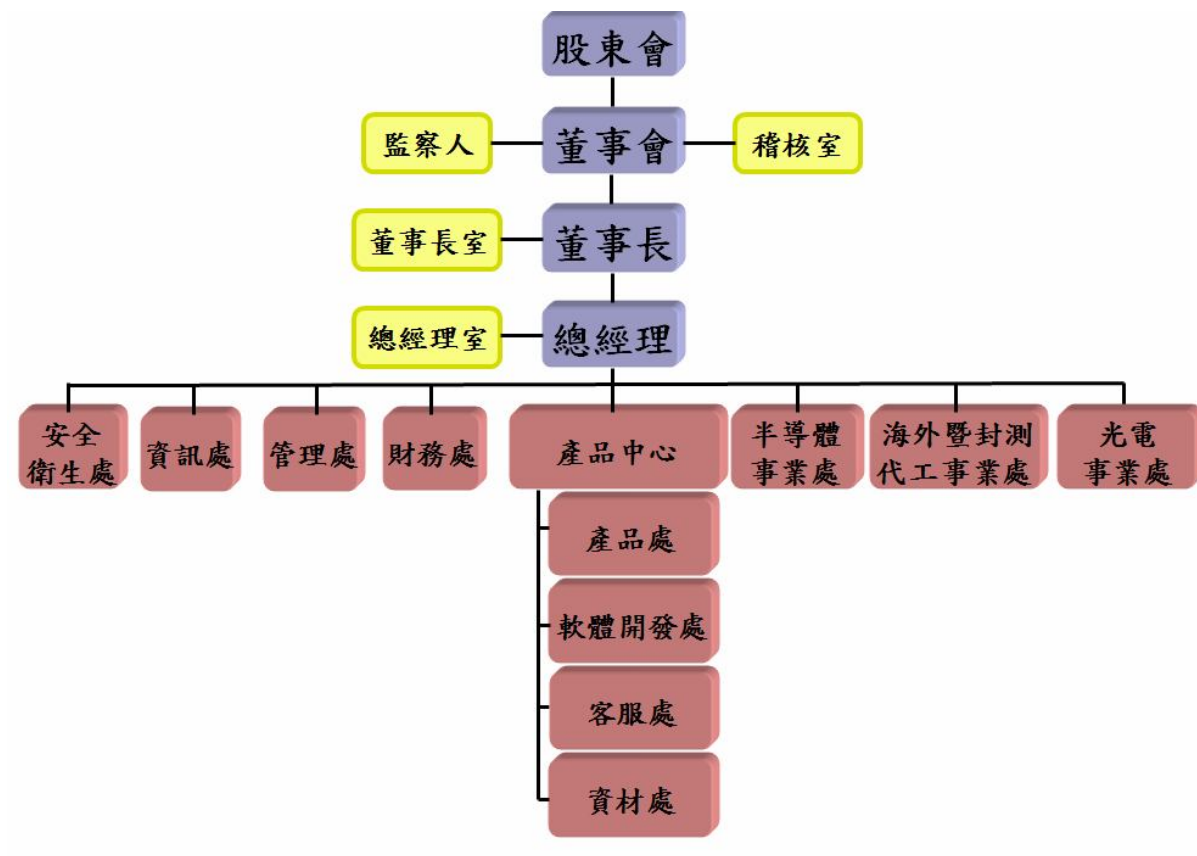
參、公司治理報告

一、組織系統：

(一)組織結構：

弘塑科技股份有限公司

組織圖(110年3月31日)



(二)各主要部門所營業務：

110 年 3 月 31 日

部門	工作執掌
董事長室	◎承股東會及董事會決議與董事長命令綜理本公司一切事務。
總經理室	◎公司願景及經營策略制度規劃，協助公司營運目標達成。 ◎綜合各單位組織業務之執行、協調及核定組織結構與制度規劃，提升營運績效。
稽核室	◎擬訂年度稽核計畫，確實執行並作成稽核報告。 ◎督促各單位辦理自行檢查，覆核各單位之自行檢查報告。 ◎適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施。
半導體事業處	◎半導體設備行銷策略、業務拓展、產品行銷及營業管理等業務。 ◎負責產品交期之掌握與跟催、協助應收帳款之催收。 ◎負責提供市場發展資訊，導引研發方針與資源配置。 ◎協助產品交貨、產品品質管理、售後服務與客訴事件之處理。
海外暨封測代工事業處	◎半導體設備行銷策略、業務拓展、產品行銷及營業管理等業務。 ◎負責產品交期之掌握與跟催、協助應收帳款之催收。 ◎協助產品交貨、產品品質管理、售後服務與客訴事件之處理。 ◎國外客戶之業務拓展、產品行銷及客戶關係等業務。 ◎國外客戶之產品交貨及安裝、產品品質管理、售後服務與客訴事件之處理。
光電事業處	◎光電設備行銷策略、業務拓展、產品行銷及營業管理等業務。 ◎負責產品交期之掌握與跟催、協助應收帳款之催收。 ◎負責提供市場發展資訊，導引研發方針與資源配置。 ◎協助產品交貨、產品品質管理、售後服務與客訴事件之處理。
客服處	◎製程品質巡檢、品質優劣原因分析、判定及改善成效追蹤，協助處理品質異常與客戶抱怨事件。 ◎協助產品交貨、安裝、售後維修服務，機台維修與備品銷售、管理。 ◎檢測設備的管理與保養、校正。
產品處	◎負責產品技術開發、規格制定、組裝與製造過程品管與專案控管。 ◎負責製程技術改善、產品功能設計改善、下包商之管理與協助客戶產品應用。 ◎協助產品交貨、安裝。 ◎負責廠房管理、無塵室管理等業務。 ◎負責製程技術改善、產品功能設計改善、研發產品新應用。 ◎專利申請、關鍵技術建立、新技術引進與開發、前瞻技術資料之收集與管理。
軟體開發處	◎公司產品之自動化應用程式規劃、軟體開發、程式撰寫與協助

部門	工作執掌
	客戶產品應用。 ◎研發專案設備相關應用程式之開發。
財務處	◎負責財務資金調配、公司整體預算規劃。 ◎負責建立及維護有關會計管理業務與成本之結算。 ◎每月報表之審核與彙總，各項會計、財務與稅務作業之規劃與執行。
資材處	◎負責產品之生產管控與滿足客戶所需之交期及品質。 ◎負責倉儲、物流管理、存貨庫存管理與盤點。 ◎各項資產、原物料、設備之採購，交期追蹤，與供應商管理等業務。
管理處	◎負責公司整體總務、行政服務、固定資產管理等業務。 ◎負責廠房消防及安全、環境清潔、各類修繕。 ◎人力資源管理、人事行政管理、員工薪資福利、教育訓練等事務。 ◎負責人事政策及組織編制之規劃與執行。
資訊處	◎負責公司整體電腦化作業之規劃與推展，電腦軟硬體之規劃、維護。 ◎系統工具導入之評估規劃、執行與管理，資安之規劃、執行與管理。 ◎公司網站平台維護管理。
安全衛生處	◎安全衛生作業之擬訂、規劃、督導及推動安全衛生管理事項。 ◎指導有關部門實施教育訓練、資訊宣導、檢查及檢點並做記錄。 ◎工作環境危險/有害物標示、設備或器具或護具使用管理、施工安全評估、職災等事件調查處理。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)董事及監察人：

1.董事及監察人資料：

110年4月25日 單位：股

職 稱	國籍 或註冊地	姓 名	性 別	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人		
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	張鴻泰	男	108.06.19	三年	89.05.02	5,907,338	20.22%	5,907,338	20.22%	0	0.00%	0	0.00%	北阿拉巴馬州立大學碩士 佳霖科技董事長	註 1	監察人 代表人	蔡素滿	弟媳
董事	中華民國	詹仕戎	男	108.06.19	三年	102.06.13	120,740	0.41%	62,740	0.21%	0	0.00%	0	0.00%	明新科技大學化學工程與材料 科技碩士 添鴻科技總經理	添鴻科技董事 弘懋光電科技(上海)董事	無	無	無
董事	中華民國	石本立	男	108.06.19	三年	105.06.16	5,000	0.02%	8,000	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	政治大學高階主管管理碩士 清華大學材料科學碩士 弘塑科技副總經理 新日光能源科技資深處長 旺宏電子處長	弘塑科技總經理 弘懋光電科技(上海)董事長 佳霖電子(上海) 董事長 添鴻科技董事長 太引資訊董事長 佳霖科技董事 喬鼎資訊獨立董事	無	無	無
獨立 董事	中華民國	施聖亭	男	108.06.19	三年	108.06.19	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	北阿拉巴馬州立大學碩士 左右國際董事長	左右國際董事長 左右設計董事長 左右旅行社董事長	無	無	無
獨立 董事	中華民國	何幼梅	女	108.06.19	三年	108.06.19	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	交通大學高階主管管理碩士 清華大學材料科學系 應用材料台灣區資深處長 科林研發台灣區總經理	鴻海科技集團戰 略顧問 唯峰科技顧問	無	無	無
監察人	中華民國	佳霖科技(股) 代表人： 蔡素滿	女	108.06.19 108.06.19	三年 三年	100.06.22 102.06.13	694,520 55,612	2.38% 0.19%	694,520 25,612	2.38% 0.09%	0 0	0.00% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	無 醒吾商專會計科	無 佳霖科技協理 佳霖電子(上海) 監察人	董事長	張鴻泰	配偶 之兄
監察人	中華民國	任克川	男	108.06.19	三年	100.06.22	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國麻省大學羅爾分校物理學博 士 成功大學物理系 漢辰科技總經理 美國應用材料資深處長	美商亞舍立科技資 深副總經理	無	無	無
監察人	中華民國	邱水珠	女	108.06.19	三年	98.06.16	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	交通大學高階主管管理碩士 中興大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所副理 台灣應用材料會計及稅務經理	明兆會計師事務所 會計師 力致科技監察人	無	無	無

註 1：佳霖科技董事長、群呈科技監察人、定睿投資董事、Challenge Technology Corp.董事長、Grand Plastic Technology Limited 董事長、AQUA Talent Co., Ltd.董事長。

2.法人股東之主要股東：

110 年 4 月 25 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例(%)
佳霖科技股份有限公司	弘塑科技股份有限公司	100.00

3.主要股東為法人者其主要股東：請參閱本年報-肆、募資情形，一、資本及股份：段落(四)主要股東名單。

4.董事或監察人所具專業知識及獨立性之情形：

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形（註）												兼任其 他公 開發 行公 司獨 立董 事 數
		商務、財務、 財務、會計或 公司業務所須 相關科系之公 私立大專院校 講師以上	法官、檢察官、律 師、會計師或其他 與公司業務所需 之國家考試及格 領有證書之專門 職業及技術人員	商務、法 務、會計或 公司業務 所須之工 作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
張鴻泰		X	X	V	V	X	X	X	X	V	V	V	V	X	V	V	0
詹仕戎		X	X	V	V	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0
石本立		X	X	X	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1
施聖亭		X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0
何幼梅		X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0
蔡素滿		X	X	V	X	V	V	X	X	V	V	V	V	X	V	X	0
任克川		X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0
邱水珠		X	V	V	V	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

5.董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施等相關資訊：無此情形。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管：

1.主管資料：

110 年 4 月 25 日，單位：股

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
總經理	中華民國	石本立	男	103.01.02	8,000	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	政治大學高階主管管理碩士 清華大學材料科學碩士 弘塑科技副總經理 新日光能源科技資深處長 旺宏電子處長	弘懋光電(上海)董事長 佳霖電子(上海)董事長 添鴻科技董事長 太引資訊董事長 佳霖科技董事 喬鼎資訊獨立董事	無	無	無
產品中心執行副總經理 產品處主管 軟體開發處主管	中華民國	黃富源	男	102.05.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中央大學資管所碩士 交通大學管理科學所碩士 星科金朋 Bumping 處副處長 華宸科技工程部課長 台灣積體電路製造蝕刻設備工程師	添鴻科技董事 弘懋光電(上海)董事	無	無	無
資訊處處長 資材處處長	中華民國	周雲程	男	100.06.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	交通大學高階主管管理碩士 交通大學機械工程系 台灣國際商務機器資訊整合顧問 劍麟公司製造部經理	無	無	無	無
客服處處長	中華民國	王明忠	男	95.03.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	黎明工專電機科 伯東通商高級工程師 科程科技維修工程師	無	無	無	無
半導體事業處處長 光電事業處主管	中華民國	梁勝銓	男	100.03.07	1,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	交通大學工業工程所碩士 台灣積體電路製造採購主任 台灣積體電路製造 IE 工程師	無	無	無	無
海外暨封測代工事業處處長	中華民國	顏榮偉	男	99.07.20	5,000	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	政治大學高階主管管理碩士 中興大學機械工程學系 日月光半導體製造副理 利機企業經理 華泰電子經理	無	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
財務處處長	中華民國	曾繁斌	男	99.04.09	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國俄亥俄州立大學企管碩士 中興大學企管系 航欣科技財務長 台精科技處長	添鴻科技監察人 佳霖科技監察人 太引資訊監察人	無	無	無
管理處處長 安全衛生處主管	中華民國	黃志達	男	104.01.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	成功大學企管系 台灣飛利浦電子人資經理 奇美電子(群創)中央人資經理 冠捷科技集團人資副處長	無	無	無	無
稽核室經理 總經理特助	中華民國	莊凱吉	男	97.05.21	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	交通大學工業工程與管理碩士 中原大學會計系 碩達科技稽核室課長 緯晶光電稽核室課長	無	無	無	無

2.總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：無此情形。

(三)最近年度支付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.一般董事及獨立董事之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)：

單位：新台幣元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(註10)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例(註10)		有無來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)				薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)						
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司		財務報告內所有公司(註7)		本公司	財務報告內所有公司(註7)	
		現金金額	股票金額	現金金額	股票金額																	
董事長兼執行長	張鴻泰	0	0	0	0	2,974,875	4,800,736	720,000	960,000	0.93%	1.45%	6,117,552	7,327,552	108,000(提撥)	108,000(提撥)	3,535,985	0	3,535,985	0	3.39%	4.22%	無
董事	詹仕戎																					
董事兼總經理	石本立																					
獨立董事	施聖亭	0	0	0	0	1,983,250	1,983,250	240,000	240,000	0.56%	0.56%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.56%	0.56%	無
獨立董事	何幼梅																					

(1)獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：支付獨立董事之酬金係指獨立董事執行業務之報酬或相關費用，依其所擔任之職務權責及其貢獻度，包括投入之心力與時間，並參考同業對於獨立董事水準訂定，尚屬合理。

(2)除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問)領取之酬金：0元。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註 8)	財務報告內所有公司(註 9) H	本公司(註 8)	財務報告內所有公司(註 9) I
低於 1,000,000 元	石本立	—	—	—
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	張鴻泰、詹仕戎、施聖亭、何幼梅	張鴻泰、詹仕戎、施聖亭、何幼梅	詹仕戎、施聖亭、何幼梅	詹仕戎、施聖亭、何幼梅
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	—	石本立	張鴻泰	張鴻泰
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	—	石本立	石本立
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	5	5	5	5

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係 109 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係 109 年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4：係 109 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：係 109 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 6：係 109 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)金額，係 109 年度經董事會通過分派，以 108 年度分派比率估算而得。

註 7：應揭露財務報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 9：財務報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：稅後純益係指本公司 109 年度個體財務報告之稅後純益新台幣 396,873 仟元。

註 11：酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞及業務執行費用等相關酬金。

2.監察人之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)：

單位：新台幣元

職稱	姓名	監察人酬金						A、B 及 C 等三項總額占稅後純益之比例 (註 8)		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 (註 9)
		報酬(A) (註 2)		酬勞(B) (註 3)		業務執行費用(C) (註 4)				
		本公司	財務報告內所有公司(註 5)	本公司	財務報告內所有公司(註 5)	本公司	財務報告內所有公司(註 5)	本公司	財務報告內所有公司(註 5)	
監察人	佳霖科技股份有限公司 代表人：蔡素滿	0	0	2,974,875	2,974,875	360,000	360,000	0.84%	0.84%	無
監察人	任克川									
監察人	邱水珠									

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司(註 6)	財務報告所有公司(註 7) D
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	佳霖科技(股)公司-代表人：蔡素滿、 任克川、邱水珠	佳霖科技(股)公司-代表人：蔡素滿、 任克川、邱水珠
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	—	—
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	—	—
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	—
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	3	3

註 1：監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。

註2：係109年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係109年度經董事會通過分派之監察人酬勞金額。

註4：係109年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：應揭露財務報告內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。

註6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註7：財務報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註8：稅後純益係指本公司109年度個體財務報告之稅後純益新台幣396,873仟元。

註9：酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞及業務執行費用等相關酬金。

3.總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)：

單位：新台幣元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等四 項總額占稅後純益 之比例(註8)		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 (註9)
		本公司	財務報告內所有公司 (註5)	本公司	財務報告內所有公司 (註5)	本公司	財務報告內所有公司 (註5)	本公司		財務報告內所有公司(註5)		本公司	財務報告內所有公司 (註5)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	石本立	4,943,000	5,653,000	216,000	216,000	4,573,368	4,573,368	5,261,098	0	5,261,098	0	3.78%	3.96%	無
副總經理	黃富源			(提撥)	(提撥)									

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註6)	財務報告內所有公司(註7) E
低於1,000,000元	—	—
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	—	—
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	—	—
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	—	—
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	石本立、黃富源	石本立、黃富源
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	—	—
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	—	—
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	—	—
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	—	—
100,000,000元以上	—	—
總計	2	2

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。

註2：係109年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註3：係109年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係109年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），以108年度分派比率估算而得。

註5：應揭露財務報告內所有公司（包括本公司）給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註7：財務報告內所有公司（包括本公司）給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註8：稅後純益係指本公司109年度個體財務報告之稅後純益新台幣396,873仟元。

註9：酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞及業務執行費用等相關酬金。

4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額 (註1)	總計	總額占稅後純 益之比例(%)
經 理 人	總經理	石本立	0	6,117,938	6,117,938	1.54%
	副總經理	黃富源				
	會計主管	曾繁斌				

註1：係109年度經董事會通過分派經理人之金額總數，以108年度分派比率估算而得。

5.前五位酬金最高主管之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）：不適用。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

(1)董事及監察人

本公司 108 及 109 年度支付董事及監察人之酬金總額占稅後純益比例分別為 2.44%及 2.33%，其酬金係指董監執行業務之報酬或相關費用，不包括兼任員工者所支領之員工薪酬，依其所擔任之職務權責及其貢獻度，並參考同業對於同類職位水準訂定。

(2)總經理及副總經理

本公司 108 及 109 年度支付總經理及副總經理之酬金總額占稅後純益比例分別為 3.92%及 3.78%，其酬金係指薪資、獎金及特支費及員工分紅，依其所擔任之職位及所承擔的責任，參考同業對於同類職位水準訂定。此外，本公司於年度決算有盈餘可供分派時，依公司章程提撥之員工紅利中，考量其年度工作績效，決定員工紅利之配發數額。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形：

(1)最近年度董事會開會 4 次(A)，董事、監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	張鴻泰	4	0	100%	
董事	石本立	4	0	100%	
董事	詹仕戎	4	0	100%	
獨立董事	施聖亭	4	0	100%	
獨立董事	何幼梅	4	0	100%	
監察人	佳霖科技股份有限公司 代表人：蔡素滿	4	不適用	100%	
監察人	任克川	4	不適用	100%	
監察人	邱水珠	4	不適用	100%	
其他應記載事項：					
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：					
(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：無。					
(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。					
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無相關之議案。					
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：本公司董監已包括獨立董事二席暨過半數監察人具備獨立性，已完成公司上櫃承諾應辦事項及強化公司治理。					

(2)董事會評鑑執行情形：109 年度評鑑完成，本公司採自評方式，每位董事均回覆問卷，平均得分為 4.5 分(滿分為 5 分)。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1.審計委員會運作情形：本公司尚未設立審計委員會，故不適用。

2.監察人參與董事會運作情形：

最近年度董事會開會 4 次(A)，監察人列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席 次數(B)	實際列席率 (%)【B/A】	備註
監察人	佳霖科技股份有限公司 代表人：蔡素滿	4	100%	
監察人	任克川	4	100%	
監察人	邱水珠	4	100%	
其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責： (一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形：溝通管道暢通，公司員工可以 E-mail 方式、股東以出席股東會方式與監察人溝通。 (二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：監察人列席董事會，定期核閱本公司稽核報告、審查財務營運表冊，每年查核公司內控情況，每季就公司財務、業務狀況進行了解。監察人與內部稽核主管及會計師間均以電話或 E-mail 方式進行溝通，內部稽核主管及會計師均能充分尊重監察人之建議。 二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。				

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？		V	無。	本公司目前尚未訂定公司治理實務守則，但公司對待股東及對股東權利的尊重與上市上櫃公司治理實務守則的精神一致。公司皆依據相關法規揭露公司重大訊息、定期揭露財務資訊；董事會亦遵照股東賦與之責任，引導公司經營策略、監督經營階層之管理。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(一) 股東可於股東會提出建議；平時亦有發言人負責相關事宜。 (二) 本公司主要股東大都為本公司董監事及經營團隊，每月定期向公司申報持股異動情形。 (三) 本公司訂有「子公司營運管理辦法」與「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」，並依本公司內部控制制度辦理，確實執行風險控管及防火牆機制。 (四) 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(一) 本公司董事會成員背景為跨領域專長，並設置獨立董事二席。 (二) 未來依法將設置審計委員會，其他則視情形。 (三) 目前規畫中，預計109年度開始施行。 (四) 本公司董事會定期評估簽證會計師獨立性之情形。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		(一) 本公司公司治理兼職單位為管理處，人員為其主管或主管指派專人。管理處同時負責辦理公司登記及變更登記。 (二) 董事會及股東會有關之工作為投資人關係專人負責，由總經理指派。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司依規定揭露公司財務業務資訊，本公司往來銀行、債權人、股東、員工、客戶及供應商等利害關係人，可透過本公司發言人(或其指派專人)或各業務窗口瞭解公司營運狀況。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任專業股務代辦機構為群益金鼎證券，辦理股東會事務。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		(一) 本公司已架設網路，定期更新與增加其內容。有關本公司財務、業務及公司治理之資訊，均依規定於公開資訊觀測站揭露。 (二) 公司網站亦有英文版，設有法說會專區，並已設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作，並已建立發言人制度。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		(一) 對公司之員工權益除依勞基法及相關法令辦理並成立職工福利委員會、實施退休金制度外，鼓勵員工參與各項訓練課程與技術研討、規劃員工團體保險及安排定期健康檢查，重視勞工關係，與員工維繫良好互動及溝通。 (二) 本公司每季舉辦聚餐，每年定期辦理員工健康檢查，員工婚喪喜慶均有補助，員工心聲皆可透過部門主管或是部門職福委員予以上反應。 (三) 本公司依法及時公告重大訊息於公開資訊觀測站，財務資訊依規定準時申報，攸關投資者之訊息均刊載於年報。本公司已設立發言人及代理發言人，另公司設有股務溝通窗口。 (四) 與供應商溝通管道暢通，執行情形良好。 (五) 本公司與關係企業間曾之業務往來，已訂有「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「子公司營運管理辦法」並確實遵循。另本公司制定有「董事會議事規範」，董事對董事會議案如涉及利害關係時需予以迴避，不得加入討論及表決。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(六)董事及監察人進修之情形：本公司董事及監察人均具有專業背景，且依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」持續進修相關課程。最近二年度董監進修情形如下： (1)109 年： a.董事會如何督導企業併購後整合暨管理機制建立(3 小時)：所有董監。 b.企業如何提升執行力與經營績效(3 小時)：所有董監。 (2)108 年： a.集團治理(3 小時)：所有董監。 b.董事受託義務與商業判斷準則(3 小時)：所有董監。 c.108 年最新法令與實務解析(7 小時)：邱水珠。 (七)本公司業已制定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。 (八)本公司已訂有「授信管理辦法」並執行之，並落實執行 ISO 9001 制度中針對客戶權益之程序，例如「售後服務作業程序」、「客戶滿意度調查程序」等，以保障客戶之權益。 (九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司於 99 年 1 月 1 日起，截至本年度，每年度均替董事及監察人購買責任保險，以配合公司治理，強化股東權益之保障。	
九、最近年度之公司治理評鑑結果，已改善情形及就尚未改善項目之優先加強事項與措施。	V		(一)本公司強化網路內容。 (二)本公司自願編制企業社會責任報告書，並上傳公司網站。 (三)本公司提早公告上傳股東會相關資訊，例如股東會年報。 (四)本公司未來擬將強化董事會職能列為優先事項。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1.本公司薪酬委員會，其組成與成員資料：

身份別 (註 1)	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註 2)										兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成員家數	備註
		商務、法務、 財務、會計或 公司業務所需 相關料系之公 私立大專院校 講師以上	法官、檢察官 、律師、會計 師或其他與公 司業務所需之 國家考試及格 領有證書之專 門職業及技術 人員	具有商務、 法務、財務、 會計或公司 業務所需之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
獨立董事	施聖亭	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	
獨立董事	何幼梅	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	
其 他	陳錦俊	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	

註 1：身分別請填列為董事、獨立董事或其他。

註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

2.本公司薪酬委員會之職責：

本公司依法於 100 年 10 月 26 日成立薪酬委員會，成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人，目前三位成員除了二位獨立董事外，尚包含一位外部專業人士。委員會主要職責與運作情形為：(1)以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考；(2)審核年度員工酬勞總數是否符合公司章程規範；(3)運作情形為每年至少召開二次會議，但有緊急情事者，不在此限。

3.本公司薪酬委員會運作情形：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：108 年 6 月 20 日至 111 年 6 月 18 日，最近年度薪資報酬

委員會開會 2 次，本年度截至年報刊印日止，本公司薪酬委員會開會 1 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席次 數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	施聖亭	3	0	100	
委員	何幼梅	3	0	100	
委員	陳錦俊	3	0	100	
其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無相關之議案。 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無相關之議案。					

(五)履行社會責任情形：

1. 已執行情形或規劃情形之具體說明：

社會責任項目	執行情形			已執行情形或規劃情形之具體說明
	未執行	已執行	規劃中	
1. 人權				
(1)符合勞基法等勞工相關法令規定		V		本公司依據勞動基準法制定「員工上班須知」，以及訂定任用招募、獎懲、離職、退休、陞遷等管理辦法。本公司定期或不定期舉辦勞資會議。
(2)其他(如維護員工及應徵者之就業機會平等、確保員工免於騷擾及歧視等)		V		本公司每年定期召開人評會，審核員工晉升，並訂定有「性騷擾防治措施暨申訴作業辦法」、「員工滿意度調查程序」等管理辦法。本公司招募員工，對於應徵者之就業機會，均遵循勞動基準法、性別工作平等法等相關法令。
2. 員工權益				
(1)提供員工充分之教育訓練		V		本公司新人報到時均接受新人教育訓練，本公司訂定有「教育訓練作業程序」，針對在職員工工作上所需之技能或個人之自我發展，每年編列有教育訓練預算與員工教育訓練計畫，且皆能達到有效的執行度。
(2)提供員工充分反應意見之權利		V		本公司對公司員工設有意見管道由專人處理員工對公司的建言並將意見反應至上層。
(3)其他(如職業安全衛生管理系統方面經 ISO 45001 或相關機構之認證、提供員工合理之福利與報酬等)		V		1. 本公司員工薪資符合法令最低工資之規定，且公司員工之福利與報酬，管理者皆能參照同業予以適當調整。本公司並在金融海嘯與失業率攀升之氛圍下，充分響應政府就業政策，不以動輒資遣員工為手段

社會責任項目	執行情形			已執行情形或規劃情形之具體說明
	未執行	已執行	規劃中	
				。而在半導體景氣復甦之際，以增聘員工為實際作為，提高就業率。 2.本公司成立「安全衛生處」，專責人員負責維護與改善勞工職業安全衛生。 3.本公司已於 108 年取得 ISO 14001 與 ISO 45001 之認證。ISO 14001 認證機構：SGS；證書編號：TW19/10072；本次證書有效起迄：2019/01/28~2022/01/28。
3.僱員關懷				
(1)確保工作環境之安全		V		本公司訂定有「安全衛生工作守則」、「無塵室進出管理程序」等管理辦法，管理單位確實監督員工遵循。對於工作環境、設備儀器、有害物質的管理，遵守相關環保法規，保障員工工作上的安全與健康。本公司已於 108 年取得 ISO 14001 與 ISO 45001 之認證。
(2)訂定書面之勞工衛生安全相關政策		V		本公司訂定有「安全衛生工作守則」、「緊急應變組織作業程序」等管理辦法。
(3)其他(如重視勞工身心發展及家庭生活等)		V		1.本公司依法提撥勞退金，繳納勞保費、健保費，並辦理員工團保，若發生職災時可以增加保障員工。 2.本公司每年提供員工免費健檢，每年讓員工自行編列教育訓練計畫。 3.本公司依法成立職工福利委員會，定期辦理聚餐，表揚資深員工。不定期辦理球類運動、旅遊踏青，補助員工婚喪喜慶，發放三節禮券或禮金。
4.環保				
(1)訂定書面環保政策		V		本公司訂定有「廢棄物處理作業管理程序」與「危害物質分類及圖示指導作業程序」等管理辦法。
(2)遵行環保相關法令		V		本公司對內除落實遵循管理辦法外，對外遵守環保法令規定，一般廢棄物與事業廢棄物均委託合法業者清運並訂有委任契約。
(3)其他(如發展節能、減污及防污之技術、設備及活動；資源之再利用、廢棄物回收及減量、有害物質的禁用等)		V		本公司除積極配合法令及政府政策外，對內提倡省電、省水節約能源及 5S 環境政策以響應環保。委任之廢棄物清運業者均能協助資源之回收分類與再利用。本公司已於 108 年取得 ISO 14001 認證。
5.社區參與				
(1)參與社區服務及慈善活動			V	本公司鼓勵員工參與社區公益或慈善活動，或擔任志工。
(2)其他(如實行社區援助及投資【包括人力、物力、知識及技能等】、確保社區健康與安全等)		V		本公司鼓勵員工實行社區援助及捐助，例如本公司董事長以身作則固定每年捐款予不特定單位，例如：新竹女中、文昌國中、新竹縣峨眉國小、竹東高中、新竹高中家長會

社會責任項目	執行情形			已執行情形或規劃情形之具體說明
	未執行	已執行	規劃中	
				等機關團體。
6.社會貢獻				
(1)捐助慈善事業及教育、醫療、藝術等活動		V		1.本公司不定期捐款予下列機構：喜憨兒社福基金會、陽光基金會、人安基金會、華山基金會、仁愛社會福利基金會等社福團體。 2.本公司定期/不定期捐款予學術機構，例如新竹地區國小、苗栗幼安教養院、北一女、新竹市西門國小。 3.本公司董事長固定每年捐款予不特定單位，例如：嘉義聖心教養院、法鼓山佛教基金會、台東天主教聖母醫院、新竹市天主教仁愛社會福利基金會、蘋果日報慈善基金、伊甸社會福利基金會、家扶中心、中華民國紅十字會等社福團體。
(2)其他(如援助落後地區國家、提供弱勢團體就業機會等)		V		本公司董事長固定每年捐款予不特定單位，例如：好好好家庭教育基金會、龍潭啟智教養院、海鷗春陽文教基金會、TVBS 關懷台灣文教基金會、周大觀文教基金會、財團法人犯罪被害人保護協會等社福團體。
7.社會服務				
(1)推動社會福利			V	本公司鼓勵員工擔任義工或志工，並鼓勵員工參加社福團體的公開活動。
(2)其他				無。
8.投資者關係				
(1)提高營運透明度		V		1.本公司已架設網路，定期更新與增加其內容。有關本公司財務、業務及公司治理之資訊，均依規定於公開資訊觀測站揭露。 2.本公司已設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作，並已建立發言人制度。
(2)重視公司治理		V		1.公司皆依據相關法規揭露公司重大訊息、定期揭露財務資訊；董事會亦遵照股東賦與之責任，引導公司經營策略、監督經營階層之管理。 2.本公司五董三監中，設置有獨立董事二席且過半數監察人具備獨立性。 3.本公司每季均召開董事會，並制定有「董事會議事規範」，董事對董事會議案如涉及有利害關係時需予以迴避，不得加入討論及表決。 4.本公司於 99 年 1 月 1 日起替董事及監察人購買責任保險，以配合公司治理，強化股東權益之保障。
(3)其他		V		本公司已設有發言人、代理發言人及股務窗口，確保股東權益與對應事宜。
9.供應商關係				

社會責任項目	執行情形			已執行情形或規劃情形之具體說明
	未執行	已執行	規劃中	
(1)重視採購價格之合理性		V		本公司與往來供應商皆能保持良好的關係和互動。本公司請購、採購流程均落實詢、比、議價，並訂有「供應廠商評鑑與考核作業程序」，定期對供應商考核。
(2)其他		V		本公司訂有「採購作業程序」。
10.與利害關係人之權益				
(1)尊重智慧財產權		V		本公司尊重他人之智慧財產權，截至目前為止並無侵權之情事。
(2)重視與顧客之關係(如保護消費者權益、重視產品品質、安全性及創新、重視並立即處理客訴、提供完整產品資訊等)		V		1.本公司重視成品檢驗、不合格品管制等品質程序。 2.本公司落實執行 ISO 9001 制度中針對客戶權益之程序，例如「客戶滿意度調查程序」，以保障客戶之權益。 3.本公司訂有「售後服務作業程序」、「客訴管制作業程序」，及時處理售後服務或客訴事件，以保障客戶之權益與維持與客戶之良好關係。
(3)遵守法令規範		V		本公司業已制定各種內部規章與管理辦法，均能遵守相關法令之規定。
(4)其他(如於公司網站揭露社會責任政策之執行情形等)		V		本公司網站已放置相關資訊。
11.其他				無。

2.履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司業已制定相關內部規章與管理辦法，及ISO 9001與ISO 14001相關程序書，並列入年度內控自行評估。	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。
二、公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？		V	本公司有設置推動企業社會責任專(兼)職單位。	本公司目前尚未訂定本身之企業社會責任實務守則，但有設置推動企業社會責任專(兼)職單位，且公司對企業社會責任的重視與上市上櫃公司企業社會責任實務守則的精神一致。公司營運符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (二) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？ (四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		(一)~(三)已執行，具體之執行情形請參照上表「1.已執行情形或規劃情形之具體說明」。 (四)則列在公司自願編制之企業社會責任報告書，並已上傳本公司網站。	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ (二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ (三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ (五) 對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？ (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(一)~(六)已執行，具體之執行情形請參照上表「1.已執行情形或規劃情形之具體說明」。	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	△		公司自願編制企業社會責任報告書，並已上傳本公司網站。然報告書並未委請第三方單位驗證。	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司目前尚未訂定本身之企業社會責任實務守則，但公司對企業社會責任的重視與上市上櫃公司企業社會責任實務守則的精神一致。本公司本於尊重社會倫理與注意其他利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理與營運。				
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：請參照上表「1.已執行情形或規劃情形之具體說明」。				

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施：

1.履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(一)~(三)已執行，本公司具體之政策均已訂立在公司之各項管理辦法。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(一)~(五)已執行，本公司具體之政策均已訂立在公司之各項管理辦法。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		已執行，本公司具體之政策均已訂立在公司之人事管理辦法。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？		V	本公司目前尚未將誠信經營相關資訊揭露於公司網站。	本公司目前尚未將誠信經營相關資訊揭露於公司網站，但本公司對誠信經營的重視與上市上櫃公司一致。未來將視公司營運所需，改善後，將符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司目前尚未訂定本身之誠信經營守則，但公司對誠信經營責任的重視與上市上櫃公司誠信經營守則的精神一致。本公司本於誠信經營之精神，在追求永續經營與獲利之同時，亦將其納入公司管理與營運。				

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：無。			

(七)公司治理守則及相關規章查詢方式：本公司尚未訂定公司治理守則及相關規章，未來將視公司營運狀況之需要適時訂定之。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1.經理人參與公司治理有關之進修與訓練：

(1)經理人兼任董事者，參加「董事會如何督導企業併購後整合暨管理機制建立」、「企業如何提升執行力與經營績效」之持續進修課程。

(2)主管兼任安衛主管，參加在職教育訓練課程。

2.與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照：

(1)會計主管：發行人證券商證券交易所會計主管合格證書、109 年會計主管持續進修合格證書。

(2)會計主管代理人：109 年會計主管持續進修合格證書。

(3)內部稽核主管：國際內部稽核師證書、中華民國內部稽核師證書、109 年稽核人員持續進修合格證書。

(4)內部稽核代理人：公開發行公司內部稽核人員初任合格證書、109 年稽核人員持續進修合格證書。

3.員工行為或倫理守則：本公司訂有員工守則與獎懲規定等管理辦法。

4.內部重大資訊處理作業程序：本公司訂有「財務及非財務資訊管理辦法」、「財務報表編製管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」等管理辦法。

5.公司董事會評估簽證會計師獨立性：

(1)109 年會計師獨立性及適任性評估結果：本公司之簽證會計師具備獨立性及專業適任性。

(2)本公司 109 年簽證會計師：勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立會計師、鍾鳴遠會計師。

(3)會計師工作內容：每季財報核閱、年度財報簽證、不定期財務稅務諮詢服務。

(4)依據會計師法第 47 條與會計師職業道德規範第 10 號公報評估結果如下：

項目	結果
1.截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	☒ 是 ☐ 否
2.與委託人無重大財務利害關係。	☒ 是 ☐ 否
3.避免與委託人有任何不適當關係。	☒ 是 ☐ 否
4.會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	☒ 是 ☐ 否
5.執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	☒ 是 ☐ 否
6.會計師名義不得為他人使用。	☒ 是 ☐ 否
7.未握有本公司及關係企業之股份。	☒ 是 ☐ 否
8.未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	☒ 是 ☐ 否
9.未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	☒ 是 ☐ 否
10.未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪	☒ 是 ☐ 否
11.未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	☒ 是 ☐ 否
12.未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	☒ 是 ☐ 否
13.與本公司管理階層人員無配偶、直系血親直系姻親或	☒ 是 ☐ 否
14.未收取任何與業務有關之佣金。	☒ 是 ☐ 否
15.截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。	☒ 是 ☐ 否

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

- 1.內部控制聲明書：請參閱附件一第 233 頁。
- 2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.一〇九年股東常會(109.06.18)重要決議內容及執行情形

項次	重要決議事項	執行情形
1	照案通過一〇八年度營業報告書暨財務報表案。	照案表決通過。
2	照案通過一〇八年度盈餘分配案。	照案表決通過，配發股東現金股利每股 8 元，共 233,728,120 元，並已於 109 年 8 月 20 日發放完畢。

2.一〇九年度及截至年報刊印日止董事會之重要決議

日期	會議	重要決議事項
109.03.23	第十屆第四次董事會	1. 通過一〇八年度員工酬勞、董監酬勞。 2. 通過一〇八年度營業報告書暨財務報告。 3. 通過一〇八年度盈餘分配案。 4. 通過一〇八年度內部控制制度聲明書。 5. 通過一〇九年度預算案。 6~7.通過對子公司添鴻科技分別向玉山銀行/華南銀行申請之綜合額度背書保證案。 8~9.通過對子公司太引資訊分別向玉山銀行/華南銀行申請之綜合額度背書保證案。 10.通過對子公司佳霖電子(上海)向華南銀行申請之綜合額

日 期	會 議	重 要 決 議 事 項
		度背書保證案。 11.通過對子公司添鴻化學科技(上海)向華南銀行申請之綜合額度背書保證案。 12~13.分別通過華南銀行/玉山銀行融資案。 14.通過一〇九年股東常會召開事宜。 15.通過一〇九年股東常會受理股東提案作業。
109.05.04	第十屆第五次董事會	1. 通過一〇九年第一季財務報告。 2. 通過對子公司添鴻科技向土地銀行申請之綜合額度背書保證案。
109.08.03	第十屆第六次董事會	1. 通過一〇九年第二季財務報告。 2. 通過土地銀行融資案。 3~5.通過對子公司太引資訊分別向玉山銀行/兆豐銀行申請之中長期授信額度背書保證案。
109.11.09	第十屆第七次董事會	1. 通過一〇九年第三季財務報告。 2. 通過一一〇年度稽核計畫。 3. 通過對子公司添鴻科技向兆豐銀行申請之綜合額度背書保證案。 4. 修訂『核決權限表』案。 5. 購買 Silicon Valley X-Ray Inc.公司債案。
110.03.22	第十屆第八次董事會	1. 通過會計師事務所內部職務輪調之更換會計師案。 2. 通過一〇九年度員工酬勞、董監酬勞。 3. 通過一〇九年度營業報告書暨財務報告。 4. 通過一〇九年度盈餘分配案。 5. 通過一〇九年度內部控制制度聲明書。 6. 通過一一〇年度預算案。 7~8.通過對子公司添鴻科技分別向玉山銀行/華南銀行申請之綜合額度背書保證案。 9~10.通過對子公司太引資訊分別向玉山銀行/華南銀行申請之綜合額度背書保證案。 11.通過對子公司佳霖電子(上海)向華南銀行申請之綜合額度背書保證案。 12.通過對子公司添鴻化學科技(上海)向華南銀行申請之綜合額度背書保證案。 13~14.分別通過華南銀行/玉山銀行融資案。 15.出售 TAZMO 公司股票案。 16.修訂公司章程部份條文案。 17.通過一一〇年股東常會召開事宜。 18.通過一一〇年股東常會受理股東提案作業。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司如有證券交易法第 14 條之 3 或其他獨立董事有反對或保留意見之議案、證券交易法第 14 條之 5 或其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

(十四)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

四、會計師公費資訊：

(一)會計師公費資訊級距表：

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備 註
勤業眾信聯合會計師事務所	方蘇立	葉東輝	109.01.01~109.09.30	無
勤業眾信聯合會計師事務所	方蘇立	鍾鳴遠	109.10.01~109.12.31	無

金額單位：新台幣仟元

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合 計
1	低於 2,000 仟元		—	—	—
2	2,000 仟元（含）~4,000 仟元		2,000	—	2,000
3	4,000 仟元（含）~6,000 仟元		—	—	—
4	6,000 仟元（含）~8,000 仟元		—	—	—
5	8,000 仟元（含）~10,000 仟元		—	—	—
6	10,000 仟元（含）以上		—	—	—

(二)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：不適用。

(三)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。

(四)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊：因會計師事務所內部職務輪調，109 年由方蘇立會計師與葉東輝會計師，更換為方蘇立會計師與鍾鳴遠會計師。

(一)關於前任會計師：

更 換 日 期	110 年 1 月 11 日		
更 換 原 因 及 說 明	會計師事務所內部職務輪調，方蘇立會計師不變，葉東輝會計師更換為鍾鳴遠會計師		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情 況	會計師	委任人
	主動終止委任	葉東輝會計師	不適用

	不再接受(繼續)委任		不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無此情形			
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務	
			財務報告之揭露	
			查核範圍或步驟	
			其 他	
	無	V		
	說明：不適用			
其他揭露事項 (本準則第十條第五款第一目第四點應加以揭露者)	無此情形			

(二)關於繼任會計師：

事 務 所 名 稱	勤業眾信聯合會計師事務所 (與原事務所同)
會 計 師 姓 名	方蘇立會計師(不變)、鍾鳴遠會計師(新任)
委 任 之 日 期	110 年 1 月 11 日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：不適用。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

職 稱	姓 名	109 年度		110 年度截至 4 月 25 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長兼大股東	張鴻泰	0	0	0	0
董事兼總經理	石本立	0	0	0	0

職 稱	姓 名	109 年度		110 年度截至 4 月 25 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事	詹仕戎	(51,000)	0	0	0
獨立董事	施聖亭	0	0	0	0
獨立董事	何幼梅	0	0	0	0
監察人	佳霖科技股份有限 公司	0	0	0	0
監察人	邱水珠	0	0	0	0
監察人	任克川	0	0	0	0
副總經理	黃富源	0	0	0	0
會計部門主管	曾繁斌	0	0	0	0

(二)股權移轉資訊：最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事、監察人、經理人及持股比例超過 10%之股東，股權移轉之交易相對人並無屬於關係人身分之情形。

(三)股權質押資訊：最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事、監察人、經理人及持股比例超過 10%之股東，無股權質押情形。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

110 年 4 月 25 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配 偶、二親等以內之親屬關係者，其名 稱或姓名及關係		備 註
	股數	持股 比例	股數	持股 比例	股數	持股 比例	名稱或 姓名	關係	
張鴻泰	5,907,338	20.22%	0	0.00%	0	0.00%	佳霖科技	張鴻泰擔任佳霖科技董事長	
定睿投資(股)公司	1,856,819	6.36%	0	0.00%	0	0.00%	張鴻泰	擔任董事	
富邦人壽保險股份有限公司	1,595,000	5.46%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
群呈科技(股)公司	1,573,351	5.39%	0	0.00%	0	0.00%	張鴻泰	張鴻泰擔任群呈科技監察人	
富邦產物保險股份有限公司	750,000	2.57%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
佳霖科技(股)公司	694,520	2.38%	0	0.00%	0	0.00%	張鴻泰	張鴻泰擔任佳霖科技董事長	
華南商業銀行(股)受託保管	561,000	1.92%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱或姓名	關係	
國泰小龍證券投資信託基金專戶									
盧○浩	500,000	1.71%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
台北富邦商業銀行受託保管國泰科技生化證券投資信託基金專戶	482,000	1.65%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
彰化商業銀行信託部受託保管國泰大中華證券投資信託基金專戶	400,000	1.37%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

單位：仟股；110年4月25日

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
添鴻科技股份有限公司	10,000	100.00%	0	0%	10,000	100.00%
Grand Plastic Technology Limited	600	100.00%	0	0%	600	100.00%
弘懋光電科技(上海)有限公司	不適用	0%	不適用	100.00%	不適用	100.00%
AQUA TALENT CO., LTD.	350	100.00%	0	0%	350	100.00%
添鴻化學科技(上海)有限公司	不適用	0%	不適用	100.00%	不適用	100.00%
太引資訊系統股份有限公司	2,831	78.10%	0	0%	2,831	78.10%
太引信息科技(南京)有限公司	不適用	0%	不適用	100.00% (註1)	不適用	100.00% (註1)

註1：太引信息科技(南京)係太引資訊系統100%持股之子公司。

肆、募資情形

一、資本及股份：

(一)股本來源：

1.股本形成經過：

單位：新台幣仟元/仟股；110年4月25日

年 月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源(仟元)	以現金以外之財產抵充股款者	其他
82年05月(註一)	—	—	3,000	—	3,000	創立募集 3,000	無	註二
84年12月(註一)	—	—	12,000	—	12,000	現金增資 9,000	無	註三
86年12月	10	3,000	30,000	3,000	30,000	現金增資 18,000	無	註四
87年09月	12	7,000	70,000	6,500	65,000	現金增資 35,000	無	註五
87年12月	10	7,000	70,000	7,000	70,000	盈餘轉增資 5,000	無	註六
89年01月	14	9,200	92,000	9,200	92,000	現金增資 22,000	無	註七
89年04月	14	15,000	150,000	15,000	150,000	現金增資 58,000	無	註八
89年10月	20	20,000	200,000	20,000	200,000	現金增資 50,000	無	註九
92年10月	10	30,000	300,000	29,000	290,000	現金增資 90,000	無	註十
95年10月	10	30,000	300,000	13,147	131,473	減資彌補虧損(158,527)	無	註十一
96年08月	10	30,000	300,000	16,000	160,000	現金增資 10,950 盈餘轉增資 17,577	無	註十二
97年07月	20	30,000	300,000	20,000	200,000	現金增資 10,000 盈餘轉增資 30,000	無	註十三
100年01月	62	30,000	300,000	22,000	220,000	現金增資 20,000	無	註十四
102年01月	74.52	30,000	300,000	24,684	246,838	增資發行新股 26,838 用以合併添鴻科技	無	註十五
108年03月	167.69	30,000	300,000	29,216	292,160	增資發行新股 45,322 用以合併佳霖科技	無	註十六

註一：86年11月以前組織型態為有限公司。

註二：核准日期及文號：82.05.07 八二建三丁字第二九〇五六一號。

註三：核准日期及文號：84.12.15 八四建三庚字第四七七四五號。

註四：核准日期及文號：86.12.26 八六建三庚字第二八六二八二號。

註五：核准日期及文號：87.09.29 經(○八七)商字第○八七一三〇二四四號。

註六：核准日期及文號：87.12.16 經(○八七)商字第○八七一四〇八五四號。

註七：核准日期及文號：89.01.05 經(○八九)中字第八九三五七六七八號。

註八：核准日期及文號：89.04.12 經(○八九)商字第○八九一一〇九六三號。

註九：核准日期及文號：89.10.21 經(○八九)商字第○八九一三八八一八號。

註十：核准日期及文號：92.10.01 經授中字第○九二二二七三九〇一〇號。

註十一：核准日期及文號：95.10.16 經授中字第○九五三二九九二二三〇號。

註十二：核准日期及文號：96.08.16 經授中字第○九六三二六二三七八〇號。

註十三：核准日期及文號：97.07.11 經授中字第○九七三二六一七六一〇號。

註十四：核准日期及文號：100.01.24 經授中字第 10031587690 號。

註十五：核准日期及文號：102.01.30 經授中字第 10233119500 號。

註十六：核准日期及文號：108.03.12 經授中字第 10833144720 號。

2.已發行股份種類：

單位：股

股 種 類	份 類	核定股本			備註
		流 通 在 外 股 份	未發行股份	合計	
普通股		29,216,015	783,985	30,000,000	

3.總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)股東結構：

110 年 4 月 25 日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	外國機構 及 外 人	個 人	合 計
人 數	3	30	262	36	12,633	12,964
持 有 股 數	680,000	5,590,000	5,713,466	651,968	16,580,581	29,216,015
持 股 比 例	2.33%	19.13%	19.56%	2.23%	56.75%	100.00%

1.第一上市（櫃）公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例：不適用。

(三)股權分散情形：

110 年 4 月 25 日

持 股 分 級	股 東 人 數	持 有 股 數	持 股 比 例
1 至 999	9,048	147,263	0.50%
1,000 至 5,000	3,539	5,829,498	19.95%
5,001 至 10,000	189	1,419,167	4.86%
10,001 至 15,000	58	737,162	2.52%
15,001 至 20,000	32	571,518	1.96%
20,001 至 30,000	25	630,129	2.16%
30,001 至 40,000	17	612,000	2.10%
40,001 至 50,000	10	472,510	1.62%
50,001 至 100,000	21	1,443,740	4.94%
100,001 至 200,000	10	1,585,500	5.43%
200,001 至 400,000	6	1,847,500	6.32%
400,001 至 600,000	3	1,543,000	5.28%
600,001 至 800,000	2	1,444,520	4.94%
800,001 至 1,000,000	0	0	0%
1,000,001 以上	4	10,932,508	37.42%
合 計	12,964	29,216,015	100.00%

(四)主要股東名單：

持股比例達百分之五以上之股東或或股權比例占前十名之股東

110 年 4 月 25 日

主要股東名稱	股 份	持 有 股 數	持 股 比 例
張鴻泰		5,907,338	20.22%
定睿投資(股)公司		1,856,819	6.36%
富邦人壽保險股份有限公司		1,595,000	5.46%
群呈科技(股)公司		1,573,351	5.39%
富邦產物保險股份有限公司		750,000	2.57%
佳霖科技(股)公司		694,520	2.38%
華南商業銀行(股)受託保管國泰小龍證券投資信託基金專戶		561,000	1.92%
盧○浩		500,000	1.71%
台北富邦商業銀行受託保管國泰科技生化證券投資信託基金專戶		482,000	1.65%
彰化商業銀行信託部受託保管國泰大中華證券投資信託基金專戶		400,000	1.37%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：

單位：新台幣元；仟股

項目		年度	108 年 (109 年分配)	109 年 (110 年分配)	110 年度截至 3 月 31 日止
每股市價	最 高		300	468	454.5
	最 低		103	142	328
	平 均		214.95	309.36	385.75
每股淨值	分 配 前		99.63	99.45	註 3
	分 配 後		91.63	88.45(註 1)	不適用(註 4)
每股盈餘	加權平均股數		27,901	28,521	註 3
	每 股 盈 餘		11.11	13.92(註 2)	註 3
每股股利	現 金 股 利		8	11	不適用(註 4)
	無償 配股	盈餘配股	0	0	不適用(註 4)
		資本公積配股	0	0	不適用(註 4)
	累積未付股利		0	0	0
投資報酬 分析	本益比		19.35	22.22	不適用(註 5)
	本利比		26.87	28.12	不適用(註 6)
	現金股利殖利率		3.72%	3.56%	不適用(註 7)

註 1：109 年分配後之每股淨值，係經董事會通過，將送 110 年 6 月 23 日股東常會討論之追溯調整後數字。

註 2：109 年每股盈餘為 13.92 元，盈餘分配係經董事會通過，將送 110 年 6 月 23 日股東常會討論。

註 3：截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成。

註 4：因 111 年方會決定 110 年股利數字，故不適用。

註 5：本益比=股價/每股盈餘，係以 110 年第一季之平均市價，除以第一季每股盈餘換算全年度計算而得，因截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成，故不適用。

註 6：本利比=市價/每股現金股利，因 111 年方會決定 110 年股利數字，故不適用。

註 7：現金股利殖利率=每股現金股利/每股股價，因 111 年方會決定 110 年股利數字，故不適用。

(六)公司股利政策及執行狀況：

1.公司章程所訂之股利政策：

本公司股東紅利分派得以現金或股票方式發放，惟股東現金紅利分派之比例以不低於股東紅利總額之百分之一為原則，惟此現金紅利分派比例仍得視當年度營運狀況調整之。

本公司所屬產業正處於成長階段，分派股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。

2.董事會最近五年度之股利政策：

本公司最近五年度(105~109 年)配息率分別為：63%、66%、84%、75%、81%，顧及股東權益報酬率及股本膨脹速度，本公司原則上股利分派之政策：(1)以現金為主，且考量股東權益，配息率均能(2)穩定維持在至少 50%以上，優於大多數上市櫃公司。

3.本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司 109 年盈餘分配案，業經 110 年 3 月 22 日第十屆第八次董事會中擬訂如下表所示，本案將送 110 年 6 月 23 日股東常會討論，俟股東常會決議通過，並經主管機關核准後(若無則免)，再由董事會另訂除息基準日及股利發放日。若僅發放現金股利，則由董事會授權董事長決定除息基準日等相關事宜。

一〇九年度盈餘分配表

項 目	金額	備 註
期初可供分配盈餘	576,910,413	
當年度-109 年稅後淨利	396,873,025	
加：精算(損)益列入保留盈餘	2,491,288	確定福利計畫精算利益
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	51,017,624	
當年度可供分配盈餘	450,381,937	
減：提列 10%法定盈餘公積	(45,038,194)	
截至 109 年可供分配盈餘	982,254,156	
分配項目：		
股東現金股利	321,376,165	每股現金 11 元
期末未分配盈餘	660,877,991	

(七)本年度擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響：

109 年度盈餘分配案不擬配發股東股票股利與員工股票酬勞，故並無對公司營運績效及每股盈餘造成影響。

另依有關準則規定，本公司尚無須公佈財務預測，故本項不適用。

(八)員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司當年度如有獲利，應提撥員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；並以當年度獲利數額，由董事會決議提撥董監酬勞；前開所稱獲利，係指稅前利益尚未扣除員工酬勞與董監酬勞。員工酬勞不得低於百分之七點五，董監酬勞不得高於百分之三。若尚有累積虧損時，應先保留彌補虧損數額，尚有餘額時再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

109 年度之員工酬勞、董監酬勞，均與 109 年度帳上估列數一致。本期之估列基礎，除依據公司章程之規定外，尚考量當年度產業狀況、公司營運情形，以及參考以前年度之實際配發金額。

109 年度不擬配發員工股票酬勞，故並無實際配發金額與估列數有差異之情形。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 決議以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額：

本公司 109 年員工酬勞及董事、監察人酬勞，業經 110 年 3 月 22 日第十屆第八次董事會中決議通過，員工酬勞現金 39,666,471 元及董監事酬勞 7,933,000 元。本案將送 110 年 6 月 23 日股東常會報告。

109 年度之員工酬勞、董監酬勞均與認列費用年度 109 年度帳上估列數一致。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本公司 109 年度之員工酬勞不擬配發股票，故不適用。

4. 前一年度(108 年度)員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 108 年員工酬勞及董事、監察人酬勞，業於 109 年 6 月 18 日股東常會報告，員工酬勞現金 31,145,489 元及董監事酬勞 6,232,000 元，實際配發情形與股東常會報告相同。

108 年度之員工酬勞、董監酬勞均與認列費用年度 108 年度帳上估列數一致。

108 年度未配發員工股票紅利，故並無實際發放數與帳上估列數產生差異之情形。

(九)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

(一)最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者，應揭露事項：無。

(二)最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者，應揭露執行情形及被併購或受讓公司之基本資料。辦理中之併購或受讓他公司股份發行新股應揭露執行情形及對股東權益之影響：無。

八、資金運用計畫執行情形：

(一)計畫內容：

1.截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者，應詳細說明前開各次發行或私募有價證券計畫內容，包括歷次變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因、變更前後效益及變更計畫提報股東會之日期，並應刊載輸入本會指定資訊申報網站之日期：本公司截至年報刊印日之前一季止，尚無發生計畫未完成，或計畫已完成但效益尚未顯現之情形，故本項不適用。

(二)執行情形：

- 1.本年度及截至年報刊印日之前一季止，各次發行或私募有價證券計畫之用途，逐項分析其執行情形及與原預計效益之比較：無。
- 2.本年度及截至年報刊印日之前一季止，各次發行或私募有價證券計畫執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明其原因、對股東權益之影響及改進計畫：無。
- 3.本年度及截至年報刊印日之前一季止，如為併購或受讓其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者，應就不動產、廠房及設備、營業收入、營業成本及營業利益等項目予以比較說明：無。
- 4.本年度及截至年報刊印日之前一季止，如為轉投資其他公司，應就該轉投資事業之營運情形、對公司投資損益之影響加以說明：無。
- 5.本年度及截至年報刊印日之前一季止，如為充實營運資金、償還債務者，應就流動資產、流動負債及負債總額之增減情形、利息支出、營業收入等科目及每股盈餘予以比較說明，並分析財務結構：無。

伍、營運概況

一、業務內容：

(一)業務範圍：

1.所營業務之主要內容：

半導體及積體電路製造設備之工程承包、製造、買賣及維修工程；半導體相關之機械安裝、電子零組件製造。

2.主要產品之營業比重：

服務項目	商品產值	109 年度	
		營業額(仟元)	營業比重(%)
機台設備產品		1,223,744	49.19
化學產品		746,690	30.02
維修服務及其它		436,343	17.54
軟體銷售及安裝		56,992	2.29
半導體及電子設備銷售代理		23,902	0.96
合 計		2,487,671	100.00

3.公司目前之商品(服務)項目：

A.機台設備產品：酸槽設備(Wet Station)、單晶片旋轉設備(Single Wafer Spin Processor)設備，依製程應用可分為清洗、顯影、蝕刻及去光阻...等；化學品調配供應系統(Chemical Supply System)等等。

B.化學產品：工業級、試藥級、電子級混酸（蝕刻液）、電鑄藥液等等。

C.維修服務及其他：半導體及積體電路製造設備之維修及其材料、零件之代理及買賣業務。

D.軟體銷售及安裝。

E.半導體及電子設備銷售代理。

4.計畫開發之新商品(服務)項目：

本公司秉持提供客戶客製化及高品質之產品為原則，108 及 109 年度主要目標仍以持續改善原有之 Wet Bench 與 Single Wafer Spin Processor(UFO)等設備產品為主。隨著 3D IC 構裝技術之發展，未來將發展功能達到與國外無電鍍鍍金設備商相同水準之 3D IC 無電鍍金屬化鍍製程設備；及整合型扇型封裝(InFO)；Square Fanout 封裝設備等。

主要發展方向如下：

研 發 項 目	用 途 說 明
3D IC 無電鍍金屬化鍍製程設備	化鍍 Ni, Pb, Au 及 Au。
製程設備新應用研發	因應客戶新製程所需，例如：Square Fanout UBM Etcher、Square Fanout RP Stripper、UFO 300 4CH Al/Ti UBM Etchin。

研 發 項 目	用 途 說 明
玻璃薄化設備/邊緣強化	採用濕式製程，同時去除玻璃兩面之特定厚度，以達玻璃減薄之需求；採用濕式製程，強化玻璃之邊緣。
LED 特殊製程設備	採用濕式製程，以高溫磷酸製程應用於上游磊晶製程需求為主。

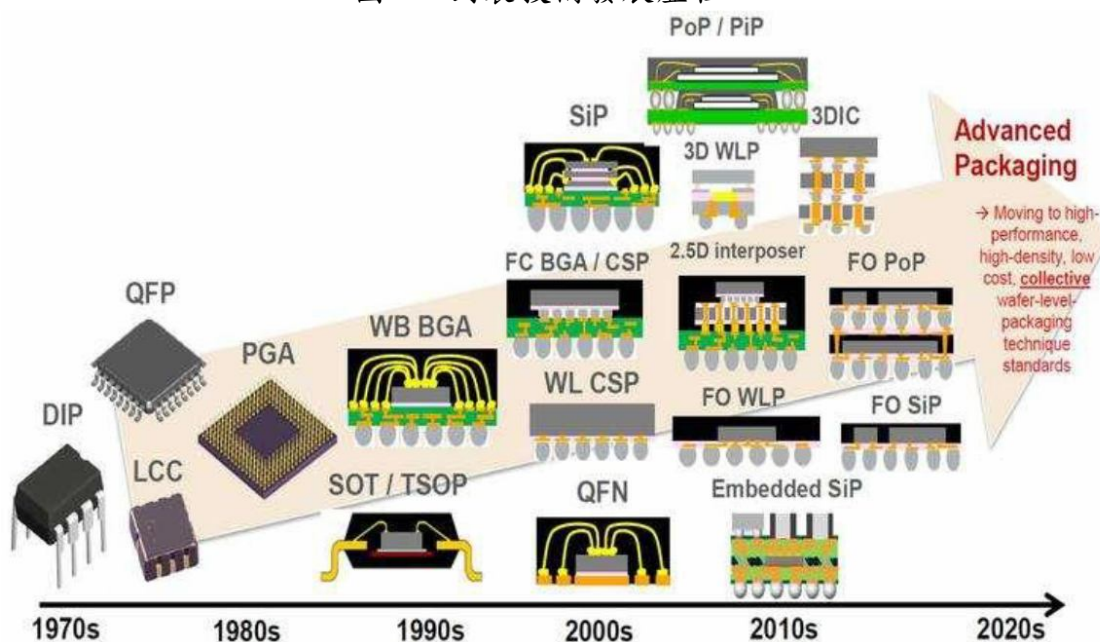
(二)產業概況：

1.產業之現況與發展：

(a)先進封裝技術漸成主流，帶來新製程設備商機

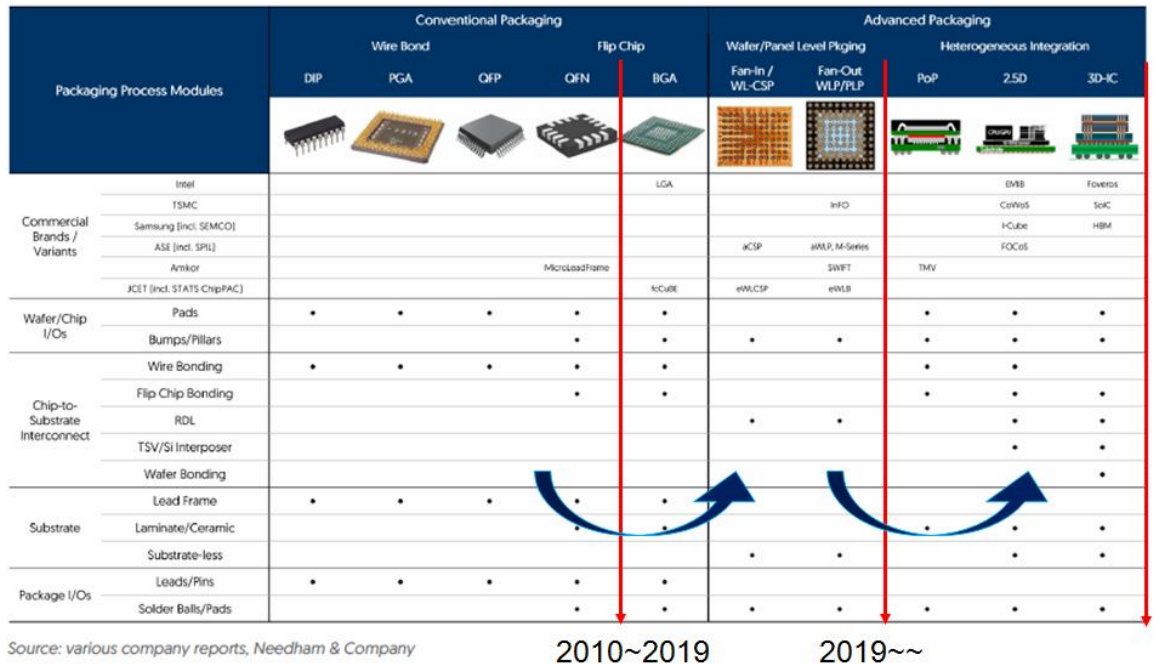
半導體產品在由二維向三維發展，從技術發展方向，半導體產品出現了系統級封裝(SiP)等新的封裝方式，從技術實現方法出現了覆晶(Flip Chip)，凸塊(Bumping)，晶圓級封裝(Wafer Level Package)，2.5D 封裝(interposer, RDL 等)，3D 封裝(TSV)...等先進封裝技術(圖 1、圖 2)。隨著摩爾定律的放緩，半導體行業逐漸步入後摩爾時代，SiP 的優勢在靈活性更高，更廣泛的兼容兼容性，成本更低，生產周期更短。面積小的產品，SiP 更有優勢，靈活性較高。以下就封裝技術面簡介之。

圖 1 封裝技術發展歷程-1



資料來源：Yole Developpement (2020/02)

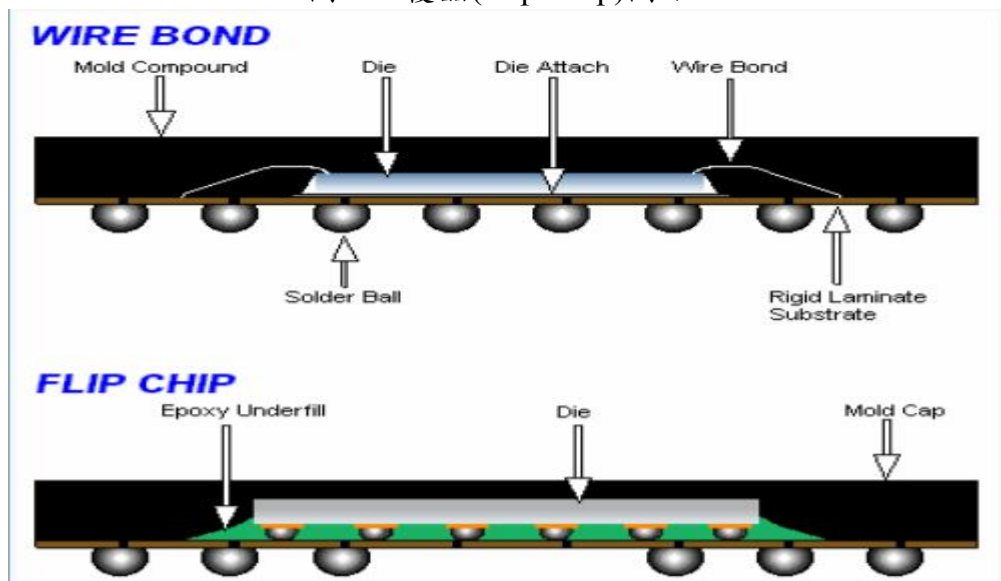
圖 2 封裝技術發展歷程-2



(a)-1 覆晶(Flip Chip) & 凸塊(Bumping)

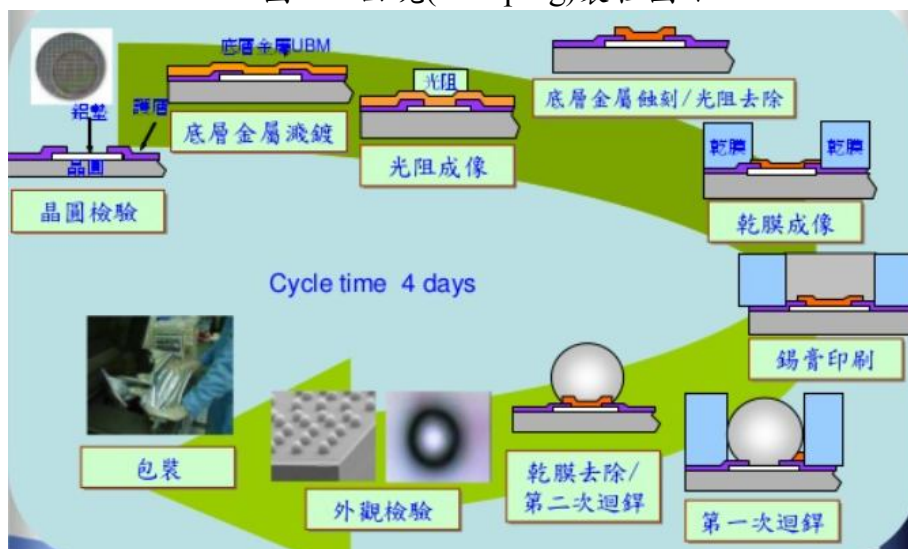
覆晶(Flip Chip)指的是晶片倒裝，以往的封裝技術都是將晶片的有源區面朝上，背對基板而貼後鍵合。而 Flip Chip 則將晶片有源區面對著基板，通過晶片上呈陣列排列的焊料凸點（Bumping）實現晶片與襯底的互聯。矽片直接以倒扣方式安裝到 PCB 從矽片向四周引出 I/O，互聯長度大大縮短，減小了 RC（Resistance-Capacitance）延遲，有效的提高了電性能（圖 3）。Flip Chip 的優勢主要在於以下幾點：小尺寸，功能增強（增加 I/O 數量），性能增強（互聯短），提高了可靠性（倒裝晶片可減少 2/3 的互聯引腳數），提高了散熱能力（晶片背面可以有效進行冷卻）。

圖 3 覆晶(Flip Chip)圖示



凸塊(Bumping)是一種新型的晶片與基板間電氣互聯的方式。可以通過小的球形導電材料實現，這種導電球體被稱為 Bump，製作導電球這一工序被稱為 Bumping。當黏有 Bump 的晶粒被覆晶(Flip Chip)並與基板對齊時，晶粒便很容易的實現了與基板 Pad(觸墊)的連接(圖 4)。相比傳統的引線連接，Flip-Chip 有著諸多的優勢，比如更小的封裝尺寸與更快的器件速度。

圖 4 凸塊(Bumping)製程圖示

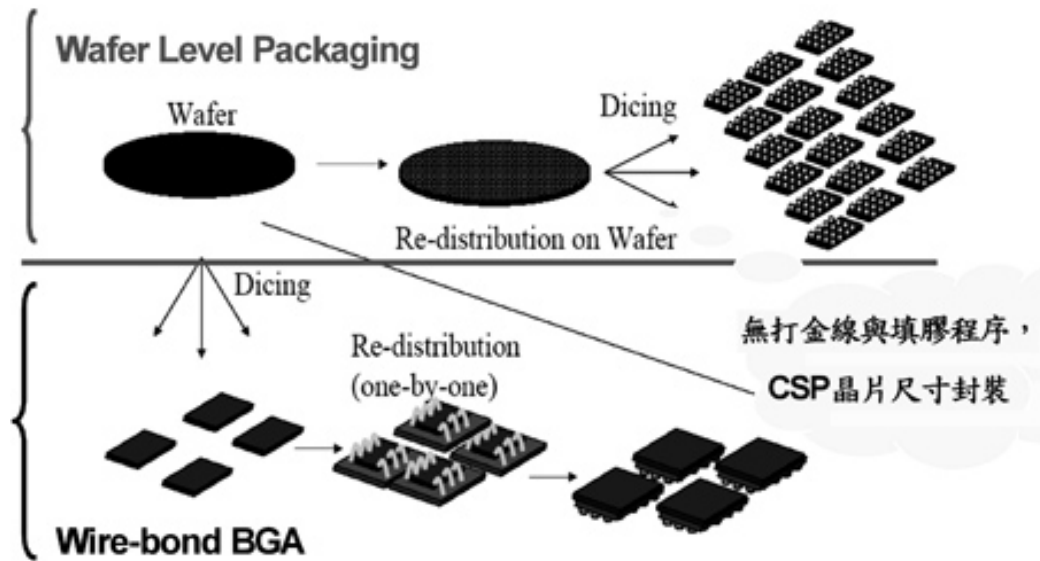


(a)-2 晶圓級封裝(Wafer-Level Package, WLP)

在傳統封裝概念中，晶圓是先被切割成小的晶粒，之後再進行連接和塑封，而晶圓級封裝(Wafer-Level Package, WLP)工序恰好相反，晶圓級封裝將晶粒在被切割前封裝完成，保護層將會被附著在晶圓的正面或是背面，電路連接在切割前已經完成。晶圓級封裝可滿足電子產品對功耗、成本與輕薄短小等多項要求，尤其在微機電元件應用日益普及下，更將成為晶圓級封裝產業成長的主要推手，因而吸引專業晶圓製造與封測代工業者大舉投入。

所謂晶圓級封裝是直接在晶圓上進行全部或大多數的封裝測試程序後，再進行切割(Singulation)製成單顆元件(圖 5)，因此毋須經過打線與填膠程序，而且封裝後的晶片尺寸等同晶粒原來大小，因此也稱為晶圓級晶片尺寸封裝(Wafer-Level Chip Scale Package, WLCSP)。

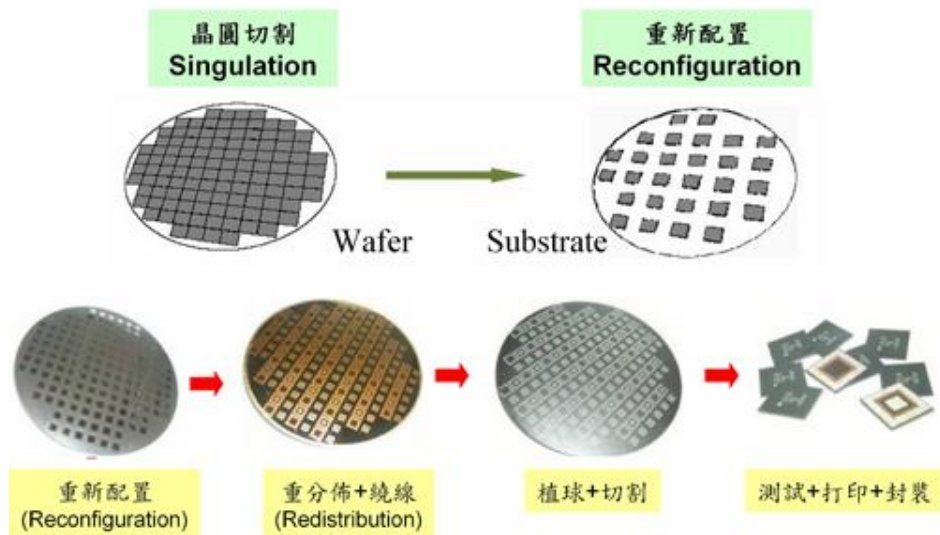
圖 5 晶圓級封裝製造流程



資料來源：Georgia Institute of Technology，IBT Research 整理

理論上，晶圓級封裝由於不需要中介層(Interposer)、填充物(Underfill)與導線架，並且省略黏晶、打線等製程，因此能夠大幅減少材料以及人工成本；除此之外，WLP 大多採用重新分布(Redistribution)與凸塊(Bumping)技術(圖 6)作為 I/O 繞線手段，因此 WLP 具有較小的封裝尺寸與較佳電性表現的優勢，目前多見於強調輕薄短小特性的可攜式電子產品 IC 封裝應用。

圖 6 英飛凌擴散型晶圓級封裝製造流程



資料來源：Infineon，IBT Research 整理

以 WLP 初期發展而言，WLP 的主要應用範圍為類比 IC、手機放大器(PA)與射頻前端模組(RF Front-end)，以及 CMOS 影像感測器(CMOS Image Sensor, CIS)等各式半導體產品(表 1)，其需求主要來自於可攜式產品對輕薄短小特性的要求，而部分 NOR Flash/SRAM 也採用 WLP 封裝。此外，基於電氣性能考量，DDR III 也考量採用 WLP 或覆晶(Flip Chip)封裝，惟

目前聯合電子工程設計發展協會(JEDEC)仍未制定最終規格，雖然海力士(Hynix)於 2007 年 1 月曾經發表採 WLP 封裝的 2Gb DDR II，然而三星(Samsung)與爾必達(Elpida)等國際大廠實際銷售產品仍都為細密球型網陣列封裝(Fine-pitch Ball Grid Array, FBGA)。至於系統級封裝(SiP)應用則屬於長期發展目標。

表 1 各種封裝型態比較

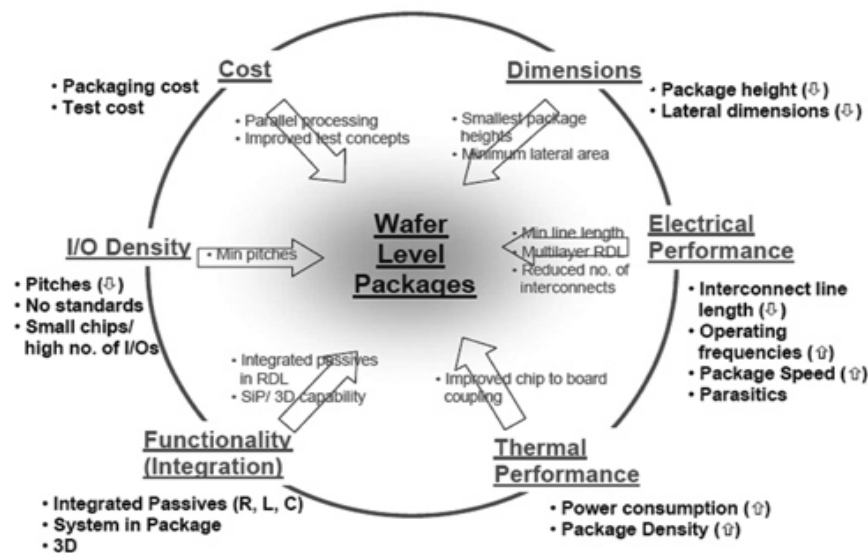


Family	QFP	BGA	FC-BGA	WLP
1st level IC	wire bond	wire bond	solder ball	none
interposer 中介層	lead frame	substrate	substrate	thin-film
2nd level IC	lead frame	solder ball	solder ball	solder ball
面積 # Si : # PCB	<1:3	<1:2	<1:1.5	1:1
高度 ⌀ Pck : ⌀ Si (X)	>3,5	>2,5	>2,5	≤2

資料來源：Infineon，IBT Research 整理

WLP 封裝優點(圖 7)包括成本低、散熱佳、電性優良、信賴度高，且為晶片尺寸型封裝，尺寸與厚度皆可達到更小要求等。WLP 封裝另一項優勢在於封裝製程採取整批作業，因此晶圓尺寸越大，批次封裝數量越多，成本能壓得更低，符合晶圓廠由 8 吋轉進 12 吋發展趨勢，WLP 專業封測廠利潤空間也可提高。

圖 7 晶圓級封裝主要優點



資料來源：Infineon，IBT Research 整理

早期 WLP 主要廠商包括具有一貫化整合製造優勢的整合元件製造商(IDM)，如意法半導體(STMicroelectronics)，以及具有凸塊技術與產能優勢的封測委外代工廠(OSAT)，如日月光，以及聚焦 WLP 技術的專業封測廠

如台積電與豪威(OmniVision)合資的精材科技，最大股東為 SST 的育需科技(2012 年群豐科技轉投資之公司群成科技與育需科技合併，育需為消滅公司)，以及長江電子(長江電子另外亦與新加坡 APS 合資成立江陰長電先進封裝)與 IPAC(Integrated Packaging Assembly Corporation)等廠商。

根據工研院 IEK 產業分析整理之資料，由江蘇長江電子和新加坡 APS 合資的江陰長電先進封裝(已於 2015 年合併星科金朋(新加坡 STATS ChipPAC))，已擁有 12 吋晶圓凸塊量產能力，而除了江陰長電外，目前全球具備 12 吋晶圓錫銀銅凸塊產能的廠商有數家，台積電產能位居第一，日月光、矽品、艾克爾(Amkor)、南茂、台星科(已於 2015 年合併星科金朋在台子公司台灣星科)和耐派斯(Nepes)(韓國)，都具備 12 吋晶圓凸塊量產能力。

由於 IDM 對於 WLP 封裝中電鍍與薄膜等製程關鍵技術的掌握度，要比半導體專業委外封測廠商來得成熟，因此目前 WLP 封裝市場多半是以 IDM 業者為主。

然而，半導體產業鏈中，晶圓製造與封測的界線日趨模糊，技術進步與產品架構的演進使 IC 設計、IC 製造與 IC 封測等不同領域廠商競合的模式將更趨明顯且重要，而 WLP 封裝技術正是 IC 製造與封測領域界線模糊的代表性標的。目前看來 IDM 大廠挾其整合優勢在 WLP 市場居於領先，但隨著晶圓代工與 IC 設計業者競逐此市場，加上專業委外封測大廠的投入，未來 WLP 產業的發展將更為蓬勃，預期將帶動更大的半導體設備需求。

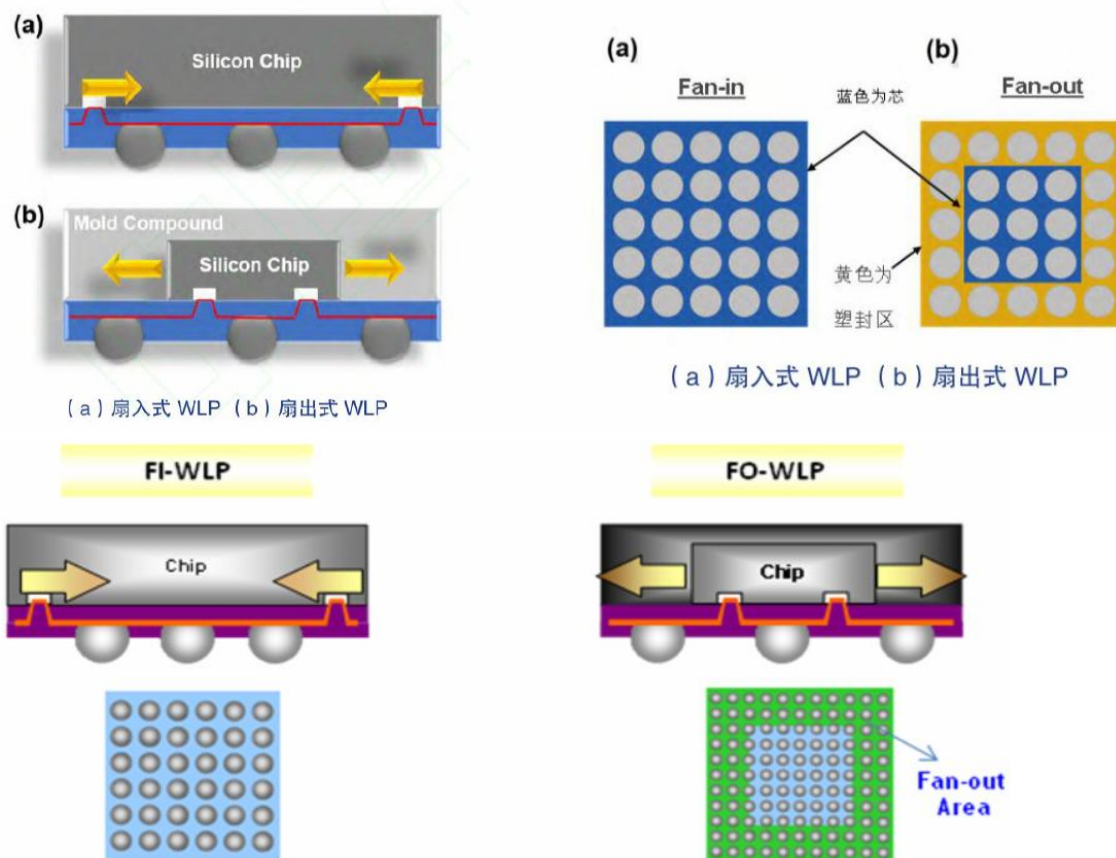
另一方面，隨著行動通訊市場與雲端運算發展，IC 對高速運算與低電流的需求與日俱增，隨著晶片設計益趨複雜，其所搭配的封裝製程難度也同步提高，IEK 認為高階覆晶封裝(Flip Chip)在近年的成長性將大於銅打線封裝，大型封測廠近年不約而同地將資本支出重點放在建置高階的覆晶封裝產能。IEK 並表示，由於覆晶封裝技術門檻高，投資金額大，國際整合元件廠(IDM)和二、三線封測廠已無力投資，前 5 大封測廠在近年進入覆晶封裝的資本支出競賽，包括日月光、Amkor、矽品和星科金朋、力成等主要封測廠，都已在 2012 年下半年開始正式提升高階封裝產能。IEK 指出，NVIDIA、超微(AMD)和高通(Qualcomm)等晶片大廠皆相繼採用 28 奈米以下製程，以提供給市場更高效能、更省電的晶片，各家有能力提供高階覆晶封裝的一線封測廠，亦皆已獲得客戶端明確的要求，希望擴大建置高階覆晶封裝產能，封測廠資本支出動向均同步出現聚焦覆晶封裝的鮮明趨勢。

(a)-3 扇入型封裝(Fan-In Wafer-Level Package, FIWLP)、扇外型封裝(Fan-Out Wafer-Level Package, FOWLP)

扇入型晶圓級封裝，也就是傳統的晶圓級封裝，切割晶粒在最後進行，適用於低引腳數的積體電路。隨著積體電路信號輸出的引腳數目的增加，焊錫球的尺寸也就變得越來越嚴格，PCB 對積體電路封裝後尺寸以及信號輸出接腳位路的調整需求得不到滿足，因此衍生出了扇外型晶圓級封裝

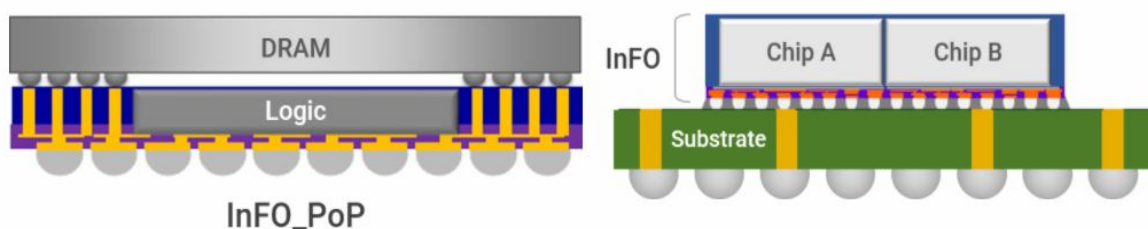
(圖 8)，扇入晶圓級封裝的特徵是封裝尺寸與晶粒同大小。扇外型晶圓級封裝，開始就將晶粒切割，再重布在一塊新的人工模塑晶圓上。它的優勢在於減小了封裝的厚度，增大了扇出(更多的 I/O 接口)，獲得了更優異的電學性質及更好的耐熱表現。

圖 8 扇入型與扇外型對比圖



台積電於 2014 年 5 月推出 InFo(Integrated Fan-out，整合型扇型封裝)製程(圖 9)，進軍跨入 2.5/3D IC 製造封測市場，導入量大產品，InFO 優勢在於可省去載板，因而成本可較傳統的封裝降低約 2~3 成以上，大幅節省晶片封裝的成本，並可應用於手機 AP 或其他 RF、電源管理 IC 等大宗應用市場。台積電的 InFo 能讓封裝後的晶片變得較薄、效能又較佳，能一舉拉高技術門檻，與三星等競爭對手做出區隔，有助於台積電取得美系手機公司下世代應用處理器及其他高階智慧手機處理器的多數訂單。

圖 9 InFO(台積電)-InFO_PoP & InFO_oS



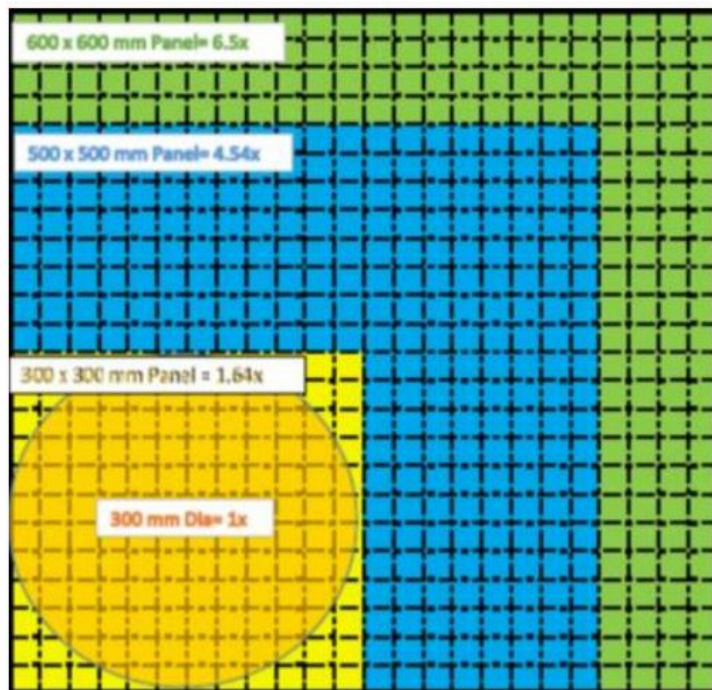
FIWLP 與 FOWLP 用途不同，均為今後的主流封裝手段。FIWLP 在模擬和混合信號晶片中用途最廣，其次是無線互聯，CMOS 圖像傳感器也

採用 FIWLP 技術封裝。FOWLP 將主要用於移動設備的處理器晶片中。根據 Yole 的預測，2018 年以前 FOWLP 的主要驅動為蘋果智慧型手機的處理器晶片，2018 年以後的 FOWLP 的主要驅動除了其他安卓手機處理器的增長，主要是高密度 FOWLP 在其他處理晶片的應用，如 AI、機器學習、物聯網等領域。

(a)-4 面板級封裝(Panel-Level Package, PLP)

面板級封裝方法與 FOWLP 類似，只不過將晶粒重組於更大的矩形面板上，而不是圓形的晶圓。更大的面積意味著節約更多的成本，更高的封裝效率。而且切割的晶粒為方形，晶圓封裝會導致邊角面積的浪費，矩形面板恰恰解決了浪費問題。但也對光刻及對準提出了更高的要求。以主流 12"/300mm 晶圓與 300mm 正方形玻璃為載具做扇出型封裝，方型載具產量為晶圓的 1.4 倍；再以主流 12" 晶圓與主流方形載具尺寸約 600mm 相比，方形載具產量為晶圓的 5.7 倍(圖 10)。

圖 10 面板級封裝示意圖



隨著人工智慧(AI)、物聯網(IoT)和 5G 的興起，帶動了大量的 IC 晶片需求，而許多應用所需的 Sensor 感測器 IC 對於線寬/線距要求較低，加上終端產品晶片同質、異質整合需求提升，使得扇出型持續朝多晶片大封裝尺寸邁進，而扇出型晶圓級工藝面積使用率較低(晶圓面積使用率 95%)，在加速生產週期及降低成本考慮下，封裝技術開發方向已由 FOWLP 轉向可在比 300 毫米晶圓更大面積的面板(方形面積的載具)上進行的 FOPLP。目前分為兩大技術：(1)採用 FPD 製程設備為基礎。(2)採用 PCB 載板製程為基礎。期望藉由 FOPLP 的技術研發，帶來更高的生產效益及成本競爭力。

(a)-5 先進封裝產業競爭趨勢

根據美國喬治城大學安全與新興技術中心(CSET)的調查，過去 3 個世代，台積電做出的晶粒平均價格都大幅下滑，但是最新的 5 奈米製程製造出的晶片，平均價格不降反升，比前一代多出了 5 美元。5 奈米製程投資成本較前一代增加近 1 倍，要製造 5 奈米晶片，不但要用到昂貴的 EUV(極紫外光)設備，而且每一片 5 奈米晶片要用到多達 14 道 EUV 光罩加工。因此，為了讓未來晶片的性能繼續提升，價格持續降低，台積電等半導體廠早已研發晶圓級先進封裝；因為，如果整顆 IC 都用最先進的製程製造不划算，新的方法是，只有晶片最重要的部分用最先進製程製造，其他次要功能，像電源管理、天線元件，則沿用舊的製程，透過封裝技術，整合成一顆晶片。台積電董事長劉德音 2020 年就公開表示，微縮加 3D IC 技術，未來能讓每單位運算密度每 2 年成長 2 倍。

2018 年日月光與矽品合併成立日月光投控，要結合兩家公司的能量，展現全球封測龍頭的領先優勢，好不容易待中國商務部同意兩家公司合併，通過了整合的最後一道關卡，卻在產業、市場變遷劇烈的 2020 年下半年，迎來三大新挑戰。首先，先進製程快速發展，讓晶片製造商台積電迅速搶進先進封裝市場，過往台積電、日月光是上下游關係，台積電完成晶片製造與上游封裝後，交由日月光進行下游封裝測試；然而隨著晶片先進製程對先進封裝的需求愈來愈高，台積電、英特爾(Intel)、三星等晶片製造業者近年皆跨入先進封裝技術研發，搶進傳統封測廠的生意地盤。其次，從市場衝擊面觀察，中美貿易戰讓日月光出貨華為受限，市場估算，華為占日月光近一成營收，無法供貨華為將使訂單出現缺口，該缺口能否迅速補上？對營運帶來多大的影響？市場也在持續觀察。最後，新冠肺炎疫情未平，雖全球積極布建 5G，但是全球景氣疲弱，恐影響發展表現。

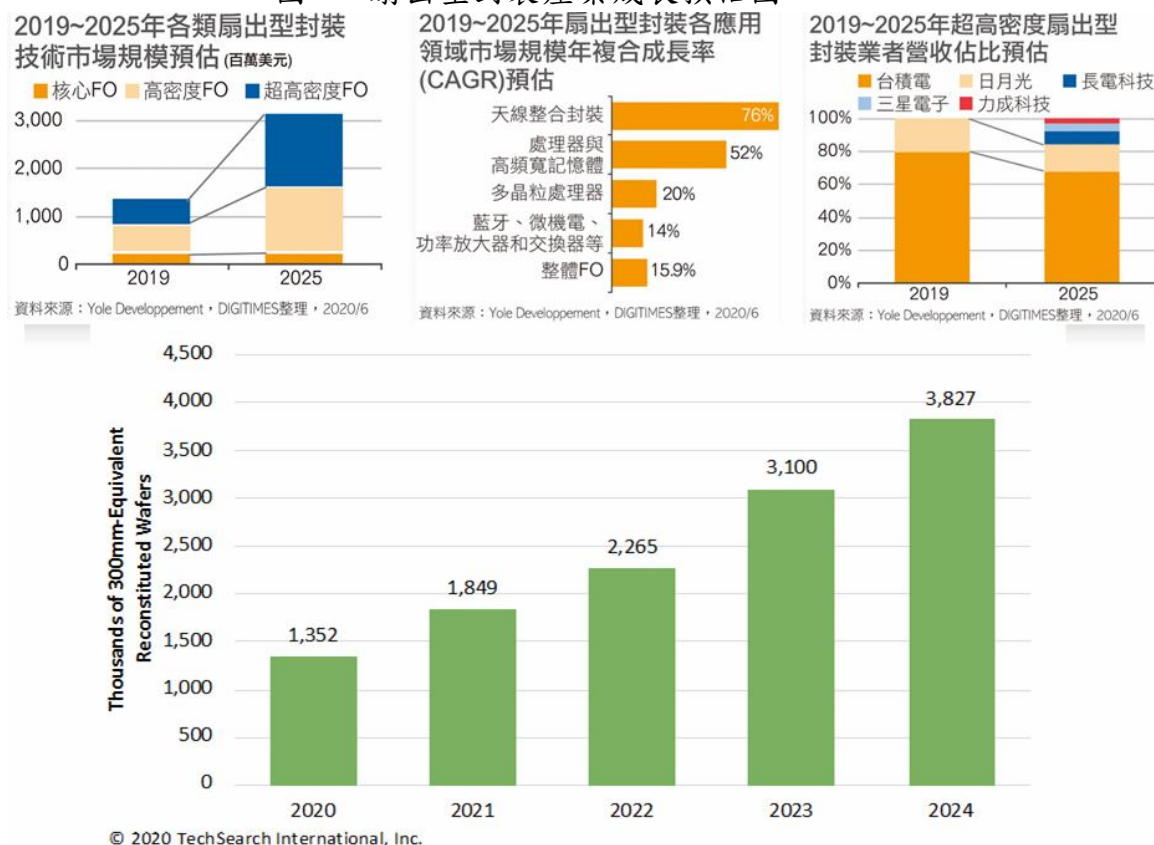
晶片製造商跨領域布局，不免讓市場議論起傳統封測廠面臨的威脅，特別是全球封測龍頭日月光，恐在高階產品訂單的競爭加劇。不過，日月光投控多次強調，日月光與台積電在封裝技術與客戶上有所差異，不完全是在同一個領域。拓璞產業研究院觀察目前晶片製造商與傳統封測廠的競爭，主要是在 HPC(高效能運算)晶片封裝，HPC 主要是應用於資料中心、雲端設備的高效能運算系統。由於需要具備高運算能力並兼顧低功耗，從前段製程到後段封裝，都力求以先進技術改善。在這項需求下，晶片製造商、特別是台積電，很容易成為 HPC 晶片客戶的首選，會選擇台積電，是因為它有製造加封裝的一條龍服務。HPC 晶片幾乎都選用先進製程製造，封裝上必須考慮與先進製程技術搭配，藉此提升封裝後的良率表現。資策會進一步解釋，以 HPC 晶片來講，需要很精密的接合，擁有先進製程的台積電，完整掌握晶片生產架構，在後段封裝更容易取得較佳的精準度表現，這對缺乏先進製程的傳統封裝廠而言，顯然需要額外學習成本。

不過，市場的競爭總是一體兩面，看似晶片製造商跨入了先進封測技術領域，對封測市場帶來影響，但是，當台積電擴大 HPC 市場的發展後，超微半導體(AMD)、輝達(NVIDIA)、英特爾等晶片設計商的布局加速，也讓日月光、矽品等傳統封測廠有了更大的分食機會。

美國知名市場調查公司 Prismark 資深顧問 Brandon Prior，接受財訊採訪時指出，全球封裝產業，不包含測試，市場規模為 570 億美元(約新台幣 1.61 兆元)；2019 年到 2024 年，全球封裝市場每年會有 5.6%複合成長率，「封裝會比整個半導體市場成長速度還快」。若只看先進封裝，目前市場規模約為 57 億美元，其中，覆晶封裝會以半導體市場的 2 倍速度成長；此外，高密度扇外型封裝(屬於晶圓級封裝)也會翻倍成長。他認為，即使是成熟的打線封裝製程，需求也會增加，「但年成長率約在 5%以下」；同時短期內大部分半導體產品不會有供過於求的狀況。AI 和 5G 對運算能力的需求極為巨大，而且半導體製程微縮愈來愈困難，成本愈來愈高。

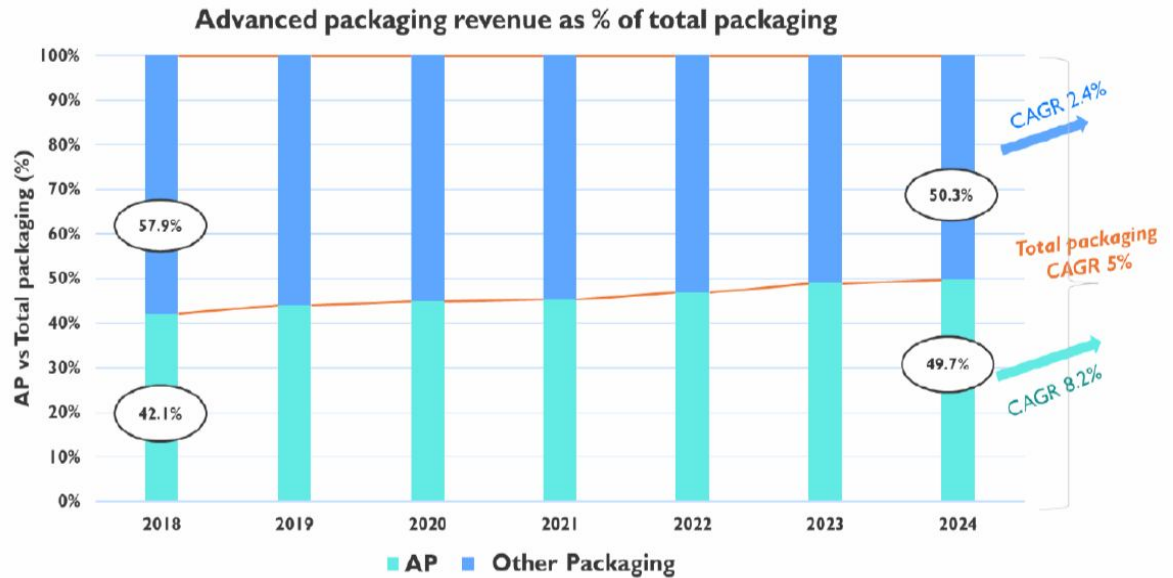
另外，隨著產業發展與市場需求，Yole Developpement 預估至 2025 年扇外型晶圓級封裝將逐年成長(圖 11)。全球半導體先進封裝於 2024 年將達 49.7%(圖 12)。

圖 11 扇外型封裝產業成長預估圖



資料來源：Yole Developpement, Digitimes 整理、TechSearch International (2020/06)

圖 12 先進封裝(AP)成長預估圖



Total packaging market grows by 5% whereas AP market grows by 8.2%

資料來源：Yole Developpement(2020/02)

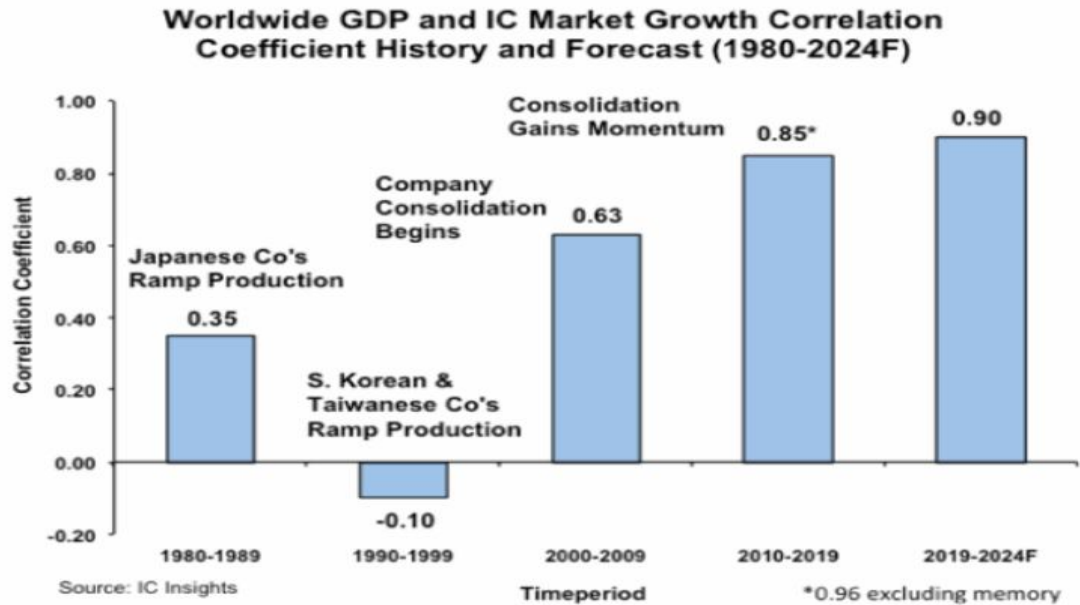
(b)半導體產業近年受美國次貸危機、歐債風暴、日本 311 地震與全球金融海嘯等影響全球 GDP 成長率事件，影響設備需求

2008 年迄今受到美國次貸危機、歐債風暴等金融風暴及日本 311 地震之影響，導致我國半導體大廠在終端消費市場需求減少之情形下，紛紛採取減少產能減少庫存損失，需多廠商財務出現嚴重虧損及流動資金不足，甚至極需要政府進行財務舒困。從總體經濟發展情形觀察，當時根據市場研究機構 IC Insights 歷史資料顯示，基於全球經濟景氣衰弱，調降了對 2011 年半導體產業營收預測數據。該機構將原先對全球半導體產業 2011 年營收成長率的 10%預測值，下修為 5%；此外將 2011 年 IC 出貨成長率由原先預測的 10%，下修為 4%。其報告列舉了一連串引發經濟景氣衰退的事件，包括 311 日本大地震、中東政局動盪、美國的天災以及歐、美政府債務危機等等；這些事件讓 2011 上半年的全球經濟成長率與前一年同期相較明顯趨緩，也拖累了電子與半導體市場的成長。全球國內生產毛額 (GDP)成長率在 2010 年達到 4.3%之後，已經開始下滑，但 IC Insights 仍表示，全球 GDP 成長率在 2012 年下半年開始好轉，主要是因為日本震後的投資需求，以及美國經濟景氣轉強。整體而言，歐、美、日等先進國家的 GDP 比重就佔了全球的一半左右，經濟要復甦還是要靠其來帶動。在新興市場與開發中國家方面，大陸與印度是經濟成長率較高的地區，讓廠商有開發新市場的機會。

IC Insights 為 2020 年版《McClean Report》全球市場 IC 市場分析，顯示 IC 市場在 2019 年下降了 15%之後增長。現隨著 COVID-19 病毒 2019 年底的迅速爆發，造成 2020 年第一季突然發生了巨大變化，先由中國擴散到亞洲、再到歐美、東南亞等地區，從 2020 年 3 月開始幾乎癱瘓了所

有國家及全球市場。根據 IC Insights 長期研究，於 2020 年初針對 IC 市場成長率與全球 GDP 成長之間的相關性進行了分析。其觀察到，2019 年全球 GDP 成長與 IC 市場成長之間呈現緊密的相關性。自 2019 年年中以來，市場明顯出現好轉的跡象。由於對 2020 年衰退的擔憂已經消退，激勵全球股價也正逐步上漲，債券收益率也上升。隨著美中貿易戰的停戰，多少都幫助了全球經濟的走向。在 2010 至 2019 年的時間範圍內，全球 GDP 成長與 IC 市場成長之間的相關係數達到 0.85(圖 13) (如果剔除掉 2017 年和 2018 年的記憶體市場的影響，係數更可達 0.96)，鑑於完全正相關係數為 1.0，因此 0.85 這一數字呈現出 GDP 與 IC 市場呈現很高的關聯度。IC Insights 發現，在此時期之前的三十年中，2000 年至 2009 年的相關係數為 0.63，1990 年至 1999 年甚至呈現負相關的-0.10，也就是那個時期 IC 市場與全球 GDP 成長完全沒有相關。IC Insights 認為，愈來愈多的併購活動導致 IC 製造商和供應商的規模愈來愈龐大，廠商數愈來愈少，這是整體供應基礎的重大變化之一，這也說明了半導體產業正逐步走向成熟，並有助於促進全球 GDP 成長與 IC 市場成長之間的產生緊密聯繫。此外，全球 GDP 成長與 IC 市場成長之間有更好的相關性的另一個原因是，消費者驅動的 IC 市場發展不斷的快速發展。IC Insights 認為，在 20 年前，大約 60% 的 IC 市場是由商業應用所驅動，而 40% 是由消費性應用所驅動，但是如今這些比例已經被逆轉了。一旦更加以消費者為導向的環境推動電子系統銷售之時，推動 IC 市場成長的情況就與全球經濟的關聯度呈現高度相關。例如：近年來，智慧型手機、穿戴式裝置、遊戲機、智慧音箱、智慧家庭等都是屬於消費性相關程度較高的產業，如果全球經濟的健康狀況愈佳，消費者購買力就會愈強，當然就會帶動 IC 市場的成長。未來在全球 GDP 維持健康水準之下，隨著人工智慧、物聯網、區塊鏈、電動車、智慧機器人等技術應用進一步普及到消費性市場之上，半導體市場的需求有望於 2021 年進一步提升。2020 年全球疫情大流行加速數位轉型，帶動 IC 產品銷售市況。預估 2020 年全球 33 個主要 IC 產品類別中，將有 21 個產品別營收可望出現正成長，其中 NAND Flash 估營收年增幅最高、可達 25%，手機應用微處理器(MPU)年增預估可達 24%。整體年營收方面，IC Insights 預估 2020 年 DRAM 總營收可達逾 652 億美元為最高，NAND 估約 552 億美元居次，顯示 2020 年記憶體銷售為各主要 IC 產品別中最大贏家。預估 DRAM 及 NAND 在 2020 全年合計營收，可達 1,204 億美元規模。

圖 13 全球 GDP 與 IC 產業增長相關係數



資料來源：IC Insights (2020/01)

國際貨幣基金 (IMF) 預估 2020 年全球經濟成長率為 -4.4%。然而，全球經濟在 2020 年轉為線上辦公與購物，進而帶動特定電子產品呈現正成長態勢。其中電腦類產品市場需求熱絡，在 2020 年較 2019 年同期呈現正成長趨勢。在終端電子產品帶動下，進而也拉升全球半導體市場正成長態勢。世界半導體貿易統計協會 (WSTS) 統計，2020 年第三季全球半導體市場銷售值為 1,136 億美元，較去年同期(2019Q3)成長 5.8%；銷售量達 2,491 億顆，較去年同期(2019Q3)成長 3.3%。WSTS 預估 2020 年全球半導體市場可達 4,260 億美元。全球半導體產業營收從 8 月以來，呈現逐步走揚態勢。據美國半導體產業協會(SIA)調查，10 月全球半導體整體營收來到 390 億美元，不僅是 2020 年以來整體月營收最高月份，10 月營收的 6% 年增幅也是 3 月以來最高，顯示全球半導體產業銷售市況從 2020 年下半年後疫情時代以來逐步回溫跡象。展望 2021 年，預估隨著對抗疫情的疫苗問世，可望帶動全球 GDP 成長率強勁反彈(表 2)，並可望帶動 2021 年 IC 市場迎來雙位數成長幅度。

表 2 全球區域型 GDP

Worldwide GDP Breakdown (2019-2021F)									
Country/Region	2019 GDP Growth %	2019 GDP (\$ Trillions)	2019 (% of Total)	2020F GDP Growth %	2020F GDP (\$ Trillions)	2020F (% of Total)	2021F GDP Growth %	2021F GDP (\$ Trillions)	2021F (% of Total)
High Income Countries/Region									
U.S.	2.3%	19.03	21.8%	-4.0%	18.27	21.9%	4.0%	19.00	21.7%
Eurozone	1.1%	13.43	15.4%	-8.0%	12.36	14.8%	5.0%	12.97	14.8%
Japan	1.0%	6.38	7.3%	-5.1%	6.05	7.3%	1.5%	6.15	7.0%
U.K.	1.2%	2.82	3.2%	-10.0%	2.54	3.0%	7.0%	2.72	3.1%
Canada	1.6%	2.03	2.3%	-5.7%	1.91	2.3%	4.1%	1.99	2.3%
Other	1.6%	12.88	14.7%	-4.5%	12.30	14.7%	5.0%	12.92	14.8%
Total High Income	1.6%	56.57	64.7%	-5.5%	53.43	64.0%	4.3%	55.74	63.7%
Developing Countries									
	3.9%	30.85	35.3%	-2.5%	30.08	36.0%	5.7%	31.79	36.3%
Worldwide Total	2.4%	87.42	100.0%	-4.5%	83.51	100.0%	4.8%	87.54	100.0%
China*	6.1%	13.14	15.0%	2.4%	13.46	16.1%	7.5%	14.46	16.5%
India*	5.0%	2.90	3.3%	-9.0%	2.64	3.2%	8.0%	2.85	3.3%
Brazil*	1.1%	2.25	2.6%	-5.3%	2.13	2.6%	3.5%	2.21	2.5%
*Included in Developing Countries									
Source: World Bank, IMF, IC Insights									

資料來源：IMF, IC Insights (2020/11)

(c) 半導體設備業未來發展

根據資策會產業情報研究所（MIC）觀測全球半導體產業趨勢，針對 2020 年資訊電子產業動態，從總體環境、生產布局切入，並觀測產業鏈上中下游動態，提出五大關鍵發展趨勢，協助臺灣業界及早布局與進行策略規劃。產業顧問楊中傑表示，2020 年總體環境須關注中國大陸十四五布局與半導體大基金二期加速投資，逐漸對臺灣半導體次產業形成威脅，另外以及貿易戰帶來臺廠關鍵地位提升的契機。針對產業鏈上中下游動態，有五大趨勢值得關注，包含：5G 應用帶動半導體市場與技術需求、串流服務與邊緣運算推動微型化雲服務資料中心、彈性化邊緣運算架構、工業數據即服務，與 AI 技術導入醫療輔助系統。

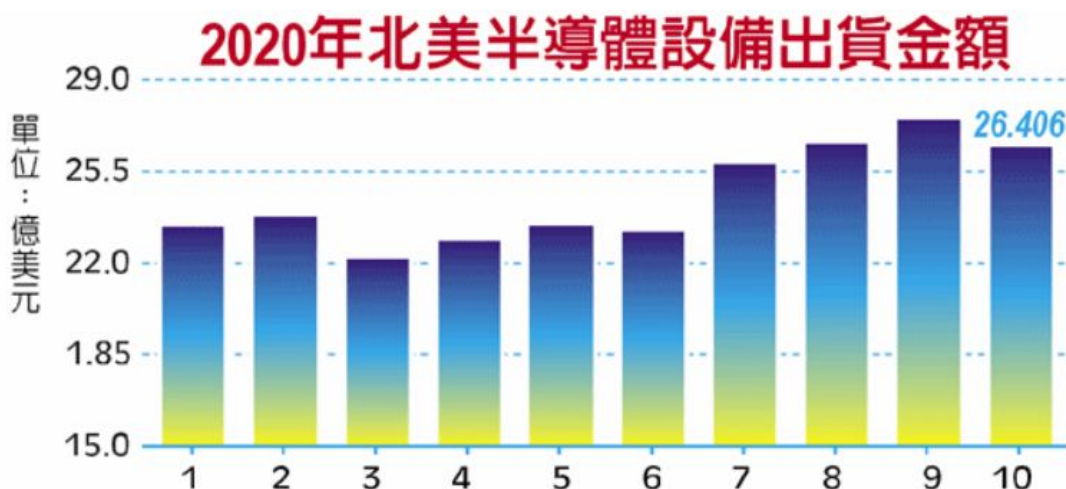
資策會 MIC 觀測，中國大陸面臨內外多重壓力，刺激經濟措施雖持續但將更為謹慎，其對內加大半導體布局，透過 AI、5G 應用推動製造業轉型升級，同時促進平台、共享與體驗經濟來提升內需消費。半導體大基金二期將加速投資，未來透過直接入股，對積體電路 IC 產業鏈的企業給予財政支持或協助購併國際大廠，投資領域包含 IC 設計、製造、記憶體、封裝測試、設備材料等產業鏈。產業顧問楊中傑指出，中國大陸占據內需市場優勢，以市場換技術、換投資的方式積極發展本土半導體產業，加上半導體產業投資基金運作，逐漸對臺灣 IC 設計、製造與封測等次產業構成威脅。

工研院產業科技國際策略發展所分析師邱琬雯指出，AIoT 與 5G 應用是半導體另一高峰，隨著未來萬物聯網的世代來臨，將會有更多的終端產品需求，如 5G 手機、穿戴式產品、汽車電子、AI 高效能運算等都將引領下一波半導體技術的進化，同時也帶動相關的半導體製程設備成長。5G 通訊是演進技術，到 2024 年約有 15 億使用者，商機自然可期，而 5G 手機 IC 將會遇到系統單晶片整合的挑戰，同時也會衍生出系統封裝（System

in Package，SiP）的相關商機。SiP 為 5G 行動通訊 RF 前端重要的封裝方式，以目前手機數據晶片及前端射頻模組的設計，無法將 RF 及 PA、濾波器（Filters）、低雜訊放大器（LNA）、天線交換器（Switch）等晶片核心，用同一種半導體晶圓製程生產，可將異質晶片整合在同一封裝的 SiP 封裝技術，就成為 5G 晶片市場的首選。

工研院 2020 年中上修台灣半導體今年產值估約年增 4%到 5.7%，優於全球平均水準，產值可達 2.8 兆元規模。8 月間，台灣半導體產業協會（TSIA）委託工研院研究，2 度上修 2020 年台灣半導體產業今年將較 2019 年成長 12.6%，成長幅度超越全球，後續又再度 3 修。工研院指出，世界半導體貿易統計組織（WSTS）統計全球半導體市場，2019 年為 4,123 億美元，年衰退 12.0%；2020 年全球因疫情衝擊全球經濟脈動，WSTS 對 2020 年全球半導體市場預估反倒樂觀預測將正成長 3.3%、全球半導體市場產值將達 4,260 億美元。參照截至 2020 年 10 月份之北美半導體設備出貨金額可見一斑(圖 14)，業界看好半導體產業積極擴張趨勢會延續到 2021 年，SEMI 同樣預估 2021 年全球半導體廠資本支出將改寫新高。

圖 14 2020 年全球半導體設備產值預估



資料來源：SEMI（2020/11）；工商時報整理

(d)後新冠肺炎時期景氣復甦帶動 2020 年以後半導體產值之增長

SEMI(國際半導體產業協會)全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸於 2020 年初表示，從美國消費性電子展（CES 2020）可看出智慧汽車、智聯網、數位健康是產業發展三大趨勢，也是半導體產業今年亮點。近期雖然中國大陸爆發新冠肺炎，對全球科技產業帶來許多不確定性，但 SEMI 看好一旦疫情獲得控制則需求會強勁回升，半導體市場下半年將復甦轉強。曹世綸表示，SEMI 近幾年來加強跨產業合作，包括致力串聯汽車上下游產業鏈，開創半導體智慧運輸新藍海，透過軟性混合電子、智慧醫療與智慧數據來橫向拓展半導體應用觸角，也經營智慧製造及先進製程等，透過 5G 及人工智慧（AI）最大化產業綜效。SEMI 指出，2019 年半導體市場經歷庫存調整去化，加上有美中貿易戰等外在環境變數影響，直至 2019 年下半年市場才開始復甦。隨著美中貿易戰暫時休兵，但新冠肺炎疫情卻成為

2020 年最大變數。不過，SEMI 對 2020 年半導體產業優於 2019 年仍抱持樂觀看法，若上半年疫情放緩且獲得控制，下半年就會進入復甦循環。

對於 2020 年半導體市場展望，SEMI 產業研究總監曾瑞榆表示，2019 年底及 2020 年初全球主要研究機構預估 2020 年半導體市場成長率介於 5~10%，平均成長率估約 7.3%，但這些預估未納入新冠肺炎帶來的影響，SEMI 評估 2020 年全球半導體市場至少可較 2019 年成長 5%。2019 年半導體市場衰退主要是受到記憶體價格下跌影響，2020 年 DRAM 價格已見止跌，NAND Flash 價格漲勢可望由 2019 年延續到 2020 年，NAND Flash 廠設備投資會提前復甦。至於邏輯晶片市場主要是 5G 及 AI 帶動先進製程投資，2019 年包括台積電及英特爾等都提高資本支出，2020 年將延續高資本支出動能。整體來看，2020 年半導體設備市場較 2019 年成長。由於台積電持續提升資本支出，預估 2020 年台灣將蟬聯最大半導體設備市場，但 2021 年按照中國大陸目前的晶圓廠投入金額預估，大陸將成為全球最大的半導體設備市場。

2020 年因在台灣疫情控制得宜，國內半導體產業持續運作，同時，承接許多國際轉單到台灣半導體的生產線上進行生產，帶動台灣半導體產值在 2020 年將會有高幅成長，工研院預估 2020 年台灣半導體產值達新台幣 3.22 兆元歷史新高。2020 年全球經濟承受疫情影響，國際貨幣基金組織（IMF）預估全球 GDP 將年衰退 4.4%，需至 2021 年才會轉為年度正成長 5.2%。今年初，全球面臨肺炎衝擊，普遍看壞全球電子產品的年度成長動能，隨著全球各地疫情持續升溫，一路下修年度成長值，普遍從正成長下修為負成長，或從負成長下探更更大的下跌幅。疫情促使人們生活與工作模式改變，帶動特定電子產品逆勢轉為正成長，線上會議與通訊需求激增，帶動起筆記型電腦、網路設備、伺服器、資安與醫療/保健等關聯的電子產品，在 2020 年全球數量不降反升。Gartner 最新預估全球半導體市場將從年初預估下滑的態勢，轉為最新預估 2020 年全球半導體市場將會正成長 3.3%，2020 年全球半導體市場可望上升至 4329 億美元。

資策會 MIC 預估，2020 年全球半導體市場將成長 4.7%，因為全球疫情帶動遠距辦公的需要，高速運算（HPC）與電腦的需求增加。疫情也導致終端消費市場需求大幅下滑，晶片庫存量升高等問題，影響 2020 下半年的半導體成長。展望 2021 年，資策會 MIC 資深產業分析師鄭凱安表示，預估 2021 年全球半導體市場成長率為 10.1%，市場規模達 4753 億美元，HPC 與 5G 將成為兩大成長動能，而因疫情帶來的無接觸需求，驅動物聯網應用快速發展，消費市場是否能在疫情受控後回復，是未來重要的市場觀測指標。半導體應用市場每年持續在變化當中，雖然 2020 年疫情使電腦與消費性電子需求短暫增加，但長期而言，消費性電子與電腦應用半導體市場比重仍逐漸減低，相反的，非 3C 應用比重逐漸上升，如通訊、車用、工業用半導體，隨著近年智慧化與自動化產品發展趨勢，可預期車用與工業用市場比重將持續增長。

2020 年台灣半導體產業產值預估成長 15.6%，達 2.7 兆新台幣，資策

會 MIC 資深產業分析師鄭凱安表示，成長主要來自遠距辦公帶動 HPC、電腦應用晶片市場營收表現，與遊戲機等需求。下半年觀測重點在於華為禁令衝擊部分台廠短期訂單，半導體第四季表現受影響，以及華為積極囤貨加深半導體庫存偏高的風險，影響臺灣半導體 2021 年成長。資策會 MIC 表示，疫情帶動宅經濟，筆電與多媒體需求大增，2020 年台灣 IC 設計產業產值預估成長 16%，下半年成長動能預期來自華為禁令所驅動的拉庫存效應與 5G 高速網通需求。2020 年 IC 封測產值可達 5,197 億新台幣，主要為上半年部分 IDM 大廠轉單效應，使 IC 封測表現優於往年，而 5G 商轉、宅經濟以及下半年手機、遊戲機新品發布，皆有助於台灣 IC 封測產業成長。針對記憶體與晶圓代工，記憶體價格下滑風險仍不可忽視，晶圓代工則因為高階製程與新興應用的帶動，預估 2020 年成長率達 19%，雖然華為占台灣 IC 製造產業比重高，但先進製程產能處於滿載，對台灣 IC 製造產業影響有限。

(e) 半導體設備投資 2019~2020 年趨勢

半導體產值高低除了受終端消費性電子產品供需之影響外，另一個影響關鍵因子仍係半導體大廠之資本支出，比較 2020 年前幾大半導體廠之資本支出(表 3)，2020 及 2019 年度半導體大廠之資本支出分別為 80,850 及 87,170 百萬美元，2020 年因新冠肺炎，預估資本支出較上一年度減少 6%，主要資本支出集中在半導體大廠，逾八成，尤其是第三大廠台積電尚有 7% 正成長，資本支出絕對金額亦有大者恆大趨勢。觀察數據之間波動可得之，全球半導體產值之變化與半導體大廠之資本支出成同向之趨勢。

表 3 2019~2020 年半導體大廠之資本支出成長率

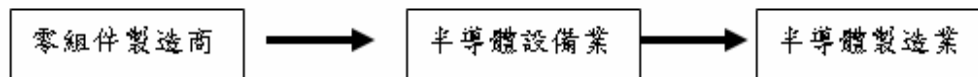
2019 Rank	Company	Headquarters Location	2018 (\$M)	2019 (\$M)	19/18 % Change	2020F (\$M)	20/19 % Change
1	Samsung	South Korea	21,630	19,900	-8%	17,600	-12%
2	Intel	North America	15,181	16,000	5%	16,500	3%
3	TSMC	Taiwan	10,443	14,500	39%	15,500	7%
4	SK Hynix	South Korea	14,611	12,500	-14%	8,500	-32%
5	Micron	North America	8,863	8,315	-6%	7,500	-10%
6	Sony	Japan	1,365	2,300	68%	1,500	-35%
7	YMTC/XMC	China	2,450	2,230	-9%	2,700	21%
8	SMIC	China	1,756	2,100	20%	2,200	5%
9	Huahong Group	China	2,379	2,070	-13%	1,400	-32%
10	Toshiba/Kioxia*	Japan	1,750	1,700	-3%	1,800	6%
11	CXMT (Innotron)	China	1,600	1,500	-6%	1,500	0%
12	ASE/SPIIL**	Taiwan	1,248	1,455	17%	1,500	3%
13	Infineon	Europe	1,412	1,400	-1%	1,450	4%
14	ST	Europe	1,262	1,200	-5%	1,200	0%
—	Top 14 Total	—	85,950	87,170	1%	80,850	-7%
—	Others	—	19,985	16,310	-18%	16,170	-1%
—	Total Spending	—	105,935	103,480	-2%	97,020	-6%

*Formerly Toshiba Memory **OSAT supplier; merged in 2018, capex combined for all of 2017 and 2018

資料來源：IC Insights，2020/02

2.產業上、中、下游之關聯性：

半導體設備業之產品為半導體製造機台，其上游為零組件製造商，下游為半導體製造業。其上中下游關係如下圖所示：



3.產品之各種發展趨勢：

濕製程設備是半導體製造必須使用之工具，製程與設備為半導體製造技術之一體兩面，設備技術與製程技術有密不可分的關係。前瞻半導體產業製程技術的趨勢，分別是晶圓往大尺寸發展、線寬往細微發展、設計往整合發展及流程往自動化發展，因此濕製程設備也將朝向符合半導體製程技術的趨勢發展。

(a)半導體製程技術

●晶圓往大尺寸發展

晶圓尺寸增加的趨勢，自 60 年代的 2 吋晶圓開始，歷經 3 吋、4 吋、5 吋、6 吋、8 吋及目前 12 吋共 7 個世代。由 8 吋轉換至 12 吋，在晶圓週邊原先剩餘無法利用的零碎空間，將由於總面積增加而可以放入晶粒，所以在 12 吋晶圓上可以產出的晶粒可以達到 8 吋的 2.4~2.6 倍。濕製程設備在晶圓往大尺寸發展所產生的問題在於晶舟面積加大，清洗槽之體積必須加大，使用之藥液也增加，晶粒數目加多，要求更佳流場的設計以確保均勻度的一致。

●封裝製程往 3D 發展

由於 3C 產品的需求，遵循摩耳(Moore)定律的半導體產品持續扮演元件集積化最重要的角色。現有的 IC 雖然仍以單價元件之特性進行設計製作，但是可攜式產品的高整合度與無線化的趨勢，已漸漸引導元件朝向模組化及系統化進行整合，最具代表即為 SoC (System on Chip)、3DIC 與 SiP (System in Package) 三大技術取向，前者主要將元件進行多功能化之設計製作，後者則提供產業最佳的 Time to Market 的整合性解決方案，而 3D-IC 技術則被視為具備兩者優點的整合方案。

●設計往整合製程發展

早年半導體設備廠商的產品開發焦點，集中於克服單元製程中來自於物理、化學過程的挑戰，而較無暇於將以單元製程為主的機台置於整合系統中運作來觀看。整個半導體廠的生產流程，就是由單元製程設備拼湊而成。這樣的生產組合，有許多因整合欠佳而產生的問題，例如每個機台的生產量相差甚大，廠房中的機台配置數容易因為機台產能的顆粒性，產生不具效益的成本。在單元製程設備成熟後，必將納入整合製程的設計，以形成較流暢的生產流程。就短期來言，可立即實施的手段是標準化，以標準的界面來聯絡各自為政的機台。長期來看，緊密結合製程前後順序相連的單元製程機台，也就是將可以處理模組製程(module

process)的機台加以組合。未來在極深次微米製程下，晶圓在包括沈積、蝕刻及化學機械研磨各製程設備間來回進行一道又一道的製程已無法因應要求，唯有整合，才能最快掌握製程狀況或解決問題。

●流程往自動化發展

半導體製造有著相當精密、複雜的製程，機器設備成本又高，為了維持產品之穩定品質與提昇生產效率，對自動化之投入始終不遺餘力。事實上半導體業之所以如此重視自動化，也有其不得不然的理由，根據德國某著名半導體潔淨室設計公司對附著於矽晶圓(Wafer)上之微塵(Particle)來源作分析後指出，人體是微塵的最主要來源，而微塵又是影響半導體品質的最大殺手，因此要改善產品可靠度的最有效途徑便是盡量減少人與產品的直接接觸，高度自動化遂成為不二法門。半導體製造牽涉對微觀尺寸的精準控制，以及對鬆散連結的機台群動態、複雜的生產管理，半導體生產過程需要數量極為龐大的數據來管理、控制、檢驗及診斷。拜電腦及網路科技長足進步之賜，生產及工程的資訊整合將使得機台內的生產及工程活動達成較和諧、有效率的狀態，這也就是晶圓尺寸世代自動化的概念。依賴規模經濟遂行成本競爭優勢的廠商，可以利用資訊整合自動化的特性，降低生產成本對生產數量的彈性，也就是說，資訊整合自動化使得多樣化的彈性生產更有效率，少量生產和大量生產之間的成本差距縮小。此外，近年半導體廠商陸續興建完成 12 吋晶圓廠，在晶圓面積及重量較以往增加數倍的情況下，自動化也成為必需的作業流程。

台灣 12 吋晶圓產能持續領先全球，然而同時國際半導體領導廠商英特爾(Intel)已提出下一世代 18 吋晶圓廠的想法，帶動全球半導體廠佈局下世代晶圓技術研發。Intel 在 ISMI(國際半導體技術協會)下推動成立了 450mm(18 吋)推動小組，成員包括 Intel、Samsung、台積電、Toshiba 等公司。面對全球此 18 吋晶圓的發展，台灣半導體設備製造商應積極投入相關設備研發，提前佈局市場及提升競爭力，廣邀國際設備商在台灣建立耗材及零組件產業，期透過上下游合作機制，逐步建立台灣在半導體設備之產業能量。

(b)濕製程設備

單片晶圓濕製程設備具有較高的製程環境控制能力與微粒去除率，加上佔地面積小、化學品與純水耗量少、極富彈性的製程調整能力等優點，使其成為未來半導體濕製程設備的主流，其產品未來發展趨勢如下：

●控制容易、良率高

在降低生產成本的考量下，未來晶圓尺寸將越趨於大型化，而積集度也將越高，每片晶圓的特性差異將越大，其加工製作所需條件也隨之改變，在此種特性下求取高良率，勢必得在一較小的高密閉環境中，予以嚴格的溫、溼度控制與高彈性的製程條件或配方。

●機台佔地面積小

因為旋轉清洗設備，藉由各種獨立化學品源的噴射機構，來取代傳統每一種化學液佔據一清洗槽的設計方式，不僅省略了清洗槽的設置，也直接減少機台的面積，這使得潔淨室的空間將能予以充分利用。

●減少化學品、廢液與廢氣排放

由於僅處理單一晶圓，而且製程環境縮小，加上以噴嘴方式僅將化學液或純水直接噴灑於晶圓上，再利用回收過濾系統，大大降低化學品與純水消耗量，也減少廢液與廢氣量的排放，既降低生產成本也兼顧環保要求。

●多項功能集於一身

由於旋轉設備的噴灑頭(Dispenser)能提供多樣獨立的化學品、純水與氮氣，再加上多槽式(Multiple chambers)設計，使得各種不同製程均能安排在同一機台上，增加彈性運作安排的空間。尤其再搭配晶片傳送自動化與化學品獨立回收再利用系統，旋轉清洗設備將構成一個完整的製程運作體系。

●與分子力結合

隨著晶圓積集度以及 IO 數目的提高，使得層數越來越多、線寬越來越窄，遂造成高深寬比(Aspect ratio)的現象。當這個比值高到某一個程度，將使得離心力與壓力差無法把深溝中的化學液、反應產物或純水帶離，而造成髒污殘留或水痕，間接使 IC 元件電氣特性變差、生產良率降低。唯有再搭配分子力(Atomic force)或化學蒸氣等方法，例如表面張力、濃度差擴散、凡得瓦力(Van der Waals)與 Vapor HF、IPA，才有機會達成目標。

4.產品競爭情形：

(a)前段酸槽設備

由於本土設備商發展較晚，台灣市場目前幾乎為日本業者所壟斷，前幾大廠商分別為 S.E.S、TEL、DNS、及 Kaijo，市場佔有率超過九成。本公司主要在 Wafer Reclaim 等低製程要求的市場上努力。

(b)晶圓級封裝產業設備

本公司為主要的設備供應商，尤其在錫鉛凸塊(Solder bumping)的光阻乾膜去除(Dry Film Stripper)製程中，佔有率為最高。另外在凸塊底下金屬層蝕刻(under-bump metallization, UBM)中，亦為國內主要的設備供應商，2004 年起已逐漸出貨至各大廠。以製程技術而言，不但領先國內同業，相較於國外大廠，亦極具競爭力。

(三)技術及研發概況：

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項 目	109 年度	110 年度截至 3 月 31 日止
研發費用	194,497	註 1
營收淨額	2,487,671	註 1
佔營收淨額比例	7.82%	註 1

註 1：截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成，故暫不列示。

2.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年 度	開發成功之技術或產品
一〇九年度	1. 垂直浸泡槽與單晶圓旋轉噴洗之可調式傳送機構。 2. 單晶圓旋轉設備搭配複數個抽氣系統。 3. 全自動電鍍銅設備之軟體開發。 4. IC 製造金屬導線銅蝕刻拋光液開發。 5. 半導體及電子級臭氧濃度計之開發與驗證。 6. EDA 工程數據分析軟體套件-人工智能預測功能模組。

(四)長、短期業務發展計畫：

1.短期業務發展計畫：

- (1)產品零件標準化，減少庫存及提高存貨週轉率，縮短應收帳款收現天數。
- (2)增設服務據點，提供即時售後支援，提昇客戶滿意度。

2.長期業務發展計畫：

- (1)與客戶共同開發製程機台，朝向產品多元化發展。
- (2)提昇產品品質，拓展行銷版圖。
- (3)加強技術研發，開發新產品應用。

二、市場及產銷概況：

(一)市場分析：

1.主要產品(服務)之銷售提供地區：

單位：新台幣仟元

銷售地區 \ 年度		108 年度		109 年度	
		銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)
內銷	台灣	1,488,133	72.19	2,017,003	81.08
外銷	亞洲	573,254	27.81	470,668	18.92
合 計		2,061,387	100.00	2,487,671	100.00

2.市場佔有率：

本公司產品主要為半導體後段封裝濕式設備，目前專攻於 200 至 300mm 之酸槽設備及單晶圓旋轉設備。國內生產類似產品之同業如嵩展及辛耘等公司，皆僅有部分設備產品重疊，其他同業則為國外設備廠商如 SEZ(2009 年已被 LAM 併購)、SSEC 及 Semitool(2010 年已被 Apply Material 併購)等公司。

根據專業研究機構顧能(Gartner)半導體設備市場預估報告，就設備類別

提供半導體設備銷售金額之預測數據(表 4)。

表 4 2016-2020 年設備類別預估之產值及變動率

單位：百萬美元；%

	2016	2017	2018	2019	2020
Semiconductor Capital Spending	70,568.9	77,794.5	77,443.5	71,814.8	73,239.5
Growth (%)	9.1	10.2	-0.5	-7.3	2.0
Wafer Fab Equipment, Including Wafer-Level Packaging	37,033.1	43,661.0	43,690.4	40,515.8	41,342.7
Growth (%)	11.4	17.9	0.1	-7.3	2.0
Other Semiconductor Capital Spending	33,535.8	34,133.5	33,753.2	31,299.0	31,896.8
Growth (%)	6.8	1.8	-1.1	-7.2	1.9

資料來源：Gartner，2018/07

109 年度本公司營業收入淨額為新台幣 2,487,671 仟元，其中設備類收入為 1,675,018 仟元，佔全球封裝設備市場之市佔率約略為 1%。本公司營運策略係以如何整合有限的人力資源，創造最大之經營績效，業務接單除了考量客戶之重要性外，訂單則係以高毛利率之機台為主，避免為了擴大市場佔有率，浪費有限資源，影響整體獲利率。

以個別應用產品之國內佔有率估計，據本公司自行觀察客戶端之機台採購情形，其酸槽設備(Wet Bench)在 12 吋晶圓級封裝中在台灣佔有率為六到八成，單晶片旋轉機台(UBM Etch)在 12 吋晶圓級封裝中在台灣佔有率約六成，至於化學品調配供應系統多屬配合客戶要求搭售，並非為本公司主力產品。

由 2020 年第三季全球主要封測代工廠商市占率來看(表 5)，表列顯示台灣封測廠商因新冠肺炎疫情控制得宜，雖在全球景氣衰退的大環境中，反而顯現出成長趨勢，繳出漂亮的成績單；而中國大陸在政府政策及本土市場快速發展的驅動下，再加上購併效益，在疫情衝擊下勉強持平或微幅下滑，不過高階技術發展及良率穩定度仍為其長期發展之關鍵。

中國 IC 封測業者將發展焦點從藉由海外購併取得高階封裝技術及市佔率，轉而著力在開發 Fan-Out 及 SiP 等先進封裝技術，並積極通過客戶認證向市場宣示自身技術來維持競爭力。中國封測廠商在高階封裝技術(Flip Chip、Bumping 等)及先進封裝(Fan-In、Fan-Out、2.5D IC、SiP 等)的產能持續開出，以及因企業購併帶來的營收認列帶動下，包含江蘇長電、通富微電、天水華天等廠商，除了通富微電 2020 年營收維持雙位數成長表現，其他兩家尚能維持僅微幅下滑，該三家公司均已能站穩全球前十大封測業排行榜內。

表 5 2020 年第三季全球主要封測代工廠商市占率

單位：百萬美元

第三季全球前十大封測代工廠排名				
排名	公司名稱	2020/Q3		
		營收 (百萬美元)	營收年增率 (%)	市占率 (%)
1	日月光ASE	1,520	15.1	22.5
2	艾克爾Amkor	1,354	24.9	20.0
3	江蘇長電JCET	982	-2.3	14.5
4	矽品SPIL	897	17.5	13.3
5	力成PTI	647	14.2	9.6
6	通富微電TFME	398	13.0	5.9
7	天水華天HuaTian	319	-1.5	4.7
8	京元電子KYECC	251	11.6	3.7
9	順邦Chipbond	197	13.1	2.9
10	南茂ChipMOS	194	12.4	2.9

資料來源：拓璞產業研究院，財訊整理，2020/12

3. 市場未來之供需狀況與成長性：

由於全球新冠肺炎疫情影響，間接帶動民眾居家辦公、遠距教學相關應用熱潮。同時，也因為台灣防疫成績位居世界前段班，國家整體環境安全性突出，相對於歐美疫情緊張情勢不斷升高下，台灣半導體產業成長表現，因此於全球市場一枝獨秀、令人驚豔。台灣半導體晶圓代工廠、IC 封測廠，現階段已成為全球 5G、遠端生活應用相關 IC 晶片，委託代工製造、封裝測試服務時，客戶首選的下單集中地。隨著全球半導體下游應用市場 5G 布建、商轉，以及遠距生活應用熱潮雙引擎的點火，不僅客戶下單熱絡，訂單擠爆台灣晶圓代工廠產能，台灣半導體 IC 封測業者也歡喜迎來大單，包括全球 IC 封裝測試龍頭大廠日月光投控-日月光半導體、旗下子公司矽品，以及力成、旗下封測廠超豐等廠商。根據業者推估，目前市場供需缺口仍高達 40% 無法獲得滿足，由於既有生產線產能截至 2021 年第二季為止，都無法順利紓解客戶訂單塞車情況，相關廠商也可能於 2021 年調漲 3%~5% 封裝代工服務報價，半導體封測台廠形容，這一波漲價熱潮，乃是過去十五年以來，市場上難得一見的大商機。市場此波漲價潮，成功一改長期以來，封測廠商被 IC 晶片廠、晶圓代工廠所要求，每年須降價的不利營運局面。由於受惠全球 5G、WiFi 6 新世代無線網通規格上路，因而帶動相關網通產品進入市場成長周期，加以居家上班、辦公的新生活趨勢發展已獲得確立，消費者對於電腦、網路設備、遊戲機等相關資通訊硬體，購買需求相當暢旺，且汽車電子產業亦開始持續復甦助攻之下，讓整體封測業生產線產能十分吃緊，整體封裝產能將滿載至 2021 年上半年，有利代工服務廠營運表現。

依據台灣半導體產業協會 TSIA 與工研院產科國際所(IEK)之預估(表 6)，2020 年台灣的 IC 產業的產值將可達到新台幣 27,742 億元，較上一年度成長 4.1%。其中，IC 設計產業、IC 製造產業的產值分別為 7,227 億元、15,285 億元，較上一年度分別成長 4.3%、3.8%。在 IC 製造產業中的晶圓代工、記憶體及其他製造產值分別為 13,649 億元、1636 億元，較上一年度分別成長 4.0%、2.5%。本表與本公司產品直接相關的為 IC 封裝業，產值為 3,615 億元，較上一年度成長 4.4%，IC 測試業亦為正成長。台灣半導體產業協會與工研院產科國際所指出，台灣 IC 產業產值受到新冠肺炎疫情的衝擊，在 2020 年度仍能較上一年度繳出均為正成長的成績單，實屬不易，展望 2021 年度，仍有高機率維持成長動能。

表 6 2020 年台灣 IC 產業產值統計結果(單位：新台幣億元)

億新台幣	2016	2016 成長率	2017	2017 成長率	2018	2018 成長率	2019	2019 成長率	2020 (e)	2020 (e) 成長率
IC 產業產值	24,493	8.2%	24,623	0.5%	26,199	6.4%	26,656	1.7%	27,742	4.1%
IC 設計業	6,531	10.2%	6,171	-5.5%	6,413	3.9%	6,928	8.0%	7,227	4.3%
IC 製造業	13,324	8.3%	13,682	2.7%	14,856	8.6%	14,721	-0.9%	15,285	3.8%
晶圓代工	11,487	13.8%	12,061	5.0%	12,851	6.6%	13,125	2.1%	13,649	4.0%
記憶體與其他製造	1,837	-16.8%	1,621	-11.8%	2,005	23.7%	1,596	-20.4%	1,636	2.5%
IC 封裝業	3,238	4.5%	3,330	2.8%	3,445	3.5%	3,463	0.5%	3,615	4.4%
IC 測試業	1,400	6.5%	1,440	2.9%	1,485	3.1%	1,544	4.0%	1,615	4.6%
IC 產品產值	8,368	2.9%	7,792	-6.9%	8,418	8.0%	8,524	1.3%	8,863	4.0%
全球半導體市場(億美元) 及成長率(%)	3,389	1.1%	4,122	21.6%	4,688	13.7%	4,121	-12.1%	4,330	5.1%

資料來源：台灣半導體產業協會 TSIA；工研院產科國際所(IEK)2020/08

下述段落係根據 SEMI(國際半導體產業協會)2020 年 7 月發布的「2020 年中整體 OEM 半導體設備預測報告」(Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast – OEM Perspective)，暨同一機構於 2020 年 12 月發布的「2020 年終整體 OEM 半導體設備預測報告」(Year-end Total Semiconductor Equipment Forecast – OEM Perspective)來說明設備業未來之供需狀況與成長性。

SEMI 在 2020 年中整體 OEM 半導體設備預測報告指出，這波資本支出走強的情況，是由多個半導體產業類別的成長所帶動。其中，晶圓廠設備(含晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備)預計 2020 年將成長 5%，接著受惠於記憶體支出復甦，以及先進製程和中國市場的大額投資，2021 年將大幅上升 13%。另外，佔晶圓製造設備總銷售約一半的晶圓代工和邏輯製程支出，在 2020 年及 2021 年也將維持個位數穩定成長。至於 DRAM 和 NAND Flash 等記憶體在 2020 年的資本支出將超過 2019 年的水平，而在 2021 年成長幅度也將分別都超越 20%。

SEMI 進一步表示，組裝及封裝設備則是拜先進封裝技術和產能的佈

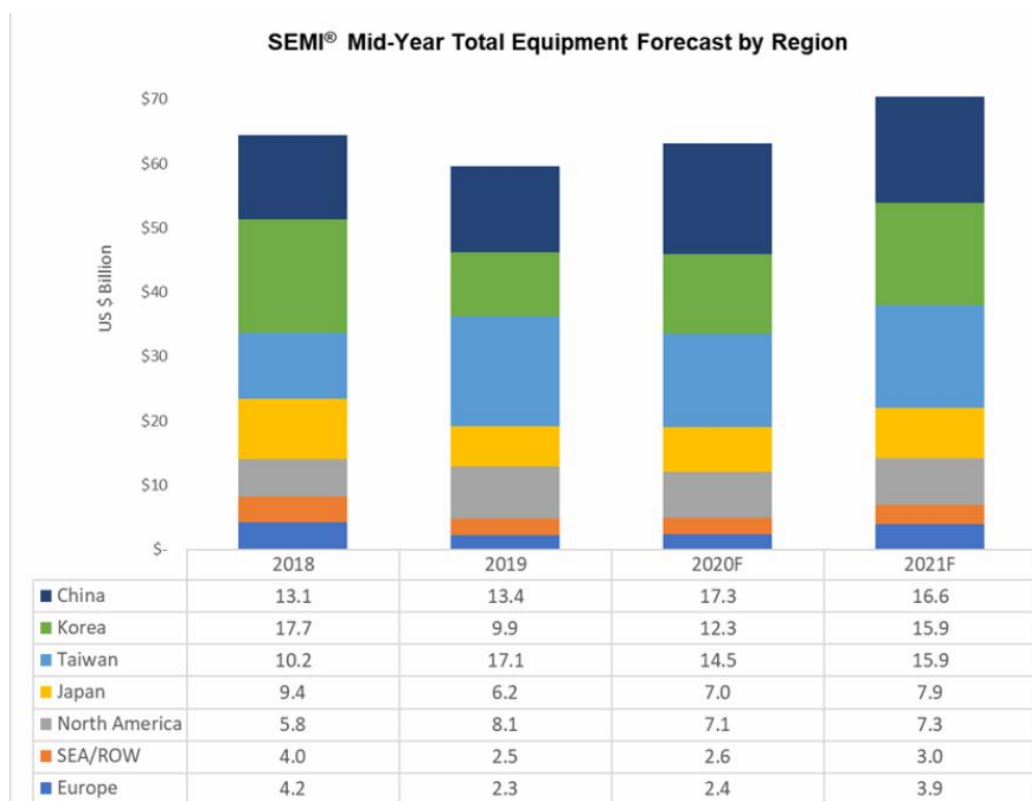
建，持續成長，預計 2020 年預計將成長 10%，金額達 32 億美元。接下來 的 2021 年仍將成長 8%，達 34 億美元。而在半導體測試設備市場上，2020 年成長幅度亮眼達到 13%，整體測試設備市場將達 57 億美元。來到 2021 年，也可望在 5G 需求持續增溫下延續成長的趨勢。

而以區域別來看，中國、台灣和南韓都是 2020 年及 2021 年設備支出 金額的領先市場。中國因境內以及境外半導體廠商在晶圓代工和記憶體 的強勁支出帶動下，於 2020 年和 2021 年兩年的半導體設備總支出中躍居首 位。台灣今年設備支出則在 2019 年大幅成長 68% 之後將略微修正，但預 計 2021 年又將再度回升，反彈幅度達 10%，讓台灣穩坐設備投資的第二 位(表 7)。

至於南韓則將超越 2019 年的表現，於 2020 年半導體設備投資中排行 第三，也讓該地區成為 2020 年第三大半導體資本支出國。南韓的半導體 設備支出主要在記憶體投資復甦推波助瀾下，預計 2021 年將成長 30%。 另外其他長期追蹤的多數地區在 2020 年或 2021 年都有機會呈成長態勢。

表 7 2018-2021 年區域市場設備支出預測-年中報告

單位：十億美元



資料來源：SEMI，2020/07

國際半導體產業協會(SEMI)2020 年 12 月於日本國際半導體展 (SEMICON Japan)公布年終整體 OEM 半導體設備預測報告，顯示 2020 年 全球原始設備製造商(OEM)之半導體製造設備銷售總額相較 2019 年的 596 億美元將增長 16%，創下 689 億美元的業界新紀錄。全球半導體設備市場 的成長力道也預計在 2021~2022 年持續走強，2021 年將進一步來到 719

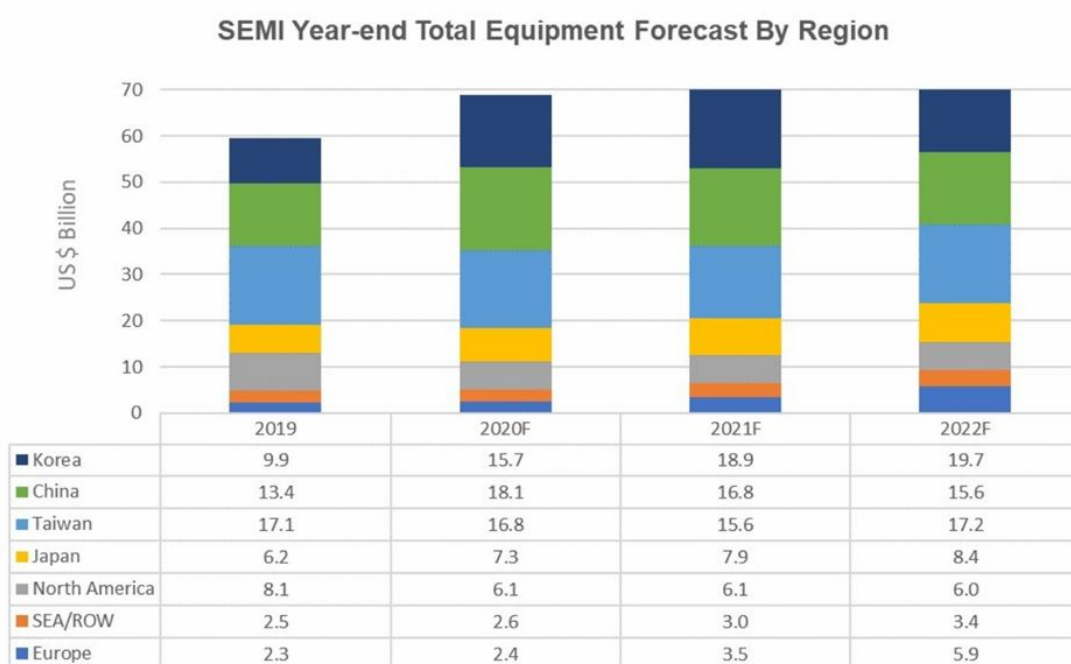
億美元，2022 年更將攀上 761 億美元新高點。SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「全球半導體設備市場持續走強，除了同時由半導體前段和後段設備需求成長所帶動外，2021 年和 2022 年也可望在 5G 和高效能運算等應用需求支持下延續增長態勢。我們看好全球市場在未來兩年將有所成長」。

這波擴張同時由半導體前段和後段設備需求成長所帶動。前段晶圓廠設備(含晶圓製程、晶圓廠設施和光罩設備)2020 年將成長 15%，達到 594 億美元，預計於 2021 年和 2022 年各有 4%和 6%的增長；而佔晶圓製造設備總銷售約一半的代工和邏輯部門，拜先端技術大量投資所賜，2020 年支出出現雙位數中段的成長幅度，達 300 億美元。NAND 快閃記憶體製造設備支出則有 30%的大幅增長，超過 140 億美元，DRAM 則有望在 2021 年和 2022 年成為帶動成長的火車頭。此外，組裝和封裝設備部門在先端封裝應用的助長之下，預估 2020 年增長 20%，金額達 35 億美元，2021 年和 2022 年也各有 8%和 5%的成長；半導體測試設備市場 2020 年將大漲 20%，達 60 億美元，2021 年和 2022 年也可望在 5G 和高效能運算(HPC)應用需求支持下延續增長勢頭。

以地區來看，中國、台灣和韓國都是 2020 年設備支出金額的領先集團。中國在晶圓代工和記憶體部門投資持續挹注下，2020 年將首次於整體半導體設備市場中躍居首位；韓國則在記憶體投資復甦和邏輯投資增加推波助瀾之下，可望在 2021 年領先全球，對照 SEMI 7 月出具之 2020 年中報告，韓國資本支出數字調升最多；台灣得益於先進邏輯晶圓代工的持續投資，設備支出依舊強勁(表 8)。

表 8 2019-2022 年區域市場設備支出預測-年終報告

單位：十億美元



資料來源：SEMI，2020/12

2009 年因受金融風暴影響，使得原先半導體大廠之資本支出預算，在 2010 年景氣復甦的帶動下大幅成長 148%，成長持續到 2012 年，2013 年則在歐債風暴狀況不明下，呈現出二位數的衰退。依據國際半導體設備材料產業協會(SEMI) 每年底之年終預測，2013 年整體半導體設備市場，因景氣復甦未如預期，較 2012 年下滑 13.8%，除了台灣仍為逆勢成長外，其他僅中國市場可看出有較明顯成長；2014 年因美國景氣復甦程度超出預期，除台灣因基期高而顯現衰退外，其他地區均有成長，尤以北美地區最為明顯(請參閱本公司以前年度股東會年報)。2015 年則因景氣能見度不明，故呈現出持平狀態，而 2016~2018 年全球經濟的不確定因素逐一消除後，可發現明顯成長。2019 年景氣不明朗，經濟成長趨緩，且有貿易戰等不確定因素，導致資本預算衰退，反映出投資心態的保守。2020~2022 年因東亞區域控制新冠肺炎疫情得宜，且預測後新冠肺炎的景氣復甦，新技術新應用推升需求，資本支出亦將隨之成長。以上十餘年全球經濟大事件的演進，顯示半導體設備之成長力道與商機，與經濟成長力密不可分。

4.競爭利基：

(A)服務支援機動性高

由於貼近國內市場，可提供即時且彈性之售後支援服務，且在文化、語言溝通方面較無障礙，更容易接近客戶，目前除位於北台灣(新竹)之總部據點外，已建立中部(台中)，南部(高雄、台南)及中國(上海)之服務據點。

(B)優越的研發能力

本公司自成立後即投入濕製程設備之研發，為國內最早投入該產品領域之公司，在歷經多年之研究開發工作後，已累積厚實之自有技術智慧財產(IP)，能適時推出新產品獲得客戶採用。

(C)設備產品競爭力

比較美、日等國之國際大廠之產品，本公司生產之設備，已具有品質及價格競爭優勢，並得業界領導廠商之認可及購置。

(D)整合性高的週邊團隊支援

本公司透過策略結盟及產業串聯的合作，從重要上游零組件之取得，到成品應用設計，都有關係密切的合作伙伴，藉以增加市場推廣的成功率，降低新產品導入的風險成本，提升整體的競爭力。

(E)政府獎勵及國內客戶採購策略

本土化半導體製程設備是政府積極輔導產業之一，可享有多項優惠措施及科專經費補助，國內客戶採購策略開始較著重於建立國內製程設備供應商夥伴關係。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

A.有利因素

(A)台灣半導體設備市場之持續發展

台灣擁有從 IC 設計到半導體代工及封裝測試，完整之供應鏈產業

，且世界級前五大 CSP(Chip Scale Package)及 WLP(Wafer Level Package)封裝廠，如日月光、矽品、台積電、Amkor、星科金朋(SCT)，多位於台灣設廠。雖 2008 年遭逢全球不景氣，連帶影響半導體產業景氣，惟自 2009 年第二季起產能利用率即大幅提升，在台灣，領先之封測公司更針對晶圓植凸塊(wafer bumping)和晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)方面，修正年度資本支出計畫，後市成長可期。

(B)擁有領先同業之研發技術

本公司自設立初期即已投入半導體晶圓清洗設備之研發，1999 年即已開發出第一套 8 吋單晶圓濕式旋轉清洗設備，2002 年取得半導體設備業產品認證(Semi S2-200)，2011 年 12 吋酸槽設備取得 Semi S2-0310 與 S8-0308E 產品認證，2012 年 12 吋單晶片旋轉機台取得 Semi S2-0310 與 S8-0310 產品認證，使公司擁有出貨給半導體製造商之產品安全性認證，不僅在製程技術之研發及經驗累積完善，且擁有厚實之自有技術智慧財產權(IP)。在研發技術、產品改善速度及產品量產速度均可與國外同業抗衡。且已獲得台灣半導體領導廠商之認可，在後段晶圓級封裝市場中，本公司領先同業，為客戶在 CSP 及 WLP 之封裝領域，提供最佳解決方案。

(C)價格競爭優勢

本公司生產之設備就近於台灣生產組裝及提供台系半導體大廠售後維修服務。除製造成本較美、日等國際大廠低外，亦同步與客戶共同開發及設計製程設備。公司投入半導體設備行業時間逾 20 年，持續打入半導體代工或封測大廠之設備供應鏈，證明本公司之產品品質有相當之水準，有利其產品之銷售。

(D)深耕設備之系統整合能力，可滿足客戶不同需求

本公司透過與客戶技術共同開發，在設備方面，從重要上游零組件之取得，到設計應用，皆有密切合作之廠商。可快速設計出符合客戶需求之設備，以滿足各個客戶不同之需求。公司早已取得 ISO 9001 國際認證及 SEMI S2-200 安全認證，有助於半導體設備之市場推廣。且因其產品認證期長，進入門檻高，而本公司目前已與業界一級大廠建立密切之合作夥伴關係，有助於未來持續耕耘該市場。

(E)政府獎勵及國內客戶採購策略

本土化半導體製程設備是政府積極輔導產業之一，可享有多項優惠措施及科專經費補助，國內客戶採購策略開始較著重於建立國內製程設備供應商夥伴關係。

B.不利因素及因應對策

(A)需投入大量研發機台相關之驗證及檢測費用

面對晶圓製程及封裝科技日新月異，研發機台之相關驗證及檢測設備昂貴，且需持續投入資金於研發新技術及新產品上，以維持其競爭力。

因應措施：

(a)本公司本著良好之財務結構及償債能力，再藉由公司上櫃以提高企業知名度，加強本公司於資本市場籌措資金之競爭力，以解決資金需求之問題。

(b)與下游國際級客戶合作，以技術合作之方式同步為客戶設計及開發設備，不僅可轉嫁產品開發之風險，亦可節省產品開發完成後相關驗證及檢測之成本花費，且確保合作開發出之產品，由客戶直接採購，減少存貨呆滯風險。

(B)新競爭者的進入，使得售價降低

國內高階封裝設備市場仍屬寡佔，因此吸引國外其他競爭者欲切入此市場，使得部份設備價格下降。

因應措施：

(a)本公司致力於開發如高附加價值與特殊應用類之新產品，以期因應競爭者加入時，持續維持其競爭利基。

(b)利用整合協力廠商資源之方式，並藉由製造外包以增加產能彈性。而本公司之人力則專注於研發及掌握關鍵之系統整合技術，提高核心競爭力，增加公司獲利。

(c)為拓展市場，於中國大陸設立行銷據點，配合大陸半導體市場發展需求，取得市場先佔商機，增加獲利來源。

(d)製程能力之提升：該公司之產品客製化程度高，除基礎研究能力提升外，藉由配合客戶就新產品或製程採需求而共同開發之模式，提供較國外廠商靈活性高之客製化機台，以因應同業競爭。

(e)提升作業品質：以改良機台設計及提高產能利用率降低設備生產成本。在改良機台設計方面，依客戶需求檢視機台之設計及組裝程序，以減少重工之花費；另藉由未來逐漸獲得客戶認證及下單，提高產能稼動，降低機台生產之平均成本。

本公司之產品係因應客戶需求規格開發，原則上設備廠商之產品皆係依客戶製程規格設計開發。現就本公司與國外設備商之差異比較如下：

比較項目	弘塑科技	國外設備商
市場區格與差異	1.國內自製，當地技術支援及維修容易。 2.運送及成本較低，使相較國外競爭者為低。 3.可就近服務台灣半導體廠，且設備交貨迅速。	1.技術支援及維修需仰賴國外原廠支援。 2.因運送及成本高，使其售價偏高。 3.本身不一定於客戶所在地設有服務據點，需由代理商服務，交貨及服務速度慢。

比較項目	弘塑科技	國外設備商
競爭優勢	1.可根據客戶需求進行共同開發及特別設計。 2.長期貼近客戶服務之經驗，能以較有效率之方式，瞭解客戶真正需求。	1.生產設備之經驗豐富且經多年認證及使用，信賴度較佳。 2.擁有較佳之國際視野。

(C)研發人才養成不易

該產業之設備複雜度日益增加，需靠有經驗之研發人員，方能因應不同客戶之設計需求，且要培養調整產品流程及設計能力之人才，需累積相當時間及經驗，因此研發人員培養不易。

因應措施：

- (a)藉由公司上櫃以提高企業知名度，進一步吸收優秀人才；另提高員工福利，並配合實施相關員工激勵制度，以期留住人才。
- (b)與國際級客戶配合，共同開發，以提升技術人才之研發能力。

(D)銷貨客戶及產業集中

由於全世界前五大半導體封裝廠集中於國內，其持續擴廠計劃較為積極，其他業者資本支出之投入相對保守，導致短期銷貨客戶集中情形無法改善。

因應措施：

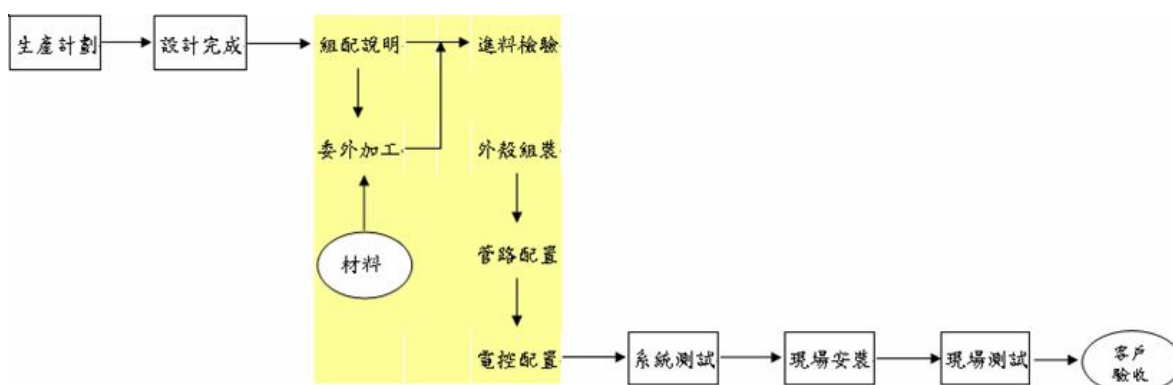
- (a)除持續拓展國內商機外，亦積極爭取大陸設備市場需求，以增加銷售客戶，降低對單一市場銷售風險。
- (b)以半導體封裝設備之技術為基礎，期能跨足 LED、太陽能及 LCD 產業，增加產品運用範圍，降低對單一產業銷售風險。

(二)主要產品之重要用途及產製過程：

1.主要產品之重要用途：

提供半導體 IC 封裝製程之濕式設備。濕製程機台包括清洗、顯影、蝕刻、去光阻、電鍍、化鍍等製程。

2.產製過程：



(三)主要原料之供應狀況：

主要原料	主要供應商	供應狀況
工 程 件	RORZE/樂華、視動自動化、TAZMO、Aime Tech、華福、導航電、英磊、均瑞、常誠、台陽實業、晶凱、順緯	穩定、良好
加 工 件	名超、暉陽、唐毅機械、協宏、大洋、廣銑、立晟、潤太、耀順、奕豐、鑫塑	穩定、良好
市 購 件	IWAKI/億昇、賢昇、彰京、Levitronix、汎達 SMC、Staubli/史陶比爾、崇越 CO2、ABB/艾波比、鼎岳、建誼、和椿	穩定、良好

本公司主要原料皆可由多家廠商供應，且品質及廠商交期穩定。本公司已與供應商建立良好之合作關係，並且分散採購來源，以確保供貨來源之穩定，降低缺貨之風險。

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

- 1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例：

單位：新台幣仟元

年度 項目	108 年度				109 年度				110 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	無	0	0.00	無	無	0	0.00	無	註 1	註 1	註 1	
	其他	938,159	100.00	無	其他	1,270,729	100.00	無	註 1	註 1	註 1	
	進貨淨額	938,159	100.00		進貨淨額	1,270,729	100.00		進貨淨額	註 1	註 1	

註 1：截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成，故暫不列示。

增減變動原因說明：

因本公司主要原料皆可由多家廠商供應，109 年度進貨分散向各廠商採購，故全年度供應商進貨及比率並無大幅變動情形。此外，半導體製程設備需求訂單倍增，故製造機台所需之原物料採購金額亦隨之增加。

- 2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例：

單位：新台幣仟元

年度 項目	108 年度				109 年度				110 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	B 客戶	332,075	16.11	無	B 客戶	574,659	23.10	無	註 1	註 1	註 1	
2	L 客戶	222,400	10.79	無	F 客戶	399,637	16.06	無	註 1	註 1	註 1	
	其他	1,506,912	73.10	無	其他	1,513,375	60.84	無	註 1	註 1	註 1	
	銷貨淨額	2,061,387	100.00		銷貨淨額	2,487,671	100.00		銷貨淨額	註 1	註 1	

註 1：截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成，故暫不列示。

增減變動原因說明：

1.F 客戶：109 年因應 5nm 先進製程產量擴增，於南科先進封裝廠同步擴產。

(五)最近二年度生產量值：

1.最近二年度生產量值表：

單位：新台幣仟元/台

生產 量值 主要商品	年度	108 年度			109 年度		
		產能	產量	產值	產能	產量	產值
機台設備產品		註 1	67	617,416	註 1	67	769,848
化學產品		註 2	註 3	300,667	註 2	註 3	357,856
維修服務及其它		註 2	註 3	117,648	註 2	註 3	192,707
軟體銷售及安裝		註 2	註 3	57,138	註 2	註 3	27,578
存貨跌價及呆滯損失		不適用	不適用	19,821	不適用	不適用	13,362
合計		註 1	不適用	1,112,690	註 1	不適用	1,361,351

註 1：本公司係採客戶訂製而生產，且各機台隨著其產品複雜度所須耗費之生產時間亦不同，故無法依各產品別估計產能。

註 2：為子公司或金額較低之營收項目，產業性質不同，故不羅列產能。

註 3：為子公司或金額較低之營收項目，產業不同、出貨單位差異甚大且不一致，故無法揭露產量。

(六)最近二年度銷售量值：

1.最近二年度銷售量值表：

單位：新台幣仟元/台

銷售 量值 主要商品	年度	108 年度				109 年度			
		內銷		外銷		內銷		外銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
機台設備產品		54	706,595	13	299,441	60	1,033,894	7	189,850
化學產品		不適用	550,575	不適用	35,314	不適用	646,749	不適用	99,941
維修服務及其它		不適用	218,074	不適用	119,182	不適用	324,826	不適用	111,517
軟體銷售及安裝		不適用	12,889	不適用	88,518	不適用	11,534	不適用	45,458
半導體及電子設備銷售代理		不適用	0	不適用	30,799	不適用	0	不適用	23,902
合計		不適用	1,488,133	不適用	573,254	不適用	2,017,003	不適用	470,668

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

年度 項目		108 年度	109 年度	110 年度截至 3 月 31 日止
員工 人數 (人)	直接員工	72	77	75
	間接員工	199	219	219
	研發人員	80	85	84
	合計	351	381	378
平均年歲(歲)		41.9	42.0	42.2
平均服務年資(年)		9.0	9.1	9.0
學歷 分布 比率 (%)	博士	1.7	1.9	1.9
	碩士	18.5	18.6	18.5
	大專	72.4	71.4	72.0
	高中	6.0	6.3	6.3
	高中以下	1.4	1.8	1.3

四、環保支出資訊：

- (一)依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形：本公司非屬法令規範之環境污染事業，故本項不適用。
- (二)防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：無。
- (三)最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。
- (四)最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失、處分之總額，並揭露其未來因應對策及可能之支出：無。
- (五)目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

五、勞資關係：

(一)員工福利措施與實施情形：

本公司為增進員工福利，依法成立職工福利委員會按期提撥福利金，目前本公司福利措施要點如下：

- A.公司法定福利措施：全民健康保險、勞工保險、提撥勞工退休準備金、提撥提撥積欠工資墊償基金、提撥職業災害保險、提繳勞工退休金。
- B.公司特別提供：員工分紅及認股、年節及績效獎金、員工教育訓練計劃、員工子女獎學金、人身及意外保險及定期健康檢查。
- C.福利委員會提供：三節禮金、生日禮金、婚喪喜慶補助金、傷病慰問金、生育津貼、社團活動、定期員工旅遊活動、定期慶生會及其他各種便利優惠活動等。

(二)員工進修與訓練：

- A.公司內部不定期舉行訓練課程，依實際需要請員工參加。
- B.員工得視工作需要參加外部訓練課程，其費用則由公司給予補助。
- C.員工進修與訓練需依據本公司「教育訓練作業程序」辦理。

109 年度員工進修實際施行狀況如下表(部分時數、費用採估計)：

課程類別	課程次數	總人次	總時數	總費用
1.新進人員訓練	20	20	120	0
2.專業職能/工程類訓練	11	11	78	41,501
3.勞安衛訓練/工安類	55	55	330	45,632
4.主管職能訓練	2	16	96	49,715
5.其他自我提升課程	0	0	0	0
總 計	88	102	624	136,848

(三)退休制度與其實施情形：

為了增進勞工退休生活保障，加強勞雇關係，本公司依法執行退休金提撥。

- A.適用舊制員工：本公司之退休制度依據勞基法相關規定辦理，並依法按月提撥退休金存入中央信託局，交由勞工退休準備金監督委員會管理。
- B.適用新制員工：依據勞工退休金條例，由公司按月給付薪資總額 6%提撥退休準備金，存入勞保局管理專戶。

(四)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司成立以來，有關勞資關係之一切規定措施，均依相關法令辦理。公司對於員工意見極為重視，並本著共存共榮之經營理念與明確的管理政策，內部溝通管道通暢，維持良好和諧的勞資關係。

(五)最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失及目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

(六)工作環境與員工人身安全的保護措施：

項目	內 容
門禁安全	1. 24 小時設有嚴密門禁監視系統。 2. 與保全公司簽約，24 小時維護廠房安全。 3. 與當地警察治安單位密切聯繫。
各項設備之維護及檢查	1. 依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，每二年委託專業公司進行公共安全檢查。 2. 依據消防法規定，每年委外進行消防檢查。 3. 依據本公司「勞工安全衛生工作守則」等辦法規定，每日、每月、每季、半年或每年等週期，對高、低壓電氣設備、升降機(客梯、貨梯)、空調、飲水機、汽車、機車、消防器具等各項設備進行維護及檢查。
災害防範措施與應變	1. 本公司訂有「勞工安全衛生工作守則」、「危害物通識管理辦法」、「廢棄物處理作業管理程序」、「系統災難復原辦法」、「勞工安全衛生管理規章」、「勞工安全衛生管理

項目	內 容
	計畫」、「自動檢查計畫」、「意外事件通報機制管理辦法」等災害防止、搶救注意事項及事故職災通報程序，明確規範本公司各級人員事前及事後因應重大事件如天災及事故等重大突發狀況之應負責任及任務內容。 2. 本公司成立消防編組，每年兩次聘請消防主管機關辦理消防防災講習。 3. 為維護員工安全與衛生，本公司設有安全衛生部門，推展安全衛生業務，編制有甲種勞工安全衛生業務主管一人(專任)及勞工安全衛生管理員一人(專任)，已向北區勞動檢查所辦理登錄在案。
生理及心理衛生	1. 健康檢查：新進人員報到前須先辦理身體健康檢查，在職人員每年定期健康檢查。 2. 工作環境衛生：工作場所依規定全面禁菸、不定期舉辦健康講座、定期進行辦公室環境清潔、消毒。 3. 意見表達：員工意見可向人資單位表達、或向部門主管、總經理表達。 4. 性騷擾防治：訂有「性騷擾防治措施暨申訴作業辦法」。
承攬商作業危害因素告知	本公司訂有「承攬商管理辦法」，並要求廠商確實遵行。
保險及醫療慰問	1. 依法投保勞保(含職災保險)、健保，另有辦理員工團體險。 2. 由本公司職福會辦理醫療慰問。

六、重要契約：

截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約(請參閱財務報告)及其他足以影響股東權益之重要契約如下：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃合約	卓○樺	109~111(日期略)	台中辦公室	無
租賃合約	李○淇	109~111(日期略)	高雄辦公室	無
租賃合約	沈○萱	108~110(日期略)	台南辦公室	無
銀行授信契約	合庫銀行	102.12.30-117.12.30	可使用授信額度 新台幣 2 億元 1 仟 5 百萬元	無

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及損益表：

(一)簡明資產負債表-合併財務報告

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料					110 年度截至 3 月 31 日止 財務資料(註 1)
		105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	
流 動 資 產		2,568,970	2,329,772	2,318,235	2,658,926	3,344,107	註 1
不動產、廠房及 設 備		808,478	874,576	900,368	1,091,273	1,046,236	註 1
無 形 資 產		321,601	310,544	433,827	519,805	488,358	註 1
其 他 資 產		399,879	683,033	406,463	629,953	564,642	註 1
資 產 總 額		4,098,928	4,197,925	4,058,893	4,899,957	5,443,343	註 1
流動負債	分配前	1,638,379	1,349,260	1,556,049	1,667,898	2,092,461	註 1
	分配後	1,885,217	1,596,098	1,789,777	1,901,626	2,413,837	註 1
非 流 動 負 債		493,797	526,427	431,822	452,355	413,127	註 1
負債總額	分配前	2,132,176	1,875,687	1,987,871	2,120,253	2,505,588	註 1
	分配後	2,379,014	2,122,525	2,221,599	2,353,981	2,826,964	註 1
歸屬於母公司業 主 之 權 益		1,966,752	2,322,238	2,035,803	2,745,917	2,905,551	註 1
股 本		246,838	246,838	246,838	292,160	292,160	註 1
資 本 公 積		601,772	601,772	601,772	1,096,802	1,102,358	註 1
保留盈餘	分配前	917,418	1,049,861	1,081,097	1,155,599	1,372,253	註 1
	分配後	670,580	803,023	847,369	921,871	1,050,877	註 1
其 他 權 益		200,724	423,767	106,096	284,004	221,428	註 1
庫 藏 股 票		0	0	0	(82,648)	(82,648)	註 1
非 控 制 權 益		0	0	35,219	33,787	32,204	註 1
權 益 總 額	分配前	1,966,752	2,322,238	2,071,022	2,779,704	2,937,755	註 1
	分配後	1,719,914	2,075,400	1,837,294	2,545,976	2,616,379	註 1

註 1：截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成，故暫不列示。

(二)簡明資產負債表-個體財務報告

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料					110 年度截至 3 月 31 日止 財務資料(註 1)
		105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	
流 動 資 產		2,174,008	1,814,869	1,727,706	1,757,916	2,202,548	不適用
不動產、廠房及 設 備		294,917	296,925	322,664	378,000	348,382	不適用
無 形 資 產		2,884	4,840	14,785	9,277	5,705	不適用
其 他 資 產		1,152,835	1,456,580	1,366,595	1,978,226	1,975,314	不適用
資 產 總 額		3,624,644	3,573,214	3,431,750	4,123,419	4,531,949	不適用
流動負債	分配前	1,428,405	986,475	1,229,363	1,183,531	1,448,777	不適用
	分配後	1,675,243	1,233,313	1,463,091	1,417,259	1,770,153	不適用
非 流 動 負 債		229,487	264,501	166,584	193,971	177,621	不適用
負債總額	分配前	1,657,892	1,250,976	1,395,947	1,377,502	1,626,398	不適用
	分配後	1,904,730	1,497,814	1,629,675	1,611,230	1,947,774	不適用
歸屬於母公司業 主 之 權 益		1,966,752	2,322,238	2,035,803	2,745,917	2,905,551	不適用
股 本		246,838	246,838	246,838	292,160	292,160	不適用
資 本 公 積		601,772	601,772	601,772	1,096,802	1,102,358	不適用
保留盈餘	分配前	917,418	1,049,861	1,081,097	1,155,599	1,372,253	不適用
	分配後	670,580	803,023	847,369	921,871	1,050,877	不適用
其 他 權 益		200,724	423,767	106,096	284,004	221,428	不適用
庫 藏 股 票		0	0	0	(82,648)	(82,648)	不適用
非 控 制 權 益		0	0	0	0	0	不適用
權 益 總 額	分配前	1,966,752	2,322,238	2,035,803	2,745,917	2,905,551	不適用
	分配後	1,719,914	2,075,400	1,802,075	2,512,189	2,584,175	不適用

註 1：年報刊印年度，截至 3 月 31 日止無須編列個體財務報告，故不適用。

(三)簡明綜合損益表-合併財務報告

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘為仟元

項 目 \ 年 度	最近五年度財務資料					110 年度截至 3 月 31 日止 財務資料(註 1)
	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	
營業收入	2,163,534	2,119,253	1,484,369	2,061,387	2,487,671	註 1
營業毛利	941,789	1,000,036	675,564	948,697	1,126,320	註 1
營業損益	502,216	538,393	265,392	414,798	533,120	註 1
營業外收入及支出	(13,759)	(63,211)	72,161	(10,743)	(23,083)	註 1
稅前淨利	488,457	475,182	337,553	404,055	510,037	註 1
繼續營業單位 本期淨利	392,523	375,675	277,828	312,756	397,358	註 1
停業單位損失	0	0	0	0	0	註 1
本期淨利（損）	392,523	375,675	277,828	312,756	397,358	註 1
本期其他綜合損益 （稅後淨額）	145,799	226,649	(318,281)	175,885	(8,628)	註 1
本期綜合損益總額	538,322	602,324	(40,453)	488,641	388,730	註 1
淨利歸屬於 母公司業主	392,523	375,675	278,684	309,970	396,873	註 1
淨利歸屬於非控制 權益	0	0	(856)	2,786	485	註 1
綜合損益總額歸屬 於母公司業主	538,322	602,324	(39,597)	486,138	387,806	註 1
綜合損益總額歸屬 於非控制權益	0	0	(856)	2,503	924	註 1
每股盈餘	15.90	15.22	11.29	11.11	13.92	註 1

註 1：截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成，故暫不列示。

(四)簡明綜合損益表-個體財務報告

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘為仟元

項 目 \ 年 度	最近五年度財務資料					110 年度截至 3 月 31 日止 財務資料(註 1)
	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	
營 業 收 入	1,667,665	1,500,267	917,256	995,351	1,199,430	不適用
營 業 毛 利	664,252	649,048	387,385	441,823	497,847	不適用
營 業 損 益	342,495	313,257	108,427	191,556	231,394	不適用
營業外收入及支出	116,782	126,612	200,262	160,385	216,837	不適用
稅 前 淨 利	459,277	439,869	308,689	351,941	448,231	不適用
繼續營業單位 本期淨利	392,523	375,675	278,684	309,970	396,873	不適用
停業單位損失	0	0	0	0	0	不適用
本期淨利（損）	392,523	375,675	278,684	309,970	396,873	不適用
本期其他綜合損益 （稅後淨額）	145,799	226,649	(318,281)	176,168	(9,067)	不適用
本期綜合損益總額	538,322	602,324	(39,597)	486,138	387,806	不適用
淨利歸屬於 母公司業主	392,523	375,675	278,684	309,970	396,873	不適用
淨利歸屬於非控制 權益	0	0	0	0	0	不適用
綜合損益總額歸屬 於母公司業主	538,322	602,324	(39,597)	486,138	387,806	不適用
綜合損益總額歸屬 於非控制權益	0	0	0	0	0	不適用
每 股 盈 餘	15.90	15.22	11.29	11.11	13.92	不適用

註 1：年報刊印年度，截至 3 月 31 日止無須編列個體財務報告，故不適用。

(五)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年 度	會計師事務所	會計師姓名	查 核 意 見
105 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	陳錦章、蔡美貞	無保留意見
106 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	陳錦章、蔡美貞	無保留意見
107 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	方蘇立、蔡美貞	無保留意見
108 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	方蘇立、葉東輝	無保留意見
109 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	方蘇立、鍾鳴遠	無保留意見

二、最近五年度財務分析：

(一)財務分析-合併財務報告

年 度 分析項目（註2）		最 近 五 年 度 財 務 分 析					110 年度截至 3 月 31 日止 財務資料(註1)
		105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	
財務結構(%)	負債占資產比率	52.02	44.68	48.98	43.27	46.03	註 1
	長期資金占不動產、 廠房及設備比率	578.57	313.31	271.00	285.24	309.54	註 1
償債能力	流動比率(%)	156.80	172.67	148.98	159.42	159.82	註 1
	速動比率(%)	105.49	128.25	95.81	97.38	96.21	註 1
	利息保障倍數(倍)	78	62	40	51	87	註 1
經營能力	應收款項週轉率（次）	6.28	6.69	4.96	6.31	7.50	註 1
	平均收現日數	58.12	54.55	73.58	57.84	48.66	註 1
	存貨週轉率（次）	1.71	1.59	1.15	1.22	1.19	註 1
	應付款項週轉率（次）	3.86	4.10	3.88	3.80	3.43	註 1
	平均銷貨日數	213.45	229.56	317.39	299.18	306.72	註 1
	不動產、廠房及設備 週轉率（次）	5.22	2.42	1.65	1.89	2.38	註 1
	總資產週轉率(次)	0.53	0.50	0.37	0.42	0.46	註 1
獲利能力	資產報酬率（%）	10.72	9.21	6.89	7.06	7.76	註 1
	權益報酬率（%）	21.27	17.52	12.75	12.96	14.04	註 1
	稅前純益占實收資本 額比率(%)	197.89	192.51	136.75	138.30	174.57	註 1
	純益率（%）	18.41	17.73	18.72	15.04	15.95	註 1
	每股(虧損)盈餘(元)	15.90	15.22	11.29	11.11	13.92	註 1
現金流量(%)	現金流量比率	23.75	31.44	11.10	20.06	29.46	註 1
	淨現金流量允當比率	97.28	109.00	87.61	75.83	80.90	註 1
	現金再投資比率	3.62	5.91	(2.85)	3.05	10.62	註 1
槓桿度	營運槓桿度	1.09	1.09	1.22	1.24	1.21	註 1
	財務槓桿度	1.01	1.01	1.03	1.02	1.01	註 1

註 1：截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成，故暫不列示。

註 2：財務分析之計算公式說明：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／ 不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

- (1)流動比率＝流動資產／流動負債。
- (2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
- (3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

- (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
- (2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。
- (3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
- (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
- (5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。
- (6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。
- (7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

- (1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。
- (2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。
- (3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
- (4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

- (1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
- (2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。
- (3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

- (1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。
- (2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

(二)財務分析-個體財務報告

年 度 分析項目（註2）		最 近 五 年 度 財 務 分 析					110 年度截至 3 月 31 日止 財務資料(註1)
		105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	
財務結構(%)	負債占資產比率	45.74	35.01	40.68	33.41	35.89	不適用
	長期資金占不動產、 廠房及設備比率	723.99	834.95	674.82	758.83	864.77	不適用
償債能力	流動比率(%)	152.20	183.98	140.54	148.53	152.03	不適用
	速動比率(%)	97.81	129.18	78.61	81.74	83.99	不適用
	利息保障倍數(倍)	118	133	94	112	206	不適用
經營能力	應收款項週轉率（次）	8.43	9.77	7.34	7.80	15.05	不適用
	平均收現日數	43.28	37.37	49.71	46.79	24.25	不適用
	存貨週轉率（次）	1.48	1.30	0.82	0.72	0.79	不適用
	應付款項週轉率（次）	3.74	4.03	3.61	2.78	2.99	不適用
	平均銷貨日數	246.62	280.77	445.12	506.94	462.03	不適用
	不動產、廠房及設備 週轉率（次）	5.65	5.05	2.84	2.63	3.44	不適用
	總資產週轉率(次)	0.46	0.42	0.27	0.24	0.26	不適用
獲利能力	資產報酬率（%）	11.62	10.52	8.03	8.27	9.21	不適用
	權益報酬率（%）	21.27	17.52	12.79	12.96	14.04	不適用
	稅前純益占實收資本 額比率(%)	186.06	178.20	125.06	120.46	153.42	不適用
	純益率（%）	23.54	25.04	30.38	31.14	33.09	不適用
	每股(虧損)盈餘(元)	15.90	15.22	11.29	11.11	13.92	不適用
現金流量(%)	現金流量比率	15.73	17.58	2.33	8.51	21.29	不適用
	淨現金流量允當比率	75.44	76.14	53.55	40.18	42.13	不適用
	現金再投資比率	(3.21)	(2.78)	(9.64)	(4.40)	2.34	不適用
槓桿度	營運槓桿度	1.04	1.04	1.18	1.17	1.17	不適用
	財務槓桿度	1.01	1.01	1.03	1.02	1.01	不適用

註1：年報刊印年度，截至3月31日止無須編列個體財務報告，故不適用。

註2：財務分析之計算公式說明：請參閱(一)財務分析-合併財務報告之註2。

(三)最近二年度各項財務比率變動原因

A.合併財務報告

1.財務結構：

109 年度負債占資產比率較 108 年度上升 6.38%，係因 109 年度資產總額較 108 年度增加 543,386 仟元及 109 年度負債總額較 108 年度增加 385,335 仟元。

109 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率較 108 年度上升 8.52%，係因 109 年不動產、廠房及設備較 108 年減少 45,037 仟元，109 年長期借款較 108 年度減少 33,845 仟元，109 年遞延所得稅負債較 108 年度減少 10,537 仟元及 109 年度權益總額較 108 年度增加 159,634 仟元所致。

2.償債能力：

109 年度流動比率與速動比率較 108 年度上升 0.25%及下降 1.20%，係因本公司 109 年度現金及約當現金較 108 年度減少 96,796 仟元、109 年度按攤銷後成本衡量之金融資產-流動較 108 年度增加 437,755 仟元、109 年度應收帳款淨額較 108 年度增加 31,868 仟元、109 年度存貨較 108 年度增加 260,555 仟元、109 年度合約負債-流動較 108 年度增加 309,909 仟元、109 年度負債準備-流動較 108 年度減少 13,632 仟元、109 年度短期借款較 108 年度減少 50,010 仟元及 109 年度應付帳款較 108 年度增加 112,876 仟元、109 年度本期所得稅負債較 108 年度增加 30,601 仟元所致。

109 年度利息保障倍數較 108 年度上升 70.59%，係因本公司 109 年度稅前息前純益較 108 年度增加 103,824 仟元、109 年度利息支出較 108 年度減少 2,158 仟元所致。

3.經營能力：

109 年度應收款項週轉率較 108 年度上升 18.85%，週轉天數較 108 年度減少約 10 天，係因 109 年度銷貨淨額較 108 年度銷貨淨額增加 426,284 仟元及 109 年度應收帳款較 108 年度增加 31,868 仟元所致。

109 年度應付款項週轉率(次)與 108 年度所產生之變動，係因 109 年度銷貨成本較 108 年度增加 248,661 仟元及 109 年度應付帳款較 108 年度增加 112,876 仟元。

109 年度不動產、廠房及設備週轉率較 109 年度上升 25.93%，係因 109 年度銷貨淨額較 108 年度銷貨淨額增加 426,284 仟元及 109 年度不動產、廠房及設備淨額較 108 年度減少 45,037 仟元所致。

109 年度總資產週轉率較 108 年度上升 9.52%，係因 109 年度銷貨淨額較 108 年度銷貨淨額增加 426,284 仟元及 109 年度資產總額較 108 年度增加 543,386 仟元所致。

4.獲利能力：

資產報酬率及權益報酬率分別上升 9.92%及 8.33%，主因為 109 年稅後淨利較 108 年增加 84,602 仟元及 109 年資產總額較 108 年增加 543,386 仟元及 109 年權益總額較 108 年增加 159,634 仟元所致。

純益率上升 6.05%、每股盈餘上升 25.29%，主要原因係因 109 年度銷貨淨額較 108 年度銷貨淨額增加 426,284 仟元及 109 年度銷貨成本較 108 年

度增加 248,661 仟元所致。

5.現金流量：

109 年度現金流量比率較 108 年度上升 46.86%，主係因 109 年度營業活動淨現金流量入較 108 年度增加 281,819 仟元；109 年度流動負債較 108 年度增加 424,563 仟元。

109 年度淨現金流量允當比率較 108 年度上升 6.69%，主係因 109 年度最近五年度營業活動淨現金流量較 108 年度增加 236,234 仟元；109 年度最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)較 108 年度增加 153,043 仟元所致。

B.個體財務報告

1.財務結構：

109 年度負債占資產比率較 108 年度上升 7.42%，係因 109 年度資產總額較 108 年度增加 408,530 仟元及 109 年度負債總額較 108 年度增加 248,896 仟元。

109 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率較 108 年度上升 13.96%，係因 109 年度不動產、廠房及設備較 108 年度減少 29,618 仟元，109 年度長期借款較 108 年度減少 15,310 仟元，109 年度遞延所得稅負債較 108 年度減少 10,581 仟元及 109 年度權益總額較 108 年度增加 159,634 仟元所致。

2.償債能力：

109 年度流動比率與速動比率較 108 年度上升 2.36%及 2.75%，因本公司 109 年度現金及約當現金較 108 年度減少 154,090 仟元、109 年度按攤銷後成本衡量之金融資產-流動較 108 年度增加 418,055 仟元、109 年度應收帳款淨額較 108 年度減少 18,266 仟元、109 年度存貨較 108 年度增加 192,748 仟元、109 年度短期借款較 108 年度減少 10,000 仟元、109 年度合約負債較 108 年度增加 205,446 仟元、109 年度負債準備-流動較 108 年度減少 14,214 仟元、109 年度應付帳款較 108 年度增加 63,156 仟元及 109 年度本期所得稅負債較 108 年度增加 18,378 仟元所致。

109 年度利息保障倍數較 108 年度上升 83.93%，係因本公司 109 年度稅前息前純益較 108 年度增加 96,290 仟元、109 年度利息支出較 108 年度減少 972 仟元所致。

3.經營能力：

109 年度應收款項週轉率較 108 年度增加 92.95%，週轉天數較 107 年度減少約 23 天，係因 109 年度銷貨淨額較 108 年度銷貨淨額增加 204,079 仟元及 109 年度應收帳款較 108 年度減少 18,266 仟元所致。

109 年度應付款項週轉率(次)與 108 年度所產生之變動，係因 109 年度銷貨成本較 108 年度增加 148,055 仟元及 109 年度應付帳款較 108 年度增加 63,156 仟元。

109 年度不動產、廠房及設備週轉率較 108 年度上升 30.80%，係因 109 年度銷貨淨額較 108 年度銷貨淨額增加 204,079 仟元，109 年度不動產、廠房及設備淨額較 108 年度減少 29,618 仟元所致。

109 年度總資產週轉率較 108 年度上升 8.3%，係因 109 年度銷貨淨額

較 108 年度銷貨淨額增加 204,079 仟元及 109 年度資產總額較 108 年度增加 408,530 仟元所致。

4.獲利能力：

資產報酬率及權益報酬率分別上升 11.37%及 8.33%，主因為 109 年度稅後淨利較 108 年度增加 86,903 仟元及 109 年度資產總額較 108 年度增加 408,530 仟元及 109 年度權益總額較 108 年度增加 159,634 仟元所致。

純益率上升 6.26%與每股盈餘上升 25.29%，主要原因係因 109 年度銷貨淨額較 108 年度銷貨淨額增加 204,079 仟元及 109 年度銷貨成本較 108 年度增加 148,055 仟元所致。

5.現金流量：

109 年度現金流量比率較 108 年度上升 150.18%，主係因 109 年度營業活動淨現金流量入較 108 年度增加 207,734 仟元；109 年度流動負債較 108 年度增加 265,246 仟元。

109 年度淨現金流量允當比率較 108 年度上升 4.85%，主係因 109 年度最近五年度營業活動淨現金流量較 108 年度增加 70,114 仟元；109 年度最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)較 108 年度增加 80,393 仟元所致。

三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告：請參閱第 89 頁。

四、最近年度財務報告，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及附註或附表：請參閱第 90~156 頁。

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告，但不含重要會計項目明細表：請參閱第 157~218 頁。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，是否有發生財務週轉困難情事：無。

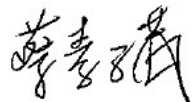
弘塑科技股份有限公司 監察人查核報告書

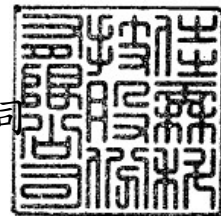
董事會造送本公司一〇九年度合併財務報告（含個體財務報告），業經勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立會計師、鍾鳴遠會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派議案，經本監察人等查核完竣認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

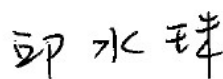
此致

弘塑科技股份有限公司一一〇年股東常會

監察人：佳霖科技股份有限公司

代表人：蔡素滿 



監察人：邱水珠 

監察人：任克川 

中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 二 十 二 日

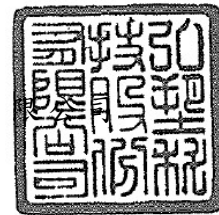
關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 109 年度（自民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：弘塑科技股份有

負責人：張 鴻



中 華 民 國 110 年 3 月 22 日

會計師查核報告

弘塑科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

弘塑科技股份有限公司及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達弘塑科技股份有限公司及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與弘塑科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對弘塑科技股份有限公司及其子公司民國 109 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對弘塑科技股份有限公司及其子公司民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入之認列

弘塑科技股份有限公司及其子公司民國 109 年度營業收入淨額為新台幣 2,487,671 仟元，與收入認列相關會計政策及資訊請參閱合併財務報告附註四及二三。

弘塑科技股份有限公司及其子公司近年來營業收入金額變化顯著對其民國 109 年度合併財務報表影響重大，惟對部分主要客戶營業收入及毛利率係顯著成長者，本會計師將其真實性列為本年度之關鍵查核事項。

本會計師因應上述風險，執行查核程序如下：

1. 瞭解及測試收入認列之主要內部控制設計及執行之有效性。
2. 抽核營業收入明細，核對客戶原始訂單及驗收單客戶簽收文件等相關憑證，是否與發票及入帳內容一致。
3. 抽核應收帳款收款金額、匯款憑證與對象是否與收入認列之金額與對象相符。

其他事項

弘塑科技股份有限公司業已編製民國 109 及 108 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估弘塑科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算弘塑科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

弘塑科技股份有限公司及其子公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對弘塑科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使弘塑科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致弘塑科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於弘塑科技股份有限公司及其子公司組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責弘塑科技股份有限公司及其子公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對弘塑科技股份有限公司及其子公司民國 109 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 方 蘇 立

方蘇立



會計師 鍾 鳴 遠

鍾鳴遠



金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0940161384 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 110 年 3 月 22 日

代 碼	資 產	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四、六及二九）	\$ 869,085	16	\$ 965,881	20
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、八及二九）	765,235	14	327,480	7
1150	應收票據淨額（附註四、九及二九）	4,150	-	782	-
1170	應收帳款淨額（附註四、五、九及二九）	344,205	6	312,337	6
1200	其他應收款（附註九及二九）	4,074	-	6,179	-
130X	存貨（附註四、五及十）	1,270,571	23	1,010,016	21
1410	預付款項	60,275	1	24,696	-
1470	其他流動資產（附註十六及三一）	26,512	1	11,555	-
11XX	流動資產總計	3,344,107	61	2,658,926	54
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四、七及二九）	506,970	10	571,482	12
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十二及三一）	1,046,236	19	1,091,273	22
1755	使用權資產（附註四及十三）	5,328	-	4,490	-
1780	其他無形資產（附註四及十五）	167,060	3	199,345	4
1805	商譽（附註四及十四）	315,970	6	315,970	7
1840	遞延所得稅資產（附註四及二五）	56,153	1	54,820	1
1990	其他非流動資產（附註十六及二九）	1,519	-	3,651	-
15XX	非流動資產總計	2,099,236	39	2,241,031	46
1XXX	資 產 總 計	\$ 5,443,343	100	\$ 4,899,957	100
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註四、十七及二九）	\$ 218,000	4	\$ 268,010	6
2130	合約負債－流動（附註十九及二三）	874,002	16	564,093	12
2150	應付票據（附註四、十八及二九）	159	-	2	-
2170	應付帳款（附註四、十八及二九）	452,920	8	340,044	7
2200	其他應付款（附註十九及二九）	328,297	6	314,957	6
2230	本期所得稅負債（附註四及二五）	119,630	2	89,029	2
2250	負債準備－流動（附註四、五及二十）	57,638	1	71,270	1
2280	租賃負債－流動（附註四、十三及二九）	1,273	-	1,482	-
2320	一年內到期之長期借款（附註四、十七及二九）	37,133	1	16,143	-
2399	其他流動負債（附註十九）	3,409	-	2,868	-
21XX	流動負債總計	2,092,461	38	1,667,898	34
	非流動負債				
2540	長期借款（附註四、十七及二九）	332,976	6	366,821	8
2550	負債準備－非流動（附註四、五及二十）	19,559	1	11,077	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及二五）	44,892	1	55,429	1
2580	租賃負債－非流動（附註四、十三及二九）	1,321	-	77	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及二一）	14,379	-	18,951	-
25XX	非流動負債總計	413,127	8	452,355	9
2XXX	負債總計	2,505,588	46	2,120,253	43
	歸屬於母公司業主之權益（附註四及二二）				
3110	普通股股本	292,160	5	292,160	6
3200	資本公積	1,102,358	20	1,096,802	22
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	343,574	6	312,577	7
3320	特別盈餘公積	1,386	-	1,386	-
3350	未分配盈餘	1,027,293	19	841,636	17
3300	保留盈餘總計	1,372,253	25	1,155,599	24
3400	其他權益	221,428	4	284,004	6
3500	庫藏股票	(82,648)	(1)	(82,648)	(2)
31XX	母公司業主權益總計	2,905,551	53	2,745,917	56
36XX	非控制權益	32,204	1	33,787	1
3XXX	權益總計	2,937,755	54	2,779,704	57
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 5,443,343	100	\$ 4,899,957	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌



弘塑科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		109年度		108年度	
		金	%	金	%
4100	營業收入（附註四、二三及三十）	\$ 2,487,671	100	\$ 2,061,387	100
5110	營業成本（附註十、二四及三十）	<u>1,361,351</u>	<u>54</u>	<u>1,112,690</u>	<u>54</u>
5900	營業毛利	<u>1,126,320</u>	<u>46</u>	<u>948,697</u>	<u>46</u>
	營業費用（附註二四及三十）				
6100	推銷費用	154,180	6	132,760	6
6200	管理費用	242,364	10	225,991	11
6300	研究發展費用	194,497	8	175,148	9
6450	預期信用減損損失	<u>2,159</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>593,200</u>	<u>24</u>	<u>533,899</u>	<u>26</u>
6900	營業淨利	<u>533,120</u>	<u>22</u>	<u>414,798</u>	<u>20</u>
	營業外收入及支出（附註二四）				
7100	利息收入	6,168	-	8,601	1
7010	其他收入	4,313	-	5,062	-
7020	其他利益及損失	(27,684)	(1)	(16,368)	(1)
7050	財務成本	<u>(5,880)</u>	<u>-</u>	<u>(8,038)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(23,083)</u>	<u>(1)</u>	<u>(10,743)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	510,037	21	404,055	20
7950	所得稅費用（附註四及二五）	<u>112,679</u>	<u>5</u>	<u>91,299</u>	<u>5</u>
8000	本年度淨利	<u>397,358</u>	<u>16</u>	<u>312,756</u>	<u>15</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註四、二一、二二及二五）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再				
	衡量數	\$ 2,930	-	(\$ 2,017)	-
8316	透過其他綜合損益				
	按公允價值衡量				
	之權益工具投資				
	未實現評價損益	(15,689)	-	224,949	11
8360	後續可能重分類至損益				
	之項目：				
8361	國外營運機構財務				
	報表換算之兌換				
	差額	991	-	(2,057)	-
8399	與可能重分類至損				
	益之項目相關之				
	所得稅	<u>3,140</u>	<u>-</u>	(<u>44,990</u>)	(<u>2</u>)
8300	本年度其他綜合損				
	益（稅後淨額）	(<u>8,628</u>)	<u>-</u>	<u>175,885</u>	<u>9</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 388,730</u>	<u>16</u>	<u>\$ 488,641</u>	<u>24</u>
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 396,873	16	\$ 309,970	15
8620	非控制權益	<u>485</u>	<u>-</u>	<u>2,786</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 397,358</u>	<u>16</u>	<u>\$ 312,756</u>	<u>15</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 387,806	16	\$ 486,138	24
8720	非控制權益	<u>924</u>	<u>-</u>	<u>2,503</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 388,730</u>	<u>16</u>	<u>\$ 488,641</u>	<u>24</u>
	每股盈餘（附註二六）				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 13.92</u>		<u>\$ 11.11</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 13.85</u>		<u>\$ 11.05</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

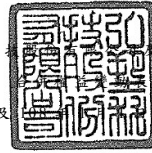
石本立

會計主管：曾繁斌



弘塑科技股份有限公司

民國 109 年及 110 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代 碼		歸 屬 於 本 公 司 業 主 之 權 益											非 控 制 權 益	權 益 總 額
		股 數 (仟 股)	股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	其 他 權 益 項 目		庫 藏 股 票	總 計			
								國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兒 換 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 未 實 現 損 益					
A1	108 年 1 月 1 日 餘 額	24,684	\$ 246,838	\$ 601,772	\$ 284,709	\$ 1,386	\$ 795,002	(\$ 1,205)	\$ 107,301	\$ -	\$ 2,035,803	\$ 35,219	\$ 2,071,022	
B1	107 年度盈餘指撥及分配													
B7	法定盈餘公積	-	-	-	27,868	-	(27,868)	-	-	-	-	-	-	
B7	現金股利	-	-	-	-	-	(233,728)	-	-	-	(233,728)	-	(233,728)	
D1	108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 淨 利	-	-	-	-	-	309,970	-	-	-	309,970	2,786	312,756	
D3	108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	(1,740)	(2,051)	179,959	-	176,168	(283)	175,885	
D5	108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	308,230	(2,051)	179,959	-	486,138	2,503	488,641	
H1	合併發行新股	4,532	45,322	489,474	-	-	-	-	-	-	534,796	-	534,796	
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,935)	(3,935)	
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	5,556	-	-	-	-	-	-	5,556	-	5,556	
L1	庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	(82,648)	(82,648)	-	(82,648)	
Z1	108 年 12 月 31 日 餘 額	29,216	292,160	1,096,802	312,577	1,386	841,636	(3,256)	287,260	(82,648)	2,745,917	33,787	2,779,704	
B1	108 年度盈餘指撥及分配													
B7	法定盈餘公積	-	-	-	30,997	-	(30,997)	-	-	-	-	-	-	
B7	現金股利	-	-	-	-	-	(233,728)	-	-	-	(233,728)	-	(233,728)	
D1	109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 淨 利	-	-	-	-	-	396,873	-	-	-	396,873	485	397,358	
D3	109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	2,491	991	(12,549)	-	(9,067)	439	(8,628)	
D5	109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	399,364	991	(12,549)	-	387,806	924	388,730	
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	5,556	-	-	-	-	-	-	5,556	-	5,556	
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,507)	(2,507)	
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	51,018	-	(51,018)	-	-	-	-	
Z1	109 年 12 月 31 日 餘 額	29,216	\$ 292,160	\$ 1,102,358	\$ 343,574	\$ 1,386	\$ 1,027,293	(\$ 2,265)	\$ 223,693	(\$ 82,648)	\$ 2,905,551	\$ 32,204	\$ 2,937,755	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌



弘塑科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 510,037	\$ 404,055
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	72,962	65,024
A20200	攤銷費用	37,262	35,317
A20300	預期信用減損損失	2,159	-
A20900	財務成本	5,880	8,038
A21200	利息收入	(6,168)	(8,601)
A21300	股利收入	(2,952)	(3,778)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	13,362	19,821
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	98	10,633
A24100	外幣兌換淨損失	4,800	7,829
A29900	預付款項攤銷	1,308	1,482
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(3,368)	984
A31150	應收帳款	(36,092)	78,428
A31180	其他應收款	1,931	(1,679)
A31200	存 貨	(273,917)	(171,546)
A31230	預付款項	(36,887)	(14,274)
A31240	其他流動資產	(14,957)	(7,549)
A31250	其他非流動資產	1,225	3,454
A32125	合約負債	309,909	(44,680)
A32130	應付票據	157	(1,183)
A32150	應付帳款	112,972	32,134
A32180	其他應付款	13,436	5,829
A32200	負債準備	(5,150)	(36,167)
A32230	其他流動負債	542	191
A32240	淨確定福利負債	(1,642)	(3,195)
A33000	營運產生之現金流入	706,907	380,567
A33100	收取之利息	6,342	8,653
A33300	支付之利息	(5,959)	(8,003)
A33500	支付之所得稅	(90,809)	(46,555)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>616,481</u>	<u>334,662</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 29,960)	\$ -
B00200	出售透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	78,784	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(437,755)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	60,706
B02200	對子公司之收購(附註二七)	-	116,280
B02700	購置不動產、廠房及設備	(25,604)	(13,470)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	101	118
B03800	存出保證金減少	907	456
B04500	購置無形資產	(4,977)	(4,013)
B09900	收取其他股利	<u>2,952</u>	<u>3,778</u>
BBBB	投資活動之淨現金(流出)流入	<u>(415,552)</u>	<u>163,855</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	(50,010)	(11,990)
C01600	舉借長期借款	30,380	-
C01700	償還長期借款	(43,235)	(37,370)
C04020	租賃負債本金償還	(2,296)	(2,106)
C04500	支付本公司業主股利	(228,172)	(228,172)
C05800	支付非控制權益現金股利	<u>(2,507)</u>	<u>(3,935)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(295,840)</u>	<u>(283,573)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(1,885)</u>	<u>(7,798)</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加數	(96,796)	207,146
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>965,881</u>	<u>758,735</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 869,085</u>	<u>\$ 965,881</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌



弘塑科技股份有限公司及子公司

合併財務報告附註

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(除另註明外，金額以新台幣仟元為單位)

一、公司沿革

弘塑科技股份有限公司(以下稱「本公司」)係於 82 年 5 月設立於新竹市之股份有限公司，並於同年 5 月開始營業，所營業務主要為各種塑膠機械安裝工程設計，五金、機械、塑膠管、泵線、槽、樹脂、塗料、化工原料貯槽工程承包買賣，前各項有關產品之進出口貿易業務，半導體及積體電路製造設備及其材料、零件之代理、買賣及其技術諮詢顧問業務。

弘塑科技股份有限公司於 107 年 11 月及 108 年 3 月，為加強異業整合，併購太引資訊股份有限公司及佳霖科技股份有限公司，太引資訊股份有限公司所營業務為各類製造設備軟體設計，佳霖科技股份有限公司所營業務為半導體及積體電路製造設備及其材料、零件之代理、買賣及其技術諮詢顧問業務。

本公司股票自 100 年 1 月起在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。

本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告於 110 年 3 月 22 日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

- (一) 首次適用金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可並發布生效之國際財務報導準則(IFRS)、國際會計準則(IAS)、解釋(IFRIC)及解釋公告(SIC)(以下稱「IFRSs」)

適用修正後之金管會認可並發布生效之 IFRSs 將不致造成合併公司會計政策之重大變動。

(二) 110 年適用之金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）認可之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
IFRS 4 之修正「適用 IFRS 9 之暫時豁免之展延」	發布日起生效
IFRS 9、IAS 39、IFRS 7、IFRS 4 及 IFRS 16 之修正「利率指標變革－第二階段」	2021 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間生效
IFRS 16 之修正「新型冠狀病毒肺炎相關租金減讓」	2020 年 6 月 1 日以後開始之年度報導期間生效

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日（註 1）
「2018-2020 週期之年度改善」	2022 年 1 月 1 日（註 2）
IFRS 3 之修正「更新對觀念架構之索引」	2022 年 1 月 1 日（註 3）
IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未 定
IFRS 17「保險合約」	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17 之修正	2023 年 1 月 1 日
IAS 1 之修正「負債分類為流動或非流動」	2023 年 1 月 1 日
IAS 1 之修正「會計政策之揭露」	2023 年 1 月 1 日（註 6）
IAS 8 之修正「會計估計之定義」	2023 年 1 月 1 日（註 7）
IAS 16 之修正「不動產、廠房及設備：達到預定使用狀態前之價款」	2022 年 1 月 1 日（註 4）
IAS 37 之修正「虧損性合約－履行合約之成本」	2022 年 1 月 1 日（註 5）

註 1：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註 2：IFRS 9 之修正適用於 2022 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間所發生之金融負債之交換或條款修改；IAS 41「農業」之修正適用於 2022 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間之公允價值衡量；IFRS 1「首次採用 IFRSs」之修正係追溯適用於 2022 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間。

註 3：收購日在年度報導期間開始於 2022 年 1 月 1 日以後之企業合併適用此項修正。

註 4：於 2021 年 1 月 1 日以後始達管理階層預期運作方式之必要地點及狀態之廠房、不動產及設備適用此項修正。

註 5：於 2022 年 1 月 1 日尚未履行所有義務之合約適用此項修正。

註 6：於 2023 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間推延適用此項修正。

註 7：於 2023 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間所發生之會計估計變動及會計政策變動適用此項修正。

截至本合併財務報告通過發布日止，合併公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之 IFRSs 編製。

(二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具及按確定福利義務現值減除計畫資產公允價值認列之淨確定福利負債外，本合併財務報告係依歷史成本基礎編製。

公允價值衡量依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第 1 等級至第 3 等級：

1. 第 1 等級輸入值：係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活躍市場之報價（未經調整）。
2. 第 2 等級輸入值：係指除第 1 等級之報價外，資產或負債直接（亦即價格）或間接（亦即由價格推導而得）之可觀察輸入值。
3. 第 3 等級輸入值：係指資產或負債之不可觀察之輸入值。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括：

1. 主要為交易目的而持有之資產；
2. 預期於資產負債表日後 12 個月內實現之資產；及
3. 現金及約當現金（但不包括於資產負債表日後逾 12 個月用以交換或清償負債而受到限制者）。

流動負債包括：

1. 主要為交易目的而持有之負債；
2. 於資產負債表日後 12 個月內到期清償之負債，以及
3. 不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少 12 個月之負債。

非屬上述流動資產或流動負債者，係分類為非流動資產或非流動負債。

(四) 合併基礎

本合併財務報告係包含本公司及由本公司所控制個體（子公司）之財務報告。合併綜合損益表已納入被收購或被處分子公司於當期自收購日起或至處分日止之營運損益。子公司之財務報告已予調整，以使其會計政策與合併公司之會計政策一致。於編製合併財務報告時，各個體間之交易、帳戶餘額、收益及費損已全數予以銷除。子公司之綜合損益總額係歸屬至本公司業主及非控制權益，即使非控制權益因而成為虧損餘額。

當合併公司對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者，係作為權益交易處理。合併公司及非控制權益之帳面金額已予調整，以反映其於子公司相對權益之變動。非控制權益之調整金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額，係直接認列為權益且歸屬於本公司業主。

子公司明細、持股比率及營業項目，參閱附註十一及附表五。

(五) 外 幣

各個體編製財務報告時，以個體功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算。因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額，於發生當期認列於損益。

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算，所產生之兌換差額列為當期損益，惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者，其產生之兌換差額列於其他綜合損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。

於編製合併財務報告時，國外營運機構（包含營運所在國家或使用之貨幣與本公司不同之子公司、關聯企業、合資或分公司）之資產及負債以每一資產負債表日匯率換算為新台幣。收益及費損項目係以當期平均匯率換算，所產生之兌換差額列於其他綜合損益。

(六) 存 貨

存貨包括原料、物料、製成品及在製品。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。存貨成本之計算係採加權平均法。

(七) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本認列，後續以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。

不動產、廠房及設備於耐用年限內按直線基礎，對每一重大部分單獨提列折舊。合併公司至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響。

不動產、廠房及設備除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

(八) 商 譽

企業合併所取得之商譽係依收購日所認列之商譽金額作為成本，後續以成本減除累計減損損失後之金額衡量。

為減損測試之目的，商譽分攤至合併公司預期因該合併綜效而受益之各現金產生單位或現金產生單位群組（簡稱「現金產生單位」）。

受攤商譽之現金產生單位每年（及有跡象顯示該單位可能已減損時）藉由包含商譽之該單位帳面金額與其可回收金額之比較，進行該單位之減損測試。若分攤至現金產生單位之商譽係當年度企業合併所取得，則該單位應於當年度結束前進行減損測試。若受攤商

譽之現金產生單位之可回收金額低於其帳面金額，減損損失係先減少該現金產生單位受攤商譽之帳面金額，次就該單位內其他各資產帳面金額之比例減少各該資產帳面金額。任何減損損失直接認列為當期損失。商譽減損損失不得於後續期間迴轉。

處分受攤商譽現金產生單位內之某一營運時，與該被處分營運有關之商譽金額係包含於營運之帳面金額以決定處分損益。

(九) 無形資產

1. 單獨取得

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損損失後之金額衡量。無形資產於耐用年限內按直線基礎進行攤銷，並且至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及攤銷方法進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響。非確定耐用年限無形資產係以成本減除累計減損損失列報。

2. 企業合併所取得

企業合併所取得之無形資產係以收購日之公允價值認列，並與商譽分別認列，後續衡量方式與單獨取得之無形資產相同。

3. 除 列

無形資產除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當期損益。

(十) 有形資產及無形資產（商譽除外）之減損

合併公司於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產（商譽除外）可能已減損。若有任一減損跡象存在，則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，合併公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。

針對非確定耐用年限及尚未可供使用之無形資產，至少每年及有減損跡象時進行減損測試。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者。個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於其帳面金額時，將該資

產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額，減損損失係認列於損益。

當減損損失於後續迴轉時，該資產或現金產生單位之帳面金額調增至修訂後之可回收金額，惟增加後之帳面金額以不超過該資產或現金產生單位若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額（減除攤銷或折舊）。減損損失之迴轉係認列於損益。

(十一) 金融工具

金融資產與金融負債於合併公司成為該工具合約條款之一方時認列於合併資產負債表。

原始認列金融資產與金融負債時，若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者，係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本，則立即認列為損益。

1. 金融資產

金融資產之慣例交易係採交易日會計認列及除列。

(1) 衡量種類

合併公司所持有之金融資產種類為按攤銷後成本衡量之金融資產與透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資。

A. 按攤銷後成本衡量之金融資產

合併公司投資金融資產若同時符合下列兩條件，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產：

- a. 係於某經營模式下持有，該模式之目的係持有金融資產以收取合約現金流量；及
- b. 合約條款產生特定日期之現金流量，該等現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

按攤銷後成本衡量之金融資產（包括現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之應收票據、應收帳款與其他應收款）於原始認列後，係以有效利息法決定之總帳面金

額減除任何減損損失之攤銷後成本衡量，任何外幣兌換損益則認列於損益。

除下列兩種情況外，利息收入係以有效利率乘以金融資產總帳面金額計算：

- a. 購入或創始之信用減損金融資產，利息收入係以信用調整後有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算。
- b. 非屬購入或創始之信用減損，但後續變成信用減損之金融資產，應自信用減損後之次一報導期間起以有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算利息收入。

信用減損金融資產係指發行人或債務人已發生重大財務困難、違約、債務人很有可能聲請破產或其他財務重整或由於財務困難而使金融資產之活絡市場消失。

約當現金包括自取得日起 3 個月內、高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款，係用於滿足短期現金承諾。

B. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

合併公司於原始認列時，可作一不可撤銷之選擇，將非持有供交易且非企業合併收購者所認列或有對價之權益工具投資，指定透過其他綜合損益按公允價值衡量。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資係按公允價值衡量，後續公允價值變動列報於其他綜合損益，並累計於其他權益中。於投資處分時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資之股利於合併公司收款之權利確立時認列於損益中，除非該股利明顯代表部分投資成本之回收。

(2) 金融資產之減損

合併公司於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產（含應收帳款）之減損損失。

應收帳款按存續期間預期信用損失認列備抵損失。其他金融資產係先評估自原始認列後信用風險是否顯著增加，若未顯著增加，則按 12 個月預期信用損失認列備抵損失，若已顯著增加，則按存續期間預期信用損失認列備抵損失。

預期信用損失係以發生違約之風險作為權重之加權平均信用損失。12 個月預期信用損失係代表金融工具於報導日後 12 個月內可能違約事項所產生之預期信用損失，存續期間預期信用損失則代表金融工具於預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

合併公司為內部信用風險管理目的，在不考量所持有擔保品之前提下，判定下列情況代表金融資產已發生違約：

A.有內部或外部資訊顯示債務人已不可能清償債務。

所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額，惟透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資之備抵損失係認列於其他綜合損益，並不減少其帳面金額。

(3) 金融資產之除列

合併公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資整體除列時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

(十二) 負債準備

認列為負債準備（包括銷售合約之保固）之金額係考量義務之風險及不確定性，而為資產負債表日清償義務所需支出之最佳估計。負債準備係以清償義務之估計現金流量折現值衡量。

當清償負債準備所需支出之一部分或全部預期可自另一方歸墊，於幾乎確定可收到該歸墊，且其金額能可靠衡量時，將歸墊認列為資產。

1. 保 固

保證產品與所協議之規格相符之保固義務係依管理階層對清償合併公司義務所需支出之最佳估計，於相關商品認列收入時認列。

(十三) 收入認列

合併公司於客戶合約辨認履約義務後，將交易價格分攤至各履約義務，並於滿足各履約義務時認列收入。

若幾乎同時與同一客戶（或客戶之關係人）簽訂數個合約，因該等合約承諾之商品或勞務係為單一履約義務，合併公司係以單一合約處理。

1. 商品銷貨收入

商品銷貨收入主要來自於半導體機台之銷售。由於半導體機台依個別合約約定，於運抵客戶指定地點或起運時，客戶已確認商品符合合約協定之規格，並具有能力可主導該產品之使用且取得該產品幾乎所有剩餘利益，故合併公司係於該時點認列收入及應收帳款。產品銷售之預收款項，於產品運抵前係認列為合約負債。

去料加工時，加工產品所有權之控制並未移轉，是以去料時不認列收入。

(十四) 租 賃

合併公司於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。

1. 合併公司為承租人

除適用認列豁免之低價值標的資產租賃及短期租賃之租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用，其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接成本及復原標的資產之估計成本）衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。使用權資產係單獨表達於合併資產負債表。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊。

租賃負債原始按租賃給付（包含固定給付及實質固定給付）之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，則使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間變動導致未來租賃給付有變動，合併公司再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，則剩餘之再衡量金額認列於損益中。租賃負債係單獨表達於合併資產負債表。

（十五）借款成本

直接可歸屬於取得、建造或生產符合要件之資產之借款成本，係作為該資產成本之一部分，直到該資產達到預定使用或出售狀態之幾乎所有必要活動已完成為止。

特定借款如於符合要件之資本支出發生前進行暫時投資而賺取之投資收入，係自符合資本化條件之借款成本中減除。

除上述外，所有其他借款成本係於發生當期認列為損益。

（十六）員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利相關負債係以換取員工服務而預期支付之非折現金額衡量。

2. 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務期間將應提撥之退休金數額認列為費用。

確定福利退休計畫之確定福利成本（含服務成本、淨利息及再衡量數）係採預計單位福利法精算。服務成本（含當期服務成本）及淨確定福利負債（資產）淨利息於發生時認列為員工福利費用。再衡量數（含精算損益及扣除利息後之計畫資產報酬）於發生時認列於其他綜合損益並列入其他權益，後續期間不重分類至損益。

淨確定福利負債（資產）係確定福利退休計畫之提撥短絀（剩餘）。淨確定福利資產不得超過從該計畫退還提撥金或可減少未來提撥金之現值。

（十七）所得稅

所得稅費用係當期所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當期所得稅

依中華民國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，係於股東會決議年度認列。

以前年度應付所得稅之調整，列入當期所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。

遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能具有課稅所得以供可減除暫時性差異、虧損扣抵或購置機器設備、研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減使用時認列。

與投資子公司及關聯企業相關之應課稅暫時性差異皆認列遞延所得稅負債，惟合併公司若可控制暫時性差異迴轉之時點，且該暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者除外。與此類投資有關之可減除暫時性差異，僅於其很有可能具有足夠課稅所得用以實現暫時性差異，且於可預見之未來預期將迴轉的範圍內，予以認列遞延所得稅資產。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視，並針對已不再很有可能足額之課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者，亦於每一資產負債表日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當期之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映合併公司於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅後果。

3. 當期及遞延所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當期及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

若當期所得稅或遞延所得稅係自企業合併所產生，其所得稅影響數納入企業合併之會計處理。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

合併公司於採用會計政策時，對於不易自其他來源取得相關資訊者，管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

合併公司將新型冠狀病毒肺炎疫情造成之經濟影響納入重大會計估計之考量，管理階層將對估計與基本假設持續檢視。若估計之修正僅影響當年度，則於修正當年度認列；若會計估計之修正同時影響當年度及未來期間，則於修正當年度及未來期間認列。

估計及假設不確定性之主要來源

存貨之減損

存貨淨變現價值係正常營業過程中之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額估計，該等估計係依目前市場狀況及類似產品之歷史銷售經驗評估，市場情況之改變可能重大影響該等估計結果。

六、現金及約當現金

	109年12月31日	108年12月31日
庫存現金	\$ 361	\$ 334
銀行支票及活期存款	609,310	820,044
約當現金		
原始到期日在3個月以內之		
銀行定期存款	<u>259,414</u>	<u>145,503</u>
	<u>\$869,085</u>	<u>\$965,881</u>

銀行存款於資產負債表日之利率區間如下：

	109年12月31日	108年12月31日
銀行存款	0.001%~0.3%	0.001%~0.65%

七、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

	109年12月31日	108年12月31日
<u>非流動</u>		
權益工具投資	<u>\$506,970</u>	<u>\$571,482</u>

(一) 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

	109年12月31日	108年12月31日
<u>非流動</u>		
國外投資		
上市（櫃）公司股票	\$386,820	\$488,520
未上市（櫃）公司股票	<u>120,150</u>	<u>82,962</u>
	<u>\$506,970</u>	<u>\$571,482</u>

合併公司依中長期策略目的投資國外上市（櫃）公司普通股及未上市（櫃）公司特別股，並預期透過長期投資獲利。合併公司管理階層認為若將該等投資之短期公允價值波動列入損益，與前述長期投資規劃並不一致，因此選擇指定該等投資為透過其他綜合損益按公允價值衡量。

合併公司於109年1月按29,960仟元購買SVXR, Inc.公司特別股，因屬中長期策略目的投資而指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量。

於109年8月，合併公司調整投資部位以分散風險，而按公允價值78,784仟元出售部分上市（櫃）公司普通股，相關其他權益一

透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益
60,575 仟元則轉入保留盈餘。

八、按攤銷後成本衡量之金融資產

	109年12月31日	108年12月31日
<u>流動</u>		
國內投資		
原始到期日超過3個月之定期存款(一)	\$736,680	\$327,480
國外投資		
SVXR, Inc.公司債券(二)	<u>28,555</u>	<u>-</u>
	<u>\$765,235</u>	<u>\$327,480</u>

(一) 截至 109 年及 108 年 12 月 31 日止，原始到期日超過 3 個月之定期存款利率區間分別為年利率 0.40%~0.82%及 0.81%~2.80%。

(二) 本公司於 109 年 11 月按面額 28,555 仟元購買 SVXR, Inc.公司債，票面利率 10%。

九、應收票據、應收帳款及其他應收款

	109年12月31日	108年12月31日
<u>應收票據</u>		
因營業而發生	<u>\$ 4,150</u>	<u>\$ 782</u>
<u>應收帳款</u>		
按攤銷後成本衡量		
應收帳款	\$346,364	\$312,337
減：備抵損失	<u>(2,159)</u>	<u>-</u>
	<u>\$344,205</u>	<u>\$312,337</u>
<u>其他應收款</u>		
應收退稅款	\$ 868	\$ 1,190
應收收益	256	430
其 他	<u>2,950</u>	<u>4,559</u>
	<u>\$ 4,074</u>	<u>\$ 6,179</u>

(一) 按攤銷後成本衡量之應收帳款

合併公司對商品銷售之平均授信期間為 60~120 天，應收帳款不予計息，合併公司採行之政策係僅與評等相當於投資等級以上（含）之對象進行交易，並於必要情形下取得足額之擔保以減輕因拖欠所產生財務損失之風險。信用評等資訊係使用其他公開可得之財

務資訊及歷史交易記錄對主要客戶予以評等。合併公司持續監督信用暴險及交易對方之信用等級，並將總交易金額分散至信用評等合格之不同客戶，另透過每年由風險管理委員會複核及核准之交易對方信用額度以管理信用暴險。

合併公司按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況、產業經濟情勢，並同時考量 GDP 預測及產業展望。因合併公司之信用損失歷史經驗顯示，不同客戶群之損失型態並無顯著差異，因此準備矩陣未進一步區分客戶群，僅以應收帳款逾期天數訂定預期信用損失率。

若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且合併公司無法合理預期可回收金額，例如交易對方正進行清算，合併公司直接沖銷相關應收帳款，惟仍會持續追索活動，因追索回收之金額則認列於損益。

合併公司依準備矩陣衡量應收帳款之備抵損失如下：

109 年 12 月 31 日

	未逾期	逾期 1~60 天	逾期 61~120 天	逾期超過 120 天	合計
總帳面金額	\$ 327,859	\$ 6,065	\$ 1,263	\$ 11,177	\$ 346,364
備抵損失(存續期間預期信用損失)	-	-	-	(2,159)	(2,159)
攤銷後成本	<u>\$ 327,859</u>	<u>\$ 6,065</u>	<u>\$ 1,263</u>	<u>\$ 9,018</u>	<u>\$ 344,205</u>

108 年 12 月 31 日

	未逾期	逾期 1~60 天	逾期 61~120 天	逾期超過 120 天	合計
總帳面金額	\$ 241,224	\$ 7,606	\$ 18,063	\$ 45,444	\$ 312,337
備抵損失(存續期間預期信用損失)	-	-	-	-	-
攤銷後成本	<u>\$ 241,224</u>	<u>\$ 7,606</u>	<u>\$ 18,063</u>	<u>\$ 45,444</u>	<u>\$ 312,337</u>

應收帳款備抵損失之變動資訊如下：

	109年度	108年度
年初餘額	\$ -	\$ -
加：本年度提列減損損失	<u>2,159</u>	<u>-</u>
年底餘額	<u>\$ 2,159</u>	<u>\$ -</u>

合併公司對該等應收帳款餘額並未持有任何擔保品。

十、存 貨

	109年12月31日	108年12月31日
在 製 品	\$ 860,880	\$ 705,806
原 物 料	189,436	137,738
商品存貨	185,147	138,857
製 成 品	35,108	27,615
	<u>\$ 1,270,571</u>	<u>\$ 1,010,016</u>

109 及 108 年度與存貨相關之銷貨成本分別為 1,361,351 仟元及 1,112,690 仟元。銷貨成本包括存貨跌價損失 13,362 仟元及 19,821 仟元。

十一、子 公 司

列入合併財務報告之子公司

本合併財務報告編製主體如下：

投 資 公 司 名 稱	子 公 司 名 稱	業 務 性 質	所 持 股 權 百 分 比		說 明
			109年 12月31日	108年 12月31日	
本公司	添鴻科技股份有限公司	化學原料製造	100%	100%	—
	GRAND PLASTIC TECHNOLOGY LIMITED	投資業務	100%	100%	—
	AQUA TALENT CO., LTD.	投資業務	100%	100%	—
	太引資訊系統股份有限公司	軟體銷售及安裝	78.1%	78.1%	—
	佳霖科技股份有限公司	半導體及電子設備銷售代理	100%	100%	—
GRAND PLASTIC TECHNOLOGY LIMITED	弘懋光電(上海)有限公司	經營半導體機台買賣及維修	100%	100%	—
AQUA TALENT CO., LTD.	添鴻化學科技(上海)有限公司	化學原料製造及銷售	100%	100%	—
太引資訊系統股份有限公司	太引信息科技(南京)有限公司	軟體銷售及安裝	100%	100%	—
佳霖科技股份有限公司	Challenge Tech. Corp.	投資業務	100%	100%	—
Challenge Tech. Corp.	佳霖電子(上海)有限公司	半導體及電子設備銷售代理	100%	100%	—

十二、不動產、廠房及設備

(一) 109 年

	自 有 土 地	建 築 物	機 器 設 備	試 驗 設 備	其 他 設 備	建 造 中 之 不 動 產	合 計
成 本							
109年1月1日餘額	\$ 550,791	\$ 517,508	\$ 54,652	\$ 114,225	\$ 105,007	\$ 3,965	\$ 1,346,148
增 添	-	5,142	9,940	100	12,028	935	28,145
處 分	-	(1,924)	(8,242)	(1,775)	(7,835)	-	(19,776)
重 分 類	-	-	900	-	230	(3,671)	(2,541)
淨兌換差額	-	35	-	-	176	-	211
109年12月31日餘額	<u>\$ 550,791</u>	<u>\$ 520,761</u>	<u>\$ 57,250</u>	<u>\$ 112,550</u>	<u>\$ 109,606</u>	<u>\$ 1,229</u>	<u>\$ 1,352,187</u>
累計折舊及減損							
109年1月1日餘額	\$ -	\$ 145,234	\$ 23,653	\$ 16,676	\$ 69,312	\$ -	\$ 254,875
折舊費用	-	24,713	12,658	21,814	11,319	-	70,504
處 分	-	(1,924)	(8,242)	(1,675)	(7,736)	-	(19,577)
重 分 類	-	-	-	-	-	-	-
淨兌換差額	-	-	-	-	149	-	149
109年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 168,023</u>	<u>\$ 28,069</u>	<u>\$ 36,815</u>	<u>\$ 73,044</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 305,951</u>
109年12月31日淨額	<u>\$ 550,791</u>	<u>\$ 352,738</u>	<u>\$ 29,181</u>	<u>\$ 75,735</u>	<u>\$ 36,562</u>	<u>\$ 1,229</u>	<u>\$ 1,046,236</u>
成 本							
108年1月1日餘額	\$ 500,066	\$ 366,892	\$ 36,719	\$ 35,352	\$ 45,538	\$ 15,628	\$ 1,000,195
增 添	-	1,623	2,779	-	4,841	4,227	13,470
重 分 類	-	610	15,002	78,873	331	(15,890)	78,926
處 分	(11,325)	(3,488)	(4,877)	-	(7,887)	-	(27,577)
由企業合併取得	62,050	151,871	5,029	-	62,688	-	281,638
淨兌換差額	-	-	-	-	(504)	-	(504)
108年12月31日餘額	<u>\$ 550,791</u>	<u>\$ 517,508</u>	<u>\$ 54,652</u>	<u>\$ 114,225</u>	<u>\$ 105,007</u>	<u>\$ 3,965</u>	<u>\$ 1,346,148</u>
累計折舊及減損							
108年1月1日餘額	\$ -	\$ 62,757	\$ 12,609	\$ 3,358	\$ 21,103	\$ -	\$ 99,827
折舊費用	-	25,239	12,202	13,318	12,043	-	62,802
處 分	-	(3,488)	(4,816)	-	(7,657)	-	(15,961)
由企業合併取得	-	60,613	3,658	-	44,220	-	108,491
重 分 類	-	-	-	-	-	-	-
淨兌換差額	-	113	-	-	(397)	-	(284)
108年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 145,234</u>	<u>\$ 23,653</u>	<u>\$ 16,676</u>	<u>\$ 69,312</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 254,875</u>
108年12月31日淨額	<u>\$ 550,791</u>	<u>\$ 372,274</u>	<u>\$ 30,999</u>	<u>\$ 97,549</u>	<u>\$ 35,695</u>	<u>\$ 3,965</u>	<u>\$ 1,091,273</u>

折舊費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

建 築 物	
廠房主建物	43 至 50 年
電 梯	15 年
其 他	4 至 10 年
機 器 設 備	1 至 10 年
試 驗 設 備	3 至 8 年
其 他 設 備	2 至 15 年

合併公司設定質押作為借款擔保之不動產、廠房及設備金額，
請參閱附註三一。

十三、租賃協議

(一) 使用權資產

	109年12月31日	108年12月31日
使用權資產帳面金額		
土 地	\$ 2,741	\$ 2,936
辦公設備	2,587	453
建 築 物	-	1,024
運輸設備	-	77
	<u>\$ 5,328</u>	<u>\$ 4,490</u>
	109年度	108年度
使用權資產之增添		
購 置	<u>\$ 3,318</u>	<u>\$ 2,210</u>
合併轉入（附註二七）	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,473</u>
使用權資產之折舊費用		
土 地	\$ 195	\$ 162
辦公設備	1,162	718
建 築 物	1,024	878
運輸設備	77	464
	<u>\$ 2,458</u>	<u>\$ 2,222</u>

(二) 租賃負債

	109年12月31日	108年12月31日
租賃負債帳面金額		
流 動	<u>\$ 1,273</u>	<u>\$ 1,482</u>
非 流 動	<u>\$ 1,321</u>	<u>\$ 77</u>

租賃負債之折現率區間如下：

	109年12月31日	108年12月31日
建 築 物	2.53%	2.93%
辦公設備	1.04%~2.93%	1.09%~2.93%
運輸設備	-	5.69%

(三) 其他租賃資訊

	109年度	108年度
短期租賃費用	<u>\$ 6,931</u>	<u>\$ 7,842</u>
租賃之現金（流出）總額	<u>(\$ 9,263)</u>	<u>(\$ 9,640)</u>

十四、商 譽

	109年度	108年度
成 本		
年初餘額	\$315,970	\$284,306
本年度企業合併取得（附註二七）	-	31,897
重 分 類	-	(233)
年底餘額	315,970	315,970
累計減損損失		
年初及年底餘額	-	-
年底淨額	<u>\$315,970</u>	<u>\$315,970</u>

合併公司於 109 及 108 年度經評估商譽之可回收金額，認為添鴻科技股份有限公司、AQUA TALENT CO., LTD.、太引資訊系統股份有限公司及佳霖科技股份有限公司之獲利穩定成長中，故尚無需對相關之商譽提列減損。

十五、其他無形資產

	客 戶 關 係	核 心 技 術	未 出 貨 訂 單	開 發 中 專 案	專 門 技 術	專 利 權	電 腦 軟 體 成 本	合 計
成 本								
109 年 1 月 1 日餘額	\$ 177,943	\$ 56,900	\$ 3,600	\$ 27,644	\$ 23,258	\$ 2,500	\$ 40,325	\$ 332,170
單獨取得	-	-	-	-	-	2,500	2,477	4,977
處 分	-	-	-	-	-	-	(4,302)	(4,302)
109 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 177,943</u>	<u>\$ 56,900</u>	<u>\$ 3,600</u>	<u>\$ 27,644</u>	<u>\$ 23,258</u>	<u>\$ 5,000</u>	<u>\$ 38,500</u>	<u>\$ 332,845</u>
累計攤銷及減損								
109 年 1 月 1 日餘額	(\$ 62,864)	(\$ 33,192)	(\$ 3,600)	(\$ 4,607)	(\$ 2,584)	(\$ 292)	(\$ 25,686)	(\$ 132,825)
攤銷費用	(15,753)	(4,741)	-	(4,608)	(2,584)	(500)	(9,076)	(37,262)
處 分	-	-	-	-	-	-	4,302	4,302
109 年 12 月 31 日餘額	<u>(\$ 78,617)</u>	<u>(\$ 37,933)</u>	<u>(\$ 3,600)</u>	<u>(\$ 9,215)</u>	<u>(\$ 5,168)</u>	<u>(\$ 792)</u>	<u>(\$ 30,460)</u>	<u>(\$ 165,785)</u>
109 年 12 月 31 日淨額	<u>\$ 99,326</u>	<u>\$ 18,967</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 18,429</u>	<u>\$ 18,090</u>	<u>\$ 4,208</u>	<u>\$ 8,040</u>	<u>\$ 167,060</u>
成 本								
108 年 1 月 1 日餘額	\$ 102,100	\$ 56,900	\$ 3,600	\$ 27,507	\$ 23,162	\$ 2,500	\$ 26,179	\$ 241,948
單獨取得	-	-	-	-	-	-	4,013	4,013
由企業合併取得	75,843	-	-	-	-	-	10,994	86,837
處 分	-	-	-	-	-	-	(861)	(861)
重 分 類	-	-	-	137	96	-	-	233
108 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 177,943</u>	<u>\$ 56,900</u>	<u>\$ 3,600</u>	<u>\$ 27,644</u>	<u>\$ 23,258</u>	<u>\$ 2,500</u>	<u>\$ 40,325</u>	<u>\$ 332,170</u>
累計攤銷及減損								
108 年 1 月 1 日餘額	(\$ 49,009)	(\$ 28,447)	(\$ 3,600)	\$ -	\$ -	(\$ 42)	(\$ 11,329)	(\$ 92,427)
攤銷費用	(13,855)	(4,745)	-	(4,607)	(2,584)	(250)	(9,276)	(35,317)
由企業合併取得	-	-	-	-	-	-	(5,942)	(5,942)
處 分	-	-	-	-	-	-	861	861
108 年 12 月 31 日餘額	<u>(\$ 62,864)</u>	<u>(\$ 33,192)</u>	<u>(\$ 3,600)</u>	<u>(\$ 4,607)</u>	<u>(\$ 2,584)</u>	<u>(\$ 292)</u>	<u>(\$ 25,686)</u>	<u>(\$ 132,825)</u>
108 年 12 月 31 日淨額	<u>\$ 115,079</u>	<u>\$ 23,708</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 23,037</u>	<u>\$ 20,674</u>	<u>\$ 2,208</u>	<u>\$ 14,639</u>	<u>\$ 199,345</u>

攤銷費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

客 戶 關 係	10 至 12 年 6 個月
核 心 技 術	12 年
開 發 中 專 案	6 年
專 門 技 術	9 年
電 腦 軟 體 成 本	1 至 5 年
專 利 權	10 年

合併公司未有將其他無形資產設定質押作為借款擔保。

十六、其他資產

	109年12月31日	108年12月31日
<u>流 動</u>		
受限制資產（附註三一）	\$ 11,055	\$ 6,489
留抵稅額	2,275	2,603
代 付 款	553	1,253
暫 付 款	73	1,210
其 他	<u>12,556</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 26,512</u>	<u>\$ 11,555</u>
<u>非 流 動</u>		
存出保證金	\$ 1,414	\$ 2,321
其 他	<u>105</u>	<u>1,330</u>
	<u>\$ 1,519</u>	<u>\$ 3,651</u>

十七、借 款

（一）短期借款

	109年12月31日	108年12月31日
<u>無擔保借款</u>		
信用額度借款	<u>\$218,000</u>	<u>\$268,010</u>

銀行週轉性借款之利率於 109 年及 108 年 12 月 31 日分別為 0.51%~0.85% 及 0.71%~1.26%。

（二）長期借款

	109年12月31日	108年12月31日
<u>擔保借款</u>		
銀行借款(1)	\$122,476	\$137,786
銀行借款(2)	217,500	234,900
銀行借款(3)	9,794	-
銀行借款(4)	<u>-</u>	<u>10,278</u>
小 計	349,770	382,964
<u>無擔保借款</u>		
銀行借款(5)	18,380	-
銀行借款(6)	1,959	-
減：列為 1 年內到期部分	<u>(37,133)</u>	<u>(16,143)</u>
長期借款	<u>\$332,976</u>	<u>\$366,821</u>

1. 該銀行借款係以弘塑公司自有土地及建築物抵押擔保（參閱附註三一），借款到期日為 117 年 12 月 30 日，截至 109 年及 108 年 12 月 31 日止，有效年利率分別為 1.15%及 1.25%。此次動撥金額係用於購買土地、廠房及設備。
2. 該銀行借款係以添鴻公司自有土地及建築物抵押擔保（參閱附註三一），借款到期日為 122 年 5 月 30 日，截至 109 年及 108 年 12 月 31 日止，有效年利率分別為 0.98%及 1.25%。此次動撥金額係用於購買土地、廠房及設備。
3. 該銀行借款係以太引公司自有土地及建築物抵押擔保（參閱附註三一），借款到期日為 124 年 8 月 12 日，截至 109 年 12 月 31 日止，有效年利率為 1.00%。此次動撥金額係用於購買土地、廠房及設備。
4. 自 106 年 4 月至 121 年 4 月止，按月償還，已提前於 109 年 8 月全數清償，年利率浮動，108 年 12 月 31 日有效年利率為 1.63%。
5. 自 109 年 8 月至 112 年 8 月止，按月償還，年利率浮動，截至 109 年 12 月 31 日止，有效年利率為 1.40%。
6. 自 109 年 8 月至 124 年 8 月止，共分 25 期攤還本金，年利率浮動，截至 109 年 12 月 31 日止，有效年利率為 1.00%。

十八、應付票據及應付帳款

	<u>109年12月31日</u>	<u>108年12月31日</u>
<u>應付票據</u>		
因營業而發生	\$ <u>159</u>	\$ <u>2</u>
<u>應付帳款</u>		
因營業而發生	\$ <u>452,920</u>	\$ <u>340,044</u>

合併公司採購原物料平均付款天數為 90 至 150 天，自應付帳款發票日起不加計利息。合併公司訂有財務風險管理政策，以確保所有應付款於預先約定之信用期限內償還。

十九、其他負債

	109年12月31日	108年12月31日
<u>流動</u>		
其他應付款		
應付薪資及獎金	\$198,165	\$208,457
應付員工酬勞	67,112	53,587
應付董監事酬勞	13,422	9,439
應付保險費	6,155	5,533
應付退休金	4,883	4,630
應付營業稅	3,673	2,667
應付勞務費	1,704	1,600
應付服務費	1,497	1,123
其 他	<u>31,686</u>	<u>27,921</u>
	<u>\$328,297</u>	<u>\$314,957</u>
合約負債	<u>\$874,002</u>	<u>\$564,093</u>
其他負債		
代收 款	\$ 496	\$ 472
暫收 款	-	177
其 他	<u>2,913</u>	<u>2,219</u>
	<u>\$ 3,409</u>	<u>\$ 2,868</u>

二十、負債準備

	109年12月31日	108年12月31日
<u>流動</u>		
保 固	<u>\$ 57,638</u>	<u>\$ 71,270</u>
<u>非流動</u>		
保 固	<u>\$ 19,559</u>	<u>\$ 11,077</u>

	保	固
109年1月1日餘額	\$ 82,347	
本年度新增	48,680	
本年度使用	(21,517)	
本年度迴轉未使用餘額	(32,313)	
109年12月31日餘額	<u>\$ 77,197</u>	

保固負債準備係依銷售商品合約約定，合併公司管理階層對於因保固義務所導致未來經濟效益流出最佳估計數之現值。該估計係以歷史保固經驗為基礎，並考量新原料、製程變動或其他影響產品品質等因素調整。

二一、退職後福利計畫

(一) 確定提撥計畫

合併公司中之本公司、添鴻科技股份有限公司、太引資訊系統股份有限公司及佳霖科技股份有限公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資 6% 提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。

(二) 確定福利計畫

合併公司中之本公司、添鴻科技股份有限公司、太引資訊系統股份有限公司及佳霖科技股份有限公司係我國「勞動基準法」辦理之退休金制度係屬政府管理之確定福利退休計畫。員工退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前 6 個月平均工資計算。合併公司按員工每月薪資總額 2% 提撥退休金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶，年度終了前，若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工，次年度 3 月底前將一次提撥其差額。該專戶係委託勞動部勞動基金運用局管理，合併公司並無影響投資管理策略之權利。

列入合併資產負債表之確定福利計畫金額列示如下：

	109年12月31日	108年12月31日
確定福利義務現值	\$ 35,098	\$ 38,935
計畫資產公允價值	(20,719)	(19,984)
淨確定福利負債	<u>\$ 14,379</u>	<u>\$ 18,951</u>

淨確定福利負債變動如下：

	確 定 福 利 計 畫 資 產	淨 確 定 福 利
	義 務 現 值 公 允 價 值	負 債 (資 產)
108 年 1 月 1 日餘額	\$ 21,909	(\$ 15,933) \$ 5,976
利息費用 (收入)	723	(504) 219
認列於損益	723	(504) 219
再衡量數		
計畫資產報酬 (除 包含於淨利息之 金額外)	-	(1,213) (1,213)

(接 次 頁)

(承前頁)

	確 定 福 利 義 務 現 值	計 畫 資 產 公 允 價 值	淨 確 定 福 利 負 債 (資 產)
精算損失－財務假 設變動	\$ 1,734	\$ -	\$ 1,734
精算損失－經驗調 整	<u>1,590</u>	<u>-</u>	<u>1,590</u>
認列於其他綜合損益	<u>3,324</u>	<u>(1,213)</u>	<u>2,111</u>
雇主提撥	<u>-</u>	<u>(2,334)</u>	<u>(2,334)</u>
企業合併	<u>12,979</u>	<u>-</u>	<u>12,979</u>
支付福利（由計劃資產 支出）	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
108 年 12 月 31 日餘額	<u>38,935</u>	<u>(19,984)</u>	<u>18,951</u>
利息費用（收入）	<u>618</u>	<u>(565)</u>	<u>53</u>
認列於損益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
再衡量數			
計畫資產報酬（除 包含於淨利息之 金額外）	-	(1,235)	(1,235)
精算損失－財務假 設變動	521	-	521
精算損失－經驗調 整	<u>(2,045)</u>	<u>-</u>	<u>(2,045)</u>
認列於其他綜合損益	<u>(1,524)</u>	<u>(1,235)</u>	<u>(2,759)</u>
雇主提撥	<u>-</u>	<u>(1,866)</u>	<u>(1,866)</u>
支付福利（由計劃資產 支出）	<u>(2,931)</u>	<u>2,931</u>	<u>-</u>
109 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 35,098</u>	<u>(\$ 20,719)</u>	<u>\$ 14,379</u>

本公司因「勞動基準法」之退休金制度暴露於下列風險：

1. 投資風險：勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式，將勞工退休基金分別投資於國內（外）權益證券與債務證券及銀行存款等標的，惟本公司之計畫資產得分配金額係以不低於當地銀行 2 年定期存款利率計算而得之收益。
2. 利率風險：政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加，惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加，兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。

3. 薪資風險：確定福利義務現值之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

本公司之確定福利義務現值係由合格精算師進行精算，衡量日之重大假設如下：

	109年12月31日	108年12月31日
折現率	0.8%	1.00%
薪資預期增加率	3.5%	3.50%

若重大精算假設分別發生合理可能之變動，在所有其他假設維持不變之情況下，將使確定福利義務現值增加（減少）之金額如下：

	109年12月31日	108年12月31日
折現率		
增加 0.25%	(\$ 649)	(\$ 665)
減少 0.25%	\$ 677	\$ 695
薪資預期增加率		
增加 1.00%	\$ 2,818	\$ 2,906
減少 1.00%	(\$ 2,437)	(\$ 2,493)

由於精算假設可能彼此相關，僅單一假設變動之可能性不大，故上述敏感度分析可能無法反映確定福利義務現值實際變動情形。

	109年12月31日	108年12月31日
預期 1 年內提撥金額	\$ 348	\$ 348
確定福利義務平均到期期間	15 年	16 年

二、權益

(一) 股本

普通股

	109年12月31日	108年12月31日
額定股數（仟股）	30,000	30,000
額定股本	\$300,000	\$300,000
已發行且已收足股款之股數 （仟股）	29,216	29,216
已發行股本	\$292,160	\$292,160

已發行之普通股每股面額為 10 元，每股享有一表決權及收取股利之權利。

本公司於 107 年 3 月 27 日，經董事會決議發行普通股約 4,532 仟股，每股面額新台幣 10 元整，總計新發行股份總額約新台幣 45,322 仟元，作為收購佳霖科技股份有限公司全部已發行普通股之對價。前開之換股基準日為 108 年 3 月 1 日，本案經 107 年 6 月 26 日召開之股東會通過並已完成其他相關法律程序。

(二) 資本公積

	109年12月31日	108年12月31日
<u>得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本(1)</u>		
股票發行溢價	\$ 114,000	\$ 114,000
庫藏股票交易(2)	11,112	5,556
合併發行新股溢價	976,592	976,592
<u>不得作為任何用途</u>		
員工認股權	654	654
	<u>\$ 1,102,358</u>	<u>\$ 1,096,802</u>

1. 此類資本公積得用以彌補虧損，亦得於公司無虧損時，用以發放現金或撥充股本，惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。
2. 此類資本公積係子公司持有母公司股票，母公司發放現金股利時配發予子公司之股利。

(三) 保留盈餘及股利政策

依本公司章程之盈餘分派政策規定，年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司章程規定之員工及董監事酬勞分派政策，參閱附註二四之(七)員工酬勞及董監事酬勞。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25% 之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

本公司依金管證發字第 1010012865 號函、金管證發字第 1010047490 號函、金管證發字第 1030006415 號及「採用國際財務報

導準則（IFRSs）後，提列特別盈餘公積之適用疑義問答」等規定提列及迴轉特別盈餘公積。

本公司於 109 年 6 月 18 日及 108 年 6 月 19 日舉行股東常會，分別決議通過 108 及 107 年度盈餘分配案如下：

	盈 餘 分 配 案	
	108年度	107年度
法定盈餘公積	\$ 30,997	\$ 27,868
現金股利	233,728	233,728
每股現金股利（元）	8	8

本公司 110 年 3 月 22 日董事會擬議 109 年度盈餘分配案如下：

	盈 餘 分 配 案
法定盈餘公積	\$ 45,038
現金股利	321,376
每股現金股利（元）	11

有關 109 年度之盈餘分配案尚待預計於 110 年 6 月 23 日召開之股東會決議。

（四）特別盈餘公積

	109年度	108年度
年初及年底餘額	<u>\$ 1,386</u>	<u>\$ 1,386</u>

（五）其他權益項目

1. 國外營運機構財務報表換算之兌換差額

	109年度	108年度
年初餘額	(\$ 3,256)	(\$ 1,205)
國外營運機構之換算差額	<u>991</u>	<u>(2,051)</u>
年底餘額	<u>(\$ 2,265)</u>	<u>(\$ 3,256)</u>

2. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益

	109年度	108年度
年初餘額	\$287,260	\$107,301
當年度產生		
未實現損益		
權益工具	(12,549)	179,959
處分權益工具累計損益		
移轉至保留盈餘	<u>(51,018)</u>	<u>-</u>
年底餘額	<u>\$223,693</u>	<u>\$287,260</u>

(六) 非控制權益

	109年度	108年度
年初餘額	\$ 33,787	\$ 35,219
本年度淨利	485	2,786
確定福利計畫再衡量數	440	(277)
國外營運機構財務報表換算 之兌換差額	(1)	(6)
子公司發放現金股利	(2,507)	(3,935)
年底餘額	<u>\$ 32,204</u>	<u>\$ 33,787</u>

(七) 庫藏股票

收 回 原 因	子公司持有本公司 股票 (仟 股)
109 年 1 月 1 日 及 12 月 31 日 股數	<u>695</u>
108 年 1 月 1 日 股數	-
本期增加	<u>695</u>
108 年 12 月 31 日 股數	<u>695</u>

為投資目的，子公司於資產負債表日持有本公司股票，相關資訊如下：

109 年 12 月 31 日

子 公 司 名 稱	持有股數 (仟股)	帳 面 金 額	市 價
佳霖科技股份有限公司	695	\$ 82,648	\$ 276,072

108 年 12 月 31 日

子 公 司 名 稱	持有股數 (仟股)	帳 面 金 額	市 價
佳霖科技股份有限公司	695	\$ 82,648	\$ 193,424

子公司持有本公司股票視同庫藏股票處理，除不得參與本公司之現金增資及無表決權外，其餘與一般股東權利相同。

二三、收 入

	109年度	108年度
客戶合約收入		
商品銷售收入	<u>\$ 2,487,671</u>	<u>\$ 2,061,387</u>

(一) 客戶合約之說明

商品銷貨收入主要來自於半導體機台之驗收。由於產品於運抵客戶指定地點時，客戶對商品已有訂定價格與使用之權利且負有再銷售之主要責任，並承擔商品陳舊過時風險，合併公司係於該時點認列收入。產品銷售之預收款項，於機台驗收前係認列為合約負債。

(二) 合約餘額

	109年12月31日	108年12月31日	108年1月1日
應收帳款（附註九）	<u>\$ 344,205</u>	<u>\$ 312,337</u>	<u>\$ 340,435</u>
合約負債—流動（附註十九）			
商品銷貨	<u>\$ 874,002</u>	<u>\$ 564,093</u>	<u>\$ 586,265</u>

(三) 客戶合約收入之細分

1. 主要產品及勞務之收入

	109年度	108年度
機台設備產品銷售收入	\$ 1,223,744	\$ 1,006,036
化學產品銷售收入	746,690	585,889
維修服務及其它收入	436,343	337,256
軟體銷售及安裝收入	56,992	101,407
半導體及電子設備銷售		
代理收入	<u>23,902</u>	<u>30,799</u>
	<u>\$ 2,487,671</u>	<u>\$ 2,061,387</u>

2. 地區別資訊主要產品及勞務之收入

合併公司主要地區營運—台灣及中國。

合併公司來自外部客戶之繼續營業單位收入依營運地點區分之資訊列示如下：

	來自外部客戶之收入	
	109年度	108年度
台灣	\$ 2,017,003	\$ 1,488,133
中國	335,411	445,562
新加坡	61,511	9,315
歐洲	32,206	21,510
美國	30,867	85,123
亞洲	10,631	11,744
加拿大	<u>42</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 2,487,671</u>	<u>\$ 2,061,387</u>

二四、繼續營業單位淨利

繼續營業單位淨利係包含以下項目：

(一) 利息收入

	109年度	108年度
銀行存款	\$ 6,161	\$ 8,585
其 他	<u>7</u>	<u>16</u>
	<u>\$ 6,168</u>	<u>\$ 8,601</u>

(二) 其他收入

	109年度	108年度
股利收入	\$ 2,952	\$ 3,778
租金收入	360	345
其 他	<u>1,001</u>	<u>939</u>
	<u>\$ 4,313</u>	<u>\$ 5,062</u>

(三) 其他利益及損失

	109年度	108年度
淨外幣兌換損失	(\$ 27,528)	(\$ 5,730)
處分不動產、廠房及設備損失	(98)	(10,633)
什項支出	<u>(58)</u>	<u>(5)</u>
	<u>(\$ 27,684)</u>	<u>(\$ 16,368)</u>

(四) 財務成本

	109年度	108年度
銀行借款利息	\$ 5,844	\$ 7,986
租賃負債之利息	<u>36</u>	<u>52</u>
	<u>\$ 5,880</u>	<u>\$ 8,038</u>

(五) 折舊及攤銷

	109年度	108年度
折舊費用依功能別彙總		
營業成本	\$ 20,212	\$ 21,522
營業費用	<u>52,750</u>	<u>43,502</u>
	<u>\$ 72,962</u>	<u>\$ 65,024</u>
攤銷費用依功能別彙總		
營業成本	\$ 513	\$ 385
營業費用	<u>36,749</u>	<u>34,932</u>
	<u>\$ 37,262</u>	<u>\$ 35,317</u>

(六) 員工福利費用

	109年度	108年度
退職後福利		
確定提撥計畫	\$ 17,349	\$ 16,810
確定福利計畫(附註二一)	53	219
	17,402	17,029
其他員工福利	345,878	241,918
員工福利費用合計	<u>\$363,280</u>	<u>\$258,947</u>
依功能別彙總		
營業成本	\$ 97,397	\$ 59,427
營業費用	265,883	199,520
	<u>\$363,280</u>	<u>\$258,947</u>

(七) 員工酬勞及董監事酬勞

本公司依章程規定係按當年度扣除分派員工及董監酬勞前之稅前利益分別以不低於 7.5%及不高於 3%提撥員工酬勞及董監事酬勞。109 及 108 年度員工酬勞及董監事酬勞分別於 110 年 3 月 22 日及 109 年 3 月 23 日經董事會決議如下：

估列比例

	109年度	108年度
員工酬勞	8.00%	8.00%
董監事酬勞	1.60%	1.60%

金 額

	109年度				108年度			
	現	金	股	票	現	金	股	票
員工酬勞	\$ 39,666		\$ -		\$ 31,145		\$ -	
董監事酬勞		7,933		-		6,232		-

年度合併財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

108 及 107 年度員工酬勞及董監事酬勞之實際配發金額與 108 及 107 年度合併財務報告之認列金額並無差異。

有關本公司 109 及 108 年董事會決議之員工酬勞及董監事酬勞資訊，請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

二五、繼續營業單位所得稅

(一) 認列於損益之所得稅費用

	109年度	108年度
當期所得稅		
當期產生者	\$107,964	\$ 81,903
未分配盈餘加徵	2,029	-
以前年度調整	<u>1,861</u>	<u>4,869</u>
	111,854	86,772
遞延所得稅		
當期產生者	<u>825</u>	<u>4,527</u>
認列於損益之所得稅費用	<u>\$112,679</u>	<u>\$ 91,299</u>

會計所得與當期所得稅費用之調節如下：

	109年度	108年度
繼續營業單位稅前淨利	<u>\$510,037</u>	<u>\$404,055</u>
稅前淨利按法定稅率計算之		
所得稅費用	\$102,007	\$ 80,811
稅上不可減除之費損	7,441	6,215
未分配盈餘加徵	2,196	-
當年度抵用投資抵減	(167)	-
未認列之可減除暫時性差異	(659)	(596)
以前年度之當期所得稅費用		
於本年度之調整	<u>1,861</u>	<u>4,869</u>
認列於損益之所得稅費用	<u>\$112,679</u>	<u>\$ 91,299</u>

我國於 108 年 7 月經總統公布修正產業創新條例，明訂以 107 年度起之未分配盈餘興建或購置特定資產或技術得列為計算未分配盈餘之減除項目，合併公司於計算未分配盈餘稅時，僅將已實際進行再投資之資本支出金額減除。

(二) 認列於其他綜合損益之所得稅

	109年度	108年度
遞延所得稅		
本年度產生		
— 透過其他綜合損益按公		
允價值衡量之金融資		
產未實現損益	<u>\$ 3,140</u>	<u>(\$ 44,990)</u>
認列於其他綜合損益之所得稅	<u>\$ 3,140</u>	<u>(\$ 44,990)</u>

(三) 本期所得稅負債

	109年12月31日	108年12月31日
本期所得稅負債		
應付所得稅	<u>\$119,630</u>	<u>\$ 89,029</u>

(四) 遞延所得稅資產與負債

遞延所得稅資產及負債之變動如下：

109 年度

	年 初 餘 額	認 列 於 損 益	認 列 於 其 他 綜 合 損 益	直 接 認 列 於 權 益	年 底 餘 額
遞 延 所 得 稅 資 產					
暫時性差異					
負債準備	\$ 16,425	(\$ 1,028)	\$ -	\$ -	\$ 15,397
未實現薪資費用	18,137	(3,271)	-	-	14,866
未實現存貨跌價損失	9,680	2,091	-	-	11,771
確定福利退休計畫	6,782	(247)	-	-	6,535
未實現績效獎金	5,299	368	-	-	5,667
未實現兌換損失	1,464	2,713	-	-	4,177
備抵呆帳	623	418	-	-	1,041
未實現權益法投資損益	113	295	-	-	408
未實現其他收入	89	-	-	-	89
未實現休假獎金	-	33	-	-	33
職工福利	39	(39)	-	-	-
國外營運機構兌換差額	(<u>3,831</u>)	-	-	-	(<u>3,831</u>)
	<u>\$ 54,820</u>	<u>\$ 1,333</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 56,153</u>
遞 延 所 得 稅 負 債					
暫時性差異					
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 52,633	\$ -	(\$ 3,140)	(\$ 9,555)	\$ 39,938
未實現權益法投資損益	2,697	2,114	-	-	4,811
不動產、廠房及設備	77	-	-	-	77
未實現兌換利益	<u>22</u>	<u>44</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>66</u>
	<u>\$ 55,429</u>	<u>\$ 2,158</u>	<u>(\$ 3,140)</u>	<u>(\$ 9,555)</u>	<u>\$ 44,892</u>

108 年度

	年 初 餘 額	由 企 業 合 併 取 得	認 列 於 損 益	認 列 於 其 他 綜 合 損 益	年 底 餘 額
遞 延 所 得 稅 資 產					
暫時性差異					
未實現薪資費用	\$ 21,029	\$ -	(\$ 2,892)	\$ -	\$ 18,137
負債準備	23,659	-	(7,234)	-	16,425
未實現存貨跌價損失	5,879	423	3,378	-	9,680
確定福利退休計畫	4,789	2,323	(330)	-	6,782
未實現績效獎金	4,274	-	1,025	-	5,299
未實現兌換損失	(340)	(108)	1,912	-	1,464
備抵呆帳	501	-	122	-	623
未實現權益法投資損益	(843)	-	956	-	113
未實現其他收入	89	-	-	-	89
職工福利	-	195	(156)	-	39
未實現休假獎金	305	-	(305)	-	-
國外營運機構兌換差額	(<u>3,831</u>)	-	-	-	(<u>3,831</u>)
	<u>\$ 55,511</u>	<u>\$ 2,833</u>	<u>(\$ 3,524)</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 54,820</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

遞延所得稅負債	年初餘額	由企業合併取得	認列於損益	認列於其他綜合損益	年底餘額
暫時性差異					
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 7,643	\$ -	\$ -	\$ 44,990	\$ 52,633
未實現權益法投資損益	1,452	-	1,245	-	2,697
不動產、廠房及設備	77	-	-	-	77
未實現兌換利益	351	-	(329)	-	22
未實現存貨跌價損失	(87)	-	87	-	-
	<u>\$ 9,436</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,003</u>	<u>\$ 44,990</u>	<u>\$ 55,429</u>

(五) 所得稅核定情形

本公司及添鴻科技股份有限公司、太引資訊系統股份有限公司及佳霖科技股份有限公司之營利事業所得稅申報，截至 107 年度以前之申報案件業經稅捐稽徵機關核定。

二六、每股盈餘

單位：每股元

	109年度	108年度
基本每股盈餘	<u>\$ 13.92</u>	<u>\$ 11.11</u>
稀釋每股盈餘	<u>\$ 13.85</u>	<u>\$ 11.05</u>

用以計算每股盈餘之盈餘及普通股加權平均股數如下：

本年度淨利

	109年度	108年度
本年度淨利	<u>\$396,873</u>	<u>\$309,970</u>

股數

單位：仟股

	109年度	108年度
用以計算基本每股盈餘之普通股加權平均股數	28,521	27,901
具稀釋作用潛在普通股之影響：		
員工分紅	<u>143</u>	<u>162</u>
用以計算稀釋每股盈餘之普通股加權平均股數	<u>28,664</u>	<u>28,063</u>

若合併公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀

釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

二七、企業合併

108 年

(一) 收購子公司

	主要營運活動	收 購 日	具表決權之 所有權權益／ 收購比例（％）	移 轉 對 價
佳霖科技股份有 限公司	半導體及電子設 備銷售代理	108年3月	100	<u>\$ 534,796</u>

合併公司收購佳霖科技股份有限公司係為擴充對客戶服務的廣度，進而提高競爭優勢及擴大營運規模。

(二) 移轉對價

發行權益工具	佳 霖 科 技 股 份 有 限 公 司 <u>\$534,796</u>
--------	--

本公司另發行面額新台幣 10 元之普通股 4,532 仟股以作為取得佳霖公司對價之一部分。該等普通股依收購日收盤價決定之公允價值合計數為 534,796 仟元。

移轉對價除收購相關成本 534,796 仟元之外，並無當期之其他費用產生。

(三) 收購日取得之資產及承擔之負債

現金及約當現金	佳 霖 科 技 股 份 有 限 公 司 <u>\$116,280</u>
其他流動資產	181,057
不動產、廠房及設備	173,147
無形資產	
客戶關係	75,843
其他非流動資產	97,138
流動負債	(127,810)
非流動負債	(<u>12,756</u>)
	<u>\$502,899</u>

(四) 因收購產生之商譽

	佳霖科技 股份有限公司
移轉對價	\$534,796
減：所取得可辨認淨資產之公允價值	(502,899)
因收購產生之商譽	<u>\$ 31,897</u>

收購佳霖科技股份有限公司產生之商譽，主要係來自控制溢價。此外，合併所支付之對價係包含預期產生之合併綜效、收入成長、未來市場發展及收購佳霖科技股份有限公司之員工價值。惟該等效益不符合可辨認無形資產之認列條件，故不單獨認列。

因合併所產生之商譽，預期不可作為課稅減除項目。

(五) 取得子公司之淨現金流入

	佳霖科技 股份有限公司
現金支付之對價	\$ -
減：取得之現金及約當現金餘額	<u>116,280</u>
	<u>\$116,280</u>

二八、資本風險管理

合併公司進行資本管理以確保能夠於繼續經營之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，使資本有效之運用，並確保各公司順利營運。

合併公司之資本結構係由淨負債及權益所組成，毋需遵守其他外部資本規定

合併公司主要管理階層定期重新檢視資本結構，其檢視內容包括考量各類資本之成本及相關風險，目前資本結構中權益項目遠大於負債項目，將用以支應未來所需之營運資金、資本支出及股利支出等需求。

二九、金融工具

(一) 公允價值資訊－非按公允價值衡量之金融工具

合併公司於財務報導結束日之按攤銷後成本衡量之金融資產及金融負債，於財務報告中之帳面金額趨近其公允價值。

(二) 公允價值資訊－以重複性基礎按公允價值衡量之金融工具

1. 公允價值層級

109 年 12 月 31 日

	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合 計
<u>透過其他綜合損益按公</u>				
<u>允價值衡量之金融資</u>				
<u>產</u>				
國外上市(櫃)有價證券				
－權益投資	\$ 386,820	\$ -	\$ -	\$ 386,820
國外未上市(櫃)有價證				
券				
－權益投資	-	-	120,150	120,150
	<u>\$ 386,820</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 120,150</u>	<u>\$ 506,970</u>

108 年 12 月 31 日

	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合 計
<u>透過其他綜合損益按公</u>				
<u>允價值衡量之金融資</u>				
<u>產</u>				
國外上市(櫃)有價證券				
－權益投資	\$ 488,520	\$ -	\$ -	\$ 488,520
國外未上市(櫃)有價證				
券				
－權益投資	-	-	82,962	82,962
	<u>\$ 488,520</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 82,962</u>	<u>\$ 571,482</u>

109 及 108 年度無第 1 等級與第 2 等級公允價值衡量間移轉之情形。

2. 金融工具以第 3 等級公允價值衡量之調節

109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

金 融 資 產	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之 金 融 資 產 權 益 工 具
年初餘額	\$ 82,962
認列於其他綜合損益	7,228
購 買	<u>29,960</u>
年底餘額	<u>\$120,150</u>

108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

金 融 資 產	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之 金 融 資 產 權 益 工 具
年初餘額	\$122,860
認列於其他綜合損益	(39,898)
年底餘額	<u>\$ 82,962</u>

(三) 金融工具之種類

	109年12月31日	108年12月31日
<u>金融資產</u>		
按攤銷後成本衡量之金融資 產 (註 1)	\$ 1,988,163	\$ 1,614,980
透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產	506,970	571,482
<u>金融負債</u>		
按攤銷後成本衡量 (註 2)	1,369,485	1,305,977

註 1：餘額係包含現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之金融資產—流動、應收票據、應收帳款、其他應收款及存出保證金等按攤銷後成本衡量之金融資產。

註 2：餘額係包含短期借款、應付票據、應付帳款、其他應付款、一年內到期之長期負債及長期借款等按攤銷後成本衡量之金融負債。

(四) 財務風險管理目的與政策

合併公司主要金融工具包括權益及債務工具投資、應收帳款、借款、應付帳款及租賃負債。合併公司財務風險管理目標，係為管理營運活動相關之市場風險（包含匯率風險、利率風險及其他價格風險）、信用風險及流動性風險。

為降低相關財務風險，合併公司致力於辨認、評估並規避市場之不確定性，以降低市場變動對公司財務績效之潛在不利影響。

合併公司之重要財務活動，係經董事會或權責主管依相關規範及內部控制制度進行覆核。於財務計劃執行期間，合併公司必須恪遵關於整體財務風險管理及權責劃分之相關財務操作程序。

1. 市場風險

合併公司之營運活動使合併公司承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險（參閱下述(1)）以及利率變動風險（參閱下述(2)）。

合併公司有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

(1) 匯率風險

合併公司從事非功能性貨幣計價之交易因而產生匯率變動暴險，尚在合併公司匯率暴險之管理政策許可範圍內。

合併公司於資產負債表日非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額（包含合併財務報表中已沖銷之非功能性貨幣計價之貨幣性項目），參閱附註三三。

敏感度分析

合併公司主要受到美金及日圓匯率波動之影響。

下表詳細說明當新台幣（功能性貨幣）對各攸關外幣之匯率增加及減少1%時，合併公司之敏感度分析。

敏感度分析僅包括流通在外之外幣貨幣性項目。下表之正數係表示當新台幣相對於各相關貨幣升值1%時，將使稅前淨利增加之金額；當新台幣相對於各相關外幣貶值1%時，其對稅前淨利之影響將為同金額之負數。

	美 金 之 影 響		日 幣 之 影 響	
	109年度	108年度	109年度	108年度
損 益	\$ 7,958	\$ 4,048	\$ 651	\$ 19

(2) 利率風險

因合併公司內之個體同時以固定及浮動利率借入資金，因而產生利率暴險。合併公司定期評估避險活動，使其與利率觀點及

既定之風險偏好一致，以確保採用最符合成本效益之避險策略。

合併公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	109年12月31日	108年12月31日
具公允價值利率風險		
－金融資產	\$ 777,300	\$ 141,188
－金融負債	182,594	191,559
具現金流量利率風險		
－金融資產	867,319	1,157,863
－金融負債	408,109	460,974

敏感度分析

下列敏感度分析係依衍生及非衍生工具於資產負債表日之利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係假設資產負債表日流通在外之負債金額於報導期間皆流通在外。

若利率增加／減少 0.1%，在所有其他變數維持不變之情況下，合併公司 109 及 108 年度之稅前淨利將分別減少／增加 459 仟元及 697 仟元。

(3) 其他價格風險

合併公司因上市櫃及非上市櫃權益證券投資而產生權益價格暴險。該權益投資非持有供交易而係屬策略性投資。合併公司並未積極交易該等投資。合併公司權益價格風險主要集中於日本及美國地區之權益工具。

敏感度分析

若權益價格上漲／下跌 1%，109 及 108 年度其他綜合損益將因透過其他綜合損益按公允價值衡量金融資產之公允價值而增加／減少 5,070 仟元及 5,715 仟元。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠或倒閉而造成合併公司財務損失之風險。截至資產負債表日，合併公司可能因交易對方

未履行義務及合併公司提供財務保證造成財務損失之最大信用風險暴險主要係來自於：

(1) 客戶帳款無法回收。

(2) 合併公司提供財務保證所產生之或有負債金額。

合併公司之交易對方均為信用良好之金融機構及公司組織，業務單位透過外部徵信調查及同業查訪隨時掌握及了解往來客戶之信用狀況，因此不預期有重大之信用風險。

合併公司信用風險並無顯著集中，各期之應收帳款餘額中，超過應收帳款合計數之10%之客戶如下：

	109年12月31日	108年12月31日
L 客戶	\$64,399	\$62,411
W 客戶	36,853	13,120
B 客戶	25,439	36,611

3. 流動性風險

合併公司透過管理及維持足夠部位之現金或易變現之金融商品以支應合併公司之營運資金，除了合併公司投資之透過其他綜合損益衡量之金融商品無活絡市場，預期具有重大流動性風險外，合併公司資本結構中流動資產大於流動負債，故未有因無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

銀行借款對合併公司而言係為一項重要流動性來源。截至 109 年及 108 年 12 月 31 日止，合併公司未動用之融資額度，參閱下列(2)融資額度之說明。

(1) 非衍生金融負債之流動性及利率風險表

非衍生金融負債剩餘合約到期分析係依合併公司最早可能被要求還款之日期，按金融負債未折現現金流量（包含本金及估計利息）編製。因此，合併公司可被要求立即還款之銀行借款，係列於下表最早之期間內，不考慮銀行立即執行該權利之機率；其他非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

109 年 12 月 31 日

	要求即付或 短於 1 個月	1 ~ 3 個月	3 個月 ~ 1 年	1 ~ 5 年	5 年 以 上
<u>非衍生金融負債</u>					
無附息負債	\$ 272,672	\$ 158,610	\$ 21,797	\$ -	\$ -
其他應付款（註 ）	9,509	33,124	2,082	-	-
固定利率工具	130,000	50,000	-	-	-
浮動利率工具	8,062	38,302	28,770	166,009	166,967
租賃負債	<u>134</u>	<u>305</u>	<u>857</u>	<u>1,342</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 420,377</u>	<u>\$ 280,341</u>	<u>\$ 53,506</u>	<u>\$ 167,351</u>	<u>\$ 166,967</u>

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	短 於 1 年	1 ~ 5 年
租賃負債	<u>\$ 1,296</u>	<u>\$ 1,342</u>

108 年 12 月 31 日

	要求即付或 短於 1 個月	1 ~ 3 個月	3 個月 ~ 1 年	1 ~ 5 年	5 年 以 上
<u>非衍生金融負債</u>					
無附息負債	\$ 56,850	\$ 217,670	\$ 65,526	\$ -	\$ -
其他應付款(註)	10,390	27,273	1,181	-	-
固定利率工具	140,000	50,000	-	-	-
浮動利率工具	8,070	43,976	42,107	299,471	67,350
租賃負債	<u>223</u>	<u>407</u>	<u>866</u>	<u>78</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 215,533</u>	<u>\$ 339,326</u>	<u>\$ 109,680</u>	<u>\$ 299,549</u>	<u>\$ 67,350</u>

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	短 於 1 年	1 ~ 5 年
租賃負債	<u>\$ 1,496</u>	<u>\$ 78</u>

註：上述其他應付款中不包含應付薪資及獎金、應付退休金、應付員工紅利及應付董監事酬勞。

上述非衍生金融資產及負債之浮動利率工具金額，將因浮動利率與資產負債表日所估計之利率不同而改變。

(2) 融資額度

	<u>109年12月31日</u>	<u>108年12月31日</u>
無擔保銀行透支額度（ 每年重新檢視）		
— 已動用金額	\$238,339	\$268,010
— 未動用金額	<u>658,661</u>	<u>551,990</u>
	<u>\$897,000</u>	<u>\$820,000</u>

（接次頁）

(承前頁)

	109年12月31日	108年12月31日
有擔保銀行透支借款額 度（雙方同意下得展 期）		
一已動用金額	\$349,770	\$382,964
一未動用金額	<u>175,230</u>	<u>144,536</u>
	<u>\$525,000</u>	<u>\$527,500</u>

三十、關係人交易

本公司及子公司（係本公司之關係人）間之交易、帳戶餘額、收益及費損於合併時全數予以銷除，故未揭露於本附註。除已於其他附註揭露外，合併公司與其他關係人間之交易如下。

(一) 關係人名稱及其關係

關 係 人 名 稱	與 合 併 公 司 之 關 係
佳霖科技股份有限公司	其他關係人（董事長為同一人）（註）
佳霖電子（上海）有限公司	其他關係人（董事長為同一人）（註）

註：關係人於 108 年 3 月份加入弘塑合併個體。

(二) 營業收入

關 係 人 類 別 / 名 稱	109年度	108年度
其他關係人		
佳霖電子（上海）有限 公司	<u>\$ -</u>	<u>\$ 37</u>

本公司對關係人之銷貨與非關係人無重大差異，且均依照本公司之內部控制制度辦理。

(三) 進 貨

關 係 人 類 別 / 名 稱	109年度	108年度
其他關係人		
佳霖科技股份有限公司	\$ -	\$ 838
佳霖電子（上海）有限 公司	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 838</u>

(四) 其他關係人交易

帳 列 項 目	關 係 人 類 別 / 名 稱	109年度	108年度
製造費用	其他關係人		
	佳霖電子(上海)有限公司	\$ -	\$ 2,664
管理費用	其他關係人		
	佳霖電子(上海)有限公司	\$ -	\$ 182

(五) 主要管理階層薪酬

	109年度	108年度
短期員工福利	\$ 60,782	\$ 55,365
退職後福利	1,659	1,438
	<u>\$ 62,441</u>	<u>\$ 56,803</u>

董事及其他主要管理階層之薪酬係由薪酬委員會依照個人績效及市場趨勢決定。

三一、質抵押之資產

下列資產業經提供為銀行借款擔保品及貨物進口之保證金：

	109年12月31日	108年12月31日
質押定存單(帳列其他流動資產)	\$ 11,055	\$ 6,489
土地	488,742	488,741
房屋及建築物—淨額	<u>245,894</u>	<u>219,009</u>
	<u>\$745,691</u>	<u>\$714,239</u>

三二、重大或有負債及未認列之合約承諾

合併公司於資產負債表日之重大承諾事項及或有事項如下：

(一) 或有事項

1. 或有負債

合併公司因子公司及孫公司而發生之或有負債如下：

	109年12月31日	108年12月31日
對子公司及孫公司借款		
提供財務保證		
—保證金額	\$377,000	\$335,000
—實際動支金額	118,133	118,010

三三、具重大影響之外幣資產及負債資訊

合併公司具重大影響之外幣金融資產及負債資訊如下：

109 年 12 月 31 日

外幣資產	外幣	匯率	帳面金額
<u>貨幣性項目</u>			
美元	\$ 29,818	28.49	\$ 849,515
日圓	288,437	0.28	80,762
人民幣	12,393	4.38	54,281
			<u>\$ 984,558</u>
<u>外幣負債</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美元	1,882	28.53	\$ 53,693
日圓	55,913	0.28	15,656
			<u>\$ 69,349</u>

108 年 12 月 31 日

外幣資產	外幣	匯率	帳面金額
<u>貨幣性項目</u>			
美元	\$ 15,700	29.98	\$ 470,686
日圓	57,718	0.28	16,161
人民幣	9,799	4.30	42,136
			<u>\$ 528,983</u>
<u>外幣負債</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美元	2,187	30.13	\$ 65,894
日圓	50,914	0.28	14,256
			<u>\$ 80,150</u>

合併公司於 109 及 108 年度外幣兌換(損)益未實現分別為(4,800)仟元及(7,829)仟元，由於外幣交易及集團個體之功能性貨幣種類繁多，故無法按各重大影響之外幣別揭露兌換損益。

三四、附註揭露事項

(一) 重大交易事項相關資訊：

1. 資金貸與他人：無。
2. 為他人背書保證：附表一。

3. 期末持有有價證券情形（不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分）：附表二。
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新臺幣 3 億元或實收資本額 20%以上：附表三。
5. 取得不動產之金額達新臺幣 3 億元或實收資本額 20%以上：無。
6. 處分不動產之金額達新臺幣 3 億元或實收資本額 20%以上：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新臺幣 1 億元或實收資本額 20%以上：無。
8. 應收關係人款項達新臺幣 1 億元或實收資本額 20%以上：無。
9. 從事衍生工具交易：無。
10. 其他：母子公司間及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額：附表四。

(二) 轉投資事業相關資訊：附表五。

(三) 大陸投資資訊：

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、投資損益、期末投資帳面金額、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額：附表六。
2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項，及其價格、付款條件、未實現損益：無。
 - (1) 進貨金額及百分比與相關應付款項之期末餘額及百分比。
 - (2) 銷貨金額及百分比與相關應收款項之期末餘額及百分比。
 - (3) 財產交易金額及其所產生之損益數額。
 - (4) 票據背書保證或提供擔保品之期末餘額及其目的。
 - (5) 資金融通之最高餘額、期末餘額、利率區間及當期利息總額。
 - (6) 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項，如勞務之提供或收受等。

(四) 主要股東資訊：股權比例達 5%以上之股東名稱、持股數額及比例：附表七。

三五、部門資訊

(一) 部門收入與營運結果

合併公司繼續營業單位之收入與營運結果依應報導部門分析如下：

	設備製造部門	化學原料 製造部門	軟體銷售部門	設備銷售 代理部門	其他部門	總計
109年度						
來自外部客戶收入	\$ 1,121,823	\$ 705,080	\$ 56,955	\$ 553,195	\$ 50,618	\$ 2,487,671
部門間收入	<u>1,026</u>	<u>12,390</u>	<u>12,543</u>	<u>33,152</u>	<u>9,013</u>	<u>68,124</u>
部門收入	<u>\$ 1,122,849</u>	<u>\$ 717,470</u>	<u>\$ 69,498</u>	<u>\$ 586,347</u>	<u>\$ 59,631</u>	2,555,795
內部沖銷						(68,124)
合併收入						<u>\$ 2,487,671</u>
部門損益	<u>\$ 207,171</u>	<u>\$ 249,101</u>	<u>\$ 3,417</u>	<u>\$ 77,236</u>	(<u>\$ 3,805</u>)	\$ 533,120
利息收入						6,168
其他收入						4,313
其他利益及損失						(27,684)
財務成本						(5,880)
繼續營業單位稅前淨利						<u>\$ 510,037</u>
108年度						
來自外部客戶收入	\$ 865,822	\$ 551,182	\$ 101,407	\$ 429,349	\$ 113,627	\$ 2,061,387
部門間收入	<u>834</u>	<u>5,610</u>	<u>10,471</u>	<u>23,257</u>	<u>11,435</u>	<u>51,607</u>
部門收入	<u>\$ 866,656</u>	<u>\$ 556,792</u>	<u>\$ 111,878</u>	<u>\$ 452,606</u>	<u>\$ 125,062</u>	2,112,994
內部沖銷						(51,607)
合併收入						<u>\$ 2,061,387</u>
部門損益	<u>\$ 145,479</u>	<u>\$ 170,064</u>	<u>\$ 17,732</u>	<u>\$ 57,638</u>	<u>\$ 23,885</u>	\$ 414,798
利息收入						8,601
其他收入						5,062
其他利益及損失						(16,368)
財務成本						(8,038)
繼續營業單位稅前淨利						<u>\$ 404,055</u>

部門間銷貨係依市價計價。

部門利益係指各個部門所賺取之利潤，不包含其他收入、其他利益及損失、財務成本以及所得稅費用。此衡量金額係提供予主要營運決策者，用以分配資源予部門及評量其績效。

(二) 部門總資產與負債

合併公司報導部門資產均屬共用及部門負債為各部門共同承擔，故各營運部門資產及負債為合併公司之總資產及總負債。

(三) 主要產品及勞務之收入

合併公司繼續營業單位之主要產品及勞務之收入分析如下：

	109年度	108年度
機台設備產品銷售收入	\$ 1,223,744	\$ 1,006,036
化學產品銷售收入	746,690	585,889
維修服務及其它收入	436,343	337,256
軟體銷售及安裝收入	56,992	101,407
半導體及電子設備銷售代理 收入	<u>23,902</u>	<u>30,799</u>
	<u>\$ 2,487,671</u>	<u>\$ 2,061,387</u>

(四) 地區別資訊

合併公司主要於兩個地區營運－台灣及中國。

合併公司來自外部客戶之繼續營業單位收入依營運地點區分與非流動資產按資產所在地區分之資訊列示如下：

	來自外部客戶之收入		非流動資產	
	109年度	108年度	109年12月31日	108年12月31日
台灣	\$ 2,017,003	\$ 1,488,133	\$ 1,536,113	\$ 1,614,729
中國	335,411	445,562	-	-
新加坡	61,511	9,315	-	-
歐洲	32,206	21,510	-	-
美國	30,867	85,123	-	-
亞洲	10,631	11,744	-	-
加拿大	42	-	-	-
	<u>\$ 2,487,671</u>	<u>\$ 2,061,387</u>	<u>\$ 1,536,113</u>	<u>\$ 1,614,729</u>

非流動資產不包括金融工具及遞延所得稅資產等。

(五) 主要客戶資訊

來自單一客戶之收入達合併公司收入總額之 10%以上者如下：

	109年度	108年度
客戶 B (註 1)	\$ 574,659	\$ 332,075
客戶 F	399,637	NA (註 3)
客戶 L (註 2)	NA (註 3)	222,400
	<u>\$ 974,296</u>	<u>\$ 554,475</u>

註 1：本年度及上年度主係來自單晶片旋轉機台銷售收入。

註 2：上年度主係來自化學產品銷售收入。

註 3：收入金額未達合併公司收入總額之 10%。

弘塑科技股份有限公司及子公司

為他人背書保證

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表一

單位：除另註明外，
為新台幣仟元

編號	背書保證者 公司名稱	被背書保證對象		對單一企業 背書保證 限額（註 1）	本期最高背書 保證餘額	期末背書 保證餘額	實際動支金額	以財產擔保之 背書保證金額	累計背書保證 金額佔最近期 財務報表淨值 之比率（%）	背書保證 最高限額 （註 2）	屬母公司對子 公司背書保證	屬子公司對母 公司背書保證	屬對大陸地區 背書保證	備註
		公司名稱	關係											
0	弘塑科技股份有限 公司	添鴻科技股份有限 公司	本公司之 子公司	\$ 581,110	\$ 310,000	\$ 310,000	\$ 80,000	\$ -	10.67	\$ 1,162,220	是	—	—	—
		佳霖電子（上海） 有限公司	本公司之 子公司	581,110	5,000	5,000	-	-	0.17	1,162,220	是	—	是	—
		添鴻化學科技（上 海）有限公司	本公司之 子公司	581,110	5,000	5,000	-	-	0.17	1,162,220	是	—	是	—
		太引資訊系統股份 有限公司	本公司之 子公司	581,110	57,000	57,000	38,133	-	1.96	1,162,220	是	—	—	—

註 1：對單一企業背書保證限額係不超過最近一期經會計師核閱或查核財務報表所載淨值之百分之二十。

註 2：背書保證最高限額係不超過最近一期經會計師核閱或查核財務報表所載淨值之百分之四十。

弘塑科技股份有限公司及子公司

期末持有有價證券情形

民國 109 年 12 月 31 日

附表二

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元及股數仟股

持 有 之 公 司	有 價 證 券 種 類 及 名 稱	與 有 價 證 券 發 行 人 之 關 係	帳 列 科 目	期 末				備 註
				股 數	帳 面 金 額	持 股 比 例	公 允 價 值	
弘塑科技股份有限公司	股票 TAZMO CO., LTD.	無	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產－非流動	1,000	\$ 386,820	7.4%	\$ 386,820	
	Silicon Valley X-Ray Inc.	無	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產－非流動	7,398	120,150	11%	120,150	
	Silicon Valley X-Ray Inc.	無	按攤銷後成本衡量之金融資產 －流動	-	28,555	-	28,555	

註 1：投資子公司及關聯企業相關資訊，請參閱附表五。

註 2：本表所稱有價證券，係指屬國際會計準則第 39 號「金融工具：認列與衡量」範圍內之股票、債券、受益憑證及上述項目所衍生之有價證券。

弘塑科技股份有限公司及子公司

累積買進或賣出同一有價證券之金額達新臺幣 3 億元或實收資本額 20%以上

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表三

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元及股數仟股

買、賣之公司	有價證券種類及名稱 (註1)	帳列科目	交易對象 (註2)	關係 (註2)	期		初買入 (註3)		賣出 (註3)				期							
					股	數	金	額	股	數	金	額	股	數	金	額				
弘塑科技股份有限公司	股票 TAZMO CO., LTD.	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產—非流動	無	無	1,200	\$	488,520	-	\$	-	200	\$	78,784	\$	18,209	\$	60,575	1,000	\$	386,820

註 1：本表所稱有價證券，係指股票、債券、受益憑證及上述項目所衍生之有價證券。

註 2：有價證券帳列採用權益法之投資者，須填寫該二欄，餘得免填。

註 3：累計買進、賣出金額應按市價分開計算是否達 3 億元或實收資本額 20%。

註 4：實收資本額係指母公司之實收資本額。發行人股票無面額或每股面額非屬新臺幣 10 元者，有關實收資本額 20%之交易金額規定，以資產負債表歸屬於母公司業主之權益 10%計算之。

弘塑科技股份有限公司及子公司
母子公司間及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額
民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表四

單位：除另註明外，
為新台幣仟元

編號 (註 1)	交易人 名稱	交易往來對象	與交易人之關係 (註 2)	交易往來情形			
				科目	金額 (註 4)	交易條件	合併總營收或 總資產之比率 (註 3)
0	109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 弘塑科技股份有限公司	弘懋光電（上海）有限公司	1	技術服務費	\$ 9,694	依合約規定	-
				其他應付款	5,292	依合約規定	-
		添鴻科技股份有限公司	1	應收帳款	147	雙方議定	-
				合約負債	24	雙方議定	-
				銷貨收入	137	雙方議定	-
				維修收入	177	雙方議定	-
		佳霖科技股份有限公司	1	應付帳款	4,373	雙方議定	-
				進 貨	7,286	雙方議定	-
		佳霖電子（上海）有限公司	1	其他收入	143	雙方議定	-
				佣金支出	8,689	雙方議定	-
1	添鴻科技股份有限公司	添鴻化學科技（上海）有限公司	3	銷貨收入	1,002	雙方議定	-
				應收帳款	410	雙方議定	-
		太引資訊系統股份有限公司	1	銷貨收入	12,390	雙方議定	-
				應收帳款	9,640	雙方議定	-
				銷貨收入	12,531	雙方議定	1%
				應收帳款	12,476	雙方議定	-
		佳霖科技股份有限公司	3	合約負債	5,895	雙方議定	-
				雜 費	1	雙方議定	-
		佳霖電子（上海）有限公司	1	租金支出	13	雙方議定	-
				銷貨收入	5,175	雙方議定	-
2	佳霖科技股份有限公司	佳霖電子（上海）有限公司	1	應收帳款	1,145	雙方議定	-
				佣金支出	1,952	雙方議定	-
		佳霖電子（上海）有限公司	3	銷貨收入	9,341	雙方議定	-
				合約負債	3,235	雙方議定	-
				應收帳款	3,901	雙方議定	-
				銷貨收入	1,027	雙方議定	-
		添鴻化學科技（上海）有限公司	3	銷貨收入	1,027	雙方議定	-

註 1：母公司及子公司相互間之業務往來資訊應分別於編號欄註明，編號之填寫方法如下：

(1) 母公司填 0。(2) 子公司依公司別由阿拉伯數字 1 開始依序編號。

註 2：與交易人之關係有以下三種，標示種類即可（若係母子公司間或各子公司間之同一筆交易，則無須重複揭露。如：母公司對子公司之交易，若母公司已揭露，則子公司部分無須重複揭露；子公司對子公司之交易，若其一子公司已揭露，則另一子公司無須重複揭露）：

(1) 母公司對子公司。(2) 子公司對母公司。(3) 子公司對子公司。

註 3：交易往來金額佔合併總營收或總資產比率之計算，若屬資產負債項目者，以期末餘額佔合併總資產之方式計算；若屬損益項目者，以期中累積金額佔合併總營收之方式計算。

註 4：母子公司間重要交易往來，於編製合併報表時，業以沖銷之。

弘塑科技股份有限公司及子公司
被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊
民國 109 年 12 月 31 日

附表五

單位：除另予註明者外，為新台幣
千元及股數仟股

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有		被投資公司帳面金額	本期認列之投資損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率				
弘塑科技股份有限公司	GRAND PLASTIC TECHNOLOGY LIMITED	香港	投資業務	\$ 19,470	\$ 19,470	600	100%	\$ 17,470	(\$ 1,487)	(\$ 1,487)	
	添鴻科技股份有限公司	台灣	化學原料製造及銷售	513,956	513,956	10,000	100%	764,767	179,862	166,952	註3
	AQUA TALENT CO., LTD.	塞席爾	投資業務	17,838	17,838	350	100%	30,228	12,056	12,056	
	太引資訊系統股份有限公司	台灣	軟體銷售及安裝	160,783	160,783	2,831	78.1%	132,571	2,216	(5,461)	註3
	佳霖科技股份有限公司	台灣	半導體及電子設備銷售代理	534,796	534,796	20,000	100%	479,173	70,988	57,847	註3
GRAND PLASTIC TECHNOLOGY LIMITED	弘懋光電科技(上海)有限公司	上海	經營半導體機台買賣及維修	16,210	16,210	(註1)	100%	15,010	(1,445)	(1,445)	註2
AQUA TALENT CO., LTD.	添鴻化學科技(上海)有限公司	上海	化學原料製造及銷售	USD 300	USD 300	(註1)	100%	28,095	12,076	12,076	註2
太引資訊系統股份有限公司	太引信息科技(南京)有限公司	南京	軟體銷售及安裝	USD 74	USD 74	(註1)	100%	148	(1,477)	(1,477)	註2
佳霖科技股份有限公司	Challenge Tech. Corp.	薩摩亞	投資業務	\$ 19,069	\$ 19,069	1,000	100%	25,641	13,336	13,336	
Challenge Tech. Corp.	佳霖電子(上海)有限公司	上海	半導體及電子設備銷售代理	USD 600	USD 600	(註1)	100%	25,181	13,393	13,393	註2

註1：係有限公司無股數。

註2：大陸被投資公司相關資訊請參閱附表六。

註3：含企業合併產生之無形資產攤銷數。

弘塑科技股份有限公司及子公司

大陸投資資訊

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表六

單位：除另註明外，
為新台幣仟元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式 (註 1)	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益 (註 2)	期末投資帳面金額	截至本期止已匯回投資收益	備註
弘懋光電(上海)有限公司	經營半導體機台買賣及維修	\$ 16,210 (美金500仟元)	GRAND PLASTIC TECHNOLOGY LIMITED(2)	\$ 16,210 (美金 500 仟元)	\$ -	\$ -	\$ 16,210 (美金 500 仟元)	(\$ 1,445)	100%	(\$ 1,445)	\$ 15,010	\$ -	
添鴻化學科技(上海)有限公司	化學原料製造及銷售	8,927 (美金300仟元)	AQUA TALENT CO LTD(2)	26,587 (美金 870 仟元)	-	-	26,587 (美金 870 仟元)	12,076	100%	12,076	28,095	-	
太引信息科技(南京)有限公司	軟體銷售及安裝	2,254 (美金 74 仟元)	太引資訊系統股份有限公司(1)	2,254 (美金 74 仟元)	-	-	2,254 (美金 74 仟元)	(1,477)	78.1%	(1,154)	148	-	
佳霖電子(上海)有限公司	半導體及電子設備銷售代理	24,393 (美金 600 仟元)	Challenge Tech. Corp. (2)	24,393 (美金 600 仟元)	-	-	24,393 (美金 600 仟元)	13,393	100%	13,393	25,181	-	

本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投資審會核准	依經濟部投資審會規定 赴大陸地區投資限額 (註 2)
\$69,444 (美金 2,044 仟元)	\$69,444 (美金 2,044 仟元)	\$1,743,331

註 1：投資方式區分為下列三種，標示種類別即可：

- (1) 直接赴大陸地區從事投資。
- (2) 透過第三地區公司再投資大陸（請註明該第三地區之投資公司）。
- (3) 其他方式。

註 2：本公司對大陸投資累積達會計師核閱或查核財務報表所載淨值之百分之六十。

弘塑科技股份有限公司

主要股東資訊

民國 109 年 12 月 31 日

附表七

主 要 股 東 名 稱	股 份	
	持 有 股 數	持 股 比 例
張 鴻 泰	5,907,338	20.21%
定睿投資股份有限公司	2,038,819	6.97%
群呈科技股份有限公司	1,662,351	5.68%
富邦人壽保險股份有限公司	1,595,000	5.45%

註 1：本表主要股東資訊係由集保公司以當季季底最後一個營業日，計算股東持有公司已完成無實體登錄交付（含庫藏股）之普通股及特別股合計達 5%以上資料。本公司合併財務報告所記載股本與實際已完成無實體登錄交付股數，可能因編製計算基礎不同或有差異。

註 2：上開資料如屬股東將持股交付信託，係以受託人開立信託專戶之委託人個別分戶揭示。至於股東依據證券交易法令辦理持股超過 10%之內部人股權申報，其持股包括本人持股加計其交付信託且對信託財產具有運用決定權股份等，有關內部人股權申報資料請參閱公開資訊觀測站。

會計師查核報告

弘塑科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

弘塑科技股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達弘塑科技股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與弘塑科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對弘塑科技股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對弘塑科技股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入之認列

弘塑科技股份有限公司民國 109 年度營業收入淨額為新台幣 1,199,430 仟元，與收入認列相關會計政策及資訊請參閱個體財務報表附註四及二二。

弘塑科技股份有限公司近年來營業收入金額變化顯著對其民國 109 年度個體財務報表影響重大，惟對部分主要客戶營業收入及毛利率係顯著成長者，本會計師將其真實性列為本年度之關鍵查核事項。

本會計師因應上述風險，執行查核程序如下：

1. 瞭解及測試收入認列之主要內部控制設計及執行之有效性。
2. 抽核營業收入明細，核對客戶原始訂單及驗收單客戶簽收文件等相關憑證，是否與發票及入帳內容一致。
3. 抽核應收帳款收款金額、匯款憑證與對象是否與收入認列之金額與對象相符。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估弘塑科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算弘塑科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

弘塑科技股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實

表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對弘塑科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使弘塑科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致弘塑科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於弘塑科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成弘塑科技股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對弘塑科技股份有限公司民國 109 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 方 蘇 立

方蘇立



會計師 鍾 鳴 遠

鍾鳴遠



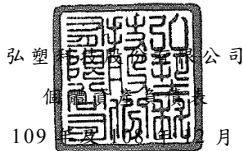
金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0940161384 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 2 日



民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四、六及二八）	\$ 396,065	9	\$ 550,155	14
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、八及二八）	735,535	16	317,480	8
1170	應收帳款（附註四、五、九、二八及二九）	70,587	2	88,853	2
1200	其他應收款（附註九及二八）	1,219	-	1,707	-
130X	存貨（附註四、五及十）	980,593	22	787,845	19
1410	預付款項	5,194	-	2,660	-
1470	其他流動資產（附註十五及三十）	13,355	-	9,216	-
11XX	流動資產總計	2,202,548	49	1,757,916	43
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四、七及二八）	506,970	11	571,482	14
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）	1,424,209	31	1,361,478	33
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十二及三十）	348,382	8	378,000	9
1755	使用權資產（附註四及十三）	2,364	-	453	-
1780	其他無形資產（附註四及十四）	3,341	-	8,824	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二四）	43,615	1	44,741	1
1990	其他非流動資產（附註十五及二八）	520	-	525	-
15XX	非流動資產總計	2,329,401	51	2,365,503	57
1XXX	資 產 總 計	\$ 4,531,949	100	\$ 4,123,419	100
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註四、十六及二八）	\$ 130,000	3	\$ 140,000	3
2130	合約負債－流動（附註十八、二二及二九）	735,733	16	530,287	13
2170	應付帳款（附註四、十七、二八及二九）	266,215	6	203,059	5
2200	其他應付款（附註十八、二八及二九）	179,142	4	177,313	4
2230	本期所得稅負債（附註四及二四）	66,716	2	48,338	1
2250	負債準備－流動（附註四、五及十九）	54,588	1	68,802	2
2280	租賃負債－流動（附註四、十三及二八）	1,046	-	377	-
2320	一年內到期之長期借款（附註四、十六及二八）	15,310	-	15,310	-
2399	其他流動負債（附註十八）	27	-	45	-
21XX	流動負債總計	1,448,777	32	1,183,531	28
	非流動負債				
2540	長期借款（附註四、十六及二八）	107,166	2	122,476	3
2550	負債準備－非流動（附註四、五及十九）	19,559	1	11,077	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及二四）	44,749	1	55,330	2
2580	租賃負債－非流動（附註四、十三及二八）	1,321	-	78	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及二十）	4,826	-	5,010	-
25XX	非流動負債總計	177,621	4	193,971	5
2XXX	負債總計	1,626,398	36	1,377,502	33
	權益（附註四及二一）				
3110	普通股股本	292,160	7	292,160	7
3200	資本公積	1,102,358	24	1,096,802	27
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	343,574	7	312,577	8
3320	特別盈餘公積	1,386	-	1,386	-
3350	未分配盈餘	1,027,293	23	841,636	20
3300	保留盈餘總計	1,372,253	30	1,155,599	28
3400	其他權益	221,428	5	284,004	7
3500	庫藏股票	(82,648)	(2)	(82,648)	(2)
3XXX	權益總計	2,905,551	64	2,745,917	67
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 4,531,949	100	\$ 4,123,419	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌



弘塑科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入（附註四、二二及二九）	\$ 1,199,430	100	\$ 995,351	100
5110	營業成本（附註十、二三及二九）	<u>701,583</u>	<u>59</u>	<u>553,528</u>	<u>56</u>
5900	營業毛利	<u>497,847</u>	<u>41</u>	<u>441,823</u>	<u>44</u>
	營業費用（附註二三）				
6100	推銷費用	44,167	4	42,301	4
6200	管理費用	90,183	7	90,363	9
6300	研究發展費用	<u>132,103</u>	<u>11</u>	<u>117,603</u>	<u>12</u>
6000	營業費用合計	<u>266,453</u>	<u>22</u>	<u>250,267</u>	<u>25</u>
6900	營業淨利	<u>231,394</u>	<u>19</u>	<u>191,556</u>	<u>19</u>
	營業外收入及支出（附註二三）				
7100	利息收入	4,931	1	6,970	1
7010	其他收入	3,598	-	4,230	-
7020	其他利益及損失	(19,416)	(2)	(2,380)	-
7050	財務成本	(2,183)	-	(3,155)	-
7070	採用權益法之子公司損益份額（附註十一）	<u>229,907</u>	<u>19</u>	<u>154,720</u>	<u>15</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>216,837</u>	<u>18</u>	<u>160,385</u>	<u>16</u>
7900	稅前淨利	448,231	37	351,941	35
7950	所得稅費用（附註四及二四）	<u>51,358</u>	<u>4</u>	<u>41,971</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>396,873</u>	<u>33</u>	<u>309,970</u>	<u>31</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度			108年度		
		金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益（附註四、二十、二一及二四）						
8310	不重分類至損益之項目：						
8311	確定福利計畫之再衡量數	(\$	116)	-	(\$	736)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(	15,689)	(1)		224,949	23
8330	採用權益法之子公司其他綜合損益份額		2,607	-	(	1,004)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目：						
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		991	-	(	2,051)	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		3,140	-	(	44,990)	(5)
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(	9,067)	(1)		176,168	18
8500	本年度綜合損益總額	\$	387,806	32	\$	486,138	49
	每股盈餘（附註二五）						
	來自繼續營業單位						
9710	基 本	\$	13.92		\$	11.11	
9810	稀 釋	\$	13.85		\$	11.05	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張鴻泰

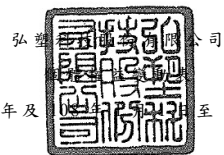


經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌





弘聖股份有限公司
民國 109 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

									其 他 權 益 項 目			
									國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兒 換 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 評 價 損 益	庫 藏 股 票	權 益 總 額
代 碼		股 數 (仟 股)	股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘				
A1	108 年 1 月 1 日餘額	24,684	\$ 246,838	\$ 601,772	\$ 284,709	\$ 1,386	\$ 795,002	(\$ 1,205)	\$ 107,301	\$ -	\$ 2,035,803	
	107 年度盈餘指撥及分配											
B1	法定盈餘公積	-	-	-	27,868	-	(27,868)	-	-	-	-	
B7	現金股利	-	-	-	-	-	(233,728)	-	-	-	(233,728)	
D1	108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利	-	-	-	-	-	309,970	-	-	-	309,970	
D3	108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,740)	(2,051)	179,959	-	176,168	
D5	108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	308,230	(2,051)	179,959	-	486,138	
H1	合併發行新股	4,532	45,322	489,474	-	-	-	-	-	-	534,796	
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	5,556	-	-	-	-	-	-	5,556	
L1	庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	(82,648)	(82,648)	
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	29,216	292,160	1,096,802	312,577	1,386	841,636	(3,256)	287,260	(82,648)	2,745,917	
	108 年度盈餘指撥及分配											
B1	法定盈餘公積	-	-	-	30,997	-	(30,997)	-	-	-	-	
B7	現金股利	-	-	-	-	-	(233,728)	-	-	-	(233,728)	
D1	109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利	-	-	-	-	-	396,873	-	-	-	396,873	
D3	109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,491	991	(12,549)	-	(9,067)	
D5	109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	399,364	991	(12,549)	-	387,806	
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	5,556	-	-	-	-	-	-	5,556	
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	51,018	-	(51,018)	-	-	
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	29,216	\$ 292,160	\$ 1,102,358	\$ 343,574	\$ 1,386	\$ 1,027,293	(\$ 2,265)	\$ 223,693	(\$ 82,648)	\$ 2,905,551	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌



弘塑科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 448,231	\$ 351,941
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	32,935	25,911
A20200	攤銷費用	5,816	6,761
A20900	財務成本	2,183	3,155
A22400	採用權益法之子公司損益份額	(229,907)	(154,720)
A21200	利息收入	(4,931)	(6,970)
A21300	股利收入	(2,952)	(3,778)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	11,533	16,889
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	57	-
A24100	外幣兌換淨損失	12,876	5,045
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	15,195	76,236
A31180	其他應收款	322	(1,086)
A31200	存 貨	(204,281)	(125,424)
A31230	預付款項	(2,534)	509
A31240	其他流動資產	(4,139)	(6,213)
A32125	合約負債	205,446	(34,508)
A32150	應付帳款	63,252	8,358
A32180	其他應付款	1,817	(12,543)
A32200	負債準備	(5,732)	(38,417)
A32230	其他流動負債	(18)	(11)
A32240	淨確定福利負債	(300)	(248)
A33000	營運產生之現金流入	344,869	110,887
A33100	收取之利息	5,097	7,179
A33300	支付之利息	(2,178)	(3,150)
A33500	支付之所得稅	(39,296)	(14,158)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>308,492</u>	<u>100,758</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 29,960)	\$ -
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	78,784	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(418,055)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	50,735
B02700	購置不動產、廠房及設備	(2,702)	(2,031)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	43	-
B03800	存出保證金減少	5	74
B04500	購置無形資產	(333)	(800)
B07600	收取子公司股利	176,330	216,965
B09900	收取其他股利	<u>2,952</u>	<u>3,778</u>
BBBB	投資活動之淨現金（流出）流 入	(<u>192,936</u>)	<u>268,721</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款（減少）增加	(10,000)	10,000
C01700	償還長期借款	(15,310)	(19,137)
C04020	租賃負債本金償還	(725)	(346)
C04500	支付股利	(<u>233,728</u>)	(<u>233,728</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>259,763</u>)	(<u>243,211</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>9,883</u>)	(<u>4,034</u>)
EEEE	現金及約當現金淨（減少）增加數	(154,090)	122,234
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>550,155</u>	<u>427,921</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 396,065</u>	<u>\$ 550,155</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌



弘塑科技股份有限公司

個體財務報告附註

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(除另註明外，金額以新台幣仟元為單位)

一、公司沿革

弘塑科技股份有限公司(以下稱「本公司」)係於 82 年 5 月設立於新竹市之股份有限公司，並於同年 5 月開始營業，所營業務主要為各種塑膠機械安裝工程設計，五金、機械、塑膠管、泵線、槽、樹脂、塗料、化工原料貯槽工程承包買賣，前各項有關產品之進出口貿易業務，半導體及積體電路製造設備及其材料、零件之代理、買賣及其技術諮詢顧問業務。

本公司股票自 100 年 1 月起在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。

本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告於 110 年 3 月 22 日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

- (一) 首次適用金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可並發布生效之國際財務報導準則(IFRS)、國際會計準則(IAS)、解釋(IFRIC)及解釋公告(SIC)(以下稱「IFRSs」)

適用修正後之金管會認可並發布生效之 IFRSs 將不致造成本公司會計政策之重大變動。

- (二) 110 年適用之金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
IFRS 4 之修正「適用 IFRS 9 之暫時豁免之展延」	發布日起生效
IFRS 9、IAS 39、IFRS 7、IFRS 4 及 IFRS 16 之修正「利率指標變革—第二階段」	2021 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間生效
IFRS 16 之修正「新型冠狀病毒肺炎相關租金減讓」	2020 年 6 月 1 日以後開始之年度報導期間生效

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日（註 1）
「2018-2020 週期之年度改善」	2022 年 1 月 1 日（註 2）
IFRS 3 之修正「更新對觀念架構之索引」	2022 年 1 月 1 日（註 3）
IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未 定
IFRS 17「保險合約」	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17 之修正	2023 年 1 月 1 日
IAS 1 之修正「負債分類為流動或非流動」	2023 年 1 月 1 日
IAS 1 之修正「會計政策之揭露」	2023 年 1 月 1 日（註 6）
IAS 8 之修正「會計估計之定義」	2023 年 1 月 1 日（註 7）
IAS 16 之修正「不動產、廠房及設備：達到預定使用狀態前之價款」	2022 年 1 月 1 日（註 4）
IAS 37 之修正「虧損性合約－履行合約之成本」	2022 年 1 月 1 日（註 5）

註 1：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註 2：IFRS 9 之修正適用於 2022 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間所發生之金融負債之交換或條款修改；IAS 41「農業」之修正適用於 2022 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間之公允價值衡量；IFRS 1「首次採用 IFRSs」之修正係追溯適用於 2022 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間。

註 3：收購日在年度報導期間開始於 2022 年 1 月 1 日以後之企業合併適用此項修正。

註 4：於 2021 年 1 月 1 日以後始達管理階層預期運作方式之必要地點及狀態之廠房、不動產及設備適用此項修正。

註 5：於 2022 年 1 月 1 日尚未履行所有義務之合約適用此項修正。

註 6：於 2023 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間推延適用此項修正。

註 7：於 2023 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間所發生之會計估計變動及會計政策變動適用此項修正。

截至本個體財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本個體財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則編製。

(二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具及按確定福利義務現值減除計畫資產公允價值認列之淨確定福利負債外，本個體財務報告係依歷史成本基礎編製。

公允價值衡量依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第 1 等級至第 3 等級：

1. 第 1 等級輸入值：係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活躍市場之報價（未經調整）。
2. 第 2 等級輸入值：係指除第 1 等級之報價外，資產或負債直接（亦即價格）或間接（亦即由價格推導而得）之可觀察輸入值。
3. 第 3 等級輸入值：係指資產或負債之不可觀察之輸入值。

本公司於編製個體財務報告時，對投資子公司係採權益法處理。為使本個體財務報告之本年度損益、其他綜合損益及權益與本公司合併財務報告中歸屬於本公司業主之本年度損益、其他綜合損益及權益相同，個體基礎與合併基礎下若干會計處理差異係調整「採用權益法之投資」、「採用權益法之子公司損益份額」、「採用權益法之子公司其他綜合損益份額」暨相關權益項目。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括：

1. 主要為交易目的而持有之資產；
2. 預期於資產負債表日後 12 個月內實現之資產；及
3. 現金及約當現金（但不包括於資產負債表日後逾 12 個月用以交換或清償負債而受到限制者）。

流動負債包括：

1. 主要為交易目的而持有之負債；
2. 於資產負債表日後 12 個月內到期清償之負債，以及

3. 不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少 12 個月之負債。

非屬上述流動資產或流動負債者，係分類為非流動資產或非流動負債。

(四) 外 幣

本公司編製個體財務報告時，以本公司功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算。因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額，於發生當期認列於損益。

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算，所產生之兌換差額列為當期損益，惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者，其產生之兌換差額列於其他綜合損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。

(五) 存 貨

存貨包括原料、物料、製成品及在製品。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。存貨成本之計算係採加權平均法。

(六) 投資子公司

本公司採用權益法處理對子公司之投資。

子公司係指本公司具有控制之個體。

權益法下，投資原始依成本認列，取得日後帳面金額係隨本公司所享有之子公司損益及其他綜合損益份額與利潤分配而增減。此外，針對本公司可享有子公司其他權益之變動係按持股比例認列。

當本公司對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者，係作為權益交易處理。投資帳面金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額，係直接認列為權益。

當本公司對子公司之損失份額等於或超過其在該子公司之權益（包括權益法下子公司之帳面金額及實質上屬於本公司對該子公司淨投資組成部分之其他長期權益）時，係繼續按持股比例認列損失。

取得成本超過本公司於取得日所享有子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額列為商譽，該商譽係包含於該投資之帳面金額且不得攤銷；本公司於取得日所享有子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額超過取得成本之數額列為當期收益。

本公司評估減損時，係以財務報告整體考量現金產生單位並比較其可回收金額與帳面金額。嗣後若資產可回收金額增加時，將減損損失之迴轉認列為利益，惟資產於減損損失迴轉後之帳面金額，不得超過該項資產在未認列減損損失之情況下，減除應提列攤銷後之帳面金額。歸屬於商譽之減損損失不得於後續期間迴轉。

本公司與子公司之順流交易未實現損益於個體財務報告予以銷除。本公司與子公司之逆流及側流交易所產生之損益，僅在與本公司對子公司權益無關之範圍內，認列於個體財務報告。

（七）不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本認列，後續以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。

不動產、廠房及設備於耐用年限內按直線基礎，對每一重大部分單獨提列折舊。本公司至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響。

不動產、廠房及設備除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

（八）無形資產

1. 單獨取得

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損損失後之金額衡量。無形資產於耐用年限內按直線基礎進行攤銷，本公司至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及攤銷方法進行檢視，並推延適

用會計估計變動之影響。非確定耐用年限無形資產係以成本減除累計減損損失列報。

2. 除 列

無形資產除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當期損益。

(九) 有形及無形資產（商譽除外）之減損

本公司於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示有形及無形資產（商譽除外）可能已減損。若有任一減損跡象存在，則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，本公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。

針對非確定耐用年限及尚未可供使用之無形資產，至少每年及有減損跡象時進行減損測試。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者。個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於其帳面金額時，將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額，減損損失係認列於損益。

當減損損失於後續迴轉時，該資產或現金產生單位之帳面金額調增至修訂後之可回收金額，惟增加後之帳面金額以不超過該資產或現金產生單位若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額（減除攤銷或折舊）。減損損失之迴轉係認列於損益。

(十) 金融工具

金融資產與金融負債於本公司成為該工具合約條款之一方時認列於個體資產負債表。

原始認列金融資產與金融負債時，若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者，係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本，則立即認列為損益。

1. 金融資產

金融資產之慣例交易係採交易日會計認列及除列。

(1) 衡量種類

本公司所持有之金融資產種類為按攤銷後成本衡量之金融資產與透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資。

A. 按攤銷後成本衡量之金融資產

本公司投資金融資產若同時符合下列兩條件，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產：

- a. 係於某經營模式下持有，該模式之目的係持有金融資產以收取合約現金流量；及
- b. 合約條款產生特定日期之現金流量，該等現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

按攤銷後成本衡量之金融資產（包括現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之應收帳款與其他應收款）於原始認列後，係以有效利息法決定之總帳面金額減除任何減損損失之攤銷後成本衡量，任何外幣兌換損益則認列於損益。

除下列兩種情況外，利息收入係以有效利率乘以金融資產總帳面金額計算：

- a. 購入或創始之信用減損金融資產，利息收入係以信用調整後有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算。
- b. 非屬購入或創始之信用減損，但後續變成信用減損之金融資產，應自信用減損後之次一報導期間起以有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算利息收入。

信用減損金融資產係指發行人或債務人已發生重大財務困難、違約、債務人很有可能聲請破產或其他財務重整或由於財務困難而使金融資產之活絡市場消失。

約當現金包括自取得日起 3 個月內、高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款，係用於滿足短期現金承諾。

B. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

本公司於原始認列時，可作一不可撤銷之選擇，將非持有供交易且非企業合併收購者所認列或有對價之權益工具投資，指定透過其他綜合損益按公允價值衡量。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資係按公允價值衡量，後續公允價值變動列報於其他綜合損益，並累計於其他權益中。於投資處分時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資之股利於本公司收款之權利確立時認列於損益中，除非該股利明顯代表部分投資成本之回收。

(2) 金融資產之減損

本公司於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產（含應收帳款）之減損損失。

應收帳款按存續期間預期信用損失認列備抵損失。其他金融資產係先評估自原始認列後信用風險是否顯著增加，若未顯著增加，則按 12 個月預期信用損失認列備抵損失，若已顯著增加，則按存續期間預期信用損失認列備抵損失。

預期信用損失係以發生違約之風險作為權重之加權平均信用損失。12 個月預期信用損失係代表金融工具於報導日後 12 個月內可能違約事項所產生之預期信用損失，存續期間預期信用損失則代表金融工具於預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

本公司為內部信用風險管理目的，在不考量所持有擔保品之前提下，判定下列情況代表金融資產已發生違約：

A. 有內部或外部資訊顯示債務人已不可能清償債務。

所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額，惟透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資之備抵損失係認列於其他綜合損益，並不減少其帳面金額。

(3) 金融資產之除列

本公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資整體除列時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

(十一) 負債準備

認列為負債準備（包括銷售合約之保固）之金額係考量義務之風險及不確定性，而為資產負債表日清償義務所需支出之最佳估計。負債準備係以清償義務之估計現金流量折現值衡量。

當清償負債準備所需支出之一部分或全部預期可自另一方歸墊，於幾乎確定可收到該歸墊，且其金額能可靠衡量時，將歸墊認列為資產。

1. 保 固

保證產品與所協議之規格相符之保固義務係依管理階層對清償本公司義務所需支出之最佳估計，於相關商品認列收入時認列。

(十二) 收入認列

本公司於客戶合約辨認履約義務後，將交易價格分攤至各履約義務，並於滿足各履約義務時認列收入。

若幾乎同時與同一客戶（或客戶之關係人）簽訂數個合約，因該等合約承諾之商品或勞務係為單一履約義務，本公司係以單一合約處理。

1. 商品銷貨收入

商品銷貨收入主要來自於半導體機台之銷售。由於半導體機台依個別合約約定，於運抵客戶指定地點或起運時，客戶已確認商品符合合約協定之規格，並具有能力可主導該產品之使用且取得該產品幾乎所有剩餘利益，故本公司係於該時點認列收入及應收帳款。產品銷售之預收款項，於產品運抵前係認列為合約負債。

去料加工時，加工產品所有權之控制並未移轉，是以去料時不認列收入。

(十三) 租賃

本公司於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。

1. 本公司為承租人

除適用認列豁免之低價值標的資產租賃及短期租賃之租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用，其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接成本及復原標的資產之估計成本）衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。使用權資產係單獨表達於個體資產負債表。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊。

租賃負債原始按租賃給付（包含固定給付及實質固定給付）之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，則使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間變動導致未來租賃給付有變動，本公司再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，則剩餘之再衡量金額認列於損益中。租賃負債係單獨表達於個體資產負債表。

(十四) 借款成本

直接可歸屬於取得、建造或生產符合要件之資產之借款成本，係作為該資產成本之一部分，直到該資產達到預定使用或出售狀態之幾乎所有必要活動已完成為止。

特定借款如於符合要件之資本支出發生前進行暫時投資而賺取之投資收入，係自符合資本化條件之借款成本中減除。

除上述外，所有其他借款成本係於發生當期認列為損益。

(十五) 員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利相關負債係以換取員工服務而預期支付之非折現金額衡量。

2. 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務期間將應提撥之退休金數額認列為費用。

確定福利退休計畫之確定福利成本（含服務成本、淨利息及再衡量數）係採預計單位福利法精算。服務成本（含當期服務成本）及淨確定福利負債（資產）淨利息於發生時認列為員工福利費用。再衡量數（含精算損益及扣除利息後之計畫資產報酬）於發生時認列於其他綜合損益並列入其他權益，後續期間不重分類至損益。

淨確定福利負債（資產）係確定福利退休計畫之提撥短絀（剩餘）。淨確定福利資產不得超過從該計畫退還提撥金或可減少未來提撥金之現值。

(十六) 所得稅

所得稅費用係當期所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當期所得稅

依我國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，係於股東會決議年度認列。

以前年度應付所得稅之調整，列入當期所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。

遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能有課稅所得以供可減除暫時性差異、虧損扣抵或購置機器設備、研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減使用時認列。

與投資子公司及關聯企業相關之應課稅暫時性差異皆認列遞延所得稅負債，惟本公司若可控制暫時性差異迴轉之時點，且該暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者除外。與此類投資有關之可減除暫時性差異，僅於其很有可能有足夠課稅所得用以實現暫時性差異，且於可預見之未來預期將迴轉的範圍內，予以認列遞延所得稅資產。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視，並針對已不再很有可能有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者，亦於每一資產負債表日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當期之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映本公司於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅後果。

3. 當期及遞延所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當期及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司於採用會計政策時，對於不易自其他來源取得相關資訊者，管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

本公司將新型冠狀病毒肺炎疫情造成之經濟影響納入重大會計估計之考量，管理階層將對估計與基本假設持續檢視。經評估不致造成合併公司重大會計估計之重大影響及變動。若估計之修正僅影響當年度，則於修正當年度認列；若會計估計之修正同時影響當年度及未來期間，則於修正當年度及未來期間認列。

估計及假設不確定性之主要來源

存貨之減損

存貨淨變現價值係正常營業過程中之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額估計，該等估計係依目前市場狀況及類似產品之歷史銷售經驗評估，市場情況之改變可能重大影響該等估計結果。

六、現金及約當現金

	109年12月31日	108年12月31日
庫存現金	\$ 64	\$ 44
銀行活期存款	272,392	441,551
約當現金（原始到期日在3個月以內之投資）		
銀行定期存款	<u>123,609</u>	<u>108,560</u>
	<u>\$396,065</u>	<u>\$550,155</u>

銀行存款於資產負債表日之利率區間如下：

	109年12月31日	108年12月31日
銀行存款	0.001%~1.90%	0.001%~2.40%

七、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

	109年12月31日	108年12月31日
<u>非流動</u>		
權益工具投資	<u>\$506,970</u>	<u>\$571,482</u>

權益工具投資

	109年12月31日	108年12月31日
非流動		
國外投資		
上市（櫃）公司股票	\$386,820	\$488,520
未上市（櫃）公司股票	<u>120,150</u>	<u>82,962</u>
	<u>\$506,970</u>	<u>\$571,482</u>

本公司依中長期策略目的投資國外上市（櫃）公司普通股及未上市（櫃）公司特別股，並預期透過長期投資獲利。本公司管理階層認為若將該等投資之短期公允價值波動列入損益，與前述長期投資規劃並不一致，因此選擇指定該等投資為透過其他綜合損益按公允價值衡量。

本公司於 109 年 1 月按 29,960 仟元購買 SVXR, Inc. 公司特別股，因屬中長期策略目的投資而指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量。

於 109 年 8 月，本公司調整投資部位以分散風險，而按公允價值 78,784 仟元出售部分上市（櫃）公司普通股，相關其他權益一透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 60,575 仟元則轉入保留盈餘。

八、按攤銷後成本衡量之金融資產

	109年12月31日	108年12月31日
流動		
國內投資		
原始到期日超過3個月之定期存款(一)	\$706,980	\$317,480
國外投資		
SVXR, Inc. 公司債券(二)	<u>28,555</u>	<u>-</u>
	<u>\$735,535</u>	<u>\$317,480</u>

(一) 截至 109 年及 108 年 12 月 31 日止，原始到期日超過 3 個月之定期存款利率區間分別為年利率 0.40%~0.82% 及 0.81%~2.25%。

(二) 本公司於 109 年 11 月按面額 28,555 仟元購買 SVXR, Inc. 公司債，票面利率 10%。

九、應收帳款及其他應收款

	109年12月31日	108年12月31日
應收帳款		
按攤銷後成本衡量		
總帳面金額－非關係人	\$ 70,030	\$ 88,257
總帳面金額－關係人	<u>557</u>	<u>596</u>
	<u>\$ 70,587</u>	<u>\$ 88,853</u>
其他應收款		
應收退稅款	\$ 868	\$ 1,190
應收收益	236	402
其 他	<u>115</u>	<u>115</u>
	<u>\$ 1,219</u>	<u>\$ 1,707</u>

(一) 按攤銷後成本衡量之應收帳款

本公司對商品銷售之平均授信期間為 60～120 天，應收帳款不予計息，本公司採行之政策係僅與評等相當於投資等級以上（含）之對象進行交易，並於必要情形下取得足額之擔保以減輕因拖欠所產生財務損失之風險。信用評等資訊係使用其他公開可得之財務資訊及歷史交易記錄對主要客戶予以評等。本公司持續監督信用暴險及交易對方之信用等級，並將總交易金額分散至信用評等合格之不同客戶，另透過每年由風險管理委員會複核及核准之交易對方信用額度以管理信用暴險。

本公司按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況、產業經濟情勢，並同時考量 GDP 預測及產業展望。因本公司之信用損失歷史經驗顯示，不同客戶群之損失型態並無顯著差異，因此準備矩陣未進一步區分客戶群，僅以應收帳款逾期天數訂定預期信用損失率。

若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且本公司無法合理預期可回收金額，例如交易對方正進行清算，本公司直接沖銷相關應收帳款，惟仍會持續追索活動，因追索回收之金額則認列於損益。

本公司依準備矩陣衡量應收帳款之備抵損失如下：

109 年 12 月 31 日

	未 逾 期	逾期 1~60 天	逾期 61~120 天	逾期超過 120 天	合 計
總帳面金額	\$ 64,713	\$ 1,833	\$ 18	\$ 4,023	\$ 70,587
備抵損失(存續期間預期信用損失)	-	-	-	-	-
攤銷後成本	<u>\$ 64,713</u>	<u>\$ 1,833</u>	<u>\$ 18</u>	<u>\$ 4,023</u>	<u>\$ 70,587</u>

108 年 12 月 31 日

	未 逾 期	逾期 1~60 天	逾期 61~120 天	逾期超過 120 天	合 計
總帳面金額	\$ 23,853	\$ 4,067	\$ 18,063	\$ 42,870	\$ 88,853
備抵損失(存續期間預期信用損失)	-	-	-	-	-
攤銷後成本	<u>\$ 23,853</u>	<u>\$ 4,067</u>	<u>\$ 18,063</u>	<u>\$ 42,870</u>	<u>\$ 88,853</u>

本公司對該等應收帳款餘額並未持有任何擔保品。

十、存 貨

	109年12月31日	108年12月31日
製 成 品	\$ -	\$ 2,266
在 製 品	814,778	671,719
原 物 料	<u>165,815</u>	<u>113,860</u>
	<u>\$980,593</u>	<u>\$787,845</u>

109 及 108 年度與存貨相關之銷貨成本分別為 701,583 仟元及 553,528 仟元。銷貨成本包括存貨跌價損失 11,533 仟元及 16,889 仟元。

十一、採用權益法之投資

	109年12月31日	108年12月31日
投資子公司	<u>\$ 1,424,209</u>	<u>\$ 1,361,478</u>

(一) 投資子公司

	109年12月31日	108年12月31日
非上市(櫃)公司		
添鴻科技股份有限公司	\$ 764,767	\$ 715,205
佳霖科技股份有限公司	479,173	464,247
太引資訊系統股份有限公司	132,571	145,406

(接次頁)

(承前頁)

	109年12月31日	108年12月31日
AQUA TALENT CO., LTD.	\$ 30,228	\$ 17,760
GRAND PLASTIC TECHNOLOGY LIMITED	<u>17,470</u>	<u>18,860</u>
	<u>\$ 1,424,209</u>	<u>\$ 1,361,478</u>

本公司於資產負債表日對子公司之所有權權益及表決權百分比如下：

	109年12月31日	108年12月31日
添鴻科技股份有限公司	100%	100%
GRAND PLASTIC TECHNOLOGY LIMITED	100%	100%
AQUA TALENT CO., LTD.	100%	100%
太引資訊系統股份有限公司	78.10%	78.10%
佳霖科技股份有限公司	100%	100%

本公司收購佳霖科技股份有限公司之揭露，請參閱本公司 109 年度合併財務報告附註二七。

本公司間接持有之投資子公司明細，請參閱附註三三。

109 及 108 年度採用權益法之子公司損益及其他綜合損益份額，係依據各子公司同期間經會計師查核之財務報告認列。

十二、不動產、廠房及設備

(一) 自用

	自有土地	建築物	機器設備	試驗設備	其他設備	合計
成本						
109年1月1日餘額	\$ 95,187	\$ 237,080	\$ 1,600	\$ 114,226	\$ 12,074	\$ 460,167
增添	-	705	-	100	1,897	2,702
處分	-	(1,924)	-	(1,774)	(3,438)	(7,136)
109年12月31日餘額	<u>\$ 95,187</u>	<u>\$ 235,861</u>	<u>\$ 1,600</u>	<u>\$ 112,552</u>	<u>\$ 10,533</u>	<u>\$ 455,733</u>
累計折舊及減損						
109年1月1日餘額	\$ -	\$ 56,238	\$ 878	\$ 16,677	\$ 8,374	\$ 82,167
折舊費用	-	8,180	101	21,814	2,125	32,220
處分	-	(1,924)	-	(1,674)	(3,438)	(7,036)
109年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 62,494</u>	<u>\$ 979</u>	<u>\$ 36,817</u>	<u>\$ 7,061</u>	<u>\$ 107,351</u>
109年12月31日淨額	<u>\$ 95,187</u>	<u>\$ 173,367</u>	<u>\$ 621</u>	<u>\$ 75,735</u>	<u>\$ 3,472</u>	<u>\$ 348,382</u>

(接次頁)

(承前頁)

	自有土地	建築物	機器設備	試驗設備	其他設備	合計
成本						
108年1月1日餘額	\$ 95,187	\$ 239,797	\$ 1,200	\$ 35,353	\$ 12,728	\$ 384,265
增添	-	771	400	-	860	2,031
重分類	-	-	-	78,873	-	78,873
處分	-	(3,488)	-	-	(1,514)	(5,002)
108年12月31日餘額	<u>\$ 95,187</u>	<u>\$ 237,080</u>	<u>\$ 1,600</u>	<u>\$ 114,226</u>	<u>\$ 12,074</u>	<u>\$ 460,167</u>
累計折舊及減損						
108年1月1日餘額	\$ -	\$ 50,324	\$ 758	\$ 3,359	\$ 7,160	\$ 61,601
折舊費用	-	9,402	120	13,318	2,728	25,568
處分	-	(3,488)	-	-	(1,514)	(5,002)
108年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 56,238</u>	<u>\$ 878</u>	<u>\$ 16,677</u>	<u>\$ 8,374</u>	<u>\$ 82,167</u>
108年12月31日淨額	<u>\$ 95,187</u>	<u>\$ 180,842</u>	<u>\$ 722</u>	<u>\$ 97,549</u>	<u>\$ 3,700</u>	<u>\$ 378,000</u>

折舊費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

建築物	
廠房主建物	43 至 50 年
電梯	15 年
其他	4 至 10 年
機器設備	6 至 8 年
試驗設備	3 至 8 年
其他設備	3 至 8 年

本公司設定作為借款擔保之自用不動產、廠房及設備金額，請參閱附註三十。

十三、租賃協議

(一) 使用權資產

	109年12月31日	108年12月31日
使用權資產帳面金額		
辦公設備	<u>\$ 2,364</u>	<u>\$ 453</u>
使用權資產之增添	<u>109年度</u>	<u>108年度</u>
使用權資產之折舊費用	<u>\$ 2,648</u>	<u>\$ 308</u>
辦公設備	<u>\$ 715</u>	<u>\$ 343</u>

(二) 租賃負債

	109年12月31日	108年12月31日
租賃負債帳面金額		
流 動	\$ 1,046	\$ 377
非 流 動	\$ 1,321	\$ 78

租賃負債之折現率區間如下：

	109年12月31日	108年12月31日
辦公設備	1.04%~1.25%	1.09%~1.25%

(三) 其他租賃資訊

	109年度	108年度
短期租賃費用	\$ 1,171	\$ 1,906
租賃之現金（流出）總額	(\$ 1,907)	(\$ 2,257)

十四、其他無形資產

	電 腦 軟 體 成 本
<u>成 本</u>	
109年1月1日餘額	\$ 20,285
單獨取得	333
處 分	(4,302)
109年12月31日餘額	\$ 16,316
<u>累計攤銷及減損</u>	
109年1月1日餘額	(\$ 11,461)
攤銷費用	(5,816)
處 分	4,302
109年12月31日餘額	(\$ 12,975)
109年12月31日淨額	\$ 3,341
<u>成 本</u>	
108年1月1日餘額	\$ 20,346
單獨取得	800
處 分	(861)
108年12月31日餘額	\$ 20,285

(接 次 頁)

(承前頁)

	電腦軟體成本
<u>累計攤銷及減損</u>	
108年1月1日餘額	(\$ 5,561)
攤銷費用	(6,761)
處分	<u>861</u>
108年12月31日餘額	(\$ <u>11,461</u>)
108年12月31日淨額	<u>\$ 8,824</u>

攤銷費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

電腦軟體成本 3年

本公司未有將其他無形資產設定質押作為借款擔保。

十五、其他資產

	109年12月31日	108年12月31日
<u>流動</u>		
受限制資產（附註三十）	\$ 11,055	\$ 6,489
留抵稅額	2,275	2,603
暫付款	<u>25</u>	<u>124</u>
	<u>\$ 13,355</u>	<u>\$ 9,216</u>
<u>非流動</u>		
存出保證金	<u>\$ 520</u>	<u>\$ 525</u>

十六、借 款

(一) 短期借款

	109年12月31日	108年12月31日
<u>無擔保借款</u>		
信用額度借款	<u>\$130,000</u>	<u>\$140,000</u>

銀行週轉性借款之利率於 109 年及 108 年 12 月 31 日分別為 0.51%~0.80%及 0.71%~0.99%。

(二) 長期借款

	109年12月31日	108年12月31日
<u>擔保借款</u>		
銀行借款	\$122,476	\$137,786
減：列為 1 年內到期部分	(<u>15,310</u>)	(<u>15,310</u>)
長期借款	<u>\$107,166</u>	<u>\$122,476</u>

該銀行借款係以本公司自有土地及建築物抵押擔保（參閱附註三十），借款到期日為 117 年 12 月 30 日，截至 109 年及 108 年 12 月 31 日止，有效年利率分別為 1.15%及 1.25%。此次動撥金額係用於購買土地、廠房及設備。

十七、應付帳款

	109年12月31日	108年12月31日
<u>應付帳款</u>		
因營業而發生	<u>\$266,215</u>	<u>\$203,059</u>

本公司採購原物料平均付款天數為 90 至 150 天，自應付帳款發票日起不加計利息。本公司訂有財務風險管理政策，以確保所有應付款於預先約定之信用期限內償還。

十八、其他負債

	109年12月31日	108年12月31日
<u>流動</u>		
其他應付款		
應付薪資及獎金	\$109,904	\$124,523
應付員工酬勞	39,666	31,145
應付董監事酬勞	7,933	6,232
應付保險費	3,099	2,644
應付勞務費	1,254	1,040
其 他	<u>11,994</u>	<u>10,308</u>
	173,850	175,892
其他應付款－關係人	<u>5,292</u>	<u>1,421</u>
	<u>\$179,142</u>	<u>\$177,313</u>
合約負債	<u>\$735,733</u>	<u>\$530,287</u>
其他負債		
代收 款	\$ 27	\$ 28
暫收 款	-	17
	<u>\$ 27</u>	<u>\$ 45</u>

十九、負債準備

	109年12月31日	108年12月31日
<u>流動</u>		
保 固	<u>\$ 54,588</u>	<u>\$ 68,802</u>
<u>非流動</u>		
保 固	<u>\$ 19,559</u>	<u>\$ 11,077</u>
		保 固
109年1月1日餘額		\$ 79,879
本年度新增		46,095
本年度使用		(21,228)
本年度迴轉未使用餘額		(30,599)
109年12月31日餘額		<u>\$ 74,147</u>

保固負債準備係依銷售商品合約約定，本公司管理階層對於因保固義務所導致未來經濟效益流出最佳估計數之現值。該估計係以歷史保固經驗為基礎，並考量新原料、製程變動或其他影響產品品質等因素調整。

二十、退職後福利計畫

(一) 確定提撥計畫

本公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資 6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。

(二) 確定福利計畫

本公司依我國「勞動基準法」辦理之退休金制度係屬政府管理之確定福利退休計畫。員工退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前 6 個月平均工資計算。本公司按員工每月薪資總額 2%提撥退休金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶，年度終了前，若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工，次年度 3 月底前將一次提撥其差額。該專戶係委託勞動部勞動基金運用局管理，本公司並無影響投資管理策略之權利。

列入個體資產負債表之確定福利計畫金額列示如下：

	109年12月31日	108年12月31日
確定福利義務現值	\$ 19,338	\$ 18,629
計畫資產公允價值	(14,512)	(13,619)
淨確定福利負債	<u>\$ 4,826</u>	<u>\$ 5,010</u>

淨確定福利負債變動如下：

	確 定 福 利 義 務 現 值	計 畫 資 產 公 允 價 值	淨 確 定 福 利 負 債
108 年 1 月 1 日餘額	<u>\$ 17,267</u>	<u>(\$ 12,745)</u>	<u>\$ 4,522</u>
利息費用（收入）	<u>216</u>	<u>(116)</u>	<u>100</u>
認列於損益	<u>216</u>	<u>(116)</u>	<u>100</u>
再衡量數			
精算損失－財務假設變動	665	-	665
精算損失－經驗調整	481	-	481
計畫資產報酬（除包含於淨利息之金額外）	<u>-</u>	<u>(410)</u>	<u>(410)</u>
認列於其他綜合損益	<u>1,146</u>	<u>(410)</u>	<u>736</u>
雇主提撥	<u>-</u>	<u>(348)</u>	<u>(348)</u>
108 年 12 月 31 日餘額	<u>18,629</u>	<u>(13,619)</u>	<u>5,010</u>
利息費用（收入）	<u>186</u>	<u>(138)</u>	<u>48</u>
認列於損益	<u>186</u>	<u>(138)</u>	<u>48</u>
再衡量數			
精算損失－財務假設變動	521	-	521
精算損失－經驗調整	2	-	2
計畫資產報酬（除包含於淨利息之金額外）	<u>-</u>	<u>(407)</u>	<u>(407)</u>
認列於其他綜合損益	<u>523</u>	<u>(407)</u>	<u>116</u>
雇主提撥	<u>-</u>	<u>(348)</u>	<u>(348)</u>
109 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 19,338</u>	<u>(\$ 14,512)</u>	<u>\$ 4,826</u>

本公司因「勞動基準法」之退休金制度暴露於下列風險：

1. 投資風險：勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式，將勞工退休基金分別投資於國內（外）權益證券與債務證券及銀行存款等標的，惟本公司之計畫資產得分配金額係以不低於當地銀行 2 年定期存款利率計算而得之收益。

2. 利率風險：政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加，惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加，兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。

3. 薪資風險：確定福利義務現值之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

本公司之確定福利義務現值係由合格精算師進行精算，衡量日之重大假設如下：

	109年12月31日	108年12月31日
折現率	0.80%	1.00%
薪資預期增加率	3.50%	3.50%

若重大精算假設分別發生合理可能之變動，在所有其他假設維持不變之情況下，將使確定福利義務現值增加（減少）之金額如下：

	109年12月31日	108年12月31日
折現率		
增加 0.25%	(\$ 649)	(\$ 665)
減少 0.25%	\$ 677	\$ 695
薪資預期增加率		
增加 1.00%	\$ 2,818	\$ 2,906
減少 1.00%	(\$ 2,437)	(\$ 2,493)

由於精算假設可能彼此相關，僅單一假設變動之可能性不大，故上述敏感度分析可能無法反映確定福利義務現值實際變動情形。

	109年12月31日	108年12月31日
預期1年內提撥金額	\$ 348	\$ 348
確定福利義務平均到期期間	15年	16年

二一、權益

(一) 股本

普通股

	109年12月31日	108年12月31日
額定股數（仟股）	30,000	30,000
額定股本	\$300,000	\$300,000
已發行且已收足股款之股數 （仟股）	29,216	29,216
已發行股本	\$292,160	\$292,160

已發行之普通股每股面額為 10 元，每股享有一表決權及收取股利之權利。

本公司於 107 年 3 月 27 日，經董事會決議發行普通股約 4,532 仟股，每股面額新台幣 10 元整，總計新發行股份總額約新台幣 45,322 仟元，作為收購佳霖科技股份有限公司全部已發行普通股之對價。前開之換股基準日為 108 年 3 月 1 日，本案經 107 年 6 月 26 日召開之股東會通過並已完成其他相關法律程序。

(二) 資本公積

	109年12月31日	108年12月31日
<u>得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本(1)</u>		
股票發行溢價	\$ 114,000	\$ 114,000
庫藏股票交易(2)	11,112	5,556
合併發行新股溢價	976,592	976,592
<u>不得作為任何用途</u>		
員工認股權	654	654
	<u>\$ 1,102,358</u>	<u>\$ 1,096,802</u>

1. 此類資本公積得用以彌補虧損，亦得於公司無虧損時，用以發放現金或撥充股本，惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。
2. 此類資本公積係子公司持有母公司股票，母公司發放現金股利時配發予子公司之股利。

(三) 保留盈餘及股利政策

依本公司章程之盈餘分派政策規定，年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司章程規定之員工及董監事酬勞分派政策，參閱附註二三之(七)員工酬勞及董監事酬勞。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25% 之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

本公司依金管證發字第 1010012865 號函、金管證發字第 1010047490 號函、金管證發字第 1030006415 號及「採用國際財務報導準則（IFRSs）後，提列特別盈餘公積之適用疑義問答」等規定提列及迴轉特別盈餘公積。

本公司於 109 年 6 月 18 日及 108 年 6 月 19 日舉行股東常會，分別決議通過 108 及 107 年度盈餘分配案如下：

	盈餘分配案	
	108年度	107年度
法定盈餘公積	\$ 30,997	\$ 27,868
現金股利	233,728	233,728
每股現金股利（元）	8	8

本公司 110 年 3 月 22 日董事會擬議 109 年度盈餘分配案如下：

	109年度
法定盈餘公積	\$ 45,038
現金股利	321,376
每股現金股利（元）	11

有關 109 年度之盈餘分配案尚待預計於 110 年 6 月 23 日召開之股東會決議。

(四) 特別盈餘公積

	109年度	108年度
年初及年底餘額	<u>\$ 1,386</u>	<u>\$ 1,386</u>

(五) 其他權益項目

1. 國外營運機構財務報表換算之兌換差額

	109年度	108年度
年初餘額	(\$ 3,256)	(\$ 1,205)
國外營運機構之換算差額	<u>991</u>	<u>(2,051)</u>
年底餘額	<u>(\$ 2,265)</u>	<u>(\$ 3,256)</u>

2. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益

	109年度	108年度
年初餘額	\$287,260	\$107,301
當年度產生		
未實現損益		
權益工具	(12,549)	179,959
處分權益工具累計損益		
移轉至保留盈餘	(51,018)	-
年底餘額	<u>\$223,693</u>	<u>\$287,260</u>

(六) 庫藏股票

收	回	原	因	子公司持有本公司 股票 (仟 股)
109 年 1 月 1 日及 12 月 31 日股數				<u>695</u>
108 年 1 月 1 日股數				-
本期增加				<u>695</u>
108 年 12 月 31 日股數				<u>695</u>

為投資目的，子公司於資產負債表日持有本公司股票，相關資訊如下：

109 年 12 月 31 日

子 公 司 名 稱	持有股數 (仟股)	帳 面 金 額	市 價
佳霖科技股份有限公司	695	\$ 82,648	\$ 276,072

108 年 12 月 31 日

子 公 司 名 稱	持有股數 (仟股)	帳 面 金 額	市 價
佳霖科技股份有限公司	695	\$ 82,648	\$ 193,424

子公司持有本公司股票視同庫藏股票處理，除不得參與本公司之現金增資及無表決權外，其餘與一般股東權利相同。

二二、收 入

	109年度	108年度
客戶合約收入		
商品銷售收入	<u>\$ 1,199,430</u>	<u>\$ 995,351</u>

(一) 客戶合約之說明

商品銷貨收入主要來自於半導體機台之驗收。由於產品於運抵客戶指定地點時，客戶對商品已有訂定價格與使用之權利且負有再銷售之主要責任，並承擔商品陳舊過時風險，合併公司係於該時點認列收入。產品銷售之預收款項，於機台驗收前係認列為合約負債。

(二) 合約餘額

	109年12月31日	108年12月31日	108年1月1日
應收帳款（附註九）	<u>\$ 70,587</u>	<u>\$ 88,853</u>	<u>\$ 166,385</u>
合約負債—流動（附註十八）			
商品銷貨	<u>\$ 735,733</u>	<u>\$ 530,287</u>	<u>\$ 564,795</u>

(三) 客戶合約收入之細分

1. 主要產品及勞務之收入

	109年度	108年度
機台設備產品銷售收入	\$ 1,113,034	\$ 865,821
維修服務及其它收入	<u>86,396</u>	<u>129,530</u>
	<u>\$ 1,199,430</u>	<u>\$ 995,351</u>

2. 地區別資訊主要產品及勞務之收入

本公司主要地區營運—台灣、中國、美國與新加坡。

本公司來自外部客戶之繼續營業單位收入依營運地點區分之資訊列示如下：

	來自外部客戶之收入	
	109年度	108年度
台灣	\$ 1,016,523	\$ 791,560
中國	128,513	164,585
新加坡	54,394	3,166
美國	<u>-</u>	<u>36,040</u>
	<u>\$ 1,199,430</u>	<u>\$ 995,351</u>

二三、繼續營業單位淨利

繼續營業單位淨利係包含以下項目：

(一) 利息收入

	109年度	108年度
銀行存款	<u>\$ 4,931</u>	<u>\$ 6,970</u>

(二) 其他收入

	109年度	108年度
股利收入	\$ 2,952	\$ 3,778
其 他	<u>646</u>	<u>452</u>
	<u>\$ 3,598</u>	<u>\$ 4,230</u>

(三) 其他利益及損失

	109年度	108年度
淨外幣兌換（損）益	(\$ 19,359)	(\$ 2,380)
處分不動產、廠房及設備損失	<u>(57)</u>	<u>-</u>
	<u>(\$ 19,416)</u>	<u>(\$ 2,380)</u>

(四) 財務成本

	109年度	108年度
銀行借款利息	\$ 2,172	\$ 3,150
租賃負債之利息	<u>11</u>	<u>5</u>
	<u>\$ 2,183</u>	<u>\$ 3,155</u>

(五) 折舊及攤銷

	109年度	108年度
折舊費用依功能別彙總		
營業成本	\$ 3,937	\$ 4,505
營業費用	<u>28,998</u>	<u>21,406</u>
	<u>\$ 32,935</u>	<u>\$ 25,911</u>
攤銷費用依功能別彙總		
營業成本	\$ 59	\$ 114
營業費用	<u>5,757</u>	<u>6,647</u>
	<u>\$ 5,816</u>	<u>\$ 6,761</u>

(六) 員工福利費用

	109年度	108年度
退職後福利		
確定提撥計畫	\$ 8,031	\$ 7,910
確定福利計畫(附註二十)	48	100
	8,079	8,010
其他員工福利	244,698	225,607
員工福利費用合計	<u>\$252,777</u>	<u>\$233,617</u>
依功能別彙總		
營業成本	\$ 59,103	\$ 55,437
營業費用	193,674	178,180
	<u>\$252,777</u>	<u>\$233,617</u>

(七) 員工酬勞及董監事酬勞

本公司依章程規定係按當年度扣除分派員工及董監酬勞前之稅前利益分別以不低於 7.5%及不高於 3%提撥員工酬勞及董監事酬勞。109 及 108 年度員工酬勞及董監事酬勞分別於 110 年 3 月 22 日及 109 年 3 月 23 日經董事會決議如下：

估列比例

	109年度	108年度
員工酬勞	8.00%	8.00%
董監事酬勞	1.60%	1.60%

金 額

	109年度				108年度			
	現	金	股	票	現	金	股	票
員工酬勞	\$ 39,666		\$ -		\$ 31,145		\$ -	
董監事酬勞		7,933		-		6,232		-

年度個體財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

108 及 107 年度員工酬勞及董監事酬勞之實際配發金額與 108 及 107 年度個體財務報告之認列金額並無差異。

有關本公司 109 及 108 年董事會決議之員工酬勞及董監事酬勞資訊，請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

二四、繼續營業單位所得稅

(一) 認列於損益之所得稅費用

	109年度	108年度
當期所得稅		
本年度產生者	\$ 45,035	\$ 33,055
未分配盈餘加徵	2,029	-
以前年度之調整	<u>1,054</u>	<u>2,023</u>
	48,118	35,078
遞延所得稅		
本年度產生者	<u>3,240</u>	<u>6,893</u>
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 51,358</u>	<u>\$ 41,971</u>

會計所得與所得稅費用之調節如下：

	109年度	108年度
繼續營業單位稅前淨利	<u>\$448,231</u>	<u>\$351,941</u>
稅前淨利按法定稅率計算之		
所得稅費用	\$ 89,646	\$ 70,388
永久性差異	(43,868)	(30,391)
暫時性差異	2,497	(49)
未分配盈餘加徵	2,175	-
當年度抵用投資抵減	(146)	-
以前年度之當期所得稅費用		
於本年度之調整	<u>1,054</u>	<u>2,023</u>
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 51,358</u>	<u>\$ 41,971</u>

我國於 108 年 7 月經總統公布修正產業創新條例，明訂以 107 年度起之未分配盈餘興建或購置特定資產或技術得列為計算未分配盈餘之減除項目，本公司於 108 年計算未分配盈餘稅時，僅將已實際進行再投資之資本支出金額減除。

(二) 認列於其他綜合損益之所得稅

	109年度	108年度
遞延所得稅		
本年度產生		
— 透過其他綜合損益按		
公允價值衡量之金融		
資產未實現損益	<u>\$ 3,140</u>	<u>(\$ 44,990)</u>
認列於其他綜合損益之所得		
稅	<u>\$ 3,140</u>	<u>(\$ 44,990)</u>

(三) 本期所得稅資產與負債

	109年12月31日	108年12月31日
本期所得稅負債		
應付所得稅	<u>\$ 66,716</u>	<u>\$ 48,338</u>

(四) 遞延所得稅資產與負債

遞延所得稅資產及負債之變動如下：

109 年度

	年 初 餘 額	認 列 於 損 益	認 列 於 其 他 綜 合 損 益	直 接 認 列 於 權 益	年 底 餘 額
<u>遞 延 所 得 稅 資 產</u>					
暫時性差異					
未實現績效獎金					
費用	\$ 18,137	(\$ 3,271)	\$ -	\$ -	\$ 14,866
負債準備	15,976	(1,147)	-	-	14,829
未實現存貨跌價					
損失	8,573	1,725	-	-	10,298
確定福利退休計					
畫	4,789	-	-	-	4,789
未實現兌換損益	1,009	1,566	-	-	2,575
未實現其他收入	89	-	-	-	89
國外營運機構兌					
換差額	(<u>3,832</u>)	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	(<u>3,831</u>)
	<u>\$ 44,741</u>	(<u>\$ 1,126</u>)	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 43,615</u>
<u>遞 延 所 得 稅 負 債</u>					
暫時性差異					
透過其他綜合損					
益按公允價值					
衡量之金融資					
產	\$ 52,633	\$ -	(\$ 3,140)	(\$ 9,555)	\$ 39,938
未實現權益法投					
資損益	<u>2,697</u>	<u>2,114</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,811</u>
	<u>\$ 55,330</u>	<u>\$ 2,114</u>	(<u>\$ 3,140</u>)	(<u>\$ 9,555</u>)	<u>\$ 44,749</u>

108 年度

	年 初 餘 額	認 列 於 損 益	認 列 於 其 他 綜 合 損 益	年 底 餘 額
<u>遞 延 所 得 稅 資 產</u>				
暫時性差異				
未實現績效獎金費				
用	\$ 21,029	(\$ 2,892)	\$ -	\$ 18,137
負債準備	23,659	(7,683)	-	15,976
未實現存貨跌價損				
失	5,879	2,694	-	8,573
確定福利退休計畫	4,789	-	-	4,789
未實現兌換損益	(532)	1,541	-	1,009
未實現其他收入	89	-	-	89
國外營運機構兌換				
差額	(3,831)	(1)	-	(3,832)
未實現權益法投資				
損益	(<u>693</u>)	<u>693</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 50,389</u>	(<u>\$ 5,648</u>)	<u>\$ -</u>	<u>\$ 44,741</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

	年 初 餘 額	認 列 於 損 益	認 列 於 其 他 綜 合 損 益	年 底 餘 額
遞延所得稅負債				
暫時性差異				
透過其他綜合損益				
按公允價值衡量				
之金融資產	\$ 7,643	\$ -	\$ 44,990	\$ 52,633
未實現權益法投資				
損益	1,452	1,245	-	2,697
	<u>\$ 9,095</u>	<u>\$ 1,245</u>	<u>\$ 44,990</u>	<u>\$ 55,330</u>

(五) 所得稅核定情形

本公司之營利事業所得稅申報，截至 107 年度以前之申報案件業經稅捐稽徵機關核定。

二五、每股盈餘

單位：每股元

	109年度	108年度
基本每股盈餘	<u>\$ 13.92</u>	<u>\$ 11.11</u>
稀釋每股盈餘	<u>\$ 13.85</u>	<u>\$ 11.05</u>

用以計算每股盈餘之盈餘及普通股加權平均股數如下：

本年度淨利

	109年度	108年度
淨 利	<u>\$396,873</u>	<u>\$309,970</u>

股 數

單位：仟股

	109年度	108年度
用以計算基本每股盈餘之普通 股加權平均股數	28,521	27,901
具稀釋作用潛在普通股之影響：		
員工分紅	<u>143</u>	<u>162</u>
用以計算稀釋每股盈餘之普通 股加權平均股數	<u>28,664</u>	<u>28,063</u>

若本公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度

決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

二六、取得投資子公司－取得控制

	主要營運活動	收購日	具表決權之 所有權權益／ 收購比例(%)	移轉對價
佳霖科技股份有限公司	半導體及電子設備銷售代理	108年3月	100	\$ 534,796

本公司取得佳霖科技股份有限公司係為擴充對客戶服務的廣度，進而提高競爭優勢及擴大營運規模。取得佳霖科技股份有限公司之說明，請參閱本公司 109 年度合併財務報告附註二七。

二七、資本風險管理

本公司進行資本管理以確保能夠於繼續經營之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，使資本有效之運用，並確保各公司順利營運。本公司之資本結構係由淨負債及權益所組成，毋需遵守其他外部資本規定。本公司主要管理階層定期重新檢視資本結構，其檢視內容包括考量各類資本之成本及相關風險，目前資本結構中權益項目遠大於負債項目，將用以支應未來所需之營運資金、資本支出及股利支出等需求。

二八、金融工具

(一) 公允價值資訊－非按公允價值衡量之金融工具

本公司於財務報導結束日之按攤銷後成本衡量之金融資產及金融負債，於財務報告中之帳面金額趨近其公允價值。

(二) 公允價值資訊－以重複性基礎按公允價值衡量之金融工具

1. 公允價值層級

109 年 12 月 31 日

	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合計
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產				
國外上市（櫃）有價證券				
－權益投資	\$ 386,820	\$ -	\$ -	\$ 386,820
國外未上市（櫃）有價證券				
－權益投資	-	-	120,150	120,150
	<u>\$ 386,820</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 120,150</u>	<u>\$ 506,970</u>

108 年 12 月 31 日

	第 1 等 級	第 2 等 級	第 3 等 級	合 計
透過其他綜合損益按公允				
價值衡量之金融資產				
國外上市（櫃）有價證券				
－權益投資	\$ 488,520	\$ -	\$ -	\$ 488,520
國外未上市（櫃）有價證券				
－權益投資	-	-	82,962	82,962
	<u>\$ 488,820</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 82,962</u>	<u>\$ 571,482</u>

109 及 108 年度無第 1 等級與第 2 等級公允價值衡量間移轉之情形。

2. 金融工具以第 3 等級公允價值衡量之調節

109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

金 融 資 產	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之 金 融 資 產 權 益 工 具
年初餘額	\$ 82,962
認列於其他綜合損益	7,228
購 買	<u>29,960</u>
年底餘額	<u>\$120,150</u>

108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

金 融 資 產	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之 金 融 資 產 權 益 工 具
年初餘額	\$122,860
認列於其他綜合損益	(39,898)
年底餘額	<u>\$ 82,962</u>

(三) 金融工具之種類

	<u>109年12月31日</u>	<u>108年12月31日</u>
金融資產		
按攤銷後成本衡量之金融資 產（註1）	\$ 1,203,926	\$ 958,720
透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產	506,970	571,482

（接次頁）

(承前頁)

	109年12月31日	108年12月31日
<u>金融負債</u>		
按攤銷後成本衡量(註2)	\$ 697,833	\$ 658,158

註1：餘額係包含現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之金融資產—流動、應收帳款(含關係人)、其他應收款及存出保證金等按攤銷後成本衡量之金融資產。

註2：餘額係包含短期借款、應付帳款(含關係人)、其他應付款(含關係人)、一年內到期之長期負債及長期借款等按攤銷後成本衡量之金融負債。

(四) 財務風險管理目的與政策

本公司主要金融工具包括權益及債務工具投資、應收帳款、借款、應付帳款及租賃負債。本公司財務風險管理目標，係為管理營運活動相關之市場風險(包含匯率風險、利率風險及其他價格風險)、信用風險及流動性風險。

本公司透過衍生金融工具規避暴險，以減輕該等風險之影響。衍生金融工具之運用受本公司董事會通過之政策所規範，其為匯率風險、利率風險、信用風險、衍生金融工具與非衍生金融工具之運用以及剩餘流動資金之投資書面原則。內部稽核人員持續地針對政策之遵循與暴險額度進行複核。本公司並未以投機目的而進行金融工具(包括衍生金融工具)之交易。

財務管理部門每季對本公司之風險管理委員會提出報告，該委員會係為專責監督風險與落實政策以減輕暴險之獨立組織。

1. 市場風險

本公司之營運活動使本公司承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險(參閱下述(1))以及利率變動風險(參閱下述(2))。

本公司對有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

(1) 匯率風險

本公司從事非功能性貨幣計價之交易因而產生匯率變動暴險，尚在本公司匯率暴險之管理政策許可範圍內。

本公司於資產負債表日非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額以及具匯率風險暴險之衍生工具帳面金額，參閱附註三二。

敏感度分析

本公司主要受到美金及日圓匯率波動之影響。

下表詳細說明當新台幣（功能性貨幣）對各攸關外幣之匯率增加及減少1%時，本公司之敏感度分析。

敏感度分析僅包括流通在外之外幣貨幣性項目並將其年底之換算以匯率變動1%予以調整。下表之正數係表示當新台幣相對於各相關貨幣升值1%時，將使稅前淨利增加之金額；當新台幣相對於各相關外幣貶值1%時，其對稅前淨利之影響將為同金額之負數。

	美 金 之 影 響		日 幣 之 影 響	
	109年度	108年度	109年度	108年度
損 益	\$ 5,646	\$ 3,086	\$ 617	\$ 17

(2) 利率風險

因本公司內之個體同時以固定及浮動利率借入資金，因而產生利率暴險。本公司定期評估避險活動，使其與利率觀點及既定之風險偏好一致，以確保採用最符合成本效益之避險策略。

本公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	109年12月31日	108年12月31日
具公允價值利率風險		
—金融資產	\$611,793	\$ 94,245
—金融負債	130,000	130,000
具現金流量利率風險		
—金融資產	530,798	779,835
—金融負債	122,476	147,786

敏感度分析

下列敏感度分析係依非衍生工具於資產負債表日之利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係假設資產負債表日流通在外之負債金額於報導期間皆流通在外。本公司內部向主要管理階層報告利率時所使用之變動率為利率增加或減少 1%，此亦代表管理階層對利率之合理可能變動範圍之評估。

若利率增加／減少 1%，在所有其他變數維持不變之情況下，本公司 109 及 108 年度之稅前淨利將分別減少／增加 4,083 仟元及 6,320 仟元，主因為本公司之變動利率借款。

(3) 其他價格風險

本公司因上市櫃及非上市櫃權益證券投資而產生權益價格暴險。該權益投資非持有供交易而係屬策略性投資。本公司並未積極交易該等投資。本公司權益價格風險主要集中於日本及美國地區之權益工具。

敏感度分析

若權益價格上漲／下跌 1%，109 及 108 年度其他綜合損益將因透過其他綜合損益按公允價值衡量金融資產之公允價值而增加／減少 5,070 仟元及 5,715 仟元。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成本公司財務損失之風險。截至資產負債表日，本公司可能因交易對方未履行義務及本公司提供財務保證造成財務損失之最大信用風險暴險主要係來自於：

(1) 客戶帳款無法回收。

(2) 本公司提供財務保證所產生之或有負債金額。

本公司之交易對方均為信用良好之金融機構及公司組織，業務單位透過外部徵信調查及同業查訪隨時掌握及了解往來客戶之信用狀況，因此不預期有重大之信用風險。

本公司信用風險並無顯著集中，各期之應收帳款餘額中，超過應收帳款合計數之10%之客戶如下：

	109年12月31日	108年12月31日
X 客戶	\$ 19,309	\$ 9,490
F 客戶	10,123	16,826
A 客戶	7,586	-
D 客戶	7,267	-
W 客戶	-	11,765
T 客戶	-	9,082
Q 客戶	-	8,908

3. 流動性風險

本公司透過管理及維持足夠部位之現金或易變現之金融商品以支應本公司之營運資金，除了本公司投資之備供出售金融商品無活絡市場，預期具有重大流動性風險外，本公司資本結構中流動資產大於流動負債，故未有因無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

銀行借款對本公司而言係為一項重要流動性來源。截至 109 年及 108 年 12 月 31 日止，本公司未動用之融資額度，參閱下列(2)融資額度之說明。

(1) 非衍生金融負債之流動性及利率風險表

非衍生金融負債剩餘合約到期分析係依本公司最早可能被要求還款之日期，按金融負債未折現現金流量（包含本金及估計利息）編製。因此，本公司可被要求立即還款之銀行借款，係列於下表最早之期間內，不考慮銀行立即執行該權利之機率；其他非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

109 年 12 月 31 日

	要求即付或 短於1個月	1 ~ 3 個月	3個月~1年	1 ~ 5 年	5 年 以 上
<u>非衍生金融負債</u>					
無附息負債	\$ 260,285	\$ 1,234	\$ 4,696	\$ -	\$ -
其他應付款（註 ）	-	16,347	-	-	-
固定利率工具	80,000	50,000	-	-	-
浮動利率工具	-	3,827	11,483	61,240	45,926
租賃負債	95	191	781	1,342	-
	<u>\$ 340,380</u>	<u>\$ 71,599</u>	<u>\$ 16,960</u>	<u>\$ 62,582</u>	<u>\$ 45,926</u>

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	短 於 1 年	1 ~ 5 年
租賃負債	<u>\$ 1,067</u>	<u>\$ 1,342</u>

108 年 12 月 31 日

	要求即付或 短於1個月	1 ~ 3 個月	3個月~1年	1 ~ 5 年	5 年 以 上
非衍生金融負債					
無附息負債	\$ 43,489	\$ 100,067	\$ 59,503	\$ -	\$ -
其他應付款（註 ）	-	13,992	-	-	-
固定利率工具	130,000	-	-	-	-
浮動利率工具	-	13,827	11,483	61,240	61,236
租賃負債	<u>35</u>	<u>71</u>	<u>274</u>	<u>78</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 173,524</u>	<u>\$ 127,957</u>	<u>\$ 71,260</u>	<u>\$ 61,318</u>	<u>\$ 61,236</u>

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	短 於 1 年	1 ~ 5 年
租賃負債	<u>\$ 380</u>	<u>\$ 78</u>

註：其他應付款金額中不包含應付薪資及獎金、應付員工紅利及董監事酬勞等。

上述非衍生金融資產及負債之浮動利率工具金額，將因浮動利率與資產負債表日所估計之利率不同而改變。

(2) 融資額度

	109年12月31日	108年12月31日
無擔保銀行透支額度（ 每年重新檢視）		
— 已動用金額	\$130,000	\$140,000
— 未動用金額	<u>150,000</u>	<u>140,000</u>
	<u>\$280,000</u>	<u>\$280,000</u>
有擔保銀行透支額度		
— 已動用金額	\$122,476	\$137,786
— 未動用金額	<u>92,524</u>	<u>77,214</u>
	<u>\$215,000</u>	<u>\$215,000</u>

二九、關係人交易

除已於其他附註揭露外，本公司與關係人間之交易如下。

(一) 關係人名稱及其關係

<u>關 係 人 名 稱</u>	<u>與 本 公 司 之 關 係</u>
添鴻科技股份有限公司	子 公 司
弘懋光電科技(上海)有限公司	孫 公 司
佳霖科技股份有限公司	子公司(註1)
佳霖電子(上海)有限公司	孫公司(註2)

註1：佳霖科技股份有限公司於108年3月份成為本公司持股100%之子公司。

註2：佳霖電子(上海)有限公司於108年3月份成為本公司間接持股100%之孫公司。

(二) 營業收入

<u>關 係 人 類 別 / 名 稱</u>	<u>109年度</u>	<u>108年度</u>
子公司／孫公司		
佳霖電子(上海)有限公司	\$ 1,002	\$ 765
添鴻科技股份有限公司	314	261
	<u>\$ 1,316</u>	<u>\$ 1,026</u>

對關係人之銷貨與非關係人無重大差異，且均依照本公司之內部控制制度辦理。

(三) 進 貨

<u>關 係 人 類 別 / 名 稱</u>	<u>109年度</u>	<u>108年度</u>
子 公 司		
佳霖科技股份有限公司	<u>\$ 7,286</u>	<u>\$ 3,619</u>

對關係人之進貨與非關係人無重大差異，且均依照本公司之內部控制制度辦理。

(四) 佣金支出

關 係 人 名 稱	109年度	108年度
孫 公 司		
佳霖電子(上海)有限公司	\$ 8,689	\$ 1,379

(五) 應收關係人款項 (不含對關係人放款)

關 係 人 類 別 / 名 稱	109年12月31日	108年12月31日
子 公 司		
佳霖電子(上海)有限公司	\$ 410	\$ 526
添鴻科技股份有限公司	147	70
	<u>\$ 557</u>	<u>\$ 596</u>

本公司對關係人之應收款項與非關係人無重大差異，且均依照本公司之內部控制制度辦理。

流通在外之應收關係人款項未收取保證。109及108年度應收關係人款項並未提列備抵損失。

(六) 應付關係人款項 (不含向關係人借款)

關 係 人 類 別 / 名 稱	109年12月31日	108年12月31日
子 公 司		
佳霖科技股份有限公司	<u>\$ 4,373</u>	<u>\$ 1,629</u>

流通在外之應付關係人款項餘額係未提供擔保。

(七) 其他應付款

關 係 人 類 別 / 名 稱	109年12月31日	108年12月31日
子公司／孫公司		
弘懋光電科技(上海)有限公司	\$ 5,292	\$ 1,157
佳霖科技股份有限公司	-	264
	<u>\$ 5,292</u>	<u>\$ 1,421</u>

(八) 合約負債

關係人類別／名稱	109年12月31日	108年12月31日
子公司		
添鴻科技股份有限公司	<u>\$ 24</u>	<u>\$ 59</u>

(九) 背書保證

關係人類別／名稱	109年12月31日	108年12月31日
子公司		
添鴻科技股份有限公司	\$310,000	\$310,000
太引資訊系統股份有限公司	<u>57,000</u>	<u>20,000</u>
	367,000	330,000
孫公司		
佳霖電子(上海)有限公司	5,000	5,000
添鴻化學科技(上海)有限公司	<u>5,000</u>	<u>-</u>
	<u>\$377,000</u>	<u>\$335,000</u>

(十) 其他關係人交易

1. 孫公司弘懋光電科技(上海)有限公司為本公司提供中國大陸地區之機台銷售進行維修及售後服務，109及108年度認列並支付之相關費用分別為9,694仟元及10,893仟元。
2. 子公司佳霖科技股份有限公司提供本公司勞務服務，108年度認列並支付之勞務費用為2,010仟元。

(十一) 主要管理階層薪酬

	109年度	108年度
短期員工福利	\$ 23,060	\$ 20,136
退職後福利	<u>324</u>	<u>324</u>
	<u>\$ 23,384</u>	<u>\$ 20,460</u>

董事及其他主要管理階層之薪酬係由薪酬委員會依照個人績效及市場趨勢決定。

三十、質抵押之資產

下列資產業經提供為貨物進口之保證金及銀行借款之擔保品：

	109年12月31日	108年12月31日
質押定存單（帳列其他流動資產）	\$ 11,055	\$ 6,489
土地	95,187	95,187
房屋及建築物－淨額	152,701	154,495
	<u>\$258,943</u>	<u>\$256,171</u>

三一、重大或有負債及未認列之合約承諾

(一) 或有事項

或有負債

本公司因子公司及孫公司而發生之或有負債如下：

	109年12月31日	108年12月31日
對子公司及孫公司借款提供財務保證		
－保證金額	\$377,000	\$335,000
－實際動支金額	118,133	118,010

三二、具重大影響之外幣資產及負債資訊

以下資訊係按本公司功能性貨幣以外之外幣彙總表達，所揭露之匯率係指該等外幣換算至功能性貨幣之匯率。具重大影響之外幣資產及負債如下：

109 年 12 月 31 日

外幣資產	外幣匯率	帳面金額
<u>貨幣性項目</u>		
美元	\$ 20,035	28.48
日圓	268,968	0.28
		<u>\$ 645,908</u>
<u>外幣負債</u>		
<u>貨幣性項目</u>		
美元	211	28.46
日圓	48,501	0.28
		<u>\$ 19,585</u>

108 年 12 月 31 日

外 幣 資 產		外 幣	匯 率	帳 面 金 額
貨幣性項目				
美 元		\$ 10,424	29.98	\$ 312,520
日 圓		49,325	0.28	<u>13,614</u>
				<u>\$ 326,134</u>
外 幣 負 債				
貨幣性項目				
美 元		130	30.01	\$ 3,901
日 圓		43,120	0.28	<u>11,901</u>
				<u>\$ 15,802</u>

具重大影響之外幣兌換（損）益（未實現）如下：

		109年度		108年度			
外	幣	匯	率	淨兌換（損）益	匯	率	淨兌換（損）益
		29.55（美元：新台幣）		（\$ 19,493）	30.91（美元：新台幣）		（\$ 2,492）
美	元						
		0.277（日幣：新台幣）		（ <u>102</u> ）	0.284（日幣：新台幣）		<u>560</u>
日	圓						
				（\$ 19,595）			（\$ 1,932）

三三、附註揭露事項

（一）重大交易事項相關資訊：

1. 資金貸與他人：無。
2. 為他人背書保證：附表一。
3. 期末持有有價證券情形（不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分）：附表二。
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新臺幣 3 億元或實收資本額 20%以上：附表三。
5. 取得不動產之金額達新臺幣 3 億元或實收資本額 20%以上：無。
6. 處分不動產之金額達新臺幣 3 億元或實收資本額 20%以上：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新臺幣 1 億元或實收資本額 20%以上：無。
8. 應收關係人款項達新臺幣 1 億元或實收資本額 20%以上：無。
9. 從事衍生工具交易：無。

(二) 轉投資事業相關資訊：附表四。

(三) 大陸投資資訊：

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、本期損益及認列之投資損益、期末投資帳面金額、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額：附表五。
2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項，及其價格、付款條件、未實現損益：無。
 - (1) 進貨金額及百分比與相關應付款項之期末餘額及百分比。
 - (2) 銷貨金額及百分比與相關應收款項之期末餘額及百分比。
 - (3) 財產交易金額及其所產生之損益數額。
 - (4) 票據背書保證或提供擔保品之期末餘額及其目的。
 - (5) 資金融通之最高餘額、期末餘額、利率區間及當期利息總額。
 - (6) 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項，如勞務之提供或收受等。

(四) 主要股東資訊：股權比例達 5% 以上之股東名稱、持股數額及比例。

(附表六)

弘塑科技股份有限公司

為他人背書保證

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表一

單位：除另註明外，
為新台幣仟元

編號	背書保證者 公司名稱	被背書保證對象		對單一企業 背書保證 限額（註 1）	本期最高背書 保證餘額	期末背書 保證餘額	實際動支金額	以財產擔保之 背書保證金額	累計背書保證 金額佔最近期 財務報表淨值 之比率（%）	背書保證 最高限額 （註 2）	屬母公司對子 公司背書保證	屬子公司對母 公司背書保證	屬對大陸地區 背書保證	備註
		公司名稱	關係											
0	弘塑科技股份有限 公司	添鴻科技股份有限 公司	本公司之 子公司	\$ 581,110	\$ 310,000	\$ 310,000	\$ 80,000	\$ -	10.67	\$ 1,162,220	是	—	—	—
0	弘塑科技股份有限 公司	佳霖電子（上海） 有限公司	本公司之 子公司	581,110	5,000	5,000	-	-	0.17	1,162,220	是	—	是	—
0	弘塑科技股份有限 公司	添鴻化學科技（上 海）有限公司	本公司之 子公司	581,110	5,000	5,000	-	-	0.17	1,162,220	是	—	是	—
0	弘塑科技股份有限 公司	太引資訊系統股份 有限公司	本公司之 子公司	581,110	57,000	57,000	38,133	-	1.96	1,162,220	是	—	—	—

註 1：對單一企業背書保證限額係不超過最近一期經會計師核閱或查核財務報表所載淨值之百分之二十。

註 2：背書保證最高限額係不超過最近一期經會計師核閱或查核財務報表所載淨值之百分之四十。

弘塑科技股份有限公司
 期末持有有價證券情形
 民國 109 年 12 月 31 日

附表二

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元及股數仟股

持 有 之 公 司	有 價 證 券 種 類 及 名 稱	與 有 價 證 券 發 行 人 之 關 係	帳 列 科 目	期 末				備 註
				股 數	帳 面 金 額	持 股 比 例	公 允 價 值	
弘塑科技股份有限公司	股 票 TAZMO CO., LTD.	無	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產－非流動	1,000	\$ 386,820	7.4%	\$ 386,820	
	Silicon Valley X-Ray, Inc.	無	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產－非流動	7,398	120,150	11%	120,150	
	Silicon Valley X-Ray Inc.	無	按攤銷後成本衡量之金融資產 －流動	-	28,555	-	28,555	

註 1：本表所稱有價證券，係指屬國際會計準則第 39 號「金融工具：認列與衡量」範圍內之股票、債券、受益憑證及上述項目所衍生之有價證券。

弘塑科技股份有限公司及子公司

累積買進或賣出同一有價證券之金額達新臺幣 3 億元或實收資本額 20%以上

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表三

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元及股數仟股

買、賣之公司	有價證券 種類及名稱 (註 1)	帳列科目	交易對象 (註 2)	關係 (註 2)	期初買入 (註 3)		賣出 (註 3)		期末	
					股數	金額	股數	金額	股數	金額
弘塑科技股份有限公司	股票 TAZMO CO., LTD.	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之金融資產－非 流動	無	無	1,200	\$ 488,520	-	\$ -	200	\$ 78,784
									\$ 18,209	\$ 60,575
									1,000	\$ 386,820

註 1：本表所稱有價證券，係指股票、債券、受益憑證及上述項目所衍生之有價證券。

註 2：有價證券帳列採用權益法之投資者，須填寫該二欄，餘得免填。

註 3：累計買進、賣出金額應按市價分開計算是否達 3 億元或實收資本額 20%。

註 4：實收資本額係指母公司之實收資本額。發行人股票無面額或每股面額非屬新臺幣 10 元者，有關實收資本額 20%之交易金額規定，以資產負債表歸屬於母公司業主之權益 10%計算之。

弘塑科技股份有限公司
被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊
民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表四

單位：除另予註明者外，為新台幣
仟元及股數仟股

投 資 公 司 名 稱	被 投 資 公 司 名 稱	所 在 地 區	主 要 營 業 項 目	原 始 投 資 金 額		期 末 持 有			被 投 資 公 司 本 期 損 益	本 期 認 列 之 投 資 損 益	備 註
				本 期 期 末	去 年 年 底	股 數	比 率	帳 面 金 額			
弘塑科技股份有限公司	GRAND PLASTIC TECHNOLOGY LIMITED	香 港	投資業務	\$ 19,470	\$ 19,470	600	100%	\$ 17,470	(\$ 1,487)	(\$ 1,487)	
	添鴻科技股份有限公司	台 灣	化學原料製造及銷售	513,956	513,956	10,000	100%	764,767	179,862	166,952	註 3
	AQUA TALENT CO., LTD.	塞 席 爾	投資業務	17,838	17,838	350	100%	30,228	12,056	12,056	
	太引資訊系統股份有限公司	台 灣	軟體銷售及安裝	160,783	160,783	2,831	78.1%	132,571	2,216	(5,461)	註 3
	佳霖科技股份有限公司	台 灣	半導體及電子設備銷售代理	534,796	534,796	20,000	100%	479,173	70,988	57,847	註 3
GRAND PLASTIC TECHNOLOGY LIMITED	弘懋光電科技(上海)有限公司	上 海	經營半導體機台買賣及維修	16,210	16,210	(註 1)	100%	15,010	(1,445)	(1,445)	註 2
AQUA TALENT CO., LTD.	添鴻化學科技(上海)有限公司	上 海	化學原料製造及銷售	USD 300	USD 300	(註 1)	100%	28,095	12,076	12,076	註 2
太引資訊系統股份有限公司	太引信息科技(南京)有限公司	南 京	軟體銷售及安裝	USD 74	USD 74	(註 1)	100%	148	(1,477)	(1,477)	註 2
佳霖科技股份有限公司	Challenge Tech. Corp.	薩 摩 亞	投資業務	\$ 19,069	\$ 19,069	1,000	100%	25,641	13,336	13,336	
Challenge Tech. Corp.	佳霖電子(上海)有限公司	上 海	半導體及電子設備銷售代理	USD 600	USD 600	(註 1)	100%	25,181	13,393	13,393	註 2

註 1：係有限公司無股數。

註 2：大陸被投資公司相關資訊請參閱附表五。

註 3：含企業合併產生之無形資產攤銷數。

弘塑科技股份有限公司

大陸投資資訊

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表五

單位：除另予註明者外，
為新台幣仟元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面金額	截至本期止已匯回投資收益	備註
					匯出	收回							
弘懋光電（上海）有限公司	經營半導體機台買賣及維修	\$ 16,210 （美金 500 仟元）	GRAND PLASTIC TECHNOLOGY LIMITED(2)	\$ 16,210 （美金 500 仟元）	\$ -	\$ -	\$ 16,210 （美金 500 仟元）	（\$ 1,445）	100%	（\$ 1,445）	\$ 15,010	\$ -	
添鴻化學科技（上海）有限公司	化學原料製造及銷售	8,927 （美金 300 仟元）	AQUA TALENT CO LTD(2)	26,587 （美金 870 仟元）	-	-	26,587 （美金 870 仟元）	12,076	100%	12,076	28,095	-	
太引信息科技（南京）有限公司	軟體銷售及安裝	2,254 （美金 74 仟元）	太引資訊系統股份有限公司(1)	2,254 （美金 74 仟元）	-	-	2,254 （美金 74 仟元）	（ 1,477）	78.1%	（ 1,154）	148	-	
佳霖電子（上海）有限公司	半導體及電子設備銷售代理	24,393 （美金 600 仟元）	Challenge Tech. Corp. (2)	24,393 （美金 600 仟元）	-	-	24,393 （美金 600 仟元）	13,393	100%	13,393	25,181	-	

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投資審會依 經濟部投資限額(註2)
\$69,444 (美金 2,044 仟元)	\$69,444 (美金 2,044 仟元)
	\$1,743,331

註 1：投資方式區分為下列三種，標示種類別即可：

- (1)直接赴大陸地區從事投資。
- (2)透過第三地區公司再投資大陸（請註明該第三地區之投資公司）。
- (3)其他方式。

註 2：本公司對大陸投資累積達會計師核閱或查核財務報表所載淨值之百分之六十。

弘塑科技股份有限公司

主要股東資訊

民國 109 年 12 月 31 日

附表六

主 要 股 東 名 稱	股 份	
	持 有 股 數	持 股 比 例
張 鴻 泰	5,907,338	20.21%
定睿投資股份有限公司	2,038,819	6.97%
群呈科技股份有限公司	1,662,351	5.68%
富邦人壽保險股份有限公司	1,595,000	5.45%

註 1：本表主要股東資訊係由集保公司以當季季底最後一個營業日，計算股東持有公司已完成無實體登錄交付（含庫藏股）之普通股及特別股合計達 5%以上資料。本公司合併財務報告所記載股本與實際已完成無實體登錄交付股數，可能因編製計算基礎不同或有差異。

註 2：上開資料如屬股東將持股交付信託，係以受託人開立信託專戶之委託人個別分戶揭示。至於股東依據證券交易法令辦理持股超過 10%之內部人股權申報，其持股包括本人持股加計其交付信託且對信託財產具有運用決定權股份等，有關內部人股權申報資料請參閱公開資訊觀測站。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

(一)最近二年度財務狀況比較分析：

單位：新台幣仟元

項 目	年度	109 年度	108 年度	差異	
				金額	%
流動資產		3,344,107	2,658,926	685,181	25.77
非流動資產		2,099,236	2,241,031	(141,795)	(6.33)
流動負債		2,092,461	1,667,898	424,563	25.45
非流動負債		413,127	452,355	(39,228)	(8.67)
歸屬於母公司業主之權益		2,905,551	2,745,917	159,634	5.81
茲就各科目前後期變動達百分之二十，且變動金額達新台幣 10,000 仟元，增減變動之主要原因及其影響及未來因應計畫，說明如下：					
變動說明：					
1.流動資產：					
主係因按攤銷後成本衡量之金融資產-流動、應收帳款淨額、存貨及預付款項增加所致。					
2.流動負債：					
主係因合約負債、應付帳款、本期所得稅負債增加所致。					

二、財務績效：

(一)最近二年度經營結果分析：

單位：新台幣仟元

項目	年度	109 年度	108 年度	增(減)金額	變動比例(%)	變動分析
銷貨收入		2,487,671	2,061,387	426,284	20.68	1、2
營業成本		1,361,351	1,112,690	248,661	22.35	1、2
營業毛利		1,126,320	948,697	177,623	18.72	1、2
營業費用		593,200	533,899	59,301	11.11	1、2
營業淨利		533,120	414,798	118,322	28.53	1、2
營業外收入及支出		(23,083)	(10,743)	(12,340)	(114.87)	3
繼續營業單位稅前淨利		510,037	404,055	105,982	26.23	1、2
所得稅費用		112,679	91,299	21,380	23.42	1、2
本期淨利-母公司業主		396,873	309,970	86,903	28.04	1、2
其他綜合損益		(8,628)	175,885	(184,513)	(104.91)	4
變動原因說明：						
1.係因 108 年 3 月公司以股份轉換並發行新股方式取得佳霖科技股份有限公司 100%股權。						
2.係因 109 年度營收增加 426,284 仟元，營業成本增加 248,661 仟元使營業毛利增加 177,623 仟元所致。						
3.係因 109 年度處分不動產、淨外幣兌換利益、及財務成本增減所致。						
4.係因 109 年度，透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現						

項目 \ 年度	109 年度	108 年度	增(減)金額	變動比例(%)	變動分析
評價損益減少	240,638 仟元				國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加 3,048 仟元，確定福利之精算增加 4,947 仟元及可能重分類至損益之項目相關之所得稅增加 48,130 仟元所致。

(二)預期銷售數量與其依據：

因本公司未編列一一〇年度財務預測，故不予以預測營業額。整體而言係依據產業環境、客戶產品與產能需求、市場供需、競爭狀況而定。

(三)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

公司隨著業務的成長，經營規模穩定提升但不盲目擴張產能，財務方面目前帳上可供運用資金尚稱充足，並持續與往來銀行維持穩定合作關係，使公司體質更為健全。

三、現金流量：

(一)最近年度現金流量變動情形分析：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	109 年度	108 年度	增（減）變動	
			金額	%
營業活動之淨現金流入	616,481	334,662	281,819	84.21
投資活動之淨現金流入(出)	(415,552)	163,855	(579,407)	(353.61)
籌資活動之淨現金流(出)	(295,840)	(283,573)	(12,267)	4.33
現金及約當現金增加(減少)數	(96,796)	207,146	(303,942)	(146.73)
增減比例變動分析說明：				
1.營業活動之淨現金流入增加：主係因本期稅前淨利增加 105,982 仟元，收益費損項目減少 7,054 仟元，與營運資產及負債之淨變動數增加 227,412 仟元，收取之利息減少 2,311 仟元，支付之利息減少 2,044 仟元，支付之所得稅增加 44,254 仟元，使得營業活動資金變動所致。				
2.投資活動之淨現金流入轉為流出：主係因取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產現金流出增加 29,960 仟元，出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產現金流入增加 78,784 仟元，取得按攤銷後成本衡量之金融資產現金流出增加 437,755 仟元，處分按攤銷後成本衡量之金融資產現金流入減少 60,706 仟元，對子公司之收購現金流入減少 116,280 仟元，購置不動產、廠房現金流出增加 12,134 仟元，購置無形資產現金流出增加 964 仟元，收取其他股利流入減少 826 仟元、處分不動產、廠房及設備價款現金流入減少 17 仟元及存出保證金現金流入增加 451 仟元所致。				
3.籌資活動之淨現金流出增加：主係因短期借款現金流出增加 38,020 仟元，舉借長期借款現金流入增加 30,380 仟元及償還長期借款現金流出增加 5,865 仟元，租賃負債本金償還現金流出增加 190 仟元，支付非控制權益現金股利流出減少 1,428 仟元所致。				

(二)流動性不足之改善計畫：

本公司因業績成長，營業活動現金流量為正數，足以因應營運所需，尚無資金流動性不足之情況。本公司與銀行關係向來良好，未來若有流動性不足情況時，將以中短期融資計畫因應之。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	110 年度預計淨現金流量(預估數)			預計期末現金餘額 (預估數)
	營業活動	投資活動	籌資活動	
869,085	757,591	(353,499)	(354,833)	918,344
1.未來一年現金流量變動情形分析：				
(1)營業活動：係因 110 年度訂單成長使其營業活動淨現金增加所致。				
(2)投資活動：係因 110 年度購置無形資產及不動產、廠房及設備；取得及處分按攤銷後成本衡量之金融資產所致。				
(3)籌資活動：係因 110 年度發放現金股利及償還長期借款所致。				
2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。				

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

(一)最近年度轉投資政策：

本公司對於轉投資事業之業務管理政策係依據內部控制制度之「投資循環」、「子公司營運管理辦法」及「取得或處分資產處理程序」，作為轉投資事業經營管理之依循規範。各轉投資事業並依規定定期提供其財務資料予本公司，使本公司能及時了解其財務或業務狀況。另本公司內部稽核單位亦不定期查核各轉投資事業之營運狀況及內部控執行情形，並於董事會報告其結果，協助經營階層與董事會了解轉投資事業經營之狀況。

(二)最近年度獲利或虧損之主要原因、改善計畫：

單位：新台幣仟元

轉投資事業	投資金額	關係	獲利或虧損之主要原因	109 年度投資(損)益	改善計畫
Grand Plastic Technology Limited	19,470	本公司持股 100% 之子公司	109 年度營業淨損	(1,487)	不適用
添鴻科技(股)公司	513,956	本公司持股 100% 之子公司	109 年度營業淨利	166,952	不適用
AQUA TALENT CO., LTD.	17,838	本公司持股 100% 之子公司	109 年度營業淨利	12,056	不適用
太引資訊系統(股)公司	160,783	本公司持股 78.1% 之子公司	109 年度無形資產攤銷數	(5,461)	不適用

轉投資事業	投資金額	關係	獲利或虧損之主要原因	109 年度投資(損)益	改善計畫
佳霖科技(股)公司	534,796	本公司持股 100% 之子公司	109 年度營業淨利	57,847	不適用

(三)未來一年投資計劃：無。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣仟元

項目	109 年度(註 1)		110 年度截至 3 月 31 日止(註 2)	
	金額	佔稅前純益比率	金額	佔稅前純益比率
利息收入	6,168	1.21%	註 2	註 2
利息支出	5,880	1.15%	註 2	註 2
淨匯兌利益(損失)	(27,528)	(5.40%)	註 2	註 2

註 1：會計師查核簽證之財務報告。

註 2：截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成，故暫不列示。

1.利率變動：

本公司近兩年度利息支出甚低，故利率變動對本公司影響尚屬有限。此外，本公司 109 年底帳上「現金及約當現金」及「按攤銷後成本衡量之金融資產—流動」分別為 869,085 仟元及 765,235 仟元，因此於資金運用上尚屬寬裕，故利率變動對本公司損益之影響並不大。截至年報刊印日止，110 年度第一季財務報告尚未經會計師核閱完成。

本公司亦隨時注意利率變動情形，採取必要因應措施，以降低利率變化對本公司損益產生影響。

2.匯率變動：

本公司進貨廠商及銷貨客戶以國內居多，除 106 年度外，近年淨兌換利益(損失)甚低，匯率變動對本公司之營收及獲利均無太大影響。106 年度匯損較高，係肇因於美金匯率波動較劇，屬於特殊情形，且 107 年匯率回穩，帳上已有淨兌換利益。本公司在外幣資金管理上採穩健保守原則，盡力規避匯率變動所可能造成之不利影響，本公司財務人員也隨時與銀行保持密切聯繫，並蒐集匯率相關資訊，以期充分掌握匯率走勢。

3.通貨膨脹：

本公司並無因受通貨膨脹而有重大影響之情形，且本公司對客戶及供應商之報價，以市場之機動調整者居多，故對本公司損益影響有限。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司一向秉持專注本業及務實原則經營事業，財務政策以穩健保守

為原則，並無從事高風險、高槓桿之投資，另本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無從事資金貸與他人、對子公司以外之人背書保證及衍生性金融商品交易之情事。

本公司未來將以專注本業經營為主，有關資金貸與他人、背書保證及衍生性金融商品交易之政策，未來將以符合本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業辦法」及「從事衍生性金融商品交易處理程序」相關辦法規定，並考量財務業務需要辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

- 1.本公司秉持提供客戶客製化及高品質之產品為原則，109 及 110 年度主要目標仍以持續改善原有之 Wet Bench 與 Single Wafer Spin processor(UFO)等設備產品為主。隨著 3D IC 構裝技術之發展，未來將發展功能達到與國外無電鍍鎳金設備商相同水準之 3D IC 無電鍍金屬化製程設備；因應客戶新製程所需，製程設備需要新應用研發，並與客戶共同開發新製程機台、化學品及關鍵零組件等，例如：Square Fanout UBM Etcher、Square Fanout RP Stripper、UFO 300 4CH Al/Ti UBM Etchin，朝向產品多元化發展。

本公司針對後段封裝在未來趨勢與公司產品發展方向如下：

- (1)3D 封裝：除原已成熟之設備外，本公司最有可能有競爭力之新設備為 Via Clean 及化鍍。Via Clean 主要以 Single Wafer tool 搭配特殊化學配方。化學鍍膜設備則必須與鍍液廠商作聯盟，目前公司與外商公司及子公司添鴻科技合作，就化鍍液特性，進行機台設計開發。設計之關鍵在於溫度之均勻與穩定性及化鍍液之管理。
- (2)Fine Pitch Bump：後段封裝在極小元件尺度之挑戰上，主要在於凸塊間距變小，其挑戰為乾膜 Residue(殘餘物)。必須配合 Strip Chemical 廠商，針對化學品特性持續作機構設計變化。
- (3)Lead free(無鉛製程)：主要挑戰在於 Stripper 配方的變化導致乾膜 Residue(殘餘物)及銅氧化。設備之設計必須以不同概念發展新的機構因應。
- (4)Thin Wafer 薄片(厚度小於 6mil)：3D IC 堆疊必然須將晶圓磨薄，薄化後晶圓厚度可小於 6mil，其 warpage 可大於 2mm。晶圓傳送操作及製程處理必然是機構設計者挑戰。

目前公司開發之 3D IC 金屬化鍍製程設備尚未出售，仍在開發中。就開發進度而言，屬與客戶共同製程開發階段。雖然近年曾出貨至客戶端數台 Ni, Pt, Au 化鍍設備，但該設備屬平面化鍍製程，非 Via 化鍍。金屬化鍍製程在 3D 製程中是否為必須，且可被應用之製程，尚待驗證。但本製程尚有其它應用，如 LED Package、CMOS Sensor Package，故仍值得持續投入資源。

- 2.本公司 110 年度預計投入之研發費用為 178,515 仟元。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司日常營運均遵循國內外相關法令辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法令變動情形，以隨時調整營運策略。最近年度及截至年報刊

印日止並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務及業務之情事。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司為國內專業半導體設備製造商，所生產之產品除已取得多項專利保障外，並獲得國內半導體、封測大廠之高度評價與認同，足見本公司之研發實力與因應科技改變及產業變化之能力。未來本公司仍將持續增加研發投入外，並密切掌握市場之趨勢與脈動，以順應相關產業之演變與變化，故科技改變與產業變化對本公司財務業務尚不致產生重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持專業、誠信之永續經營原則，並重視企業形象和風險控管，最近年度及截至年報刊印日止並無企業形象改變造成企業危機管理之情事。惟企業危機一旦發生即可能對企業產生相當之損害，故本公司將持續遵守盡力落實各項公司治理要求，適時請相關專家提供諮詢意見並遵從之，以降低該等風險之發生及該等風險對於本公司財務業務之影響力。

(七)進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止尚無新的併購計畫，未來若從事相關計畫之評估及執行時，亦將依相關法令及本公司內部各項管理辦法辦理，以保障原有股東權益及落實資訊公開程序。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：

本公司因業務量漸漸擴增，為因應本公司營運規模成長之需求，已於 99 年自購土地，並於 100~101 年興建廠房，子公司添鴻科技規劃於 105 年購地自建廠房並已於 105 年第一季實施，並已於 107 年第一季遷廠完成，對本公司未來的營運規劃及發展具有正面的效益。本公司之自地建廠計畫，將評估自有資金動向，如自有資金不足時，則以銀行中長期借款支應，並將持續注意利率走勢並定期評估，據以訂定適當的融資政策以因應建廠資本支出需求。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.進貨集中風險：

本公司與各供應商間往來行之有年，除維持良好之合作關係外，供貨來源尚屬穩定，且未有供貨短缺或中斷致影響生產作業之情事。本公司除與主要供應商維持穩定之合作關係外，並持續進行各種相關可行性評估，考量品質、產品良率、交期及供貨穩定性等條件，積極尋找新供應廠商，以避免產生進貨集中之風險。

2.銷貨集中風險：

本公司主要銷售對象為國內半導體、封測製造業者等均為知名上市櫃公司，然設備廠產業特性所造成之系統風險，實為發展過程難以避免之問題。本公司將盡力維持現有良好客戶關係並積極開發新產品及拓展新客戶，分散產品結構，以擴展不同產品別客戶及訂單，避免銷貨集中之市場風險。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，於最近年度及截至年報刊印日止，尚無股權之大量移轉或更換情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司經營團隊均致力於公司之永續發展，最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變之情事。

(十二)公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：訴訟案件對股東權益或證券價格並無重大影響，故不適用。

(十三)其他重要風險及因應措施：

1.各月營收認列波動較大：

本公司為設備製造商，設備生產期間約 3 至 6 個月、單筆訂單金額大，加上本公司待客戶驗收完畢後一次全額認列銷貨收入，從在製品至製成品完工生產期間約需 3 至 6 個月，客戶驗收完工約 3 至 6 個月，合計營業週期約為 8 至 12 個月，若當月無設備完成驗收，其營收來源僅維修服務及材料買賣之業務，故每月營收及短期累積營收變動起伏較大。

因應措施：無。

2.資訊安全對公司之風險及影響：

資訊安全經公司評估後係屬營運風險之一環，對本公司影響為一般。

因應措施：

(1)本公司設有資訊部門及配置適當人數之專責資訊人員。

(2)本公司每年均經會計師事務所查核資訊環境、帳號控管、軟硬體配置、防毒軟體、防火牆、ERP 系統...等，評核結果為適切。

(3)本公司訂有各類資訊安全管理辦法，並不定期向所有同仁宣導資安重要性。

七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一)關係企業合併營業報告書：請參閱第 227~232 頁。

(二)關係企業合併財務報告：

1.關係企業合併財務報告聲明書：請參閱第 90 頁。

2.關係企業合併財務報告會計師查核報告：請參閱本年報：陸、財務概況-四、最近年度財務報告，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及附註或附表。

(三)關係企業報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由及自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形及計畫執行進度：不適用。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

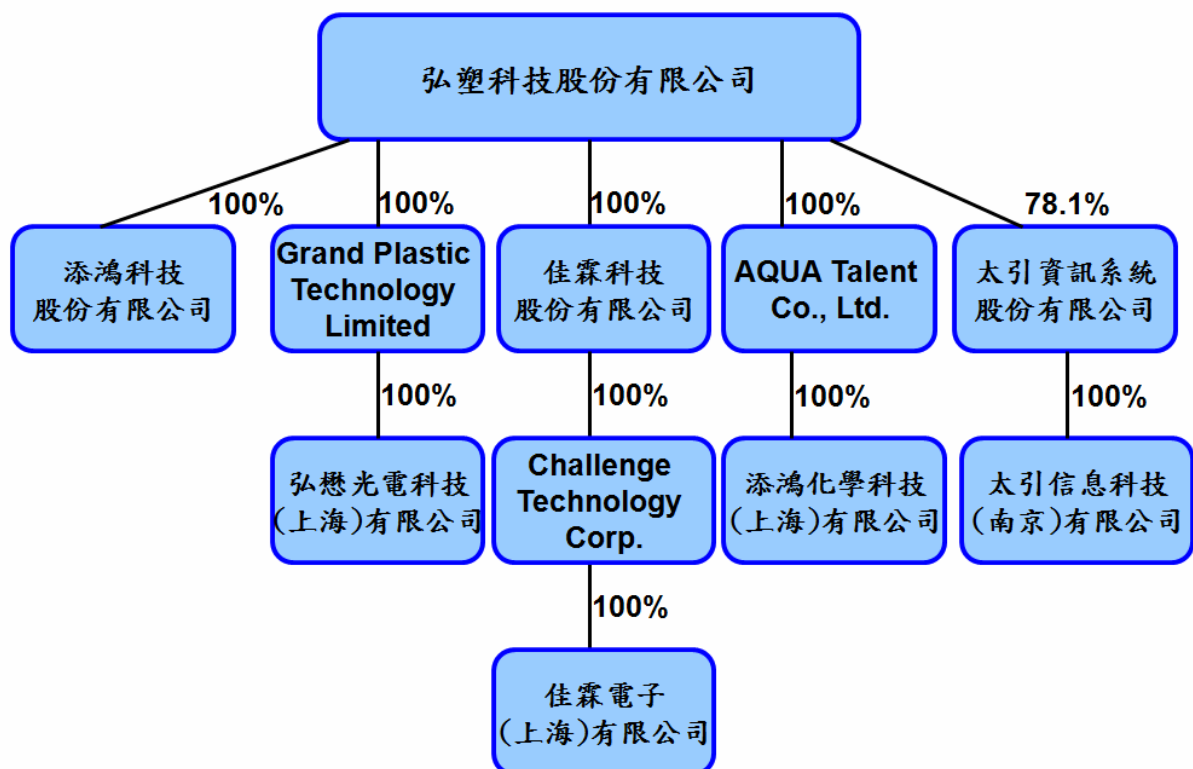
玖、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

弘塑科技股份有限公司
關係企業合併營業報告書
民國一〇九年度

一、關係企業概況

(一)關係企業組織圖



(二)各關係企業基本資料

109 年 12 月 31 日

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實收資本額	主要營業項目
<u>控制公司</u> ： 弘塑科技股份有限公司	82.05.07	30095 新竹市香山區 中華路六段 89 號	新台幣 292,160 仟元	半導體及積體電路製造 設備之工程承包、製造、 買賣及維修工程；半導體 相關之機械安裝、電子零 組件製造。
<u>從屬公司</u> ： Grand Plastic Technology Limited	97.05.16	香港中環租庇利街 1 號喜訊大廈 706 室	美金 600 仟元	一般性投資。
弘懋光電科技 (上海)有限公司	97.11.27	中國（上海）自由貿 易試驗區盛夏路 169 號、張東路 1658 號 1 幢 4 層 409 室	美金 500 仟元	半導體光電工程技術產 品及相關零部件和軟體 的安裝維護及相關技術 諮詢服務、設備及零件、 軟體批發進出口與代理。
添鴻科技股份有限 公司	91.11.06	新竹縣湖口鄉光復 路 4-2 號	新台幣 100,000 仟元	工業級、試藥級、電子級 混酸（蝕刻液）、電鑄藥 液、工業級及電子級化學 品代客分裝暨各類膠製 造與開發買賣等。
AQUA Talent Co., Ltd.	97.06.16	No.24, Lesperance Complex, Providence Industrial Estate, Mahe, Seychelles	美金 350 仟元	一般性投資。
添鴻化學科技 (上海)有限公司	98.05.07	上海市金山區漕涇 鎮平業路 66 號	美金 300 仟元	化學原料製造及銷售等。
太引資訊系統股份 有限公司	91.05.08	新竹市東區博愛街 88 號	新台幣 36,250 仟元	軟體銷售及安裝等。
太引信息科技 (南京)有限公司	106.02.15	南京市麒麟科技創 新園智匯路 300 號-B 單元二樓	美金 74 仟元	軟體銷售及安裝等。
佳霖科技股份有限 公司	76.09.07	新竹縣竹北市泰和 里泰和路 21 號	新台幣 200,000 仟元	測試儀器設備及零件、分 析實驗儀器設備及零件 、工業用儀器設備零件... 等組合加工買賣業務、進 出口貿易及售後維修等。
Challenge Technology Corp.	92.01.12	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	美金 600 仟元	一般性投資。
佳霖電子(上海)有 限公司	93.03.10	中國（上海）自由貿 易試驗區盛夏路 169 號 1 幢 503 室	美金 600 仟元	同佳霖科技業務，為其在 中國大陸之據點。

(三)推定為有控制與從屬關係者，其相同股東資料：無。

(四)營業關係說明：

公司名稱	集團之職務分工	主要營業項目
弘塑科技股份有限公司	1.集團之營運總部。 2.新產品應用領域之研發與設計。 3.統籌集團之財務、業務之運作。 4.負責台灣及海外客戶之銷售業務。	半導體及積體電路製造設備之工程承包、製造、買賣及維修工程；半導體相關之機械安裝、電子零組件製造。
Grand Plastic Technology Limited	母公司 100%持有之子公司，負責轉投資海外設立子公司事宜。	投資控股。
弘懋光電科技(上海)有限公司	位於中國大陸華東地區，主要負責出售給大陸客戶機台的安裝維護、維修及相關技術諮詢服務。	半導體光電工程技術產品及相關零部件和軟體的安裝維護及相關技術諮詢服務、設備及零件、軟體批發進出口與代理。
添鴻科技股份有限公司	母公司 100%持有之子公司，主要產品為工業級化學蝕刻液。	工業級、試藥級、電子級混酸（蝕刻液）、電鑄藥液、工業級及電子級化學品代客分裝暨各類膠製造與開發買賣等。
AQUA Talent Co., Ltd.	母公司 100%持有之子公司，負責轉投資海外設立子公司事宜。	投資控股。
添鴻化學科技(上海)有限公司	位於中國大陸華東地區，主要負責出售給大陸客戶工業級化學蝕刻液。	化學原料製造及銷售等。
太引資訊系統股份有限公司	母公司持股 78.1%之子公司，主要產品為軟體銷售及安裝等。	軟體銷售及安裝等。
太引信息科技(南京)有限公司	太引資訊 100%持有之子公司，位於中國大陸南京，主要負責大陸客戶的軟體銷售及安裝等。	軟體銷售及安裝等。
佳霖科技股份有限公司	母公司 100%持有之子公司，主要業務為設備、零組件等產品之買賣、代理、售後服務等。	測試儀器設備及零件、分析實驗儀器設備及零件、工業用儀器設備零件...等組合加工買賣業務、進出口貿易及售後維修等。
Challenge Technology Corp.	母公司 100%持有之子公司，負責轉投資海外設立子公司事宜。	投資控股。
佳霖電子(上海)有限公司	位於中國大陸華東地區，主要支援佳霖科技業務，為其在中國大陸之據點。	同佳霖科技業務，為其在中國大陸之據點。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

109 年 12 月 31 日

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Grand Plastic Technology Limited	董事長	弘塑科技股份有限公司代表人：張鴻泰	600,000 股	100.00%
弘懋光電科技(上海)有限公司	董事長 董 事 董 事	弘塑科技股份有限公司代表人：石本立 弘塑科技股份有限公司代表人：黃富源 弘塑科技股份有限公司代表人：詹仕戎	不適用	由 Grand Plastic Technology Limited 持股 100.00%
添鴻科技股份有限公司	董事長 董 事 董 事 董 事 董 事 監察人 總經理	弘塑科技股份有限公司代表人：石本立 弘塑科技股份有限公司代表人：鍾時俊 弘塑科技股份有限公司代表人：林思閏 弘塑科技股份有限公司代表人：詹仕戎 弘塑科技股份有限公司代表人：黃富源 弘塑科技股份有限公司代表人：曾繁斌 鍾時俊	10,000,000 股	100.00%
AQUA Talent Co., Ltd.	董事長	弘塑科技股份有限公司代表人：張鴻泰	350,000 股	100.00%
添鴻化學科技(上海)有限公司	董事長 監 事	弘塑科技股份有限公司代表人：鍾時俊 弘塑科技股份有限公司代表人：林思閏	不適用	由 AQUA Talent Co., Ltd. 持股 100.00%
太引資訊系統股份有限公司	董事長 董 事 董 事 監察人 總經理	弘塑科技股份有限公司代表人：石本立 弘塑科技股份有限公司代表人：周沁怡 雲勉投資有限公司代表人：邱康勉 曾繁斌 周沁怡	2,831,000 股	78.10%
太引信息科技(南京)有限公司	董事長 監 事	太引資訊系統(股)公司代表人：周沁怡 太引資訊系統(股)公司代表人：李瑞欽	不適用	由太引資訊系統持股 100.00%
佳霖科技股份有限公司	董事長 董 事 董 事 董 事 董 事 監察人 總經理	弘塑科技股份有限公司代表人：張鴻泰 弘塑科技股份有限公司代表人：石本立 弘塑科技股份有限公司代表人：張竣傑 弘塑科技股份有限公司代表人：馮啟昌 弘塑科技股份有限公司代表人：楊銘和 弘塑科技股份有限公司代表人：曾繁斌 馮啟昌	20,000,000 股	100.00%
Challenge Technology Corp.	董事長	佳霖科技股份有限公司代表人：張鴻泰	600,000 股	由佳霖科技持股 100.00%
佳霖電子(上海)有限公司	董事長 董 事 董 事 監察人	佳霖科技股份有限公司代表人：石本立 佳霖科技股份有限公司代表人：張泰山 佳霖科技股份有限公司代表人：馮啟昌 佳霖科技股份有限公司代表人：蔡素滿	不適用	由 Challenge Technology Corp. 持股 100.00%

(六)各關係企業營運概況

109 年 12 月 31 日

單位：除特別標示者外為新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總值	淨值	營業 收入	營業 利益	本期 損益 (稅後)	每股盈 餘(元) (稅後)
Grand Plastic Technology Limited	美金 600 仟元	17,470	0	17,470	0	(44)	(1,487)	(2.48)
弘懋光電科技 (上海)有限公司	美金 500 仟元	18,950	3,940	15,010	9,075	(1,074)	(1,445)	不適用
添鴻科技股份有限 公司	100,000	994,121	495,231	498,890	646,814	236,052	179,862	17.99
AQUA Talent Co., Ltd.	美金 350 仟元	29,286	0	29,286	0	(21)	12,056	34.45
添鴻化學科技 (上海)有限公司	美金 300 仟元	53,774	25,679	28,095	70,657	13,050	12,076	不適用
太引資訊系統股份 有限公司	36,250	116,130	60,379	55,751	52,763	4,955	2,216	0.61
太引信息科技 (南京)有限公司	美金 74 仟 元	13,030	12,881	149	16,735	(1,524)	(1,477)	不適用
佳霖科技股份有限 公司	200,000	961,004	300,196	660,808	506,741	62,629	70,988	3.55
Challenge Technology Corp.	美金 600 仟元	25,641	0	25,641	0	(34)	13,336	22.23
佳霖電子(上海)有 限公司	美金 600 仟元	39,988	14,807	25,181	53,581	14,641	13,393	不適用

匯率說明：匯率係採 109 年 12 月 31 日資料：

資產： 台幣：美金= 28.48：1

負債： 台幣：美金= 28.48：1

損益： 台幣：美金= 29.549：1

附件一

弘塑科技股份有限公司
內部控制制度聲明書



日期：110年03月22日

本公司民國一〇九年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一〇九年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開發行說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國110年03月22日董事會通過，出席董事五人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

弘塑科技股份有限公司

董事長：張鴻泰



總經理：石本立

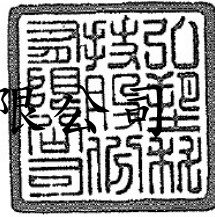
簽章



謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！

弘塑科技股份有限公司



董 事 長：張 鴻



